

목 차

분기보고서	1
【 대표이사 등의 확인 】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	30
3. 자본금 변동사항	34
4. 주식의 총수 등	35
5. 의결권 현황	39
6. 배당에 관한 사항 등	40
II. 사업의 내용	41
III. 재무에 관한 사항	102
1. 요약재무정보	102
2. 연결재무제표	105
3. 연결재무제표 주석	112
4. 재무제표	198
5. 재무제표 주석	205
6. 기타 재무에 관한 사항	279
IV. 감사인의 감사의견 등	310
V. 이사의 경영진단 및 분석의견	312
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	313
1. 이사회에 관한 사항	313
2. 감사제도에 관한 사항	322
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	325
VII. 주주에 관한 사항	326
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	332
1. 임원 및 직원의 현황	332
2. 임원의 보수 등	358
IX. 계열회사 등에 관한 사항	360
X. 이해관계자와의 거래내용	391
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	395
【 전문가의 확인 】	408
1. 전문가의 확인	408
2. 전문가와의 이해관계	408

분기보고서

(제 50 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

삼성전자주식회사

대 표 이 사 :

김 기 남

본 점 소 재 지 :

경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

(전 화) 031-200-1114

(홈페이지) <http://www.samsung.com/sec>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경팀장 (성 명) 남 궁 범

(전 화) 031-277-7218

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 회사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2018. 5. 15

삼성전자 주식회사

대표이사 : 김 기 남



신고업무 담당임원 : 노 희 찬



I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성전자주식회사이고 영문명은 Samsung Electronics Co., Ltd.입니다.

나. 설립일자

당사는 1969년 1월 13일에 삼성전자공업주식회사로 설립되었으며, 1975년 6월 11일 기업공개를 실시하였습니다.

당사는 1984년 2월 28일 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 삼성전자공업주식회사에서 삼성전자주식회사로 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)

전화번호 : 031-200-1114

홈페이지 : <http://www.samsung.com/sec>

라. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

당사는 제품의 특성에 따라 CE(Consumer Electronics), IM(Information technology & Mobile communications), DS(Device Solutions) 3개의 부문과 전장부품사업 등을 영위하는 Harman부문(Harman International Industries, Inc. 및 그 종속회사)으로 나누어 독립 경영을 하고 있습니다.

각 부문별 제품은 아래와 같습니다.

부문	제품
CE	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등
IM	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS	DRAM, NAND Flash, 모바일AP, TFT-LCD, OLED 등
Harman	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, Harman 산하 종속회사 등 269개의 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

[CE 부문]

CE 부문은 혁신적인 기술, 독특한 디자인, 편의성과 가치를 겸비한 제품을 통해 디지털시대 소비자들의 현재 요구를 충족시킬 뿐만 아니라 미래의 수요를 예측하여 새로운 상품을 지속적으로 선보임으로써 글로벌 디지털 시장을 이끌고 있습니다.

TV는 CE 사업 분야의 핵심 제품으로 2017년까지 12년째 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. LCD, LED TV 등 제품의 하드웨어 경쟁우위는 물론, Smart TV 분야에서도 독보적인 우위를 점하며 소프트웨어 산업으로의 전환을 선도하고 있습니다. 앞으로도 신기술의 개척 및 끊임없는 혁신을 통해 시장 지배력을 계속 확대할 계획입니다.

[IM 부문]

IM 부문은 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 제품 등 모바일 관련 스마트 기기를 생산/판매하는 모바일 커뮤니케이션 사업 등을 영위하고 있습니다. 모바일 커뮤니케이션 사업의 핵심 제품인 스마트폰은 '갤럭시(GALAXY)' 브랜드를 통해 프리미엄 제품부터 보급형까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 선진시장과 성장시장에서 균형 있는 발전을 이루어 왔습니다.

IM 부문은 Flexible OLED, 고화질 카메라, 생체인식 센서 등의 혁신으로 스마트폰 시장을 이끌고 있으며, 제품과 더불어 모바일 결제 서비스 'Samsung Pay', 지능형 서비스 'Bixby'를 비롯하여 Cloud, IoT, Health, AR/VR 등 미래 성장을 위한 노력을 통해 고객에게 가치 있는 경험을 제공하기 위한 의미 있는 혁신을 지속하고 차세대 통신 기술인 5G 상용화를 통해 글로벌 통신 산업을 주도해 나가겠습니다.

[DS 부문]

DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체 사업과 모바일 AP, 카메라 센서칩 등을 설계/판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업, 그리고 액정화면 표시 장치인 Display Panel을 생산/판매하는 Display 사업으로 구성되어 있으며, DRAM 등 정보 저장 용량의 획기적인 개선 및 모바일 제품의 두뇌에 해당하는 AP제품 성능 향상을 통한 완성품의 신수요 창출을 통하여 완제품 시장을 선도할 수 있는 역량을 지속적으로 확대/강화하고 있습니다.

반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등 초미세 공정 기술을 적용하여 경쟁사 대비 차별성 있는 제품의 생산과 원가 경쟁력을 지속적으로 확보하여 전세계 메모리 시장의 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다. System LSI는 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며 당사는 지속적으로 추진해온 선행 공정 개발로 AP, CIS 등의 제품 차별화 및 경쟁력 제고로 시장 지배력을 확대시켜 나갈 것입니다. Foundry는 앞선 선단공정 기술을 바탕으로 대형 Fabless 업체와 협력 중이며 8나노·7나노 공정 또한 적기 개발하여 시장을 주도하기 위해 역량을 집중하고 있습니다. 특히 2018년 세계최초 EUV공정을 도입하여 선단공정 기술을 선도하려고 합니다.

OLED는 Flexible 제품에 대한 시장 수요에 적기 대응 가능한 시스템을 구축하는 한편, 경쟁사와의 지속적인 기술 차별화를 진행하여 시장을 선도하고 있습니다. 또한, TFT-LCD는 고화질, 초대형, Quantum Dot, Frameless 등 고부가 제품의 판매를 확대하고, 수율 및 원가를 지속적으로 개선하여 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

[Harman 부문]

Harman 부문은 커넥티드카 시스템, 오디오/비디오 제품, 프로페셔널솔루션 및 커넥티드 서비스 사업분야에서 전세계 자동차 제조사, 소비자 및 기업을 대상으로 커넥티드 제품과 솔루션을 디자인하고 개발하는 등 전장 부품 시장을 선도하고 있습니다.

Harman 부문은 주요시장에서 널리 알려진 브랜드들과 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 자체적인 개발 또는 지속적인 전략적 인수들을 통해 각 사업분야에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2018년 1분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 1개 회사가(에스프린팅솔루션(주)) 감소하여 62개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 46개사입니다.

(2018.3.31. 현재)

구분	회사수	회사명	법인등록번호
상장사	16	삼성물산(주)	1101110015762
		삼성전자(주)	1301110006246
		삼성에스디아이(주)	1101110394174
		삼성전기(주)	1301110001626
		삼성화재해상보험(주)	1101110005078
		삼성중공업(주)	1101110168595
		삼성생명보험(주)	1101110005953
		㈜멀티캠퍼스	1101111960792
		삼성증권(주)	1101110335649
		삼성에스디에스(주)	1101110398556
		삼성카드(주)	1101110346901
		삼성엔지니어링(주)	1101110240509
		㈜에스원	1101110221939
		㈜제일기획	1101110139017
		㈜호텔신라	1101110145519
		삼성바이오로직스(주)	1201110566317
비상장사	46	㈜서울레이크사이드	1101110504070
		㈜삼우종합건축사사무소	1101115494151
		㈜씨브이네트	1101111931686
		삼성바이오에피스(주)	1201110601501
		삼성디스플레이(주)	1345110187812
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140000991
		에스유머티리얼스(주)	1648110061337
		스테코(주)	1647110003490
		세메스(주)	1615110011795
		삼성전자서비스(주)	1301110049139
		삼성전자판매(주)	1801110210300
		삼성전자로지텍(주)	1301110046797
		수원삼성축구단(주)	1358110160126
		삼성메디슨(주)	1346110001036
		삼성화재애니카손해사정(주)	1101111595680
		삼성화재서비스손해사정(주)	1101111237703
㈜삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424		

		대정해상풍력발전(주)	2201110095315
		삼성선물(주)	1101110894520
		삼성자산운용(주)	1701110139833
		(주)생보부동산신탁	1101111617434
		삼성생명서비스손해사정(주)	1101111855414
		삼성에스알에이자산운용(주)	1101115004322
		(주)삼성생명금융서비스보험대리점	1101115714533
		에스디플렉스(주)	1760110039005
		제일패션리테일(주)	1101114736934
		네추럴나인(주)	1101114940171
		삼성웰스토리(주)	1101115282077
		(주)시큐아이	1101111912503
		에스티엠(주)	2301110176840
		에스코어(주)	1101113681031
		오픈핸즈(주)	1311110266146
		(주)미라콤아이앤씨	1101111617533
		삼성카드고객서비스(주)	1101115291656
		(주)휴먼티에스에스	1101114272706
		에스원씨알엠(주)	1358110190199
		신라스테이(주)	1101115433927
		에이치디씨신라면세점(주)	1101115722916
		(주)삼성경제연구소	1101110766670
		(주)삼성라이온즈	1701110015786
		삼성벤처투자(주)	1101111785538
		삼성액티브자산운용(주)	1101116277382
		삼성헤지자산운용(주)	1101116277390
		(주)하만인터내셔널코리아	1101113145673
		레드벤드소프트웨어코리아(주)	1101113613315
		에스비티엠(주)	1101116536556
합	62		

☞ 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 연결대상 종속기업 개황

기업회계기준서 제1110호 '연결채무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 2018년 1분기말 현재 269개사입니다. 전년말 대비 1개 기업이 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업 연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 기업여부
Samsung Electronics America, Inc.	1978.07	Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA	전자제품 판매	26,266,636	의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	○
NexusDX, Inc.	2009.07	6759 Mesa Ridge Road Suite 100 San Diego, CA 92121	의료기기	6,046	상동	X
NeuroLogica Corp.	2004.02	14 Electronics Ave. Danvers, MA 01923 USA	의료기기	180,138	상동	○
Dacor Holdings, Inc.	1998.12	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	Holding Company	45,265	상동	X
Dacor	1965.03	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	가전제품 생산 및 판매	45,337	상동	X
Dacor Canada Co.	2001.06	Summit Place 6th floor 1601 Lower Water St. Halifax, Nova Scotia, B3J 3P6 Canada	가전제품 판매	52	상동	X
EverythingDacor.com, Inc.	2006.06	1440 Bridge Gate Drive Diamond Bar, CA 91765	가전제품 판매	0	상동	X
Distinctive Appliances of California, Inc.	2014.06	14425 Clark Ave, City of Industry, CA 91745, USA	가전제품 판매	0	상동	X
Samsung HVAC America, LLC	2001.07	3001 Northern Cross Blvd. #361 Fort Worth TX 76137 USA	에어컨공조 판매	36,562	상동	X
SmartThings, Inc.	2012.04	456 University Avenue, Suite 200, Palo Alto, CA 94301	스마트홈기기 판매	210,589	상동	○
Samsung Oak Holdings, Inc.	2016.06	3655 N. First St. San Jose, CA 95134	Holding Company	153,045	상동	○
Joyent, Inc.	2005.03	655 Montgomery Street, Suite 1600, San Francisco, CA 94111	클라우드서비스	203,005	상동	○
Samsung Pay, Inc.	2006.03	8 New England Executive Park #220, Burlington, MA, USA	모바일 결제 개발 및 서비스	317,193	상동	○
Stellus Technologies, Inc.	2015.11	3500 South Dupont Highway, Dover, DE 19901	반도체 시스템 생산 및 판매	32,493	상동	X
Prismview, LLC	2007.10	1651 N 1000 W, Logan, Utah 84321	LED 디스플레이 생산 및 판매	52,130	상동	X
Samsung Semiconductor, Inc.	1983.07	North First St. San Jose, CA, USA	반도체/DP 판매	10,125,193	상동	○
Samsung Electronics Canada, Inc.	1980.07	2050 Derry Road West, Mississauga, ON, Canada	전자제품 판매	762,677	상동	○

AdGear Technologies Inc.	2010.08	481 Viger West, Suite 300, Montreal, QC, Canada, H2Z 1G6	디지털광고 플랫폼	10,432	상동	X
Viv Labs, Inc.	2012.09	10 Almaden Boulevard Suite 560, San Jose, CA 95113, USA	인공지능 서비스	254,464	상동	O
SigMast Communications Inc.	2009.07	26 Union Street, Suite 305, Bedford, Nova Scotia, Canada B4A 2B5	문자메시지 개발	1,515	상동	X
RT SV CO-INVEST, LP	2014.02	260 East Brown Street, Suite 380 Birmingham, MI 48009, USA	벤처기업 투자	11,764	상동	X
Samsung Research America, Inc	1988.10	665 Clyde Avenue Mountain View CA, USA 94043	R&D	576,727	상동	O
Samsung Next LLC	2016.08	665 Clyde Avenue Mountain View CA, USA 94043	Holding Company	53,584	상동	X
Samsung Next Fund LLC	2016.08	665 Clyde Avenue Mountain View CA, USA 94043	신기술사업자, 벤처기업 투자	54,185	상동	X
Samsung International, Inc.	1983.10	9335 Airway Rd. Suite 105 San Diego, CA, USA 92154	CTV/모니터 생산	792,117	상동	O
Samsung Mexicana S.A. de C.V	1988.03	Parque Ind. El Florido Seguna Seccion Tijuna B.C. Mexico	전자제품 생산	44,878	상동	X
Samsung Austin Semiconductor LLC.	1996.02	12100 Samsung Blvd. Austin, Texas USA 78754	반도체 생산	4,943,576	상동	O
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	1995.07	Col. Chapultepec Morales, Del Miguel Hidalgo D.F., Mexico	전자제품 판매	1,049,929	상동	O
SEMES America, Inc.	1998.10	78754 9701 Dessau Rd. #305 Austin Texas, USA	반도체 장비	1,412	상동	X
Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	2012.12	Av. Benito Juarez #119, Parque Industrial Qro. Sta. Rosa Jauregui C.P 76220 Queretaro, Mexico	전자제품 생산	485,469	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	1995.05	9800 NW 41st Street Suite 200, Miami, FL, USA 33178	전자제품 판매	263,365	상동	O
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	1989.04	Calle 50 Edificio PH Credicorp Bank Piso 16, Panama City, Panama	전자제품 판매	373,528	상동	O
Samsung Electronics Venezuela, C.A.	2010.05	Torre Kepler Piso 1, Av. Blandin Castellana, Municipio Chacao, Caracas Venezuela	마케팅 및 서비스	1,241	상동	X
Samsung Electronica Colombia S.A.	1997.03	Carrera 7 # 114-43 Oficina 606 Bogota Colombia	전자제품 판매	421,924	상동	O
Samsung Electronics Panama. S.A.	2012.07	Torre de Las Americas, TorreC, Piso 23, Panama City Panama	컨설팅	189	상동	X
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	1995.01	Avenida das Nacoes Unidas, 12901-8 andar - Torre Oeste Brooklin Novo Sao Paulo SP Brazil	전자제품 생산 및 판매	5,838,533	상동	O
Samsung Electronics Argentina S.A.	1996.06	Bouchard 7107 Piso Ciudad de Buenos Aires, Argentina	마케팅 및 서비스	55,595	상동	X

Samsung Electronics Chile Limitada	2002.12	Americo Vespucio Sur 100 Oficina 102, Las Condes, Chile	전자제품 판매	445,411	상동	O
Samsung Electronics Peru S.A.C.	2010.04	Ricardo Rivera Navarrete 501, 9th floor, Avenue, Peru	전자제품 판매	223,403	상동	O
Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	2017.08	284 Mawsons way, SC 29108	가전제품 생산	282,076	상동	O
AMX Holding Corporation	2005.12	3000 Research Drive Richardson, TX 75082, USA	Holding Company	0	상동	X
AMX LLC	2005.11	3000 Research Drive Richardson, TX 75082, USA	Holding Company	73,777	상동	X
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	1981.06	30001 Cabot Drive, Novi, Michigan 48377, USA	오디오제품 생산, 판매, R&D	1,942,159	상동	O
Harman Connected Services, Inc.	2002.02	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043, USA	Connected Service Provider	1,021,364	상동	O
Harman Connected Services Engineering Corp.	2004.09	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043, USA	Connected Service Provider	3,016	상동	X
Harman Connected Services Holding Corp.	2012.03	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043, USA	Connected Service Provider	879,079	상동	O
Harman Connected Services South America S.R.L.	2015.04	Tucuman 1, 4th Floor, City of Buenos Aires, Argentina	Connected Service Provider	30	상동	X
Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes Ltda.	2005.07	City of Manaus, State of Amazonas, at Avenida Cupiuba, no. 401, L/3, 77/1, Distrito Industrial, Brazil	오디오제품 생산, 판매	48,331	상동	X
Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	1997.02	2290 Ave Delas Torres Cd. Juarez, Chih 32575, Mexico	오디오제품 생산	46,687	상동	X
Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	1958.11	City of Nova Santa Rita, Tabai-Canos Highway BR 386, KM 435	오디오제품 판매, R&D	212,767	상동	O
Harman Financial Group LLC	2004.06	400 Atlantic Street, 15th Floor Stamford, CT 06901, USA	Management Company	593,054	상동	O
Harman International Industries Canada Ltd.	2005.05	2900 - 550 Burrard St., Vancouver BC V6C 0A3, Canada	오디오제품 판매	902	상동	X
Harman International Industries, Inc.	1980.01	400 Atlantic Street, 15th Floor Stamford, CT 06901, USA	Holding Company	14,156,148	상동	O
Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	2014.12	2290 Ave Delas Torres Cd. Juarez, Chih 32575, Mexico	오디오제품 판매	26,208	상동	X
Harman Investment Group, LLC	2015.12	400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, USA	Financing Company	629,382	상동	O
Harman KG Holding, LLC	2009.03	400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, USA	Holding Company	0	상동	X

Harman Professional, Inc.	2006.07	8500 Balboa Blvd. Northridge, CA, USA	오디오제품 판매, R&D	757,906	상동	O
Red Bend Software Inc.	2001.03	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043, USA	소프트웨어 디자인	14,379	상동	X
S1NN USA, Inc.	2011.02	1227 Prospect Street, Suite 200 La Jolla, CA 92037, USA	R&D	164	상동	X
Southern Vision Systems, Inc	2003.04	360B Quality Circle Suite 200, Huntsville, AL 35806, USA	영상 감지 장치 개발	1,212	상동	X
Triple Play Integration LLC	2003.11	636 Ellis Street Mountain View, CA 94043, USA	Connected Service Provider	3,256	상동	X
Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	2014.12	Elian Fiduciary Services Limited, 89 Nexus Way, Cayman Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands	벤처기업 투자	26,727	상동	X
China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	2017.09	23 Lime Tree Bay Avenue, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	벤처기업 투자	1,544	상동	X
Samsung Electronics (UK) Ltd.	1995.07	Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	전자제품 판매	1,615,723	상동	O
Samsung Electronics(London) Ltd.	1999.01	Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, UK	Holding Company	6,324	상동	X
Samsung Electronics Holding GmbH	1982.02	65824 Samsung Haus Am Kronberger Hang 6, Schwalbach, Germany	Holding Company	711,919	상동	O
Samsung Semiconductor Europe GmbH	1987.12	Koelner Str. 12, 65760 Eschborn, Germany	반도체/DP 판매	853,110	상동	O
Samsung Electronics GmbH	1984.12	65824 Samsung Haus Am Kronberger Hang 6, Schwalbach, Germany	전자제품 판매	1,743,138	상동	O
Samsung Electronics Iberia, S.A.	1989.01	Parque Empresarial Omega Edificio C Avenida de, Barajas, Espanol	전자제품 판매	734,838	상동	O
Samsung Electronics France S.A.S	1988.01	1 Rue Fructidor 93400 Saint-Ouen, France	전자제품 판매	1,262,849	상동	O
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	1989.10	H-1037 Budapest, Szepvolgyi ut 35-37, Hungary	전자제품 생산 및 판매	1,823,278	상동	O
Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	2010.01	V Parku 14, Praha, Czech Republic 14800	전자제품 판매	140,176	상동	O
Samsung Electronics Italia S.P.A.	1991.04	Via Carlo Donat Cattin 5, Cernusco sul Naviglio, 20073 Milan Italy	전자제품 판매	822,200	상동	O
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	1991.05	Olof Palmestraat 10, 2616LR Delft, Netherlands	물류	1,927,321	상동	O
Samsung Electronics Benelux B.V.	1995.07	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	1,484,026	상동	O
Samsung Display Slovakia s.r.o.	2007.03	919 42 Voderady 401 Voderady Slovakia	DP 임가공	128,831	상동	O
Samsung Electronics Romania LLC	2007.09	Sos. Pipera-Tunari, nr. 1/VII, Nord City Tower Voluntari Ilfov Romania	전자제품 판매	211,181	상동	O

Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	1996.04	ul.Marynarska 15 Warszawa Poland	전자제품 판매	528,044	상동	O
Samsung Electronics Portuguesa S.A.	1982.09	Lagoas Parque, Edificio 5B Piso 0 2740-298 Porto Salvo - Portugal	전자제품 판매	159,301	상동	O
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	1992.03	Kanal Vagen 10A, 194 27, Upplands Vasby, Sweden	전자제품 판매	701,024	상동	O
Samsung Semiconductor Europe Limited	1997.04	No.5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, UK	반도체/DP 판매	83,503	상동	O
Samsung Electronics Austria GmbH	2002.01	Praterstraße 31 1020 Vienna Austria	전자제품 판매	313,654	상동	O
Samsung Electronics Switzerland GmbH	2013.05	CH-8055 Binzallee 4, Samsung Electronics Zurich ZH, Switzerland	전자제품 판매	151,235	상동	O
Samsung Electronics Slovakia s.r.o	2002.06	Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia	CTV/모니터 생산	2,019,572	상동	O
Samsung Electronics Baltics SIA	2001.10	Dunties iela 6, Riga, Latvia	전자제품 판매	94,244	상동	O
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	2008.10	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, Netherlands	Holding Company	9,474,960	상동	O
Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	2010.02	ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland	가전제품 생산	351,051	상동	O
Samsung Electronics Greece S.A.	2010.04	280 Kifissias Ave, Halandri 15232 Athens Greece	전자제품 판매	76,845	상동	O
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	2017.04	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, Netherlands	에어컨공조 판매	73,016	상동	X
Samsung Nanoradio Design Center	2004.02	Torshamnsgatan 39 164 40 Kista Sweden	R&D	23,863	상동	X
Samsung Denmark Research Center ApS	2012.09	c/o Novi Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst, Denmark	R&D	22,157	상동	X
Samsung France Research Center SARL	2012.10	Les 2 Arcs, Bat.B, etage 4, 1800 Route des cretes, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne, France	R&D	13,064	상동	X
Samsung Cambridge Solution Centre Limited	2012.09	St. John's Houst, St. John's Innovation Park, Cowley Road, Cambridge, UK, CB4 0ZT	R&D	119,230	상동	O
Samsung Electronics Overseas B.V.	1997.01	Evert van de Beekstraat 310, 1118CX Schiphol, Netherlands	전자제품 판매	105,267	상동	O
Innoetics E.P.E.	2006.04	Artemidos 6, Athens 151 25 Greece	소프트웨어 개발	536	상동	X
Aditi Technologies Europe GmbH	2013.03	Friedrichstrasse 90, 10117 Berlin, Germany	오디오제품 판매 등	79	상동	X
AKG Acoustics GmbH	1947.03	254, Laxenburger Str., Wien (Vienna), 1230, Austria	오디오제품 생산, 판매	337,450	상동	O
AMX GmbH	2007.08	Behrstrasse 100, D-73240 Wendlingen, Germany	오디오제품 판매	898	상동	X
AMX UK Limited	1993.03	CLIFTON MOOR YORK NORTH YORKSHIRE, York, YO30 4GD, UK	오디오제품 판매	6,786	상동	X

Arcam Limited	2004.07	The West Wing, Stirling House, Waterbeach Cambridge CB25 9PB, UK	Holding Company	5,073	상동	X
A&R Cambridge Limited	1993.12	The West Wing, Stirling House, Waterbeach Cambridge CB25 9PB, UK	오디오제품 판매	7,260	상동	X
Duran Audio B.V.	1991.11	Koxkampseweg 10, 5301KK Zaltbommel, Netherlands	오디오제품 판매, R&D	518,454	상동	O
Duran Audio Iberia Espana S.L.	2012.11	C/ ERCILLA 17 3°BILBAO48, BIZKAIA, Spain	오디오제품 판매	88	상동	X
Endeleo Limited	2003.05	Auster Road, Clifton Moor York, YO30 4GD, UK	오디오제품 판매, R&D	0	상동	X
Harman Automotive UK Limited	2012.10	6th Floor, Salisbury House London Wall London England EC2M 5QQ, UK	오디오제품 생산	449,850	상동	O
Harman Becker Automotive Systems GmbH	1990.07	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307, Germany	오디오제품 생산, 판매, R&D	4,105,781	상동	O
Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	2005.12	17, Viale Luigi Majno, Milano (MI), 20122, Italy	오디오제품 판매	873	상동	X
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	1994.08	Szokesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fasor 19-HU, Hungary	오디오제품 생산, R&D	2,789,251	상동	O
Harman Belgium SA	1967.04	Drukperstraat 4 , Brussels, 1000, Belgium	오디오제품 판매	978	상동	X
Harman Connected Services AB.	1984.10	Nordenskioldsgatan 24 211 19 Malmo	Connected Service Provider	51,834	상동	X
Harman Connected Services Finland OY	1998.07	Hermiankatu 1 A 33720 Tampere, Finland	Connected Service Provider	1,159	상동	X
Harman Connected Services GmbH	2005.12	Gebertstraße 5, Nuremberg, 90411, Germany	Connected Service Provider	44,593	상동	X
Harman Connected Services Limited	1992.12	Vita House, London Street Basingstoke RG21 7PG, UK	Connected Service Provider	8,932	상동	X
Harman Connected Services Poland Sp.zoo	2007.06	Ul Kasprzaka 6 Lodz PL 91-803, Poland	Connected Service Provider	4,387	상동	X
Harman Connected Services UK Ltd.	2008.09	Devonshire House, 60 Goswell Road, London, EC1M 7AD, UK	Connected Service Provider	79,516	상동	O
Harman Consumer Division Nordic A/S	1992.01	Hejreskovvej 18A Kvistgaard, DK-3460 DA, Denmark	오디오제품 판매	12,434	상동	X
Harman Consumer Finland OY	2002.07	Koysikuja 1 Vantaa, 01640, Finland	오디오제품 판매	18	상동	X
Harman Consumer Nederland B.V.	1995.12	Herikerbergweg 9, Amsterdam, CN 1101, Netherlands	오디오제품 판매	392,974	상동	O
Harman Deutschland GmbH	1998.03	Parkring 3 B. Munich, Garching, 85748, Germany	오디오제품 판매	0	상동	X
Harman Finance International GP S.a.r.l	2015.04	6, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Grand-Duche de Luxembourg	Holding Company	18	상동	X
Harman France SNC	1995.11	12 bis, rue des Colannes-du-Trone, Paris, 75012, France	오디오제품 판매	136,765	상동	O

Harman Holding Gmbh & Co. KG	2002.06	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307, Germany	Management Company	4,762,822	상동	O
Harman Hungary Financing Ltd.	2012.06	Szekesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fisor 19-HU, Hungary	Financing Company	795,547	상동	O
Harman Inc. & Co. KG	2012.06	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307, Germany	Holding Company	3,831,950	상동	O
Harman International Estonia OU	2015.05	Parnu mnt 139a, Tallinna linn, Harju maakond, 11317	R&D	177	상동	X
Harman International Industries Limited	1980.03	6th Floor, Salisbury House London Wall London England EC2M 5QQ, UK	오디오제품 판매 등	221,161	상동	O
Harman International Romania SRL	2015.02	5-7, Bdul. Dimitrie Pompeiu, Metrooffice, Cladirea A parter, et. 2 si et. 4, Sector 2, Bucharest, Romania	R&D	11,255	상동	X
Harman Finance International. SCA	2015.04	6, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Grand-Duche de Luxembourg	Financing Company	465,108	상동	O
Harman International s.r.o	2015.02	Pobe n 394/12, Karl n, 186 00 Pra, Czech Republic	오디오제품 생산	83	상동	X
Harman International SNC	1989.02	2 Route De Tours Chateau De Loir, 72500, France	오디오제품 판매	2,161	상동	X
Harman Management GmbH	2002.04	Becker Goering Street 16, Karlsbad D-76307, Germany	Holding Company	3	상동	X
Harman Professional Kft	2014.12	Szekesfehervar H-8000 Hungary, Holland Fisor 19-HU, Hungary	오디오제품 생산, R&D	63,361	상동	X
Inspiration Matters Limited	2002.06	Auster Road, Clifton Moor York, YO30 4GD, UK	오디오제품 판매, R&D	0	상동	X
Knight Image Limited	1989.09	Auster Road, Clifton Moor York, YO30 4GD, UK	오디오제품 판매, R&D	0	상동	X
Martin Manufacturing (UK) Ltd	1985.05	Belvoir Way, Fairfield Industrial Est, Louth LN11 0LQ, UK	오디오제품 생산	4,133	상동	X
Harman Professional Denmark ApS	1987.07	Olof Palmes Alle 18., DK-8200 Aarhus N, Denmark	오디오제품 판매, R&D	170,431	상동	O
Harman Professional France SAS	1990.01	1, rue du Gevaudan, 91090 Lisses, France	오디오제품 판매	631	상동	X
Harman Professional Germany GmbH	1999.12	Robert-Bosch-Straße 285716 Unterschleißheim, Germany	오디오제품 판매	725	상동	X
R&D International BVBA	1989.12	3400 Landen, Industriezone Roosveld 9A, Belgium	오디오제품 생산	121	상동	X
Red Bend Software Ltd.	2004.08	Devonshire House, 1 Devonshire Street, London W1W 5DR, UK	소프트웨어 디자인	4,564	상동	X
Red Bend Software SAS	2002.10	Immeuble 15 place Georges Pompidou 78180 Montigny Le Bretonneux, France	소프트웨어 디자인	3,817	상동	X

Studer Professional Audio GmbH	2003.11	Althardstrasse 30, Regensdorf Switzerland, CH 8105, Switzerland	오디오제품 판매, R&D	35,003	상동	X
Samsung Electronics Rus Company LLC	2006.10	Bolshoi Gnezdnikovsky per., 1, bldg.2 Moscow Russia	전자제품 판매	1,189,176	상동	O
Samsung Electronics Ukraine Company LLC	2008.09	75A, Zhylanska Str Kiev, Ukraine	전자제품 판매	135,052	상동	O
Samsung R&D Institute Rus LLC	2011.11	127018 Office 1401, building 1, 12, Dvintsev Street, Moscow Russia	R&D	26,921	상동	X
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	2008.09	Naurizbay batyr st. Almaty Republic of Kazakhstan	전자제품 판매	93,208	상동	O
Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	2014.10	1065 Bridge Plaza Biz Centre, 6 Bakikhanov str, 12th Fl Baku Azerbaijan	마케팅	1,746	상동	X
Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	2007.07	Kaluga region, Borovsk district, Koryakovo village, Perviy Severniy Drive,1, Russia	CTV 생산	960,288	상동	O
Harman Connected Services OOO	1998.11	10/16, Alekseevskaya St., Office P5, office 17, Nizhny Novgorod, 603005, Russia	Connected Service Provider	12,036	상동	X
Harman RUS CIS LLC	2011.08	RS 12/1 Dvintsev street, Block B Moscow, 127018 Russia	오디오제품 판매	61,926	상동	X
Samsung Electronics West Africa	2010.03	Mulliner Tower, Alfred Rewane Road, Ikoyi, Lagos, Nigeria	마케팅	36,712	상동	X
Samsung Electronics East Africa	2011.12	27577 00506, Milford Suites, 4th Floor, Pa Nairobi, Kenya	마케팅	25,581	상동	X
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	1995.05	R/A-5, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE	전자제품 판매	743,222	상동	O
Samsung Electronics Egypt S.A.E	2012.07	62815 Piece No. 98,Engineering Sector, Kom Abu Radi, Industrial Zone, AlWastaCity, BeniSuef, Egypt	전자제품 생산 및 판매	492,092	상동	O
Samsung Electronics Israel Ltd.	2012.09	60972 1st Fl, Holland Building Europark Yakum Israel	마케팅	8,630	상동	X
Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	2012.09	1053 2eme etage Immeuble Adonis, rue du Lac D'annecy Les Berges du Lac 1053 Tunis, Tunisia	마케팅	3,458	상동	X
Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	2012.11	No.4 1st Fl. Park Lane Tower 172 Turfail Road Lahore Cantt, Lahore Pakistan	마케팅	2,529	상동	X
Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	1994.06	Medscheme Office Park, Phase 110 Muswell Road, South Bryanston, Johannesburg South Africa	전자제품 판매	496,007	상동	O

Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	2014.07	35 UMKHOMAZI DR, LA MERCY, KWAZULU-NATAL, South Africa	CTV/모니터 생산	55,915	상동	X
Samsung Electronics Turkey	1984.12	Flatofis Is Merkezi Otakcilar Caddesi No.78 Kat 3 No.B3 Eyup, Istanbul, Turkey	전자제품 판매	626,822	상동	O
Samsung Semiconductor Israel R&D Center,Ltd.	2007.10	10 Oholiav Street, Ramat Gan 52522, Israel	R&D	48,431	상동	X
Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	2009.07	Building Nr.5, King Hussein Business Park, King Abdullah II St. P.O 962372, Amman 11196 , Jordan	전자제품 판매	382,616	상동	O
Samsung Electronics Maghreb Arab	2009.11	Lot N°9 Mandarouna 300 Route Sidi Maarouf 20190, Ain Chock Hay Hassani Casablanca Morocco	전자제품 판매	171,095	상동	O
Broadsense Ltd.	2007.03	4 HaCharash St., Neve Ne'eman Industrial Park, Hod Ha'Sharon, Israel	서비스	0	상동	X
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	2002.01	International Financial Services Ltd, IFS Court, Twenty Eight CyberCity, Ebene, Mauritius	Holding Company	39,033	상동	X
Harman Connected Services Morocco	2012.04	TECHNOPARK, ROUTE NOUACEUR, RS 114 & CT1029, Ain chock-Casablanca, Morocco	Connected Service Provider	3,321	상동	X
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	2009.10	IFS Court Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius	Holding Company	79,330	상동	O
iOnRoad Ltd	2011.08	7 Ze'ev Jabotinsky Rd., Ramat Gan 5252007, (P.O. Box 13, Ramat Gan 5210001), Israel	R&D	138	상동	X
iOnRoad Technologies Ltd	2012.01	7 Ze'ev Jabotinsky Rd., Ramat Gan 5252007, (P.O. Box 13, Ramat Gan 5210001), Israel	R&D	1,623	상동	X
Red Bend Ltd.	1998.02	4 HaCharash St., Neve Ne'eman Industrial Park, Hod Ha'Sharon, Israel	오디오제품 생산	68,744	상동	X
Towersec Ltd.	2008.04	20 Atir Yeda St., Kfar-Saba 4464315, Israel	R&D	3,577	상동	X
Samsung Japan Corporation	1975.12	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	934,227	상동	O
Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	1992.08	2-7,Sugasawa-cho,Tsurumi- ku,Yokohama,230-0027, Japan	R&D	138,096	상동	O
Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	2008.09	ROPPONGI T-CUBE 3-1-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532, Japan	전자제품 판매	723,211	상동	O
Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	1995.03	Tuanku Jaafar Industrial Park, 71450 Seremban. Negeri Sembilan. Malaysia	전자제품 생산	24,794	상동	X
Samsung Medison India Private Ltd.	2009.01	H-79, Basement, Kalkaji, New dehli, India 110019	의료기기	0	상동	X

Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	1989.09	North Klang Straits, Area 21 Industrial Park 42000 Port Klang Selangor, Malaysia	가전제품 생산	155,377	상동	O
Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	1995.01	938 1A Highway, Linh Trung ward, Thu Duc Dist. Ho Chi Minh city, Vietnam	전자제품 판매	218,680	상동	O
Samsung Asia Private Ltd.	2006.07	3 Church Street #26-01 Samsung Hub, Singapore	전자제품 판매	6,138,652	상동	O
Samsung India Electronics Private Ltd.	1995.08	Copia Corporate Suites, Plot no 9, Jasola District Center, New Delhi, India	전자제품 생산 및 판매	6,200,351	상동	O
Samsung R&D Institute India- Bangalore Private Limited	2005.05	Bagmane Tech. Park Bangalore, India	R&D	222,450	상동	O
Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	2017.11	Ward No 1, Durbar Marg, Kathmandu Municipality, Kathmandu, Nepal	서비스	77	상동	X
Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	1987.11	Quad Samsung, 8 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127 Australia	전자제품 판매	382,133	상동	O
Samsung Electronics New Zealand Limited	2013.09	24 The Warehouse Way, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand	전자제품 판매	74,917	상동	X
PT Samsung Electronics Indonesia	1991.08	Cikarang Industrial Estate, Jl. Jababeka Raya Blok F29-33, Cikarang, Bekasi, West Java, Indonesia	전자제품 생산 및 판매	1,562,037	상동	O
PT Samsung Telecommunications Indonesia	2003.03	Prudential Tower 23rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 79 Jakarta 129-10 Indonesia	전자제품 판매 및 서비스	1,746	상동	X
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	1988.10	313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand	전자제품 생산 및 판매	2,191,519	상동	O
Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd	2016.09	3rd Floor Kolao Tower 2, 23 Singha Rd Vientiane Capital LAO PDR	마케팅	561	상동	X
Samsung Electronics Philippines Corporation	1996.03	8th Floor HanjinPhil Building 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City Taguig 1634 Philippines	전자제품 판매	219,316	상동	O
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	2014.07	Yenphong I I.P, Yenprung Commune, Yenphong Dist, Bacninh Province Vietnam	DP 생산	10,460,75 5	상동	O
Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	2003.05	Suite E-09-01, Level 9, East Wing, No.1 Jalan 1/68F, Jalan Tun Razak , 55000 Kuala Lumpur, Malaysia	전자제품 판매	337,274	상동	O
Samsung R&D Institute BanglaDesh	2010.08	Bangladesh, Dhaka, Gulshan Avenue, Gualshan-1, Bangladesh	R&D	7,288	상동	X

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	2008.03	YenTrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh Province, Vietnam	전자제품 생산	9,592,074	상동	O
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	2013.03	Yen Binh 1, Industrial Park, Pho Yen district, Thai Nguyen Province, Vietnam	통신제품 생산	10,044,337	상동	O
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd.,	2015.02	Lot I-11, D2 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam	전자제품 생산 및 판매	1,784,883	상동	O
AMX Products And Solutions Private Limited	2008.02	10 No. 1305, 13th Mezzanine Floor, Raheja Towers, No.26-27, Mahatma Gandhi Road, Bengaluru, India	오디오제품 판매	604	상동	X
Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	1994.08	C-4 Block, Wing A, Manyata Embassy Business Park Rachenahalli Village, Outer ring road Bangalore, India	Connected Service Provider	73,264	상동	X
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	2002.04	Survey No. 85 & 86, Sadarmangala Village, Krishnarajapuram Hobli Bangalore, India	Connected Service Provider	454,392	상동	O
Harman Connected Services Japan Co., Ltd.	2009.12	Akihabara Daibiru 901, 1-18-13, Sotokanda, Chiyoda -ku, Tokyo, Japan	Connected Service Provider	448	상동	X
Harman International (India) Private Limited	2009.01	Sarjapur Marathahalli Ring Road, Kadubeesanahalli Village, Bangalore, India	오디오제품 판매, R&D	174,103	상동	O
Harman International Industries PTY Ltd.	2014.12	Warehouse 25 26-18, Roberna Street, Moorabbin VIC 3189, Australia	Holding Company	0	상동	X
Harman International Japan Co., Ltd.	1991.06	8F Akihabara Business Center, 1-1 Akihabara, Taito-ku, Tokyo, Japan	오디오제품 판매, R&D	48,995	상동	X
Harman International Singapore Pte. Ltd.	1993.12	No. 108, Pasir Panjang Road, #02-08 Golden Agri Plaza, Singapore 118535	오디오제품 판매	4,326	상동	X
Harman Malaysia Sdn. Bhd.	2008.07	Suite 1008, 10th Floor Wisma Lim Foo Yong, 86 Jalan Raha Chulan, Kuala Lumpur 50200, Malaysia	오디오제품 판매	3,909	상동	X
Harman Professional Singapore Pte. Ltd	2007.08	108 Pasir Panjang Road #02-08 Golden Agri Plaza Singapore 118535	오디오제품 판매	5,640	상동	X
INSP India Software Development Pvt. Ltd.	2007.06	C-4 BLOCK, WING A, MANYATA EMBASSY RACHENAHALLI VILLAGE BANGALORE, India	소프트웨어 개발 및 공급	0	상동	X
Martin Professional Pte. Ltd.	1995.06	No. 108, Pasir Panjang Road, #02-08 Golden Agri Plaza, Singapore 118535	오디오제품 판매	4,036	상동	X
Red Bend Software Japan Co., Ltd.	2005.11	Akihabara Daibiru, 1-18-13, Sotokanda, Tokyo, Japan	소프트웨어 디자인	10,689	상동	X
Studer Japan Ltd.	1982.12	8F, Akihabara Business Center, 1-1 Akihabara, Taito-ku, Tokyo, Japan	Holding Company	6,077	상동	X

Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	2001.11	High Technology Industrial Zone, Houjie, Dongguan, Guangdong, China	DP 생산	1,400,671	상동	O
Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	2004.06	NO.25,Mip Fourth Road,Xi qing District, Tianjin, China	DP 생산	1,036,566	상동	O
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	1988.09	33/f., Central Plaza, 18 Harbour Road, Hong Kong	전자제품 판매	1,157,142	상동	O
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	1995.04	No.501, SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	558,610	상동	O
Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	1995.04	No.501, SuHong East Road, Suzhou Industry Park, China	가전제품 생산	405,961	상동	O
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	1996.03	Beijing, China No.118, Jian Guo Lu, Chao Yang District 2208-13/ China Merchants Tower	전자제품 판매	13,409,281	상동	O
Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	2010.01	A3 Building, No.185 Kexue Avenue, Science City, Luogang District, Guangzhou, China	R&D	62,796	상동	X
Samsung Tianjin Mobile Development Center	2010.08	No.14 weiliu Rd.Micro-Electronic Industrial Park Xiqing Dist. Tianjin, China	R&D	35,253	상동	X
Samsung R&D Institute China-Shenzhen	2013.03	12th Fl., EVOG Technology Building, No. 31 Gaoxin Central Avenue 4th,Nanshan District, Shenzhen, China	R&D	14,961	상동	X
Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	1994.12	Suzhou Industrial Park Suzhou No.15, JinJiHu Road, China	반도체 임가공	950,691	상동	O
SEMES (XIAN) Co., Ltd.	2013.07	Unit 6, No.1, Yicuiyuan 3nd town(North), Jinye 2nd Road Gaoxin District, Xi'an, Shanxi, China	반도체 장비	1,107	상동	X
Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	1992.12	256,6th Road ,Zhongkai Chenjiang Town Huizhou 516029 Guangdong China	전자제품 생산	6,440,564	상동	O
Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	1993.04	#12, no 4 Big Street, Dong Ting Road Teda, Tianjin, China	CTV/모니터 생산	672,687	상동	O
Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	1994.11	10F,No.399, Rui Guang Rd., Nei Hu Dist, Taipei, Taiwan, R.O.C	전자제품 판매	1,447,907	상동	O
Beijing Samsung Telecom R&D Center	2000.09	china beijing Chaoyang District, xiaguangli, No. 9, Zhongdian fazhan Building,12/F	R&D	87,170	상동	O
Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	2001.03	No.9 WeiWu Rd.Micro Electronic Industrial Park Xiqing Dist, Tianjin, China	통신제품 생산	1,019,144	상동	O
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	2001.10	P.R.C. Shenzhen, 46F,New World Center, 6009 Yitian Road, Futian District, China	반도체/DP 판매	5,169,438	상동	O

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	2002.09	NO.198,Fangzhou Road, Suzhou Industrial park, Jiangsu province, China	전자제품 생산	910,833	상동	O
Samsung Suzhou Module Co., Ltd.	2002.09	NO.318 Fang Zhou Road,Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	DP 임가공	721,040	상동	O
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	2011.07	NO.337 Fengli Street,IP,Suzhou, China	DP 생산	2,019,262	상동	O
Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	2002.02	Samsung Kejian Plant,No.2 songping St.,North Area of Hi-tech Park, Nanshan, Shenzhen,PRC., China	통신제품 생산	129,943	상동	O
Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	2003.04	No.15, Jinjihu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China	R&D	27,417	상동	X
Samsung Electronics China R&D Center	2004.05	8/F, Huijie Plaza, 268 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu Province, China	R&D	46,359	상동	X
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	2012.09	A12F, City Gate, 1 Jinye Rd., Xi'an, China	반도체 생산	8,076,107	상동	O
Samsung SemiConductor Xian	2016.04	8F Customs Clearance Center , No.5 Tonghai First Road, Changan District, Xian City, China	반도체/DP 판매	796,942	상동	O
Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited	2005.01	2/F, B-Building, No.2, LiZeZhongYuan 2 Road, ChaoYang District, Beijing, China	서비스	138,193	상동	O
Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	2009.05	300385 China Tianjin No 1. Weisan Rd., Miero-Electronic Industrial Park., Xiqing Dist.	LED 생산	416,578	상동	O
Harman (China) Technologies Co., Ltd.	2011.03	No. 68, First Yinquan Road, Zhengxing District, Dandong, Liaoning Province, China	오디오제품 생산	132,594	상동	O
Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	2013.03	Room 2013, 20F, Modern Logistics No. 88 Modern Avenue, Suzhou I, China	오디오제품 판매	9,422	상동	X
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	2006.09	No. 125, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu Province, China	오디오제품 생산, R&D	307,506	상동	O
Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	2010.10	Unit 101, No. 1, Lane 507, Middle Fuxing Road, Huangpu District, China	오디오제품 판매	2,691	상동	X
Harman Connected Services Solutions (Beijing) Co., Ltd.	2007.03	Suite 1505, Global Trade Center, No. 36, North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, China	Connected Service Provider	332	상동	X
Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	2007.08	Floor 6, Building B5, Tianfu Software Park, No. 99, Tian Hua 1st Road, Chengdu, Sichuan, China	Connected Service Provider	18,211	상동	X
Harman Connected Services Taiwan Inc.	2005.08	11F.-11 No 152 Song Jiang Road, Taipei City, TW	Connected Service Provider	263	상동	X
Harman Holding Limited	2007.05	Flat/RM A 20F, Kiu Fu Commercial BLDG, 300 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong	오디오제품 판매	438,879	상동	O

Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	2009.06	Suite 3004, Chong Hing Finance Center, 288 Nanjing Road West, Huangpu District, Shanghai, China	오디오제품 판매, R&D	553,526	상동	O
Harman Automotive InfoTech (Dalian) Co., Ltd.	2013.12	Room 206, No. 901-7 Huangpu Road, Dalian High-tech Industrial Zone, Dalian, Liaoning Province, China	소프트웨어 개발 및 공급	543	상동	X
Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	2004.09	Floor 14, China Merchants Bureau Port Building, Merchants Street, Nanshan District, Shenzhen, China	오디오제품 판매, R&D	27,115	상동	X
삼성디스플레이㈜	2012.04	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1	DP 생산 및 판매	50,723,199	상동	O
에스유머티리얼스㈜	2011.08	충청남도 아산시 탕정면 탕정로 380-2	DP 부품 생산	31,730	상동	X
스테코㈜	1995.06	충청남도 천안시 서북구 3공단1로 20	반도체 부품 생산	170,098	상동	O
세메스㈜	1993.01	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 77	반도체/FPD 제조장비	1,043,351	상동	O
삼성전자서비스㈜	1998.10	경기도 수원시 영통구 삼성로 290	전자제품 수리서비스	347,411	상동	O
삼성전자판매㈜	1996.07	경기도 성남시 분당구 황새울로 340	전자제품 판매	590,110	상동	O
삼성전자로지텍㈜	1998.04	경기도 수원시 영통구 삼성로 129	종합물류대행	155,878	상동	O
삼성메디슨㈜	1985.07	서울특별시 강남구 테헤란로108길 42(대치동), 삼성메디슨빌딩	의료기기	329,064	상동	O
㈜미래로시스템	1994.01	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120	반도체 S/W	20,371	상동	X
SVIC 21호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	85,857	상동	O
SVIC 22호 신기술투자조합	2011.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	126,264	상동	O
SVIC 23호 신기술투자조합	2012.10	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	24,340	상동	X
SVIC 26호 신기술투자조합	2014.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	192,444	상동	O
SVIC 27호 신기술투자조합	2014.09	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	16,871	상동	X
SVIC 28호 신기술투자조합	2015.02	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	186,164	상동	O
SVIC 29호 신기술투자조합	2015.04	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	48,251	상동	X
SVIC 32호 신기술투자조합	2016.08	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	64,077	상동	X
SVIC 33호 신기술투자조합	2016.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	64,873	상동	X
SVIC 37호 신기술투자조합	2017.11	서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)	신기술사업자, 벤처기업 투자	23,886	상동	X
반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	2017.03	서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 4층	반도체산업 투자	51,906	상동	X

㈜하만인터내셔널코리아	2005.01	서울특별시 강남구 강남대로 298(역삼동), 푸르덴셜타워 5층	소프트웨어 개발 및 공급 등	17,868	상동	X
레드벤드소프트웨어코리아㈜	2007.02	서울특별시 강남구 선릉로90길 36(대치동), 미소빌딩 6층	소프트웨어 개발 및 공급	960	상동	X

※ 주요 종속 기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상입니다.

※ 주요 사업에 대한 상세 내역은 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(종속기업의 변동)

구분	미주	유럽/ 중아/ CIS	아시아	중국	국내	합계	증가	감소
제47기 (2015년말)	33	55	24	30	17	159개사		
제48기 (2016년말)	44	53	23	29	20	169개사	[국내 : 4개사] SVIC 32호 신기술투자조합 SVIC 33호 신기술투자조합 미래로시스템, 에스프린팅솔루션 [미주 : 13개사] Samsung Oak Holdings, Inc. Joyent, Inc. Joyent Canada, Inc. AdGear Technologies Inc. Samsung Next LLC Samsung Next Fund LLC Dacor Holdings, Inc. Dacor Dacor Canada Co. EverythingDacor.com, Inc. Distinctive Appliances of California, Inc. Viv Labs, Inc. NewNet Communication Technologies(Canada), Inc. [유럽 : 1개사] Joyent Ltd. [아시아 : 1개사] Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd [중국 : 1개사] Samsung SemiConductor Xian	[국내 : 1개사] SVIC 14호 신기술투자조합 [미주 : 2개사] Grandis, Inc., Joyent Canada, Inc. [유럽/CIS : 3개사] Samsung Russia Service Centre SonoAce Deutschland GmbH Samsung Electronics Kazakhstan LLP [아시아 : 2개사] Samsung Telecommunications Malaysia Future Technology & Service, [중국 : 2개사] Samsung R&D Institute China-Xian Samsung Electronics Shanghai Telecommunication Co., Ltd.

제49기 (2017년말)	63	109	38	38	22	270개사 [국내 : 4개사] 반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁 ㈜하만인터내셔널코리아 레드벤드소프트웨어코리아㈜ SVIC 37호 신기술투자조합 [미주 : 25개사] Samsung Electronics Home Appliances America, LLC Kngine, Inc. AMX Holding Corporation AMX LLC Harman Becker Automotive Systems, Inc. Harman Connected Services Inc. Harman Connected Services Engineering Corp. Harman Connected Services Holding Corp. Harman Connected Services South America S.R.L. Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes Ltda. Harman de Mexico S. de R.L. de C.V. Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda. Harman Financial Group, LLC Harman International Industries Canada Ltd. Harman International Industries, Inc. Harman International Mexico S de RL de CV Harman Investment Group, LLC Harman KG Holding, LLC Harman Professional, Inc. Red Bend Software Inc. S1NN USA, Inc. Southern Vision Systems, Inc TowerSec Inc. Triple Play Integration LLC China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership [유럽/CIS/중아 : 62개사] Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Aditi Technologies Europe GmbH AKG Acoustics GmbH AMX GmbH AMX UK Limited Duran Audio B.V. Duran Audio Iberia Espana S.L. Endeleo Limited Harman Automotive UK Limited Harman Becker Automotive Systems GmbH Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	[미주 : 6개사] Samsung Receivables Corporation TowerSec Inc. Kngine, Inc. PrinterOn Inc. PrinterOn America Corporation Simpres Comercio, Locacao e Servicos S.A. [유럽/CIS : 6개사] Samsung Electronics Rus LLC Samsung Electronics Ukraine LLC Surfkitchen Limited AMX LLC (Russia) Martin Professional Ltd. PrinterOn Europe Limited [아시아 : 2개사] VFX Systems PTY Ltd. I.P.S.G. International Product Solution Group PTY. LTD. [중국 : 3개사] Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd. Tianjin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd. Martin Trading Zhuhai Ltd. [국내 : 2개사] SVIC 20호 신기술투자조합 에스프린팅솔루션㈜
------------------	----	-----	----	----	----	--	---

						Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman Belgium SA Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Finland OY Harman Connected Services GmbH Harman Connected Services Limited Harman Connected Services Poland Sp.zoo Harman Connected Services UK Ltd. Harman Consumer Division Nordic A/S Harman Consumer Finland OY Harman Consumer Nederland B.V. Harman Deutschland GmbH Harman Finance International GP S.a.r.l Harman France SNC Harman Holding GmbH & Co. KG Harman Hungary Financing Ltd. Harman Inc. & Co. KG Harman International Estonia OU Harman International Industries Limited Harman International Romania SRL Harman Finance International SCA Harman International s.r.o Harman International SNC Harman Management GmbH Harman Professional Kft Inspiration Matters Limited Knight Image Limited Martin Manufacturing (UK) Ltd Harman Professional Denmark ApS Harman Professional France SAS Harman Professional Germany GmbH Martin Professional Ltd. R&D International BVBA Red Bend Software Ltd. Red Bend Software SAS Studer Professional Audio GmbH Surfkitchen Limited AMX LLC (Russia) Harman Connected Services OOO Harman RUS CIS LLC Broadsense Ltd. Global Symphony Technology Group Private Ltd. Harman Connected Services Morocco Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. iOnRoad Ltd iOnRoad Technologies Ltd	
--	--	--	--	--	--	---	--

							Red Bend Ltd. TowerSec Ltd. Innoetics E.P.E. ARCAM Ltd A&R Cambridge Ltd [아시아 : 17개사] AMX Products And Solutions Private Limited Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. Harman Connected Services Japan Co. Ltd. Harman International (India) Private Limited Harman International Industries PTY, Ltd. Harman International Japan Co. Ltd. Harman International Singapore Pte. Ltd. Harman Malaysia Sdn. Bhd. Harman Professional Singapore Pte. Ltd I.P.S.G. International Product Solution Group PTY. LTD. INSP India Software Development Pvt. Ltd. Martin Professional Pte. Ltd. Red Bend Software Japan Co., Ltd. Studer Japan, Ltd. VFX Systems PTY Ltd. Samsung Nepal Services Pvt, Ltd [중국 : 12개사] Harman (China) Technologies Co. Ltd. Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co. Ltd. Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co. Ltd Harman Commercial (Shanghai) Co. Ltd. Harman Connected Services Solutions (Beijing) Co., Ltd. Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. Harman Connected Services Taiwan Inc. Harman Holding Limited Harman International (China) Holdings Co. Ltd Harman Automotive InfoTech (Dalian) Co., Ltd. Harman Technology (Shenzhen) Co. Ltd. Martin Trading Zhuhai Ltd.	
제50기 1분기 (2018년 3월말)	63	108	38	38	22	269개사	[유럽/CIS : 1개사] Joyent Ltd.	

- 당기 중 종속기업 변동내용

구분	자회사	사유
연결 제외	Joyent Ltd.	청산

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 무디스(Moody's) 및 S&P로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 2018년말 1분기말 현재 무디스(Moody's)의 당사 평가등급은 A1, 투자전망은 긍정적(Positive)이고, S&P의 당사 평가등급은 AA-, 투자전망은 안정적(Stable)입니다.

평가일	평가대상 유가증권	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사 (신용평가 등급범위)	비고
'16.07	회사채	A+	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'16.08	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가
'17.07	회사채	AA-	S&P (미국) (AAA ~ D)	정기평가
'17.08	회사채	A1	Moody's (미국) (Aaa ~ C)	정기평가

2. 회사의 연혁

- 2014.01.15 종속기업인 삼성디스플레이의 삼성코닝정밀소재 주식 매각 및 Corning Incorporated사 전환우선주 취득
- 2014.08.18 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 SmartThings사(100%) 지분 인수
- 2015.01.01 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 STA(Samsung Telecommunications America LLC) 흡수합병
- 2015.02.23 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 LoopPay사(100%) 지분 인수
- 2016.01.28 삼성카드(주) 지분(37.5%) 매각
- 2016.06.24 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Joyent사(100%) 지분 인수
- 2016.09.07 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Dacor사(100%) 지분 인수
- 2016.10.07 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Viv Labs사(100%) 지분 인수
- 2016.11.01 프린팅솔루션사업부 분할(에스프린팅솔루션 주식회사 설립)
- 2017.03.10 종속기업인 SEA(Samsung Electronics America Inc.)의 Harman International Industries, Inc.사(100%) 지분 인수
- 2017.11.01 프린팅솔루션 사업 매각

※ 본사 소재지는 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동)입니다

(경영진의 중요한 변동)

당사는 2013년 3월 15일 주주총회를 통해 윤부근, 신종균, 이상훈 사내이사가 신규 선임되었으며, 사외이사 임기만료자인 이인호 사외이사가 재선임되고 송광수, 김은미 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2013년 3월 15일 윤부근, 신종균 사내이사가 대표이사로 신규 선임되어 대표이사가 3인(권오현, 윤부근, 신종균)으로 변경되었습니다.

2015년 3월 13일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 권오현 사내이사가 재선임되었으며, 사외이사 임기만료자 2인(김한중, 이병기)이 재선임되었습니다.

2016년 3월 11일 주주총회를 통해 사내이사 임기만료자 3인(윤부근, 신종균, 이상훈)이 재선임되었습니다. 또한 사외이사 임기만료자 3인(이인호, 송광수, 김은미) 중 김은미 사외이사는 퇴임하고, 이인호, 송광수 사외이사가 재선임 되었으며, 박재완 사외이사가 신규 선임되었습니다.

2016년 10월 27일 임시 주주총회를 통해 이재용 사내이사가 신규 선임되었으며, 이상훈 사내이사가 사임하였습니다.

2018년 3월 23일 주주총회를 통해 이상훈, 김기남, 김현석, 고동진 사내이사와 김종훈, 김선욱, 박병국 사외이사가 신규 선임되었으며, 사내이사 임기만료자(권오현)와 사외이사 임기만료자 2인(김한중, 이병기)이 퇴임하고 윤부근, 신종균 사내이사가 사임하였습니다.

2018년 3월 23일 김기남, 김현석, 고동진 사내이사가 대표이사로 신규 선임 되었습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(이상훈, 이재용, 김기남, 김현석, 고동진), 사외이사 6인(이인호, 송광수, 김선욱, 박재완, 박병국, 김종훈), 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다.

(그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)

당사는 2015년 12월 LED사업부를 LED사업팀으로 조직개편 하였습니다.

2016년 11월 프린팅솔루션사업부를 에스프린팅솔루션 주식회사로 분할하였습니다.

2017년 6월 System LSI사업부를 Foundry 사업부와 System LSI사업부로 분리하였습니다.

[2015년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP, LED)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2016년 12월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 프린팅솔루션, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

[2017년 6월]

	변경전	변경후
사업 조직	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)	CE부문 (영상디스플레이, 생활가전, 의료기기)
	IM부문 (무선, 네트워크)	IM부문 (무선, 네트워크)
	DS부문 (메모리, SYS.LSI, DP)	DS부문 (메모리, SYS.LSI, Foundry, DP)
	-	Harman부문
지역 총괄	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카	한국, 북미, 중남미, 구주, CIS, 서남아, 동남아, 중국, 중동, 아프리카
	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)	미주(DS), 구주(DS), 중국(DS), 동남아(DS), 일본(DS)

※ 2018년 1분기부터 의료기기사업부는 CE부문에서 제외되었습니다.

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종 류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2018년 1분기말 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주) 및 무의결권 기명식 우선주식(이하 우선주)의 수는 각각 128,386,494주와 18,072,580주입니다. (소각주식수 제외) 당사는 2018년 1분기말 현재까지 보통주 27,222,843주와 우선주 5,820,847주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 2018년 1분기말 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 8,990,843주, 우선주 1,614,846주를 제외한 보통주 119,395,651주, 우선주 16,457,734주입니다. 다만 2018년 3월 23일 주식분할에 대한 주주총회결의가 있었던 바, 정관상 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)에서 25,000,000,000주(1주의 금액 : 100원)로 변경되었으며, 주식분할에 대한 구체적인 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항'을 참고하시기 바랍니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류			비고	
	보통주	우선주	합계		
I. 발행할 주식의 총수	400,000,000	100,000,000	500,000,000	-	
II. 현재까지 발행한 주식의 총수	155,609,337	23,893,427	179,502,764	-	
III. 현재까지 감소한 주식의 총수	27,222,843	5,820,847	33,043,690	-	
1. 감자	-	-	-	-	
	2. 이익소각	27,222,843	5,820,847	33,043,690	자사주소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)	128,386,494	18,072,580	146,459,074	-	
V. 자기주식수	8,990,843	1,614,846	10,605,689	-	
VI. 유통주식수 (IV-V)	119,395,651	16,457,734	135,853,385	-	

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.

이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식

당사는 2018년 중 주주환원의 목적으로 보통주 292,718주, 우선주 72,675주를 각각 취득하였으며, 보통주 712,000주, 우선주 178,000주를 소각하였습니다. 2018년 1분기말 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 8,990,843주, 우선주 1,614,846주입니다.

(기준일 : 2018년 3월 31일)

(단위 : 주)

취득방법		주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고	
				취득(+)	처분(-)	소각(-)			
배당가능 이익 범위내 취득	직접 취득	장내	보통주	9,410,125	292,718	-	712,000	8,990,843	
		직접 취득	우선주	1,720,171	72,675	-	178,000	1,614,846	
		장외	보통주	-	-	-	-	-	
		직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	
			우선주	-	-	-	-	-	
	소계(a)	보통주	9,410,125	292,718	-	712,000	8,990,843		
		우선주	1,720,171	72,675	-	178,000	1,614,846		
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	
			우선주	-	-	-	-	-	
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	
			우선주	-	-	-	-	-	
	소계(b)	보통주	-	-	-	-	-		
		우선주	-	-	-	-	-		
기타 취득(c)		보통주	-	-	-	-	-		
		우선주	-	-	-	-	-		
총 계(a+b+c)		보통주	9,410,125	292,718	-	712,000	8,990,843		
		우선주	1,720,171	72,675	-	178,000	1,614,846		

다. 다양한 종류의 주식

당사는 기명식 보통주식의 비누적적 무의결권 기명식 우선주식이 있습니다. 동 우선주식은 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%의 금전배당을 더 받을 수 있도록 하고 있으며, 당분기말 현재 발행주식수는 18,072,580주입니다.

[우선주식 발행현황]

(단위 : 원)

발행일자		1989년 08월 25일(최초 발행일)	
주당 액면가액		5,000	
발행총액(액면가기준) / 발행주식수		119,467백만원	23,893,427주
현재 잔액/ 현재주식수		90,363백만원	18,072,580주
주식의 내용	이익배당에 관한 사항		액면금액 기준 보통주식보다 1%의 금전배당을 추가로 받음
	잔여재산분배에 관한 사항		-
	상환에 관한 사항	상환조건	-
		상환방법	-
		상환기간	-
		주당 상환가액	-
		1년 이내 상환 예정인 경우	-
	전환에 관한 사항	전환조건	-
		전환청구기간	-
		전환으로 발행할 주식의 종류	-
		전환으로 발행할 주식수	-
의결권에 관한 사항		의결권 없음	
기타 투자 판단에 참고할 사항		-	

※ 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 90,363백만원으로 납입자본금(119,467백만원)과 상이합니다.

[발행일자별 내역]

일자	사유	증가(감소)한 주식의 내용					
		종류	수량(주)	주 당 액면가액(원)	액면가액 합계(원)	주 당 발행가액(원)	발행가액 합계(원)
1989.08.25	유상증자	우선주식	3,400,000	5,000	17,000,000,000	28,800	97,920,000,000
1989.08.25	무상증자	우선주식	340,000	5,000	1,700,000,000	5,000	1,700,000,000
1990.10.29	전환권 행사	우선주식	371,620	5,000	1,858,100,000	29,600	10,999,952,000
1991.03.19	전환권 행사	우선주식	40,898	5,000	204,490,000	29,341	1,199,988,218
1991.03.30	전환권 행사	우선주식	5,112	5,000	25,560,000	29,341	149,991,192
1991.04.08	전환권 행사	우선주식	1,704	5,000	8,520,000	29,341	49,997,064
1991.05.17	DR 발행	우선주식	1,907,671	5,000	9,538,355,000	37,973	72,439,990,883
1991.07.24	전환권 행사	우선주식	34,081	5,000	170,405,000	29,341	999,970,621

1991.07.30	전환권 행사	우선주식	20,449	5,000	102,245,000	29,341	599,994,109
1991.07.31	전환권 행사	우선주식	64,754	5,000	323,770,000	29,341	1,899,947,114
1991.08.30	전환권 행사	우선주식	214,716	5,000	1,073,580,000	29,341	6,299,982,156
1991.09.30	전환권 행사	우선주식	20,448	5,000	102,240,000	29,341	599,964,768
1993.06.17	DR 발행	우선주식	2,542,372	5,000	12,711,860,000	47,312	120,284,704,064
1993.10.29	전환권 행사	우선주식	105,999	5,000	529,995,000	28,302	2,999,983,698
1993.11.12	DR 발행	우선주식	2,158,273	5,000	10,791,365,000	55,975	120,809,331,175
1993.11.29	전환권 행사	우선주식	58,295	5,000	291,475,000	28,302	1,649,865,090
1993.11.30	전환권 행사	우선주식	19,079	5,000	95,395,000	28,302	539,973,858
1994.04.06	DR 발행	우선주식	1,086,956	5,000	5,434,780,000	74,502	80,980,395,912
1994.06.03	전환권 행사	우선주식	16,027	5,000	80,135,000	25,809	413,640,843
1994.06.06	전환권 행사	우선주식	9,072	5,000	45,360,000	25,809	234,139,248
1994.06.13	전환권 행사	우선주식	17,236	5,000	86,180,000	25,809	444,843,924
1994.06.22	전환권 행사	우선주식	1,209	5,000	6,045,000	25,809	31,203,081
1994.06.27	전환권 행사	우선주식	16,632	5,000	83,160,000	25,809	429,255,288
1994.06.28	전환권 행사	우선주식	54,131	5,000	270,655,000	25,809	1,397,066,979
1994.06.29	전환권 행사	우선주식	292,127	5,000	1,460,635,000	25,809	7,539,505,743
1994.06.30	전환권 행사	우선주식	52,922	5,000	264,610,000	25,809	1,365,863,898
1994.07.01	전환권 행사	우선주식	232,854	5,000	1,164,270,000	25,809	6,009,728,886
1994.07.04	전환권 행사	우선주식	116,426	5,000	582,130,000	25,809	3,004,838,634
1994.07.05	전환권 행사	우선주식	188,401	5,000	942,005,000	25,809	4,862,441,409
1994.07.06	전환권 행사	우선주식	686,164	5,000	3,430,820,000	25,809	17,709,206,676
1994.07.07	전환권 행사	우선주식	270,349	5,000	1,351,745,000	25,809	6,977,437,341
1994.07.08	전환권 행사	우선주식	977,068	5,000	4,885,340,000	25,809	25,217,148,012
1994.07.12	전환권 행사	우선주식	6,048	5,000	30,240,000	25,809	156,092,832
1994.07.19	전환권 행사	우선주식	68,040	5,000	340,200,000	25,809	1,756,044,360
1994.07.20	전환권 행사	우선주식	4,232	5,000	21,160,000	25,809	109,223,688
1994.08.12	전환권 행사	우선주식	944	5,000	4,720,000	25,502	24,073,888
1995.03.13	무상증자	우선주식	3,028,525	5,000	15,142,625,000	5,000	15,142,625,000
1996.03.13	무상증자	우선주식	5,462,593	5,000	27,312,965,000	5,000	27,312,965,000
2003.04.14	이익소각	우선주식	-470,000	5,000	-2,350,000,000	-	-
2004.01.15	이익소각	우선주식	-330,000	5,000	-1,650,000,000	-	-
2004.05.04	이익소각	우선주식	-260,000	5,000	-1,300,000,000	-	-
2016.01.15	이익소각	우선주식	-1,240,000	5,000	-6,200,000,000	-	-
2016.04.20	이익소각	우선주식	-530,000	5,000	-2,650,000,000	-	-
2016.07.19	이익소각	우선주식	-320,000	5,000	-1,600,000,000	-	-
2016.09.28	이익소각	우선주식	-230,000	5,000	-1,150,000,000	-	-
2017.04.12	이익소각	우선주식	-255,000	5,000	-1,275,000,000	-	-
2017.05.02	이익소각	우선주식	-1,614,847	5,000	-8,074,235,000	-	-
2017.07.24	이익소각	우선주식	-225,000	5,000	-1,125,000,000	-	-
2017.10.25	이익소각	우선주식	-168,000	5,000	-840,000,000	-	-
2018.01.30	이익소각	우선주식	-178,000	5,000	-890,000,000	-	-
우선주식 계			18,072,580		90,362,900,000		642,261,376,652

5. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 128,386,494주이며 정관상 발행할 주식 총수(5억주)의 25.7%에 해당됩니다. 보통주 외에 18,072,580주의 우선주가 있습니다.

이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 8,990,843주 및 발행된 우선주는 의결권이 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식(12,506,577주)을 제외할 경우, 의결권 행사 가능 주식수는 106,889,074주입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	128,386,494	-
	우선주	18,072,580	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	8,990,843	상법 상 자기주식
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배 제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	18,072,580	우선주인 자기주식 1,614,846주 포함
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	12,479,184	· 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 제한 [삼성생명 10,622,814주, 삼성화재 1,856,370주]
	보통주	27,393	· 보험업법에 의한 제한 [삼성생명 특별계정 일부]
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	106,889,074	-
	우선주	-	-

※ "기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한"된 주식 중, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 제한 주식수 12,479,184주(삼성생명 고유계정 10,622,814주, 삼성화재 1,856,370주) 중 일부는 임원의 선임 또는 해임 및 정관변경 등과 관련하여 의결권 행사 가능합니다.

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제50기 1분기	제49기	제48기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		11,611,833	41,344,569	22,415,655
(별도)당기순이익(백만원)		8,452,458	28,800,837	11,579,749
(연결)주당순이익(원)		85,435	299,868	157,967
현금배당금총액(백만원)		2,404,605	5,826,302	3,991,892
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		20.7	14.1	17.8
현금배당수익률(%)	보통주	0.7	1.7	1.6
	우선주	0.9	2.1	2.0
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	17,700	42,500	28,500
	우선주	17,700	42,550	28,550
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 49기 3월 분기배당금은 972,373백만원(주당 7,000원), 6월 분기배당금은 965,348백만원(주당 7,000원), 9월 분기배당금은 959,051백만원(주당 7,000원)입니다.

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.

※ 기본주당이익 산출근거는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산·판매법인, Harman 산하 종속회사 등 269개의 동종업종을 영위하는 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업군별로 보면 Set 사업에서는 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등을 생산/판매하는 CE 부문과 스마트폰 등 HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산/판매하는IM 부문이 있습니다. 부품사업에서는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산/판매하고 있는 반도체 사업과 TV, 모니터, 노트북 PC, 모바일용 등의 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산/판매하고 있는 DP 사업의 DS 부문으로 구성되어 있습니다.

또한 2017년 중 신규로 인수한 Harman 부문에서 Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등을 생산/판매하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문		주요 제품
CE 부문		TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등
IM 부문		HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
DS 부문	반도체 사업부문	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
	DP 사업부문	TFT-LCD, OLED 등
Harman 부문		Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등

지역별로 보면 국내에는 CE, IM 부문 및 반도체 사업을 총괄하는 본사와 22개의 종속기업이 사업을 운영하고 있습니다.

본사는 수원사업장(CE 부문 및 R&D 센터 등)과 구미사업장(IM 부문), 기흥사업장(반도체 사업), 화성사업장(반도체 사업), 평택사업장(반도체 사업), 광주사업장(생활가전 사업) 등으로 구성이 되어 있으며, 국내 종속기업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매, 제품의 서비스를 담당하는 삼성전자서비스 및 제품의 운송을 담당하는 삼성전자로지텍 등 총 22개의 비상장 종속기업으로 구성되어 있습니다.

해외는 미주, 유럽, 아시아, 아프리카 등지에서 생산, 판매, 연구활동을 담당하는 247개의 해외 종속기업이 운영되고 있습니다.

미주는 TV, HHP 등 Set제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(뉴저지, 미국), TV 생산을 담당하는 SAMEX(티후아나, 멕시코), 반도체 제조를 담당하는 SAS(오스틴, 미국) 및

Harman 등을 포함하여 총 63개의 판매, 생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽은 영국내 Set제품 판매를 담당하는 SEUK(영국)와 SEF(프랑스), SEG(독일), SEI(이탈리아) 등의 판매법인이 있으며, 유럽내 TV 생산을 담당하는 SESK(슬로바키아), SEH(헝가리) 및 냉장고 등 가전생산을 담당하는 SEPM(폴란드) 등의 생산법인 등을 포함하여 총 78개의 법인이 운영되고 있습니다.

아시아는 SAPL(싱가폴)을 중심으로 SEAU(호주), SEPCO(필리핀), SME(말레이시아) 등 판매법인 및 HHP 생산법인 SEV·SEVT(베트남), TV 등 생산법인 SEHC(베트남), TV·HHP 등 복합 생산법인 SIEL(인도) 등을 포함하여 총 38개의 법인이 운영되고 있습니다.

중국은 중국내 Set 제품 판매를 담당하는 SCIC(북경), SEHK(홍콩) 등의 판매법인과 Set 제품의 생산, 반도체 및 DP의 임가공을 담당하는 천진지역, 소주지역 등의 생산법인(TSTC, SSEC, SESS 등)을 포함하여 총 38개의 법인이 운영되고 있습니다.

아프리카, 중동, CIS에서는 판매, 생산 등을 담당하는 30개 법인이 운영되고 있습니다.

[CE 부문]

(산업의 특성 등)

TV산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산/판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV사업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송 확산(영/미 1998년~)을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, FPTV는 화질, 디자인 등 제품 성능 향상과 지속적인 Set가격 하락을 통해 성장을 지속하며 기존 CRT 시장을 빠르게 대체하였습니다.

또한 2010년 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체들의 부상과 스마트기기에 대한 사용자들의 관심 확대로 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 2013년에는 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV, 2014년에는 새로운 Form Factor인 Curved TV가 출시되었으며 2015년에는 퀀텀닷TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하였습니다.

전체 TV 수요는 2017년 기준 2억 1,510만대 수준으로 LCD TV 수요가 2억 1천만대로 99% 이상의 시장 점유를 이어 나갔으며, OLED 수요는 159만대로 성장하였으나 비중은 0.7%로 영향이 미미하였습니다. 2018년도 전체 TV 수요는 성장세로 돌아서서 2억 2,200만대 이상을 기록하며 전년 대비 3% 중반 수준의 성장이 예상됩니다.

최근 TV시장은 고해상도 대형화면에 대한 Needs가 지속적으로 증가하여, 2018년도TV수요 중 UHD TV의 수요는 전년비 28% 가까이 증가한 1억대로 전체 TV 수요 중 비중이 45% 수준이 될 전망이며, 60"이상 대형 TV 수요도 전년비 33% 이상 성장한 약 20백만대로 예상됩니다. 또한, 75"이상 초대형 TV 수요도 전년비 47% 이상 성장한 약 1.8백만대로 전망되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

TV시장의 Mega Trend인 대형화/고화질화가 Device간, 업체간 경쟁 격화에 따라 더욱 빠른 속도로 진행되고 있으며, 이에 제품력, 브랜드파워를 앞세운 Major 업체의 강세가 지속되고 있습니다. 또한 고화질 및 슬림 제품에 대한 소비자 Needs가 높아짐에 따라 친환경 소재인 LED BLU(Back Light Unit)를 적용하여 TV의 밝기와 명암비를 높이고 소비전력을 낮춘 LED TV가 시장의 Main Stream으로 자리 잡았습니다

한편 시청자가 콘텐츠를 구매하는 생태계 변화에 맞춰, TV에서 다양한 콘텐츠를 쉽게 사용할 수 있도록 스마트UX 혁신을 이뤄냈으며(2015년), 연결된 주변기기를 자동으로 인식할 뿐만 아니라 하나의 리모컨으로 인식된 주변기기를 컨트롤하고, TV 시청을 방해 받지 않고 다양한 소스를 한 화면에서 이용할 수 있도록 하였습니다(2016년).

TV에서의 경험을 모바일로 확장하여 모바일 기기를 통해 쉽게 스마트 허브를 이용하고 TV를 제어할 수 있도록 하였으며, 지능형 음성인식 기능을 이용하여 볼륨, 채널 이동, 화면 모드 변경까지 사용자가 원하는 TV 제어 기능을 더욱 쉽게 활용 할 수 있도록 했습니다(2017년).

TV 시청 경험 강화를 넘어서 Lifestyle 가치를 강화하는 최근 트렌드에 맞춰 TV 시청 외의 시간에 TV가 단순한 검은 화면이 아닌 인테리어적인 가치를 제공하고, 동시에 헤드라인 뉴스를 쉽고 간편하게 즐길 수 있도록 구성하고 있습니다(2018년).

<CE 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2018년 1분기	2017년	2016년
TV	20.1%	20.0%	21.6%

※ 2016년, 2017년 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료(수량기준)이며, 2018년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2006년 이후 2017년까지 12년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다. 특히 2009년에는 세계 최초로 LED TV(LED BLU, 초슬림/초경량화, 친환경)라는 신규 category를 창출하였고 2010년 1분기에 세계 최초로 3D TV/BDP/안경/BD Title을 동시에 제공하는 3D Total Solution 출시하며, 압도적 경쟁력 우위로 3D TV시장을 선점하였습니다. 이에 더하여 2010년에 세계 최초 TV용 App Store 'Samsung Apps'를 런칭한 이후 2011년에는 다양한 스마트 서비스를 지속 추가하여 "스마트 TV = SAMSUNG"이라는 이미지를 확립하였습니다. 또한 2012년 당사는 음성/제스처 기반의 신개념 입력방식(Smart Interaction)을 활용한 콘텐츠 개발을 통해 온 가족이 이용할 수 있는 서비스를 강화하였고, 2013년에는 기존 대비 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV를 출시하였습니다. 2014년에는 신규 Form factor인 Curved TV 출시, 2015년은 나노입자의 퀀텀닷 SUHD TV의 최초 출시를 통해 Premium 시장을 주도하며 리더십을 유지하였고, 2016년은 2세대 퀀텀닷, HDR 1000 기술로 화질의 디테일을 한층 끌어 올렸습니다.

2017년에 당사는 QLED TV로 신규 카테고리 창출을 통해 어떤 밝기 영역에서나 정확한 컬러를 표현할 수 있는 컬러 볼륨 100%를 구현하고, 최고 2,000 nit 밝기까지 제공하여 더 이상의 화질 논쟁은 필요 없는 궁극의 화질을 제공하였습니다.

또한, 세계 아티스트와 갤러리/미술관과의 협업을 통해 세계적인 명화, 사진 작품부터 개인 사진 등을 예술 작품처럼 감상할 수 있는 '더 프레임(The Frame) TV'를 선보여 소비자의 Lifestyle과 일체화된 'Screen Everywhere'의 비전을 제시하였습니다.

2018년에 당사는 QLED TV에 로컬디밍 기술을 적용하여 블랙 및 콘트라스트 등 화질 개선을 통한 시청 경험 향상뿐만 아니라, 다양한 콘텐츠를 보다 쉽고 편리하게 탐색하고 즐길 수 있으며 기기 간의 연결성 강화 및 AI·IoT 경험을 선사하여 Lifestyle 경험을 확대하도록 할 예정입니다.

또한, 데이터 신호 케이블과 TV 전원선을 결합한 단 하나의 투명 케이블을 통한 선처리, 비 시청시간에도 TV를 공간과 조화롭게 꾸미고 사용자가 원하는 다양한 정보들을 실시간 제공하는 혁신적 기능인 Ambient Mode로 TV 자체의 아름다움을 넘어 공간과 자연스럽게 어울리는 TV를 지향하였습니다.

특히, UHD보다 4배의 해상도인 8K 초고화질 QLED TV를 선보이는 등, TV 업계 리더로서, 소비자에게 진정으로 TV의 가치를 전달하고자 지속적 변화와 혁신적인 제품으로 어려운 경제 여건 속에서도 끊임없이 노력하도록 하겠습니다.

[IM 부문]

(산업의 특성 등)

휴대폰 보급률은 2017년 77% 수준에서 2018년은 79%에 이를 것으로 전망됩니다.

(2018.4월 Strategy Analytics)

휴대폰 산업은 1980년대 초 음성 통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동 통신으로 발전하였습니다. 현재는 대용량 데이터의 초고속

전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 글로벌로 확산되어 2017년에 판매된 휴대폰의 75%가 LTE를 지원하고 있습니다.(2018.2월 Strategy Analytics)

또한, 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 서비스도 현재 상용화를 준비 중에 있습니다.

스마트폰은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하였으며, 스마트폰 비중은 2017년에 이어 2018년에도 78%를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 스마트폰 비중 정체 현상은 2017년 하반기에 등장한 LTE 피쳐폰으로 인해 피쳐폰 수요가 예년 대비 증가하였기 때문입니다.(2018.3월 Strategy Analytics)

스마트폰 시장이 성숙됨에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 고화질 카메라, 센서, 방수방진, 생체 인증과 같은 Hardware뿐만 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Mobile Payment, AI, AR 등의 Software와 서비스 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

스마트폰 시장규모는 2017년 15.1억대에서 2018년 15.2억대로 전년 수준을 유지할 것으로 전망되며, 태블릿 시장은 스마트폰의 대화면화 영향으로 2017년 1.9억대에서 2018년 1.3억대로 감소가 예상됩니다.

(출처 : Strategy Analytics - 스마트폰 2018.3월, 태블릿 2018.2월)

<IM 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2018년 1분기	2017년	2016년
HHP	18.9%	19.5%	19.2%

※ 2016년, 2017년, 2018년 1분기 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계시장점유율 자료(수량기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

당사는 주력사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 현재까지 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한, 휴대폰뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블, 액세서리 등의 제품들과 함께 서비스, 온라인, B2B 등 미래 성장 동력이 될 수 있는 육성사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.

스마트폰은 당사가 보유한 Premium에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다.

특히 Premium 스마트폰은 갤럭시 S와 갤럭시 Note 시리즈를 통해 대화면 AMOLED 디스플레이, Edge 디자인, S펜, 방수방진, 고속충전 및 무선충전, Samsung Pay 등 고객 Needs 기반의 차별화된 가치를 지속적으로 선보여 왔습니다. 또한 2018년 3월 출시한 갤럭시 S9과 S9+는 슈퍼 슬로우 모션, 듀얼 조리개 모드, AR 이모지 등의 더욱 향상된 카메라 기능과 함께 Infinity Display와 사운드 기술로 몰입감 있고 생동감 넘치는 멀티미디어 경험을 제공하고 있습니다.

보급형 스마트폰은 Premium 스마트폰을 통해 검증된 메탈 디자인, 방수방진, 고화소 셀피 카메라, Samsung Pay 등 실생활에 유용한 차별화 요소를 확대 적용하여 제품 경쟁력을 높이고, 라인업 효율화와 생산성 향상을 통해 수익성을 유지하고 있습니다.

스마트폰 외에도 갤럭시 Tab S 등의 Premium 태블릿과 Smartwatch, VR 기기, 360카메라와 같은 웨어러블 제품으로 고객의 삶을 더욱 풍부하게 할 뿐만 아니라, 스마트폰에서 데스크탑 환경을 제공하는 Samsung Dex 등의 다양한 액세서리 제품을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 편리한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

제품과 더불어, 당사는 그 동안 Samsung Pay, Samsung Health, Samsung Cloud 등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 2017년에는 지능형 서비스인 Bixby로 스마트폰을 더욱 쉽게 사용하고 고객 상황에 알맞은 정보를 제공해주는 등 새롭고 차별화된 경험을 제공해 왔습니다.

당사의 모든 제품과 서비스가 연결되는 통합 IoT 솔루션을 확보하고 타사 기기와의 연결이 가능한 개방형 Ecosystem으로 확장하여 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없이 사용할 수 있도록 One 삼성 기반의 Multi Device Experience를 제공하도록 하겠습니다. 5G, Intelligence, IoT, Cloud, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 대비한 투자도 지속하고, 업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하여, 글로벌 위상을 더욱 높여 가도록 하겠습니다.

[DS 부문]

- 반도체 사업부문

(산업의 특성 등)

반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리반도체는 크게 읽고(Read) 쓸 수(Write)있는 램(RAM)제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM)제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억장치, 응용프로그램의 일시적 로딩>Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 모바일 기기, Server 등의 중앙처리장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 네트워크, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 향 AP제품과 이미지 센서, 기타 주문형 반도체 등을 공급하고 있습니다.

반도체 시장은 스마트폰 시장의 성장을 저하 및 태블릿 시장 역성장 등 모바일 기기의 수요 감소로 성장을 감소의 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장이 창출되어 향후 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되며, 수요 기반 또한 다변화되어 수급의 변동은 과거 대비 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

DRAM은 모바일 분야의 시장 성장 둔화가 예상되나, 서버용 신제품의 수요 증가로 공급부족 상황이 지속되고 있습니다. 타 공급 업체의 선단공정 안정화가 늦어지고 있고, 고성능 고신뢰성 제품 개발이 지연되고 있어 당사로의 수요 집중은 계속될 전망입니다. NAND는 SSD 채용 확대, 신규 모바일 기기의 NAND 탑재량 증가 등으로 수요가 지속 증가하고 있으나, 경쟁사의 Vertical NAND 확산으로 Chip 공급 부족이 완화될 전망입니다.

<반도체 사업부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2018년 1분기	2017년	2016년
DRAM	44.9%	45.8%	48.0%

※ 2016년, 2017년 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장 점유율 자료(금액기준)를 활용하였으며, 2018년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2017년 10나노급 2세대 DRAM을 세계최초로 출시 하였으며, 경쟁사 대비 1년 이상 앞선 경쟁력을 확보하고 있습니다. 더불어, AI/슈퍼컴퓨터에 구현되는 고성능 고대역폭 메모리(HBM2) 공급을 본격적으로 확대하고 있습니다. NAND의 경우 Planar 타입과 Vertical 타입을 동시에 양산하는 등 고객이 원하는 모든 제품을 적기 대응하고 있습니다. 특히, 경쟁사 대비 앞선 기술력을 확보한 Vertical NAND 는 4세대 적층 제품을 본격 양산하고 있으며, 이를 고성능 SSD에 탑재하여 프리미엄 시장에 적극 진입하는 한편, 연내 Vertical NAND 5세대 적층 제품을 출시할 예정입니다. 또한, 4세대 Vertical NAND가 적용된 512GB eUFS를 양산하여 프리미엄 메모리 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

2017년에 이어 2018년에도 메모리 반도체 시장의 성장이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 당사는 선단공정을 기반으로 한 차별화 제품 확대 및 다양한 제품 라인업을 이용한 응용처별 최적 대응을 통해 메모리 1위 업체로서 시장을 선도해 나갈 것입니다.

또한 System LSI 시장은 모바일 중심의 성장에서 Automotive, IoT, Wearable, Health Care 등 시장의 다각화 중으로 신규 제품군의 시장 확대로 성장세가 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 선단 공정 조기 개발 및 차별화 기술 적용 제품의 선 출시로 성장을 이어 나갈 것입니다. AP 모뎀 통합칩은 경쟁사보다 앞서 선단공정을 도입하여 프리미엄부터 중저가 시장까지 적극 대응하고 있습니다.

아울러 Foundry 시장에서는 앞선 선단공정 기술을 바탕으로 대형 Fabless 업체와 협력 중입니다. 당사는 업계 최초로 극자외선 설비를 활용한 7나노 공정을 적기 개발하여 시장을 주도하기 위해 역량을 집중하고 있습니다. 또한 8인치 Foundry 사업도 포트폴리오 다각화를 통해 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다.

- DP 사업부문

(산업의 특성 등)

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색 재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점은 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 차별화 요소로 작용하여 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 OLED의 채용이 빠르게 늘어나고 있습니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로 모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화되는 추세를 보이고 있습니다.

OLED와 TFT-LCD 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 일반적으로 이러한 장치산업은 경기변동에 민감하여, 수요가 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있습니다. 이처럼 생산이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격이 상승할 수 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

디스플레이 패널의 주요 생산업체는 대부분 아시아 지역에 위치하고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

한국 : 삼성디스플레이, 엘지디스플레이 등

일본 : Sharp, Japan Display 등

대만 : AU Optronics, Innolux 등

중국 : BOE, CSOT, Tianma, CEC Panda 등

당사는 앞선 기술력을 바탕으로 대형 TFT-LCD 시장을 선도해 왔을 뿐만 아니라, 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다.

2018년 중소형 OLED 패널은 LTPS(Low Temperature Polycrystalline Silicon, 저온 폴리 실리콘) LCD와의 경쟁 심화 속에서 상반기에 수요 약세가 예상됩니다. 하지만 하반기부터 수요가 점차 회복될 것으로 기대되며, Flexible 제품은 High-end 제품군에서 입지를 견고히 할 것으로 보입니다.

한편 대형 LCD 패널은, 고해상도 및 초대형 TV 등 프리미엄 TV 시장 성장이 지속될 것으로 기대되지만, 패널 업계의 공급 확대 및 업체간 경쟁 심화로 시장내 불확실성이 증가할 것으로 예상됩니다.

<DP 사업부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2018년 1분기	2017년	2016년
디스플레이 패널	13.2%	14.8%	17.1%

※ 2016년, 2017년, 2018년 1분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료(대형패널-금액기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등)

중소형 OLED 패널 사업은, 2018년 1분기 주요 고객의 수요 감소 및 LTPS LCD와의 경쟁 지속으로 매출이 감소하였으며, 패널 수요 약세는 2018년 2분기까지 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 원가 절감 및 생산 효율 향상을 통해 경쟁력 확보에 노력하고, 고객 확대를 추진할 계획입니다.

한편 대형 LCD 패널은, 2018년 1분기 비수기에 따른 수요 감소 및 판가의 지속적인 하락 영향으로 매출이 감소하였으며, 2018년 2분기 역시 업계 Capa 증가에 따른 공급 초과 현상의 지속이 우려됩니다. 이에 당사는 고부가 및 차별화 제품의 적기 개발과 원가 절감 활동 강화를 통해 수익을 확보할 수 있도록 노력하겠습니다.

[Harman 부문]

(산업의 특성 등)

2018년에는 전장부품 사업과 연관성이 높은 자동차 Global 생산량이 약 2% 증가하여 전년 수준을 유지할 것으로 전망됩니다.

(출처 : JD Power Global Production, 2018.3월)

최근 수년간 자동차 산업 내에서 Connectivity와 엔터테인먼트에 대한 수요는 증가해 왔습니다. 자동차 제조사들이 자율주행 자동차와 공유 모빌리티를 두 축으로 기술발전의 선두에서 있는 것을 지향하면서 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

프로페셔널/소비자 오디오 산업(커넥티드 홈, 헤드폰, 스마트 오디오 등) 중 소비자 오디오는 2021년까지 연평균 약 5% 성장할 것으로 전망되며(출처 : Futuresource, 2017.12월), 프로페셔널 오디오는 약 2% 성장할 것으로 전망됩니다.(출처 : Stiernberg Consulting, 2017.6월)

커넥티드 홈과 스마트 오디오에서의 기술혁신 결과로 산업의 수요가 크게 증가해왔으며, 세계적인 성장 기조 속에 이 분야의 기술이 지속적으로 발전함에 따라 이러한 수요증가 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(국내외 시장여건 등)

자동차와 프로페셔널/소비자 오디오 시장은 경쟁이 매우 심한 가운데 급속하게 발전하고 있습니다.

커넥티드카 분야에는 자동차 제조사들과 협력하는 여러 회사들(Alpine, Aptiv, Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)이 있습니다. 시장은 지속적으로 커넥티드카 영역에서 자동차 제조사들에게 자율주행 등 가장 앞선 기술을 지속적으로 요구하고 있어 이 분야는 현재 Major업체들과 신규업체들간 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다.

카오디오시스템 분야도 주요 업체들(Bose, Pioneer, Panasonic)간 경쟁이 매우 치열합니다. 미래에도 이 분야의 지속적인 기술 발전이 예상되며 여러 카오디오 업체들은 다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 이 사업분야 또한 향후에도 지속적으로 업체간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

프로페셔널/소비자오디오 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도업체들(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 등)이 있습니다. 특히, 커넥티드 홈과 스마트 스피커 제품은 시장 포화상태로, 새로운 업체들과 기존 업체들간 경쟁 상황이 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다.

<Harman 부문 주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2018년 1분기	2017년	2016년
Headunits	21.9%	25.4%	25.0%

※ Headunits은 텔레메틱스, 뒷좌석 연결 박스 등을 제외한 별도 제품입니다.

※ 2016년, 2017년, 2018년 1분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 자료를 활용한 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 전장부품 및 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서 뛰어난 성과를 이어 나가는데 집중하고 있으며, 이를 달성하기 위해 혁신, 전략적 인수합병, 그리고 널리 알려진 브랜드들을 통해 지속적으로 성장해 나갈 것입니다.

당사의 Harman 부문은 전장부품시장에서 선도업체의 위상을 유지하고 있습니다. 대량판매 시장에서부터 고급특화시장에 걸쳐 차량들에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드들을 활용하는 한편, Harman 브랜드에 부합하는 품질수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카오디오와 Connectivity 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사들과의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다.

추가적으로 선도기술인 OTA(Over the Air)와 소프트웨어 서비스를 통해 커넥티드 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

자동차시장에서의 성공요인들은 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 Harman 브랜드들은 일상적인 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야들에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객들을 당사로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다. 이러한 노력들을 통해 당사가 사업을 영위하는 전장부품 등의 산업분야에서 선도업체로서의 역할을 유지할 수 있을 것입니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원, %)

부문	구분	제50기 1분기		제49기		제48기		
		금액	비중	금액	비중	금액	비중	
CE 부문	총매출액	21,396,841	15.2%	102,042,983	18.2%	104,268,671	21.6%	
	내부매출액	11,655,167	14.6%	57,441,636	17.8%	59,588,715	21.3%	
	순매출액	9,741,674	16.1%	44,601,347	18.6%	44,680,255	22.1%	
	영업이익	275,153	1.8%	1,802,032	3.4%	2,922,564	10.0%	
	총자산	44,976,724	9.6%	45,301,419	10.0%	45,447,881	11.6%	
IM 부문	총매출액	60,312,806	42.9%	226,004,156	40.2%	211,523,973	43.9%	
	내부매출액	31,862,693	39.8%	119,335,838	37.0%	111,221,861	39.7%	
	순매출액	28,450,113	47.0%	106,668,318	44.5%	100,302,112	49.7%	
	영업이익	3,769,623	24.1%	11,827,324	22.0%	10,807,569	37.0%	
	총자산	125,853,748	26.8%	111,441,835	24.5%	111,574,049	30.5%	
DS 부문	반도체	총매출액	39,514,424	28.1%	141,819,969	25.2%	99,527,926	20.6%
		내부매출액	18,731,238	23.4%	67,564,374	21.0%	48,370,924	17.3%
		순매출액	20,783,186	34.3%	74,255,595	31.0%	51,157,002	25.3%
		영업이익	11,550,359	73.8%	35,204,143	65.6%	13,595,004	46.5%
		총자산	138,978,293	29.6%	131,659,288	29.0%	102,251,069	28.0%
	DP	총매출액	15,180,352	10.8%	72,108,721	12.8%	55,884,739	11.6%
		내부매출액	7,643,766	9.5%	37,643,358	11.7%	28,956,095	10.3%
		순매출액	7,536,586	12.4%	34,465,363	14.4%	26,928,644	13.3%
		영업이익	408,263	2.6%	5,398,401	10.1%	2,226,626	7.6%
		총자산	62,786,851	13.4%	69,854,363	15.4%	57,240,065	15.6%
	계	총매출액	56,023,663	39.8%	218,781,719	38.9%	159,473,455	33.1%
		내부매출액	27,677,560	34.6%	110,614,239	34.3%	81,325,252	29.0%
		순매출액	28,346,103	46.8%	108,167,480	45.1%	78,148,203	38.7%
		영업이익	11,763,656	75.2%	40,327,933	75.2%	15,850,986	54.2%
		총자산	227,988,713	48.6%	227,250,206	50.0%	183,951,625	50.3%
Harman 부문	총매출액	2,545,062	1.8%	9,171,835	1.6%	-	-	
	내부매출액	604,223	0.8%	2,069,206	0.6%	-	-	
	순매출액	1,940,839	3.2%	7,102,629	3.0%	-	-	
	영업이익	△36,740	△0.2%	57,421	0.1%	-	-	
	총자산	14,511,603	3.1%	14,676,715	3.2%	-	-	

※ 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다.

[△는 부(-)의

값임]

※ CE부문은 의료기기사업부를 제외하여 재작성하였습니다.

※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 실적입니다.

2018년(제50기) 1분기 매출은 CE 부문이 9조 7,417억원(16.1%), IM 부문이 28조 4,501억원(47.0%)이며, 반도체 사업부문이 20조 7,832억원(34.3%), DP 사업부문이 7조 5,366억원(12.4%) 등 DS 부문이 약 46.8% 수준입니다. Harman 부문은 1조 9,408억원(3.2%)입니다.

2018년(제50기) 1분기 영업이익은 CE 부문이 2,752억원으로 전체이익의 1.8%, IM 부문이 3조 7,696억원으로 전체이익의 24.1%를 차지하며, DS 부문이 전체이익의 75.2%인 11조 7,637억원을 달성하였습니다. Harman 부문은 전체이익의 $\Delta 0.2\%$ 인 $\Delta 367$ 억원입니다.

- 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용

- 1) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품/모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.
- 2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 매출

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 컴퓨터 등 완제품과 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산, 판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 인포테인먼트, 텔레메틱스 등을 생산, 판매하고 있습니다. 2018년 1분기 당사 제품별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

부문	주요 제품	순매출액	비중	
CE 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등	97,417	16.1%	
IM 부문	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	284,501	47.0%	
DS 부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	207,832	34.3%
	DP 사업	TFT-LCD, OLED 등	75,366	12.4%
	부문 계		283,461	46.8%
Harman 부문	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등	19,408	3.2%	
기타	-	△79,150	△13.1%	
전체 계		605,637	100.0%	

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준)

[△는 부(-)의 값임]

2018년 1분기 매출은 CE 부문이 9조 7,417억원으로 전체 순매출액의 16.1%, IM 부문이 28조 4,501억원으로 47.0%를 차지하며, DS 부문이 28조 3,461억원으로 46.8%를 구성하고 있습니다. Harman 부문은 1조 9,408억원으로 전체의 3.2%입니다.

☞ 세부 제품별 매출은 '5. 매출' 항목을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

2018년 1분기 TV의 평균판매가격은 2017년 대비 1.1% 하락하였으며, HHP는 2017년 대비 21.9% 상승하였습니다. 또한 메모리 평균판매가격은 2017년 대비 20.0% 상승하였으나 디스플레이 패널 평균판매가격은 2017년 대비 25.2% 하락하였습니다. Headunits의 평균판매가격은 2017년 대비 1.1% 하락하였습니다.

3. 주요 원재료

(단위 : 억원, %)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처
CE	원재료	디스플레이 패널	화상신호기	9,286	20.8%	AUO, BOE 등
	원재료	기타		35,316	79.2%	
	부문 계			44,602	100.0%	
IM	원재료	Camera Module	휴대폰용 카메라	12,999	13.5%	삼성전기, 파트론 등
	원재료	Base Band Chip	CPU	9,082	9.4%	Qualcomm, Media Tek 등
	원재료	모바일용 디스플레이 패널	화상신호기	5,661	5.9%	BOE, 이엘케이 등
	원재료	기타		68,826	71.2%	
	부문 계			96,568	100.0%	
DS	원재료	FPCA	구동회로	3,927	7.8%	비에이치, 삼성전기 등
	원재료	Wafer	반도체원판	3,715	7.4%	SUMCO, SK실트론 등
	원재료	POL	편광판	3,517	7.0%	삼성SDI, 동우화인켐 등
	원재료	Window	강화유리	3,023	6.0%	Lens, Biel 등
	원재료	기타		35,965	71.8%	
	부문 계			50,147	100.0%	
Harman	원재료	시스템온칩	자동차용 제품	777	20.0%	NVIDIA, Renesas 등
	원재료	메모리	자동차용 제품	771	19.8%	Avnet, Microchip 등
	원재료	기타		2,342	60.2%	
	Harman 계			3,890	100.0%	
기타				71	-	
총계				195,278	-	

※ 부문간 매입액 포함기준입니다.(연결기준)

※ 주요 매입처 중 삼성전기, 삼성SDI는 삼성계열 소속회사입니다.

당사의 주요 원재료는 CE 부문의 경우 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 모듈로 AUO 등에서 공급받고, IM 부문의 경우 Camera Module, Base Band Chip 및 모바일용 디스플레이 패널 등으로 삼성전기, Qualcomm, BOE 등으로부터 공급받고 있습니다.

또한 DS 부문의 경우 FPCA, Wafer, POL, Window 등을 비에이치, SUMCO, 삼성SDI, Lens 등으로부터 공급받고 있습니다.

Harman 부문의 경우 시스템온칩, 자동차용 메모리 등을 NVIDIA, Avnet 등에서 공급받고 있습니다.

- 주요 원재료 가격 변동 추이

CE 부문의 주요 원재료인 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 가격은 2017년 대비 약 14% 하락하였습니다.

IM 부문의 모바일용 디스플레이 패널 가격은 2017년 대비 약 10% 상승하였으며, Base Band Chip의 경우 2017년 대비 약 45%가 가격이 상승하였습니다.

DS 부문의 원재료 중 구동회로용 FPCA가격은 2017년 대비 변동이 없으며, 반도체원판용 Wafer 가격은 약 27% 상승하였습니다. 또한 편광판용 POL 가격은 2017년 대비 약 1% 상승하였고 강화유리용 Window 가격은 약 2% 상승하였습니다. Harman 부문의 원재료 중 시스템온칩 가격은 2017년 대비 약 5%, 메모리 가격은 약 3% 하락하였습니다.

4. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적, 가동률

(생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제50기 1분기	제49기	제48기
CE	TV	9,907	44,639	52,308
IM	HHP	104,050	415,200	447,200
DS	메모리	154,939,000	530,590,000	415,026,000
	DP	2,244	8,723	10,028
Harman	Headunits	1,397	5,483	-

※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.

※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

CE 및 IM 부문의 주요 품목별 생산능력은 평균 라인수×시간당 평균생산실적×일평균가동시간×가동일수로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1GB 환산기준으로 환산생산실적(패키지 OUT기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있고, DP의 경우 라인별 생산가능한 제품의 총면적을 8세대 Glass (2200×2500mm) 로 환산하고 있습니다.

Harman 부문의 Headunits 생산능력은 각 거래선/제품별 생산셀(조립, 테스트)수× 각 생산셀별 시간당 평균생산능력×1일 평균 생산시간×생산일수로 산출하였습니다

(생산실적)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제50기 1분기	제49기	제48기
CE	TV	9,028	39,450	47,428
IM	HHP	90,114	393,693	389,838
DS	메모리	154,939,000	530,590,000	415,026,000
	DP	1,871	7,798	8,307
Harman	Headunits	1,075	4,221	-

※ 생산실적은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다.

※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

2018년 1분기 CE 부문의 TV 생산실적은 9,028천대이고 한국(수원), 중국, 멕시코, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다.

IM 부문의 HHP 생산실적은 90,114천대이며 한국(구미), 중국, 베트남, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다.

DS 부문의 메모리 생산실적은 154,939백만개(1GB 환산기준)이며, 한국(화성, 평택) 및 중국에서 생산하고 있습니다. DP 생산실적은 1,871천개이며, 한국(천안, 아산), 중국 등 지역에서 생산 중입니다.

Harman 부문의 Headunits 생산실적은 1,075천개입니다.

(가동률)

(단위 : 천대)

부문	품 목	제50기 1분기		
		생산능력 대수	실제 생산대수	가동률
CE	TV	9,907	9,028	91.1%
IM	HHP	104,050	90,114	86.6%

당사 CE 및 IM 부문의 2018년 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV가 91.1%, HHP가 86.6%입니다.

(단위 : 시간)

부문	품 목	제50기 1분기		
		가동가능 시간	실제 가동시간	가동률
DS	메모리	17,280	17,280	100.0%
	DP	15,120	14,184	93.8%

DS부문의 메모리와 DP는 24시간 3교대 작업을 실시하고 있으며, 휴일을 포함하여 2018년 1분기 누적 가동일은 총 90일입니다. $90\text{일} \times \text{생산라인수} \times 24\text{시간}$ 으로 실제가동시간을 산출하여 가동률을 계산하였습니다.

(단위 : 천대)

부문	품 목	제50기 1분기		
		생산능력 대수	실제 생산대수	가동률
Harman	Headunits	1,397	1,075	76.9%

Harman부문의 2018년 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, 76.9%입니다.

나. 생산설비 및 투자현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 기흥, 온양, 광주 등 국내사업장 및 북미, 구주, 중국 등 해외 CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, Harman 산하 종속회사 등에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지
국내 (12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
	서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길11 (서초동)
	우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33 (우면동)
	기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성2로 95 (농서동)
	화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1 (반월동)
	평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114 (여염리)
	천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)
	온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)
	아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)
	구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)
	구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302 (임수동)
	광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107 (오선동)
해외 (CE, IM 부문 산하 9개 지역총괄)	북미 총괄	미국, 뉴저지
	구주 총괄	영국, 런던
	중국 총괄	중국, 북경
	동남아 총괄	싱가폴, 싱가포르
	서남아 총괄	인도, 뉴델리
	CIS 총괄	러시아, 모스크바
	중동 총괄	아랍에미리트, 두바이
	아프리카 총괄	남아프리카공화국, 요하네스버그
	중남미 총괄	브라질, 상파울로
해외 (DS 부문 산하 5개 지역총괄)	미주 총괄	미국, 산호세
	구주 총괄	독일, 에쉬본
	중국 총괄	중국, 상해
	동남아 총괄	싱가폴, 싱가포르
	일본 총괄	일본, 동경
Harman	미국 HQ	미국, 코네티컷

※ Harman 부문의 Connected Car 사업은 미국(Novi) 등, Lifestyle Audio 사업은 독일(Garching) 등, Professional Solution 사업은 미국(Northridge) 등, Connected Service 사업은 미국(Mt. View) 등에서 영위하고 있습니다.

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2018년 1분기말 현재 장부가액은 114조 4,123억원으로 전년말 대비 2조 7,466억원증가하였습니다. 2018년 1분기 신규취득은 8조 6,457억원이며, 감가상각비는 5조 9,153억원입니다.

(단위 : 백만원)

구 분		토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타	계
기 초	기초장부가액	9,409,276	28,058,156	57,915,798	13,910,749	2,371,669	111,665,648
	취득원가	9,409,276	41,639,045	184,392,999	13,910,749	7,176,535	256,528,604
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(13,580,889)	(126,477,201)	-	(4,804,866)	(144,862,956)
증 감	일반취득 및 자본적지출	3,330	417,429	4,767,197	2,991,891	465,854	8,645,701
	감가상각	-	(493,787)	(5,180,923)	-	(240,553)	(5,915,263)
	처분/폐기	(24,982)	(87,276)	(18,532)	-	(6,421)	(137,211)
	손상	-	-	-	-	-	-
	기타(*)	4,912	48,290	144,832	(45,808)	1,157	153,383
기 말	기말장부가액	9,392,536	27,942,812	57,628,372	16,856,832	2,591,706	114,412,258
	취득원가	9,392,536	42,021,985	188,909,854	16,856,832	7,633,761	264,814,968
	감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	(14,079,173)	(131,281,482)	-	(5,042,055)	(150,402,710)

※ 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

[()는 부

(-)의 값임]

※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.

※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.

(2) 시설투자현황

당사는 2018년 중 반도체와 DP사업부문의 라인 성능 개선 등 시설투자에 8.6조를 사용하였습니다. 2018년 투자 계획은 아직 확정되지 않았으나, 2017년에 새로운 기술과 시장 성장에 대비를 위해 시설투자가 급증했던 점을 감안할 때 전년 대비 감소할 것으로 예상됩니다.

[부문별 시설투자금액]

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	대상자산	제50기 1분기 투자액	비고
반도체	신/증설, 보완 등	'18.1~'18.3	건물/설비	72,181	
DP	신/증설, 보완 등	'18.1~'18.3	건물/설비	7,722	
기타	기타	'18.1~'18.3	건물/설비	6,554	
합 계				86,457	

5. 매출

가. 매출실적

2018년 1분기 매출은 60조 5,637억으로 전년 동기 대비 19.8% 증가하였습니다.
 부문별로 보면 전년 동기 대비 CE 부문이 4.6% 감소, IM 부문이 21.1% 증가,
 DS 부문이 24.1% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문		매출유형	품 목		제50기 1분기	제49기	제48기
CE 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등	계	97,417	446,013	446,800
IM 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	계	284,501	1,066,683	1,003,021
DS 부문	반도체 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	계	207,832	742,556	511,570
	DP 사업	상 품 제 품 용 역 기타매출	TFT-LCD, OLED 등	계	75,366	344,654	269,286
	부문 계				283,461	1,081,675	781,482
Harman 부문		상 품 제 품 용 역 기타매출	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등	계	19,408	71,026	-
기 타		기타매출	-	계	△79,150	△269,643	△212,636
합 계					605,637	2,395,754	2,018,667

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

※ CE부문은 의료기기 사업부를 제외하여 재작성하였습니다.

[△는 부(-)의 값임]

※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

- 주요제품별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제50기 1분기	제49기	제48기
영상기기	58,415	275,154	287,241
무선	276,647	1,036,218	977,494
MEMORY	173,292	603,036	378,594
DP	75,366	344,654	269,286

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준)

- 매출유형별 매출실적

(단위 : 억원)

구 분	제50기 1분기	제49기	제48기
제상품	594,570	2,368,198	2,006,326
용역 및 기타매출	11,067	27,556	12,341
계	605,637	2,395,754	2,018,667

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.

- 주요지역별 매출현황 (별도기준)

(단위 : 억원)

구 분	제50기 1분기	제49기	제48기
국내	50,553	165,684	140,656
미주	112,063	488,864	426,448
유럽	46,260	189,464	170,850
아시아 및 아프리카	87,061	317,661	281,021
중국	130,133	457,477	320,497
계	426,070	1,619,150	1,339,472

나. 판매경로

- 국 내

판매자	판매경로	소비자
생산 및 매입	전속 대리점	소비자
	유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈쇼핑 등)	
	통신사업자(SKT, KT, LG유플러스)	
	B2B 및 온라인	

- 해 외

판매자	판매경로				소비자	
생산법인	판매법인	Retailer			소비자	
		Dealer		Retailer		
		Distributor	Dealer	Retailer		
		통신사업자, Automotive OEM				
	물류법인	판매법인	Retailer			
			Dealer	Retailer		
			Distributor	Dealer		Retailer
	직접판매					

- 판매경로별 매출액 비중

경로	도매	소매	특직판	기타
비중	23%	23%	48%	6%

※ Global 기준입니다.

다. 판매방법 및 조건

- 국 내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
전속	대리점	- 약정여신수금(현금,30일여신) (담보 100%내 여신적용)	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
유통업체	양판점,할인점, 백화점,홍쇼핑,인터넷	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B 및 온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

- 해 외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담
Retailer	소매점	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
Dealer	양판점,할인점,백화점	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
Distributor	현지 거래선 직판 영업	개별계약조건	- 사안별 상호 협의하에 일부 분담
B2B	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

- 스마트 제품 등 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화
- 브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
- 고객/시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

마. 주요 매출처

2018년 1분기 당사의 주요 매출처는 Apple, AT&T, Deutsche Telekom, Sprint, Verizon 등 입니다.(알파벳순)

당사 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 13% 수준입니다.

6. 수주상황

2018년 1분기말 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한 당사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 당사는 해외 주요 권역별(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아) 지역 금융센터를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산, 당기손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 당사는 환율변동으로 인한 현금흐름의 불확실성과 손익변동을 최소화하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 당사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당분기 및 전기 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 29,964백만원 및 29,086백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동 위험의 발생을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 당사의 추가적인 금융 지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 줄이는 한편 자금 운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 당사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

당사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	89,213,233	87,260,662
자 본	223,259,880	214,491,428
부채비율	40.0%	40.7%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	32,303,752	(*1)	30,545,130	(*1)
단기금융상품	46,027,700	(*1)	49,447,696	(*1)
단기매도가능금융자산	-	-	3,191,375	3,191,375
단기상각후원가금융자산	3,733,160	(*1)	-	-
매출채권	35,370,654	(*1)	27,695,995	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	-	-	7,752,180	6,561,155
만기보유금융자산	-	-	106,751	(*1)
상각후원가금융자산	260,660	(*1)	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,997,753	6,997,753	-	-
당기손익-공정가치금융자산	624,086	624,086	-	-
기타(*3)	5,862,025	144,194	6,325,825	113,098
소 계	131,179,790		125,064,952	
금융부채				
매입채무	9,301,132	(*1)	9,083,907	(*1)
단기차입금	9,973,335	(*1)	15,767,619	(*1)
미지급금(*3)	13,638,340	318,826	12,106,609	316,928
유동성장기부채	15,631	(*1)	278,619	(*1)
사채	961,780	980,596	953,361	978,643
장기차입금	1,910,470	(*1)	1,814,446	(*1)
장기미지급금(*3)	1,636,623	28,156	1,746,184	28,285
기타(*3)	10,307,130	155,229	10,954,513	222,012
소 계	47,744,441		52,705,258	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 전기말 현재 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액 1,191,025백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 취득원가로 평가한 금액 금융자산 5,717,831백만원(전기 : 6,212,727백만원) 및 금융부채 25,079,882백만원(전기 : 24,240,081백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,985,939	51,146	3,960,668	6,997,753
당기손익-공정가치금융자산	10,497	-	613,589	624,086
기타	-	144,194	-	144,194
(2) 부 채				
미지급금	-	-	318,826	318,826
사채	-	980,596	-	980,596
장기미지급금	-	-	28,156	28,156
기타	-	148,555	6,674	155,229

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,191,375	-	3,191,375
장기매도가능금융자산	2,908,581	-	3,652,574	6,561,155
기타	-	113,098	-	113,098
(2) 부 채				
미지급금	-	-	316,928	316,928
사채	-	978,643	-	978,643
장기미지급금	-	-	28,285	28,285
기타	-	215,307	6,705	222,012

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

당사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

1) 당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2) Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산				
말타니	15,137	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.69%~9.69%(8.69%)
삼성벤처투자	7,784	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	19.56%~21.56%(20.56%)
Corning Incorporated 전환우선주	3,354,475	상향모형	위험 할인율	5.55%~7.55%(6.55%)
			가격 변동성	26.2%~32.2%(29.2%)
미지급금				
조건부금융부채	318,826	현금흐름할인모형	할인율	3.81%~4.65%(4.23%)
장기미지급금				
조건부금융부채	28,156	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	10.50%
			무위험할인율	0.97%
			자산변동성	34.54%
			신용스프레드	2.12%
기타				
조건부금융부채	4,959	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	17.57%
			무위험할인율	0.86%
			영업레버리지율	60.00%
			매출총이익할인율	6.68%
조건부금융부채	1,715	확률가중모형	가중평균자본비용	8.60%
			신용위험	2.12%

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	3,652,574	3,464,272
당기손익으로 인식된 손익	(4,565)	-
기타포괄손익으로 인식된 손익	(275,224)	(64,078)
기타	1,201,472	-
분기말	4,574,257	3,400,194

(단위: 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	351,918	342,702
당기손익으로 인식된 손익	3,367	(22,844)
사업결합으로 인한 취득	-	39,083
기타	(1,629)	(1,352)
분기말	353,656	357,589

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과 (기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	135,964	-	(131,988)
장기미지급금(*2)	112	112	(112)	(112)
계	112	136,076	(112)	(132,100)

(*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 변동성(26.2%~32.2%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 미지급금은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 10% 만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 삼성중공업의 신주인수권을 보유하고 있으며, 2018년 1분기말 현재 신주인수권의 가치는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	평가이익	평가손실
신주인수권	64,310	-	64,310	-

당사는 Corning Incorporated의 전환우선주를 보유하고 있으며, 2018년 1분기말 현재 전환우선주의 가치는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	공정가치	평가이익	평가손실
전환우선주	2,434,320	3,354,475	920,155	-

※ 공정가치는 삼항 모형을 이용, 평가이익은 자본(기타자본항목)에 반영하였습니다.

환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사의 해외법인은 장부 통화가 아닌 외화 포지션에 대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지합니다.

또한, 해외법인은 매매목적으로 통화선도를 은행을 통하여 매수 또는 매도합니다.

2018년 1분기말 현재 USD/EUR/JPY 등 총 34개 통화에 대하여 2,495건의 통화선도거래를 체결중에 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	평가이익	평가손실
통화선도	79,624	148,518	296,425	215,830

9. 경영상의 주요계약 등

계약 상대방	항 목	내 용
에릭슨	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
구글	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.25 / 영구
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	영구 라이선스 계약(향후 10년간 출원될 특허까지 포함)
시스코	계약 유형	상호 특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.01.23
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
글로벌 파운드리즈	계약 유형	공정 기술 라이선스 계약
	체결시기 및 기간	2014.02.28
	목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대
	기타 주요내용	-
인터디지털	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2014.06.03
	목적 및 내용	특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
Sharp	계약 유형	상호 특허 사용계약
	체결시기 및 기간	2015.01.01
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
마이크로소프트	계약 유형	분쟁종료 합의
	체결시기 및 기간	-
	목적 및 내용	로열티 지급에 관한 분쟁 종료 목적
	기타 주요내용	-
노키아	계약 유형	특허 사용 계약
	체결시기 및 기간	2016.07.12
	목적 및 내용	특허 라이선스를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-
HP	계약 유형	사업 매각
	체결시기 및 기간	2016.09.12
	목적 및 내용	핵심역량 강화를 통한 사업고도화
	기타 주요내용	계약금액 : USD 10.5억

Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약 (기존 계약의 수정)
	체결시기 및 기간	2018.1.1 ~ 2023.12.31
	목적 및 내용	상호 특허 라이선스/부제소를 통한 사업 자유도 확보
	기타 주요내용	-

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용

당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품, 미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다. 창조적이고 혁신적인 제품을 준비하고 있으며 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

[연구개발비용]

(단위 : 백만원)

과 목		제50기 1분기	제49기	제48기
연구개발비용 총계		4,335,970	16,805,637	14,794,318
(정부보조금)		(925)	(2,484)	(1,975)
연구개발비용 계		4,335,045	16,803,153	14,792,343
회계 처리	개발비 자산화(무형자산)	(110,403)	(447,541)	(680,962)
	연구개발비(비용)	4,224,642	16,355,612	14,111,381
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 총계 ÷ 당기매출액 × 100]		7.2%	7.0%	7.3%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

※ 비율은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. [()]는 부(-)의 값임

2018년 1분기 당사의 연구개발비용은 4조 3,360억원이며, 이 중 정부보조금 9억 및 자산화된 1,104억원을 제외한 4조 2,246억원을 당기 비용으로 회계처리하였습니다.

나. 연구개발 조직 및 운영

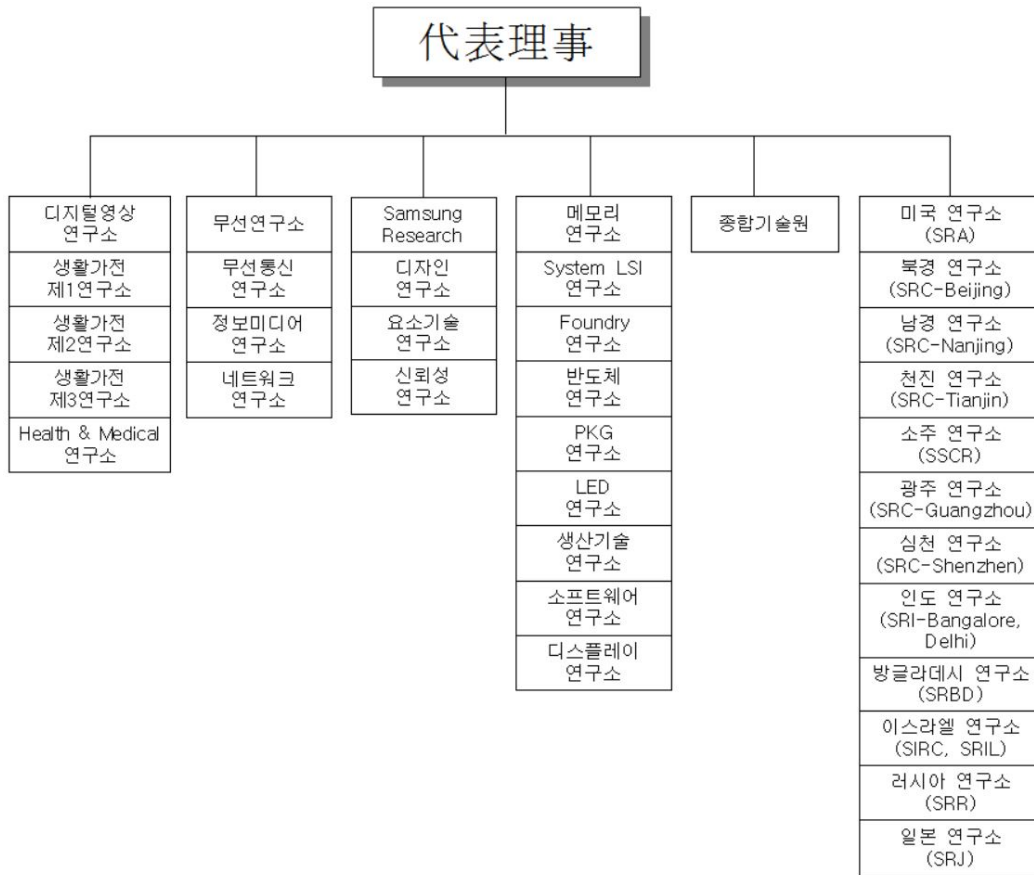
- 국내

당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 무한탐구를 실현하며 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R&D 체제를 구축하고 있습니다.

- 해외

미국(SRA), 러시아(SRR), 이스라엘(SRIL, SIRC), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 일본(SRJ), 중국(SSCR, SRC-Beijing, SRC-Nanjing, SRC-Tianjin, SRC-Guangzhou, SRC-Shenzhen) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품개발 및 기초기술연구 등의 연구활동을 수행중입니다.



※ 연구개발 조직도는 2018년 1분기말 기준입니다.

☞ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 'I. 회사의 개요'의 '사. 연결대상 종속기업 개황'을 참조하시기 바랍니다.

다. 연구개발실적

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용
HPC向 20나노 D램기반 4GB HBM2 D램 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 HPC용 4GB HBM2 D램 양산 - 시스템속도 3.6배 향상, 보드탑재 면적 97% 절감 - 기존 대비 37배 고집적 TSV기술로 속도한계 돌파 <input type="checkbox"/> 8GB HBM2 출시로 Premium 메모리 시장 성장 주도 - 그래픽, HPC에 이어 네트워크 시장도 지속 선점	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.1월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 4GB HBM2 D램 (20나노D램)
LFD DCE	<input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - DBE 모델의 기구, 패널 공용하여 Slim 대응과 NT14 플랫폼 적용으로 Light한 MagicInfo-E 솔루션 제공 - Slim Design: Bezel 9.5mm, Depth 49.9mm - MagicInfo E 솔루션을 통한 USB Contents Player 기능 제공 - RJ45/RS232C 등 Control 기능 강화	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.1월 <input type="checkbox"/> 인치 : 32"/40"/48"/55"
LM TC2	<input type="checkbox"/> 사양 및 효과 - CPU 사양 Upgrade를 통해 경쟁력 제고 ※ 1.0GHZ Dual Core → 2.2GHz Dual Core - 64bit WES7 도입으로 OS 선택폭 넓힘 - USB 단자 추가(Serial Port → USB x 2) ※ 기존 Serial Port는 USB to Serial 어댑터로 대체	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.1월 <input type="checkbox"/> 인치 : 22"/24"
DVM 시스템에어컨 AM9100K	<input type="checkbox"/> 제품 특성 - 고효율 Inverter Chiller 시장 진입 - 효율(구주) : EER : 3.4 / ESEER : 5.7 (경쟁사 대비 40%↑) - 설치면적 : 1.38㎡(경쟁사 대비 39%↓) - 운전범위 : -25 ~ 48 ℃ (경쟁사-15 ~ 43℃)	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.1월
모바일向 3세대(48단) V낸드기반 256GB UFS양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 스마트폰용 256GB UFS 양산 - uSD카드 대비 9배, SSD대비 2배 고성능 구현 - 스마트폰용 초고속·초대용량·초소형 솔루션 제공 <input type="checkbox"/> 256GB UFS 시장 본격 확대로 메모리 사업역량 강화 - 내장 스토리지 시장에서 UFS 고성장세 지속 견인	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.2월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 256GB UFS (3세대(48단) 256Gb V낸드)
서버向 3세대(48단) V낸드기반 15.36TB SAS SSD양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 서버용 15.36TB SAS SSD 양산 - 256Gb V낸드 탑재로 세계 최초 15.36TB SSD 제공 - 단일 Form Factor 저장장치 중 역대 최대 용량 구현 <input type="checkbox"/> 고용량 라인업 지속 확대로 SAS시장 본격 공략 - 데이터센터에 이어 엔터프라이즈 시장도 대폭확대	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.2월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 15.36TB SAS SSD (3세대(48단) 256Gb V낸드)
PC/서버向 10나노급(1x) 8Gb DDR4 D램 양산	<input type="checkbox"/> 세계 최초 차세대 10나노급 8Gb DDR4 D램 양산 - 20나노대비 생산성/속도 30%이상향상, 약20%절전 - 독자 개발 '3대 혁신 기술'로 미세화 한계 돌파 <input type="checkbox"/> 초고용량 D램 라인업 확대로 시장 성장세 주도 - PC, 서버에 이어 모바일 시장까지 지속 선점	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.2월 <input type="checkbox"/> 명칭 : 8Gb DDR4 D램 (10나노급D램)

<p>LM CF59</p>	<p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회로 : 1 D-Sub/1HDMI/1DP 의 Triple Interface 제공 - 기구 : 3면 Bezeless 적용을 통한 세련된 디자인과 Multi-Display의 Seamless한 usage 제공 - 패널 : 1800R 곡률 적용 ('15년 4000R) 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.2월 <input type="checkbox"/> 인치 : 27"</p>
<p>FDR 냉장고 RF9500KF</p>	<p><input type="checkbox"/> 제품 특성</p> <ul style="list-style-type: none"> - IOT시대에 새로운 사용경험 제안으로 스마트가전시장 선도 및 신규 수요 창출 - 21.5" LCD 적용 - Smart Things, Sticki Shopping 등 가족간 커뮤니케이션, 스마트 홈 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.2월</p>
<p>엑시노스8 옥타</p>	<p><input type="checkbox"/> 14나노 2세대 공정 기반 Premium 모바일 SOC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 성능과 절전효과 더욱 강화 - 독자 개발 커스텀 CPU 코어 기술 적용 - 최고 사양 LTE 모뎀 내장한 첫 Premium 통합칩 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5E8990</p>
<p>엑시노스7</p>	<p><input type="checkbox"/> 업계 최초 14나노 기반 보급형 모바일 SOC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14나노 파생공정 적용 - 기존 동일 성능의 28nm공정 제품 대비 전력효율 30% 개선 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5E7870</p>
<p>모바일 이미지센서</p>	<p><input type="checkbox"/> 듀얼 픽셀 1,200만 화소 모바일 이미지센서</p> <ul style="list-style-type: none"> - 모든 화소에서 고속으로 위상차 검출기능 구현 - 어두운 환경에서도 빠르고 정확한 자동초점 기능 - 삼성 아이소셀 기술 적용으로 성능 극대화 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5K2L1</p>
<p>LFD OHE</p>	<p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기존 Outdoor 사양 유지 - 110℃ TNI Panel로 Outdoor Usage 대응 - Quad-Core SoC 내장으로 PC-Less 솔루션 제공 - 자동 조도센서를 통한 최적의 밝기 유지, 전력 소모 최적화 및 제품 수명 극대화 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월 <input type="checkbox"/> 인치 : 24"</p>
<p>LM CF39</p>	<p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16:9 세계 최고 곡률의 1800R 적용 - 라운드 형태의 Stand Base 및 Simple Single Hinge 적용을 통한 세련된 디자인 - 후면은 심플하고 감각적인 디자인 적용을 통해 최대 곡률의 느낌을 반영 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월 <input type="checkbox"/> 인치 : 24"/27"</p>
<p>SUHD TV (KS9000)</p>	<p><input type="checkbox"/> Curved SUHD TV <input type="checkbox"/> Design : Dignity, Bezel-less, Screw-less, Axis Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : Jazz-M, Tizen OS - 화질 : UHD 120Hz, Curved, QD, Local Dimming - 기능 : Live와 OTT 통합 Home을 통해 TV 시청 컨텐츠 /서비스로의 접근성 제고 및 시청 경험 강화 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월 <input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/65"</p>

<p>SUHD TV (KS7500/KS7000)</p>	<p><input type="checkbox"/> Curved SUHD TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Triumph, Bezel-less, Screw-less, Branch Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : Jazz-M, Tizen OS - 화질 : UHD 120Hz, Curved, QD, Local Dimming - 기능 : Live와 OTT 통합 Home을 통해 TV 시청 콘텐츠 /서비스로의 접근성 제고 및 시청 경험 강화 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 43"/49"/55"/65"</p>
<p>UHD TV (KU6500/KU6400)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Curved TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : JAZZ-L, Tizen OS - 화질 : Wide Color Gamut - 기능 및 사용성 : Live와 OTT 통합 Home을 통해 TV 시청 콘텐츠/서비스로의 접근성 제고 및 시청 경험 강화 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 40"/43"/49"/55"/65"</p>
<p>UHD TV (KU6000)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Flat TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Minimalism 디자인, V-Shape 스탠드</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : JAZZ-L, Tizen OS - 화질 : UHD Upscaling, Auto Contrast Enhancer, PurColor 등 - 기능 및 사용성 : 신규 Smart TV 적용을 통해 콘텐츠/서비스로 접근성 제고 및 시청 경험 강화 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '16.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 40"/43"/50"/55"/60"/65"</p>
<p>FHD TV (K5100) (K4100)</p>	<p><input type="checkbox"/> FHD Flat TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Louvre Design, Semi Edge Slim</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : XL1,NT14L,NT16L(Non-Smart) - 화질 : 다양한 콘텐츠 시청에 최적화된 FHD화질 - 기능 및 사용성 : Sport mode, USB 2.0 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '16.4월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 32"/40"/43"/49"/55"</p>
<p>HD-TV (HE690)</p>	<p><input type="checkbox"/> Product Concept</p> <ul style="list-style-type: none"> - Market Segment별 특화 제품 및 솔루션 제공을 통한 시장 공략 - Premium Smart TV, 4~5성급 호텔 대상 <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - HMS, SINC, REACH, H.Browser, Bluetooth Music Player, Ethernet Bridge(32" ↑), Swivel Stand 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '16.8월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 22"/24"/28"/32"/40"/49"/55"</p>
<p>엑시노스7 쿼드</p>	<p><input type="checkbox"/> 커넥티비티 통합 모바일 SOC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28나노 前 세대 제품 比 성능 70%, 전력효율 30% 향상 - 모뎀, 커넥티비티, PMIC 등 주요 기능 통합해 칩셋면적 20% 축소 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '16.8월</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : S5E7570</p>
<p>식기세척기 (DW9900M)</p>	<p><input type="checkbox"/> 제품 특성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2세대 WaterWall - Zone booster 기능강화 - WiFi 앱 적용 및 Rack 기능 차별화 - Sump & New Filter System - Hidden control, Touch Type display 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 북미</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '16.12월</p>
<p>RAC 가정용에어컨 (AR5500M)</p>	<p><input type="checkbox"/> 제품 특성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 친환경(Low-GWP) R32 냉매 도입을 통한 시장 환경 변화 대응 - S-Inv 제품 도입으로 Inv 제품 경쟁력 강화 - N-PFC 적용, R32 8극 압축기 적용 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '16.12월</p>

<p>엑시노스9</p>	<p><input type="checkbox"/> 10나노 핀펫 공정 기반 Premium AP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최첨단 10나노 공정 적용, 저전력 고성능 구현 - 기가비트급 LTE 통신 지원 모뎀 통합칩 - 2세대 커스텀 CPU 및 차세대 GPU등 최고수준 성능 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.1분기</p>
<p>UHD TV (MU7000)</p>	<p><input type="checkbox"/> Flat UHD TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Slim Unibody, Real 360, Bezel-less, Screw-less, Branch Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : Kant-M, Tizen OS - 화질 : UHD 120Hz, Flat, Local Dimming - 기능 : One Connect mini로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.2월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/65"</p>
<p>UHD TV (MU6500)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Curved TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design Y-Shape Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/65"</p>
<p>UHD TV (MU6400)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Flat TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design Y-Shape Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 40/49/55/65"</p>
<p>UHD TV (MU6300 /MU6100)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Curved TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Minimalism Design, V-Shape Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 40"/43"/49"/50"/55"/65"/75"</p>
<p>QLED TV (Q8C)</p>	<p><input type="checkbox"/> Curved QLED TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : 4면bezel-less, Simple Edge, Metal Back Stainless Silver stand(Type-U) Slim Wall Mount</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : Kant-M, Tizen OS - Concept: 4면 Bezel-less 디자인 QLED TV - 화질: 최고수준의 밝기, 풍부하고 정확한 컬러, 블랙화질 및 시야각 개선 - 기능: Optical Cable 과 One Connect로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.4월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 75"</p>

<p>UHD TV (MU6100)</p>	<input type="checkbox"/> UHD Flat TV <input type="checkbox"/> Design : Minimalism Design, V-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile)을 적용하여 보다 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공 	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '17.4월 <input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/58"/75"
<p>UHD TV (LS003)</p>	<input type="checkbox"/> Lifestyle TV <input type="checkbox"/> Design : Frame Edge Design, Zero Gap WMT <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look - 기능 : Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection, Replaceable Deco Frame 	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '17.5월 <input type="checkbox"/> 인치 : 55"/65"
<p>엑시노스i (T200)</p>	<input type="checkbox"/> IoT 전용 SOC <ul style="list-style-type: none"> - 28나노 HKMG 공정 적용, 멀티코어 탑재 - 암호화/복호화 기능, 물리적 복제 방지 기능 등 보안 기능 강화 - 와이파이 얼라이언스 인증, IoT 프로토콜 표준 'IoTivity' 지원 	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '17.5월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5JT200
<p>UHD TV (MU6303)</p>	<input type="checkbox"/> 실속형 UHD Curved TV <input type="checkbox"/> Design : Minimalism Design, V-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공 - MU6300 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원) 	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '17.7월 <input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/65"
<p>UHD TV (MU6103)</p>	<input type="checkbox"/> 실속형 UHD Flat TV <input type="checkbox"/> Design : Minimalism Design, V-Shape Stand <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) - 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 콘텐츠 사용 경험 제공 - MU6100 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원) 	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '17.7월 <input type="checkbox"/> 인치 : 40"/43"/49"/50"/55"/ 65"/75"
<p>HD-TV HF690</p>	<input type="checkbox"/> Product Concept <ul style="list-style-type: none"> - Market Segment별 특화 제품 및 솔루션 제공 - 3~4성급 대상 지역 별 Premium Smart HF590/690 도입 - KANT-M(Tizen3.0)적용 도입 <input type="checkbox"/> 사양 및 효과 <ul style="list-style-type: none"> - Panel : 기존 M5500 동일 사양 : 32"/43"/49"/55" 도입 - 회로 Platfom : Kant-M(Tizen3.0) 적용 ※ SMPS : M5500 SMPS 공용설계 ※ HDMIx3,USBx2,RJ12,LAN,Opt,Comp/AV,RJP,BathSPK,LAN OUT - 기구 Design : M5500 시리즈 공용 설계 ※ Swivel Stand/Box : 16년 호텔 690동일 사양 	<input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '17.8월 <input type="checkbox"/> 인치 : 32"/43"/49"/55"

<p>LFD</p> <p>QMH</p>	<p><input type="checkbox"/> Product Concept</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premium UHD Line Up 도입 ※ 고해상도 UHD급 Signage 라인업 도입 운영 ※ SoC 적용을 통한 Signage 솔루션 제공('16년 QMF 比 주요 개선 Point) - UHD 라인업 Size 경쟁력 확대 ※ 다양한 사이즈의 Full Line-up 구축을 통한 시장의 고해상도 Needs 대응 - Non-Glare 및 24/7 사용 대응, 16년 QMF 동일 ※ LFD Usage 대응을 위한 사양 적용 <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform : Orsay → Tizen 3.0 도입, DTS, DIVX 삭제 - 회로 : FHD/UHD 모델 플랫폼 통합 : Kant-M SoC 적용 ※ 성능/기능 개선 : SE13U(Scaler) → Kant-M(SoC) - 패널 : 24/7, V-PID 및 Non-Glare 적용 (Haze 25%) 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.8월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/65"</p>
<p>청소기</p> <p>(VS8000ML)</p>	<p><input type="checkbox"/> 제품 특성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 세계 최고 흡입력 POWERStick 청소기 - Suction Power 150W, 40분 - Flex Body, 듀얼 드럼 브러시 - EzClean Dustbin & Brush - Hygienic Solution: HEPA Filter적용 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.8월</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : 파워스틱</p>
<p>UHD TV</p> <p>(LS003)</p>	<p><input type="checkbox"/> Lifestyle TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Frame Edge Design, Zero Gap WMT</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS - 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look - 기능 : Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection Replaceable Deco Frame 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.12월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 43"</p>
<p>모바일向</p> <p>4세대(64단)</p> <p>V낸드기반</p> <p>512GB</p> <p>eUFS 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 64단 V낸드기반 512GB eUFS SSD 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 512Gb V낸드 양산으로 고용량 메모리 시장 주도 - 초업계 유일 최대용량·초고속 솔루션 제공 <p><input type="checkbox"/> 4세대 512Gb V낸드 생산 확대로 시장 성장 주도</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰/태블릿 시장 선점에 이어 SSD까지 확대 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.11월</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : 모바일향 512GB eUFS (4세대 V낸드)</p>
<p>PC/서버向</p> <p>10나노급(1y)</p> <p>8Gb DDR4</p> <p>D램 양산</p>	<p><input type="checkbox"/> 세계 최초 2세대 10나노급 8Gb DDR4 D램 양산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x나노 대비 생산성 30%/속도 10% 향상/절전 15% - 독자 개발 '3대 혁신 기술'로 제품경쟁력 강화 <p><input type="checkbox"/> 차세대 D램 선행 양산 기술 확보로 시장 성장 주도</p> <ul style="list-style-type: none"> - 차세대 DDR5/LPDDR5/HBM3/GDDR6 양산 체제 구축 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.11월</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : 8Gb DDR4 D램 (1y나노 D램)</p>
<p>모바일</p> <p>이미지센서</p>	<p><input type="checkbox"/> 초소형 고화질 이미지센서 ISOCELL Fast 2L9</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자동초점, 듀얼픽셀 기술 적용 - 미세 공정 기술로 픽셀 크기 1.4μm에서 1.2μm로 줄여 사이즈 경쟁력 확보 - 이미지센서 1개로 아웃포커스 기능 구현 가능 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '17.4분기</p> <p><input type="checkbox"/> 명칭 : S5K2X7</p>

<p>모바일 이미지센서</p>	<p><input type="checkbox"/> 초소형 고화질 이미지센서 ISOCELL Slim 2X7</p> <ul style="list-style-type: none"> - 화소수를 자동 조절하여 밝고 선명한 촬영이 가능한 TetraCell (테트라셀) 기술 적용 - 업계 최초 픽셀 크기 1.0μm 미만의 (0.9μm) 초소형 이미지 센서 - 픽셀 사이 물리적 벽을 형성하는 DTI 공법 적용 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '17.4분기 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5K2L9SX</p>
<p>엑시노스 9 (9810)</p>	<p><input type="checkbox"/> 독자 개발 3세대 CPU 및 Cat.18 6CA 지원 초고속 모뎀 탑재 AP</p> <ul style="list-style-type: none"> - 싱글코어 성능 약 2배, 멀티코어 성능 40% 향상 - 업계최초 6CA LTE모뎀 탑재, 다운로드 속도 1.2Gbps 구현 <p><input type="checkbox"/> 딥러닝 알고리즘 구현, 지능형 이미지 처리 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정확한 이미지 분석, 향상된 안면인식 기능 지원 - 저조도, 흔들리는 환경에서도 고화질의 이미지와 영상 촬영 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '18.1월 <input type="checkbox"/> 명칭 : SC59810</p>
<p>이미지센서 솔루션</p>	<p><input type="checkbox"/> 이미지센서 + S/W 알고리즘 동시 제공 토탈 솔루션</p> <ul style="list-style-type: none"> - S/W 구매 비용 및 센서/AP 최적화 시간 단축 - 리포커싱/저조도 촬영 등 듀얼카메라 기능 지원 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '18.2월</p>
<p>모바일 이미지센서</p>	<p><input type="checkbox"/> D램 내장 3단 적층 구조 적용 ISOCELL Fast 2L3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 빠르게 대량의 이미지 저장 가능 - 초당 960 프레임의 슈퍼 슬로우 모션 촬영 지원 <p><input type="checkbox"/> 듀얼픽셀 기반 위상 검출 자동 초점 기술 적용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 환경 제약 없는 빠르고 정확한 오토포커스 제공 - 3D 노이즈 감소, HDR 등 첨단 기술 집약 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '18.2월 <input type="checkbox"/> 명칭 : S5K2L3</p>
<p>8인치 Foundry 공정 (RF/지문인식)</p>	<p><input type="checkbox"/> RF, 지문인식 센서 제품군에 특화된 8" 공정 개발</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8인치 Foundry 서비스 제품군 확대 <p>임베디드 플래시 메모리, 전력반도체, 디스플레이 드라이버, CMOS 이미지센서 외 RF, 지문인식 센서용 솔루션 추가</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foundry 고객의 제품 완성도 및 편의성 향상 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '18.3월</p>
<p>UHD TV (NU7100)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Flat TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Sleek & 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS - 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+ - 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색 (Universal Browse)) 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '18.3월 <input type="checkbox"/> 인치 : 40"/43"/49"/50"/55"/65"/75"</p>
<p>UHD TV (NU7300)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Curved TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Sleek & 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS - 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+ - 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색 (Universal Browse)) 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌 <input type="checkbox"/> 출시 : '18.3월 <input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/65"</p>

<p>UHD TV (NU7400)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Flat TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Sleek & 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS - 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color - 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색 (Universal Browse)) One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 콘텐츠 사용(BT 지원) 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '18.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 43"/50"/55"/65"</p>
<p>UHD TV (NU7500)</p>	<p><input type="checkbox"/> UHD Curved TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : Sleek & 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS - 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color - 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 콘텐츠 탐색 (Universal Browse)) One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 콘텐츠 사용(BT 지원) 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '18.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/65"</p>
<p>UHD TV (NU8000)</p>	<p><input type="checkbox"/> Flat UHD TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : 3면bezel-less, Cable Management, T-type Center Stand, VESA Wall Mount</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : Kant-M2, Tizen OS - 화질 : UHD 120Hz, Flat, Local Dimming - 기능 : Input lag 및 모션 관련 Game 화질 개선으로 최고의 Gaming 경험 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '18.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 49"/55"/65"/75"/82"</p>
<p>UHD TV (NU8500)</p>	<p><input type="checkbox"/> Curved UHD TV</p> <p><input type="checkbox"/> Design : 3면bezel-less, Cable 정형, T-type Center Stand, VESA Wall Mount</p> <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platform(H/W,S/W) : Kant-M2, Tizen OS - 화질 : UHD 120Hz, Curved, Local Dimming - 기능 : Input lag 및 모션 관련 Game 화질 개선으로 최고의 Gaming 경험 제공 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '18.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 55"/65"</p>

<p>LM</p> <p>CJ89</p>	<p><input type="checkbox"/> Product Concept</p> <ul style="list-style-type: none"> - B2B 모니터 시장에 없던 압도적인 사이즈(32:9비율 49") 출시 향상된 업무 생산성 / 비용절감 효과 제공 - Pain Point 해결한 B2B 모니터 Bezel의 간섭 없는 완벽한 Dual 모니터 사용성 제공 / USB-C 적용으로 최신 I/F 사양 제공 <p><input type="checkbox"/> 사양 및 효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHG9 대비 게이밍 기능 제외하고, USB-C 사양 추가 - 기존 CHG9 패널에서 QD Sheet 제외 	<p><input type="checkbox"/> 지역 : 글로벌</p> <p><input type="checkbox"/> 출시 : '18.3월</p> <p><input type="checkbox"/> 인치 : 49"</p>
-----------------------	--	---

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R&D활동의 지적재산화에도 집중하여 2018년 1분기 4조 3천억원의 R&D 투자를 통해 2018년 1분기 국내 특허 640건, 미국 특허 1,495건을 취득하였습니다.

< 국가별 등록 건수(2018년 1분기말 기준, 누적)> (단위 : 건)

국가	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가
건수	25,567	47,878	21,874	11,363	7,171	9,869

당사는 1984년 최초로 미국 특허를 등록시킨 이래 현재 세계적으로 총 123,722건의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 누적 건수 기준으로 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

< 연도별 특허등록 건수> (단위 : 건)

특허등록	'18.1Q	'17년	'16년	'15년	'14년	'13년	'12년	'11년
한국	640	2,703	3,462	3,002	3,985	2,775	2,024	1,616
미국	1,495	6,072	5,683	5,220	5,085	4,802	5,194	4,991

이들은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통해 향후 신규사업 진출 시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다.

당사는 구글('14.1월 체결, 영구), 노키아('16.7월), WD사('16.12월, 2024년까지 공유), Qualcomm('18.1월, 2023년까지 공유) 등과의 특허 크로스 라이선스 체결을 통해, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 특허 뿐 아니라 스마트폰, LED TV 등에 적용된 당사 고유의 디자인을 보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여 2018년 1분기에는 미국에서 192건의 디자인 특허를 취득하였습니다.

나. 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.

☞ 녹색기술 인증 관련 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '10. 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 "협력회사 에코파트너 인증" 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원사용 절감, 에너지 절약, 유해물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 "에코디자인 평가" 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 "폐제품 회수·재활용 시스템"을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기전자 제품 관련 국내외 환경법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수·재활용법 (例, EU WEEE Directive)
2. 유해물질사용 제한 (例, EU RoHS Directive, REACH Regulation)
3. 제품 에너지 소비효율 규정 (例, EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생하는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지 시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음진동규제법, 환경영향평가법 등
2. 온실가스 배출 관리 : 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 저탄소 녹색성장 기본법 등
3. 기타 사업장환경관리법 : 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률, 악취방지법, 토양환경보전법 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)

당사는 '저탄소 녹색성장기본법' 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	2017년	2016년	2015년
온실가스(단위 : tCO2e)	8,411,674	6,885,300	6,729,419
에너지(단위 : TJ)	130,836	107,740	111,166

- ※ 대상 : 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등
- ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다.
- ※ 삼성디스플레이 분사(2012년)로 인해 DP사업이 제외된 기준입니다.

당사는 2015년부터 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조에 따라 온실가스 배출권 거래제 적용 대상업체에 해당합니다.

☞ 녹색기술 인증 관련 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '10. 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제50기 1분기	제49기	제48기
	2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말
[유동자산]	154,941,953	146,982,464	141,429,704
· 현금및현금성자산	32,303,752	30,545,130	32,111,442
· 단기금융상품	46,027,700	49,447,696	52,432,411
· 기타유동금융자산	3,733,160	3,191,375	3,638,460
· 매출채권	35,370,654	27,695,995	24,279,211
· 재고자산	26,470,871	24,983,355	18,353,503
· 기타	11,035,816	11,118,913	10,614,677
[비유동자산]	157,531,160	154,769,626	120,744,620
· 기타비유동금융자산	7,882,499	7,858,931	6,804,276
· 관계기업 및 공동기업 투자	6,810,645	6,802,351	5,837,884
· 유형자산	114,412,258	111,665,648	91,473,041
· 무형자산	14,805,407	14,760,483	5,344,020
· 기타	13,620,351	13,682,213	11,285,399
자산총계	312,473,113	301,752,090	262,174,324
[유동부채]	68,298,586	67,175,114	54,704,095
[비유동부채]	20,914,647	20,085,548	14,507,196
부채총계	89,213,233	87,260,662	69,211,291
[지배기업 소유주지분]	215,884,505	207,213,416	186,424,328
· 자본금	897,514	897,514	897,514
· 주식발행초과금	4,403,893	4,403,893	4,403,893
· 이익잉여금	222,485,398	215,811,200	193,086,317
· 기타	△11,902,300	△13,899,191	△11,963,396
[비지배지분]	7,375,375	7,278,012	6,538,705
자본총계	223,259,880	214,491,428	192,963,033
	2018년 1월~3월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월
매출액	60,563,714	239,575,376	201,866,745
영업이익	15,642,170	53,645,038	29,240,672
연결총당기순이익	11,688,544	42,186,747	22,726,092
지배기업 소유주지분	11,611,833	41,344,569	22,415,655
비지배지분	76,711	842,178	310,437
기본주당순이익(단위 : 원)	85,435	299,868	157,967
희석주당순이익(단위 : 원)	85,435	299,868	157,967

연결에 포함된 회사수	270개	271개	170개
-------------	------	------	------

- ※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]
- ※ 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제48기~제49기 연결감사보고서 및 제50기 1분기 연결검토보고서 주석 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제50기 1분기	제49기	제48기
	2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말
[유동자산]	72,370,085	70,155,189	69,981,128
· 현금및현금성자산	7,769,590	2,763,768	3,778,371
· 단기금융상품	20,136,857	25,510,064	30,170,656
· 매출채권	30,045,336	27,881,777	23,514,012
· 재고자산	8,915,860	7,837,144	5,981,634
· 기타	5,502,442	6,162,436	6,536,455
[비유동자산]	132,836,079	128,086,171	104,821,831
· 기타비유동금융자산	990,386	973,353	913,989
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	55,730,367	55,671,759	48,743,079
· 유형자산	66,737,192	62,816,961	47,228,830
· 무형자산	2,823,356	2,827,035	2,891,844
· 기타	6,554,778	5,797,063	5,044,089
자산총계	205,206,164	198,241,360	174,802,959
[유동부채]	47,168,741	44,495,084	34,076,122
[비유동부채]	1,842,051	2,176,501	3,180,075
부채총계	49,010,792	46,671,585	37,256,197
[자본금]	897,514	897,514	897,514
[주식발행초과금]	4,403,893	4,403,893	4,403,893
[이익잉여금]	154,284,538	150,928,724	140,747,574
[기타]	△3,390,573	△4,660,356	△8,502,219
자본총계	156,195,372	151,569,775	137,546,762
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2018년 1월~3월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월
매출액	42,606,978	161,915,007	133,947,204
영업이익	11,200,897	34,857,091	13,647,436
당기순이익	8,452,458	28,800,837	11,579,749
기본주당순이익(단위 : 원)	62,189	208,881	81,602
희석주당순이익(단위 : 원)	62,189	208,881	81,602

* 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

[△는 부(-)의 값임]

* 기본주당이익(보통주) 산출근거는 제48기~제49기 감사보고서 및 제50기 1분기 검토보고서 주석사항을 참조하십시오.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 50 기 1분기말 2018.03.31 현재

제 49 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 50 기 1분기말	제 49 기말
자산		
유동자산	154,941,953	146,982,464
현금및현금성자산	32,303,752	30,545,130
단기금융상품	46,027,700	49,447,696
단기매도가능금융자산		3,191,375
단기상각후원가금융자산	3,733,160	
매출채권	35,370,654	27,695,995
미수금	3,221,846	4,108,961
선급금	1,687,013	1,753,673
선급비용	4,327,031	3,835,219
재고자산	26,470,871	24,983,355
기타유동자산	1,799,926	1,421,060
비유동자산	157,531,160	154,769,626
장기매도가능금융자산		7,752,180
만기보유금융자산		106,751
상각후원가금융자산	260,660	
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,997,753	
당기손익-공정가치금융자산	624,086	
관계기업 및 공동기업 투자	6,810,645	6,802,351
유형자산	114,412,258	111,665,648
무형자산	14,805,407	14,760,483
장기선급비용	3,880,465	3,434,375
순확정급여자산	628,122	825,892
이연법인세자산	5,012,377	5,061,687
기타비유동자산	4,099,387	4,360,259
자산총계	312,473,113	301,752,090
부채		
유동부채	68,298,586	67,175,114
매입채무	9,301,132	9,083,907
단기차입금	9,973,335	15,767,619

미지급금	15,036,480	13,899,633
선수금	1,135,681	1,249,174
예수금	821,190	793,582
미지급비용	15,288,788	13,996,273
미지급법인세	10,542,578	7,408,348
유동성장기부채	15,631	278,619
총당부채	5,254,798	4,294,820
기타유동부채	928,973	403,139
비유동부채	20,914,647	20,085,548
사채	961,780	953,361
장기차입금	1,910,470	1,814,446
장기미지급금	1,935,019	2,043,729
순확정급여부채	425,561	389,922
이연법인세부채	12,349,990	11,710,781
장기총당부채	513,347	464,324
기타비유동부채	2,818,480	2,708,985
부채총계	89,213,233	87,260,662
자본		
지배기업 소유주지분	215,884,505	207,213,416
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	222,485,398	215,811,200
기타자본항목	(11,902,300)	(13,899,191)
비지배지분	7,375,375	7,278,012
자본총계	223,259,880	214,491,428
자본과부채총계	312,473,113	301,752,090

연결 손익계산서

제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 50 기 1분기		제 49 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	60,563,714	60,563,714	50,547,526	50,547,526
매출원가	31,909,472	31,909,472	28,155,597	28,155,597
매출총이익	28,654,242	28,654,242	22,391,929	22,391,929
판매비와관리비	13,012,072	13,012,072	12,493,568	12,493,568
영업이익(손실)	15,642,170	15,642,170	9,898,361	9,898,361
기타수익	370,976	370,976	316,423	316,423
기타비용	245,263	245,263	277,234	277,234
지분법이익	64,364	64,364	19,338	19,338
금융수익	2,283,200	2,283,200	2,097,152	2,097,152
금융비용	1,939,540	1,939,540	1,889,464	1,889,464
법인세비용차감전순이익(손실)	16,175,907	16,175,907	10,164,576	10,164,576
법인세비용	4,487,363	4,487,363	2,480,222	2,480,222
계속영업이익(손실)	11,688,544	11,688,544	7,684,354	7,684,354
당기순이익(손실)	11,688,544	11,688,544	7,684,354	7,684,354
당기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	11,611,833	11,611,833	7,488,532	7,488,532
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	76,711	76,711	195,822	195,822
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위:원) (단위 : 원)	85,435	85,435	53,656	53,656
희석주당이익(손실) (단위:원) (단위 : 원)	85,435	85,435	53,656	53,656

연결 포괄손익계산서

제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 50 기 1분기		제 49 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	11,688,544	11,688,544	7,684,354	7,684,354
기타포괄손익	922,852	922,852	(4,932,049)	(4,932,049)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(177,394)	(177,394)	(39,214)	(39,214)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(174,884)	(174,884)		
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	33,371	33,371	(116)	(116)
순확정급여부채 재측정요소	(35,881)	(35,881)	(39,098)	(39,098)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,100,246	1,100,246	(4,892,835)	(4,892,835)
매도가능금융자산평가손익			165,155	165,155
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	22,286	22,286	(55,352)	(55,352)
해외사업장환산외환차이	1,087,269	1,087,269	(5,009,234)	(5,009,234)
현금흐름위험회피파생상품평가손익	(9,309)	(9,309)	6,596	6,596
총포괄손익	12,611,396	12,611,396	2,752,305	2,752,305
포괄손익의 귀속				
지배기업 소유주지분	12,516,850	12,516,850	2,591,329	2,591,329
비지배지분	94,546	94,546	160,976	160,976

연결 자본변동표

제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본							자본 합계
		지배기업 소유주지분					비지배지분		
		자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액		지배기업 소유주 지분 합계	
2017.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	193,086,317	(11,934,586)	(28,810)	186,424,328	6,538,705	192,963,033
회계정책변경누적효과									
수정후 기초자본		897,514	4,403,893	193,086,317	(11,934,586)	(28,810)	186,424,328	6,538,705	192,963,033
자본의 변동	포괄손익								
	당기순이익			7,488,532			7,488,532	195,822	7,684,354
	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익								
	매도가능금융자산평가				171,300		171,300	(6,145)	165,155
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(55,209)		(55,209)	(259)	(55,468)
	해외사업장환산외환차이				(4,980,796)		(4,980,796)	(28,438)	(5,009,234)
	순확정급여부채 재측정요소				(39,094)		(39,094)	(4)	(39,098)
	현금흐름위험회피파생상품평가손익				6,596		6,596		6,596
	매각예정 분류				(14,995)	14,995			
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래								
	배당			(3,850,352)			(3,850,352)	(997)	(3,851,349)
	연결실체내 자본거래 등				(630)		(630)	(389)	(1,019)
	연결실체의 변동								
	자기주식의 취득				(2,045,795)		(2,045,795)		(2,045,795)
자기주식의 소각									
기타				727		727	53	780	
2017.03.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	196,724,497	(18,892,482)	(13,815)	183,119,607	6,698,348	189,817,955
2018.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	215,811,200	(13,899,191)		207,213,416	7,278,012	214,491,428
회계정책변경누적효과				220,176	(261,734)		(41,558)		(41,558)
수정후 기초자본		897,514	4,403,893	216,031,376	(14,160,925)		207,171,858	7,278,012	214,449,870
자본의 변동	포괄손익								
	당기순이익			11,611,833			11,611,833	76,711	11,688,544
	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익			(146)	(142,495)		(142,641)	(32,243)	(174,884)
	매도가능금융자산평가								
	관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분				55,600		55,600	57	55,657
	해외사업장환산외환차이				1,037,246		1,037,246	50,023	1,087,269
	순확정급여부채 재측정요소				(35,876)		(35,876)	(5)	(35,881)
	현금흐름위험회피파생상품평가손익				(9,309)		(9,309)		(9,309)
	매각예정 분류								
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래								
	배당			(2,929,530)			(2,929,530)	(1,334)	(2,930,864)
	연결실체내 자본거래 등							4,031	4,031
	연결실체의 변동							(39)	(39)
	자기주식의 취득				(875,111)		(875,111)		(875,111)
자기주식의 소각			(2,228,135)	2,228,135					
기타				435		435	162	597	
2018.03.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	222,485,398	(11,902,300)		215,884,505	7,375,375	223,259,880

연결 현금흐름표

제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 50 기 1분기	제 49 기 1분기
영업활동 현금흐름	15,616,352	10,597,271
영업에서 창출된 현금흐름	16,026,531	12,382,781
당기순이익	11,688,544	7,684,354
조정	11,140,508	7,909,512
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,802,521)	(3,211,085)
이자의 수취	331,422	378,987
이자의 지급	(89,829)	(92,981)
배당금 수입	28,754	27,227
법인세 납부액	(680,526)	(2,098,743)
투자활동 현금흐름	(7,373,336)	(8,165,139)
단기금융상품의 순감소(증가)	3,472,296	10,082,810
단기매도가능금융자산의 취득		(544,463)
매도가능금융자산의 처분	(411,752)	
장기금융상품의 처분	84,373	10,153
장기금융상품의 취득	(455,778)	(86,835)
장기매도가능금융자산의 처분		53,041
장기매도가능금융자산의 취득		(28,847)
상각후원가금융자산의 취득	(158,716)	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	2,083	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(31,911)	
당기손익-공정가치금융자산의 처분	9,968	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(34,587)	
관계기업 및 공동기업 투자의 처분	148	76,522
관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(17,137)	(4,160)
유형자산의 처분	200,057	35,250
유형자산의 취득	(9,818,105)	(8,901,692)
무형자산의 처분	5,272	47
무형자산의 취득	(234,228)	(171,098)
사업결합으로 인한 현금유출액	(14,721)	(8,624,973)
현금의 기타유출입	29,402	(60,894)
재무활동 현금흐름	(6,929,313)	(5,188,892)
단기차입금의 순증가(감소)	(5,793,171)	(3,575,834)
자기주식의 취득	(875,111)	(2,045,795)
사채 및 장기차입금의 차입	3,157	434,803

사채 및 장기차입금의 상환	(264,947)	(2,042)
배당금 지급	(3,272)	(218)
비지배지분의 증감	4,031	194
외화환산으로 인한 현금의 변동	444,919	(1,791,744)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	1,758,622	(4,548,504)
기초 현금 및 현금성자산	30,545,130	32,111,442
기말 현금 및 현금성자산	32,303,752	27,562,938

3. 연결재무제표 주석

제 50 기 분기 : 2018년 3월 31일 현재

제 49 기 : 2017년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항 :

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문과 Harman부문으로 구성되어 있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, Foundry, System LSI 등의 반도체 사업과 LCD 및 OLED 패널 등의 디스플레이(DP) 사업으로 구성되어 있습니다. Harman부문은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이 및 Samsung Electronics America 등 269개의 종속기업(주석 1. 나 참조)을 연결대상으로 하고, 삼성전기 등 42개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

보고기간 종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
국내	삼성디스플레이	디스플레이 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스	디스플레이 부품 생산	50.0
	스테코	반도체 부품생산	70.0
	세메스	반도체/FPD제조장비 생산	91.5
	삼성전자서비스	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자판매	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨	의료기기	68.5
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 23호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	미래로시스템	반도체 공정불량 및 품질관리 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.0
레드밴드소프트웨어코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NexusDX(Nexus)	의료기기	100.0
	NeuroLogica	의료기기	100.0
	Samsung Semiconductor(SSI)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada(SECA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Research America(SRA)	R&D	100.0
	Samsung Mexicana(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung International(SII)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico(SEM)	전자제품 판매	99.9
	SEMES America(SEMESA)	반도체 장비	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico(SEDAM)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	RT SV CO-INVEST(RT-SV)	벤처기업 투자	99.9
	Samsung HVAC	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings	스마트홈기기 판매	100.0
	Samsung Pay	모바일 결제 개발 및 서비스	100.0
	Prismview	LED 디스플레이 생산 및 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund (Beijing Fund)	벤처기업 투자	61.4
	Stellus Technologies	반도체 시스템 생산 및 판매	100.0
Samsung Oak Holdings(SHI)	Holding Company	100.0	
AdGear Technologies	디지털광고 플랫폼	100.0	
Joyent	클라우드 서비스	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Next	Holding Company	100.0
	Samsung Next Fund	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Dacor Holdings	Holding Company	100.0
	Dacor	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada	가전제품 판매	100.0
	EverythingDacor.com	가전제품 판매	100.0
	Distinctive Appliances of California	가전제품 판매	100.0
	Viv Labs	인공지능관련 신기술 연구	100.0
	SigMast Communications	RCS (Rich Communication Service)	100.0
	AMX Holding Corporation	Holding Company	100.0
	AMX LLC	Holding Company	100.0
	Harman Becker Automotive Systems	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services Engineering	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Holding	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services South America	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	Holding Company	100.0
	Harman International Mexico S de RL de CV	오디오제품 판매	100.0
	Harman Investment Group, LLC	Financing Company	100.0
	Harman KG Holding, LLC	Holding Company	100.0
	Harman Professional	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software	소프트웨어 디자인	100.0
	S1NN USA	R&D	100.0
	Southern Vision Systems	영상 감지 장치 개발	100.0
	Triple Play Integration	Connected Service Provider	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America(SEHA)	가전제품 생산	100.0
	China Materialia	벤처기업 투자	99.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia(SESIA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia(SDSK)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas(SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe(SSEL)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Company(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus(SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics(London) Limited(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Denmark Research Center(SDRC)	R&D	100.0
Samsung France Research Center(SFRC)	R&D	100.0	
Samsung Cambridge Solution Centre(SCSC)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Switzerland GmbH(ESG)	전자제품 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics Caucasus(SECC)	마케팅	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
	Aditi Technologies Europe	오디오제품 판매 등	100.0
	AKG Acoustics	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX (Germany)	오디오제품 판매	100.0
	AMX UK	오디오제품 판매	100.0
	Duran Audio B.V.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Duran Audio Iberia Espana	오디오제품 판매	100.0
	Endeleo	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Automotive UK	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems (Germany)	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Finland OY	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services (Germany)	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Division Nordic A/S	오디오제품 판매	100.0
	Harman Consumer Finland OY	오디오제품 판매	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	Holding Company	100.0
	Harman Finance International SCA	Financing Company	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing	Financing Company	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Holding Company	100.0	
Harman International Estonia OU	R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Harman International Industries (UK)	오디오제품 판매 등	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman International SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Management	Holding Company	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Inspiration Matters	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Knight Image	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Martin Manufacturing (UK)	오디오제품 생산	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Professional France SAS	오디오제품 판매	100.0
	Harman Professional Germany GmbH	오디오제품 판매	100.0
	R&D International	오디오제품 생산	100.0
	Red Bend Software (UK)	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Innoetics E.P.E.	소프트웨어 개발	100.0
	ARCAM	Holding Company	100.0
	A&R Cambridge	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production(SSAP)	TV/모니터 생산	100.0
	Broadsense	서비스	100.0
	Global Symphony Technology Group	Holding Company	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius	Holding Company	100.0
	iOnRoad	R&D	100.0
	iOnRoad Technologies	R&D	100.0
	Red Bend	오디오제품 생산	100.0
TowerSec (Israel)	R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan(SJC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M)(SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M)(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics(SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Asia Private(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore(SRI-B)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services(SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Electronics Australia(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Samsung Electronics Philippines(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Bangladesh(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	통신제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Medison India(SMIN)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics New Zealand(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam(SDV)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Laos Samsung Electronics Sole(LSE)	마케팅	100.0
	AMX Products and Solutions Private	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services India	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Technologies	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY	Holding Company	100.0
	Harman International Singapore	오디오제품 판매	100.0
	Harman Malaysia Sdn. Bhd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Professional Singapore Pte.	오디오제품 판매	100.0
	INSP India Software Development Pvt.	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
Martin Professional Pte.	오디오제품 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국제외)	Harman Connected Services Japan	Connected Service Provider	100.0
	Harman International Japan	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Japan	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Japan	Holding Company	100.0
중국	Samsung Display Dongguan(SDD)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin(SDT)	디스플레이 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (China) Investment(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(STMC)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS)	반도체 임가공	100.0
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	전자제품 생산	99.9
	Tianjin Samsung Electronics(TSEC)	TV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer(DESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module(SSM)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	디스플레이 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication (SSET)	통신제품 생산	95.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SCRC)	R&D	100.0
Samsung (China) Semiconductor(SCS)	반도체 생산	100.0	
Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC)	서비스	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Tianjin Samsung LED(TSLED)	LED 생산	100.0
	SEMES (Xian)	반도체 장비	100.0
	Samsung Semiconductor Xian(SSCX)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Harman (China) Technologies	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai)	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Taiwan	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Automotive InfoTech (Dalian)	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	Harman Technology (Shenzhen)	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Beijing)	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu)	Connected Service Provider	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기 및 전기의 주요 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

기업명	당분기말		당분기	
	자산	부채	매출액	분기순이익(손실)
삼성디스플레이	46,420,607	8,173,071	6,207,424	(20,169)
Samsung Electronics America(SEA)	27,914,049	10,498,644	7,446,907	209,237
Samsung (China) Investment(SCIC)	14,724,516	12,535,141	1,154,847	(820)
Harman과 그 종속기업(*)	14,511,603	5,191,763	1,940,637	(97,895)
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	11,225,565	3,488,998	7,513,603	803,502
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	10,918,385	2,545,559	6,100,102	695,479
Samsung Semiconductor(SSI)	10,073,047	5,328,063	7,303,837	18,307
Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	9,930,597	7,553,587	-	1,155
Samsung (China) Semiconductor(SCS)	9,039,116	1,861,907	1,160,539	355,958
Samsung Display Vietnam(SDV)	8,088,604	6,777,088	4,567,042	352,553
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	7,471,791	1,689,869	3,412,921	119,236
Samsung India Electronics(SIEL)	7,051,396	4,125,363	2,682,830	191,966
Samsung Asia Private(SAPL)	6,984,530	576,120	398,347	784,283
Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	6,013,195	1,505,967	1,840,182	198,196
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	5,458,160	4,437,903	5,963,323	55,244
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	4,911,370	357,033	857,659	80,528
Thai Samsung Electronics(TSE)	2,546,999	582,770	1,101,144	68,321
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	2,488,558	2,037,085	3,839,749	332,078
Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,126,444	2,115,247	1,627,986	(48,967)
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	2,006,532	1,454,804	1,163,194	9,849
Samsung Electronics Hungarian(SEH)	1,943,834	286,391	609,152	46,053
Samsung Suzhou LCD(SSL)	1,900,634	681,538	414,448	9,376
Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	1,868,190	1,279,995	933,937	88,460
Samsung Electronics France(SEF)	1,729,488	1,458,137	970,978	(23,806)
Samsung Electronics Benelux(SEBN)	1,725,351	586,907	643,445	8,145

(*) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

(단위: 백만원)

기업명	전기말		전분기	
	자산	부채	매출액	분기순이익(손실)
삼성디스플레이	50,723,199	12,243,688	6,460,786	1,017,770
Samsung Electronics America(SEA)	26,266,636	8,980,828	5,723,896	(37,686)
Harman과 그 종속기업(*)	14,676,715	5,391,669	537,749	24,449
Samsung (China) Investment(SCIC)	13,409,281	11,297,307	1,447,726	108,959
Samsung Display Vietnam(SDV)	10,460,755	9,495,803	2,223,711	52,516
Samsung Semiconductor(SSI)	10,125,193	5,376,696	5,581,671	17,140
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	10,044,337	2,325,221	6,256,246	787,312
Samsung Electronics Vietnam(SEV)	9,592,074	1,875,105	3,575,874	404,542
Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	9,474,960	7,241,753	-	2,751
Samsung (China) Semiconductor(SCS)	8,076,107	1,499,220	1,047,754	132,588
Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	6,440,564	980,064	2,708,828	157,094
Samsung India Electronics(SIEL)	6,200,351	3,406,484	2,837,810	204,023
Samsung Asia Private(SAPL)	6,138,652	481,546	456,897	12,910
Samsung Electronica da Amazonia(SED)	5,838,533	1,514,891	1,670,768	346,423
Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	5,169,438	4,182,832	6,028,223	53,685
Samsung Austin Semiconductor(SAS)	4,943,576	448,772	813,142	28,976
Thai Samsung Electronics(TSE)	2,191,519	371,379	1,133,328	25,119
Samsung Electronics Slovakia(SES)	2,019,572	1,051,361	877,155	33,015
Samsung Suzhou LCD(SSL)	2,019,262	852,618	445,153	29,940
Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	1,927,321	1,810,014	3,321,753	185,513
Samsung Electronics Hungarian(SEH)	1,823,278	238,383	662,266	18,320
Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	1,784,883	1,282,489	776,762	37,895
Samsung Electronics GmbH(SEG)	1,743,138	1,685,252	1,517,785	(34,967)
Samsung Electronics (UK)(SEUK)	1,615,723	1,094,995	998,244	28,645
Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	1,562,037	1,002,213	786,911	5,848

라. 연결대상범위의 변동

(1) 당분기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	기업명	사유
유럽/CIS	Joyent(UK)	청산

(2) 당분기 중 연결재무제표의 작성대상 범위에 포함되는 종속기업은 없습니다.

2. 중요한 회계처리방침 :

2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2018년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2018년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제·개정 기준서

연결회사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정

연결회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 제정

연결회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

- 기업회계기준해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정

제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 부채, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성 부채를 최초로 인식하는 날입니다. 기업회계기준해석서 제2122호의 채택으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 연결회사가 조기 적용하지 아니한 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체할 예정입니다.

연결회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며, 최초 적용일에도 동 기준서에 따라 계약이 리스인지, 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만, 연결회사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않을 수 있습니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리해야 합니다. 리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예: 기초자산 \$5,000 이하) 리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있습니다. 또한, 리스이용자는 실무적 간편법으로 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택하여 적용할 수 있습니다.

리스제공자 회계처리는 현행 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변동되지 않았습니다.

(1) 리스이용자로서의 회계처리

리스이용자는 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류'에 따라 표시되는 각 과거 보고기간에 소급 적용하는 방법(완전 소급법)과, 최초 적용일에 최초 적용 누적효과를 인식하도록 소급 적용하는 방법(누적효과 일괄조정 경과조치) 중 하나의 방법으로 적용할 수 있습니다. 연결회사는 아직 그 적용방법을 선택하지 않았습니다.

연결회사는 보고기간 종료일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 기업회계기준서 제1116호 적용시 2018년 재무제표에 미치는 잠재적인 영향을 예비 평가 중에 있으며, 향후 추가적인 정보에 기초하여 보다 구체적인 재무적 영향을 분석할 예정입니다.

(2) 리스제공자로서의 회계처리

연결회사는 리스제공자로서 현재의 리스 회계처리가 기업회계기준서 제1116호를 적용하더라도 유의적으로 달라지지 않아 재무제표에 미치는 영향도 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

가. 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

나. 금융자산

(1) 분류

2018년 1월 1일부터 연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

- 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

다. 금융부채

(1) 분류 및 측정

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 당기손익-공정가치 측정 금융부채. 파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채. 이러한 금융부채는 주석 2.2. 나 의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 금융보증계약. 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정. 최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 기업회계기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가. 이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

라. 수익인식

연결회사는 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

(1) 수행의무의 식별

연결회사는 Incoterms Group C 조건(무역조건 CIF 등) 따라 다양한 제품 및 상품을 수출하고 있습니다. 고객에게 통제가 이전된 이후 매도인이 운송서비스를 제공하므로 해당 운송서비스(보험 포함)를 별도의 수행의무로 인식합니다.

(2) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

연결회사는 조달청을 통해 수주되는 시스템에어컨 도급공사계약에 따라 고객에게 제품을 납품하고 설치를 수행하고 있습니다. 기업회계기준서 제1115호에 따르면 기업이 수행하여 만들어지거나 가치가 높아지는 대로 고객이 통제하는 자산을 기업이 만들거나 그 자산가치를 높이는 경우 진행기준을 적용하여 수익을 인식하여야 합니다. 이에 따라 시스템에어컨 설치 용역의 경우 용역 수행 경과에 따른 결과물을 고객이 직접 통제하기 때문에 진행기준을 적용하여 수익을 인식합니다.

(3) 변동대가

연결회사는 받을 권리를 갖게 될 대가를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 기댓값 방법을 사용하여 변동 대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 기업이 받았거나 받을 대가 중에서 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 금액은 환불부채로 인식하며, 고객이 반품 권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로 그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.

(4) 거래가격의 배분

연결회사는 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법' 등을 사용합니다.

2.3. 회계정책의 변경

가. 기준서 제1109호 '금융상품'의 적용

연결회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(1) 금융상품의 분류와 측정

1) 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융상품 계정별 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	측정 범주		장부금액	
	K-IFRS 제1039호	K-IFRS 제1109호	K-IFRS 제1039호	K-IFRS 제1109호
금융자산				
현금및현금성자산	대여금및수취채권	상각후원가	30,545,130	30,545,130
단기금융상품	대여금및수취채권	상각후원가	49,447,696	49,447,696
단기매도가능금융자산	매도가능금융자산	상각후원가	3,191,375	3,191,375
매출채권	대여금및수취채권	상각후원가	27,695,995	27,695,995
장기매도가능금융자산	매도가능금융자산	기타포괄손익-공정가치	7,752,180	7,151,434
		당기손익-공정가치		600,746
만기보유금융자산	만기보유금융자산	상각후원가	106,751	106,751
기타	당기손익인식금융자산	당기손익-공정가치	67,702	67,702
	대여금및수취채권	상각후원가	6,212,727	6,212,727
	기타금융자산	기타금융자산	45,396	45,396
소 계			125,064,952	125,064,952

금융부채의 경우 당기손익인식금융부채는 당기손익-공정가치로, 상각후원가 측정 금융부채는 상각후원가로 분류하였습니다.

2) 당기초 현재 금융상품의 재분류로 인해 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	이익잉여금	기타자본항목		
		매도가능금융자산 평가손익	기타포괄손익- 공정가치 평가손익	지분법자본변동
기초 장부금액-기준서 제1039호	215,811,200	1,879,774	-	40,394
조정 :				
매도가능금융자산에서 당기손익- 공정가치금융자산으로 재분류	75,547	(75,547)	-	-
매도가능금융자산에서 기타포괄손익- 공정가치금융자산으로 재분류	105,618	(1,804,227)	1,698,609	-
관계기업 및 공동기업 투자	80,225	-	-	(80,569)
계	261,390	(1,879,774)	1,698,609	(80,569)
기초 장부금액-기준서 제1109호	216,072,590	-	1,698,609	(40,175)

(2) 금융자산의 손상

연결회사는 기준서 제1109호의 새로운 기대신용손실 모형 적용대상이 되는 세가지 유형의 금융자산을 보유하고 있습니다.

- 재고자산의 매출에 따른 매출채권
- 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품
- 상각후원가로 측정되는 채무상품

연결회사는 기준서 제1109호의 도입으로 손상차손의 인식 관련 정책을 변경하였습니다.

매출채권의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용합니다. 기준서 제 1109호의 도입에 따라 기대신용위험모형의 적용으로 인한 조정금액은 경미합니다.

(3) 위험회피회계

당기초 현재 통화선도 위험회피는 기준서 제1109호의 현금흐름위험회피 적용조건을 충족합니다. 또한, 연결회사의 위험관리전략과 위험회피 문서화는 기준서 제1109호의 요구사항을 충족하며 이에 따라 위험회피관계는 지속되는 것으로 회계처리하였습니다.

나. 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용

연결회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1115호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(1) 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1115호의 도입으로 인해 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기준서 제1115호 채택 전 금액	조 정	기준서 제1115호 조정 후 금액
매출채권	27,695,995	6,983,845	34,679,840
선급비용	3,835,219	188	3,835,407
재고자산	24,983,355	(139,546)	24,843,809
기타유동자산	1,421,060	143,866	1,564,926
관계기업 및 공동기업 투자	6,802,351	(41,214)	6,761,137
자산 총계	301,752,090	6,947,139	308,699,229
미지급비용	13,996,273	6,462,176	20,458,449
기타유동부채	403,139	526,177	929,316
부채 총계	87,260,662	6,988,353	94,249,015
이익잉여금	215,811,200	(41,214)	215,769,986
자본 총계	214,491,428	(41,214)	214,450,214

(2) K-IFRS 제1115호를 최초 적용한 보고기간인 당분기말 현재 변경 전 기준에 따라 영향을 받는 재무제표의 각 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기준서 제1115호 채택 전 금액	조 정	기준서 제1115호 조정 후 금액
매출	60,562,677	1,037	60,563,714
매출원가	31,908,435	1,037	31,909,472
매출총이익	28,654,242	-	28,654,242
영업이익	15,642,170	-	15,642,170
지분법이익	64,770	(406)	64,364
법인세비용	4,487,476	(113)	4,487,363
분기순이익	11,688,837	(293)	11,688,544
분기총포괄이익	12,611,689	(293)	12,611,396

기준서 제1115호의 적용으로 인해 각각의 영업활동, 투자활동 및 재무활동 총 현금흐름은 동일합니다.

한편, 당분기말 및 당기초 현재 계약부채는 5,604,413백만원 및 7,140,266백만원이며, 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

2.4. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 아래에서 설명하는 기준서 제 1109호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

가. 금융자산의 손상

기준서 제 1109호의 금융자산의 손실충당금은 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 연결회사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간말의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

3. 범주별 금융상품 :

보고기간종료일 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	32,303,752	-	-	-	32,303,752
단기금융상품	46,027,700	-	-	-	46,027,700
매출채권	35,370,654	-	-	-	35,370,654
상각후원가금융자산	3,993,820	-	-	-	3,993,820
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	6,997,753	-	-	6,997,753
당기손익-공정가치금융자산	-	-	624,086	-	624,086
기타	5,717,831	-	112,106	32,088	5,862,025
계	123,413,757	6,997,753	736,192	32,088	131,179,790

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위: 백만원)

금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	-	9,301,132	-	9,301,132
단기차입금	-	1,623,237	8,350,098	9,973,335
미지급금	318,826	13,319,514	-	13,638,340
유동성장기부채	-	15,631	-	15,631
사채	-	961,780	-	961,780
장기차입금	-	1,910,470	-	1,910,470
장기미지급금	28,156	1,608,467	-	1,636,623
기타	87,140	10,151,901	68,089	10,307,130
계	434,122	38,892,132	8,418,187	47,744,441

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	만기보유 금융자산	기타금융자산 (*)	계
현금및현금성자산	-	30,545,130	-	-	-	30,545,130
단기금융상품	-	49,447,696	-	-	-	49,447,696
단기매도가능금융자산	-	-	3,191,375	-	-	3,191,375
매출채권	-	27,695,995	-	-	-	27,695,995
장기매도가능금융자산	-	-	7,752,180	-	-	7,752,180
만기보유금융자산	-	-	-	106,751	-	106,751
기타	67,702	6,212,727	-	-	45,396	6,325,825
계	67,702	113,901,548	10,943,555	106,751	45,396	125,064,952

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위: 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채 (*)	계
매입채무	-	9,083,907	-	9,083,907
단기차입금	-	1,497,417	14,270,202	15,767,619
미지급금	316,928	11,789,681	-	12,106,609
유동성장기부채	-	278,619	-	278,619
사채	-	953,361	-	953,361
장기차입금	-	1,814,446	-	1,814,446
장기미지급금	28,285	1,717,899	-	1,746,184
기타	180,366	10,732,501	41,646	10,954,513
계	525,579	37,867,831	14,311,848	52,705,258

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산 :

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분상품	6,946,607	-
채무상품	51,146	-
합 계	6,997,753	-

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분상품	335,651	-
채무상품	288,435	-
합 계	624,086	-

상기 금융상품들은 전기에 매도가능금융자산으로 분류되었습니다.

나. 당분기말 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			
	보유주식수(주)	지분율(%)(*)	취득원가	장부가액 (시장가치)
삼성중공업	65,930,982	16.9	473,727	508,987
호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	192,252
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	6,473
에스에프에이	3,644,000	10.2	38,262	126,082
원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	25,860
원익아이피에스	3,701,872	9.0	32,428	123,272
ASML	6,297,787	1.4	363,012	1,323,220
Wacom	8,398,400	5.0	62,013	44,996
BYD	52,264,808	1.9	528,665	499,285
기타			158,688	146,007
계			1,701,897	2,996,436

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 매도가능금융자산 :

가. 보고기간 종료일 현재 단기매도가능금융자산 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
수익증권(*)	-	3,191,375

(*) 수익증권은 정기예금 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간 종료일 현재 장기매도가능금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권 - 상장주식	-	2,908,581
지분증권 - 비상장주식	-	4,729,124
채무증권(*)	-	114,475
계	-	7,752,180

(*) 보고기간 종료일 현재 매도가능금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대노출금액은 장부 금액입니다.

다. 전기말 현재 매도가능금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	전기말			
	보유주식수(주)	지분율(%)(*1)	취득원가	장부가액 (시장가치)
삼성중공업	65,930,982	16.9	473,727	483,274
호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	170,200
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	5,832
에스에프에이(*2)	3,644,000	10.2	38,262	141,205
원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	27,760
원익아이피에스	3,701,872	9.0	32,428	123,643
ASML	6,297,787	1.4	363,012	1,169,393
Wacom	8,398,400	5.0	62,013	48,631
BYD	52,264,808	1.9	528,665	556,381
기타			158,688	182,262
계			1,701,897	2,908,581

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 전기 중 에스에프에이는 무상증자를 실시하여, 연결회사의 보유주식수가 증가하였습니다.

취득원가는 회수가능액이 취득원가에 미달하여 인식한 매도가능금융자산 손상차손을 차감하지 아니한 금액입니다. 손상차손 금액을 제외한 취득원가와 시가의 차액은 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 감안한 후 기타자본항목(매도가능금융자산평가손익)으로 계상하고 있습니다.

6. 재고자산 :

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가충당금(*)	장부가액	평가전금액	평가충당금(*)	장부가액
제품 및 상품	8,247,434	(597,631)	7,649,803	8,201,526	(897,089)	7,304,437
반제품 및 재공품	8,518,543	(443,774)	8,074,769	7,331,394	(217,493)	7,113,901
원재료 및 저장품	10,556,913	(927,514)	9,629,399	10,196,123	(782,906)	9,413,217
미착품	1,116,900	-	1,116,900	1,151,800	-	1,151,800
계	28,439,790	(1,968,919)	26,470,871	26,880,843	(1,897,488)	24,983,355

(*) 연결회사는 생산 및 판매 중단한 재고자산을 순실현가능가치로 평가하고 원가와의 차이를 평가충당금으로 반영하였습니다.

7. 관계기업 및 공동기업 투자 :

가. 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	6,802,351	5,837,884
취득	17,137	4,160
처분	(148)	(52,204)
이익 중 지분해당액	64,364	19,338
기타(*)	(73,059)	(107,816)
분기말장부가액	6,810,645	5,701,362

(*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 및 회계변경누적효과 등으로 구성되어 있습니다.

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성전기	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국	12월
삼성에스디에스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합/관리업 등 IT서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국	12월
삼성바이오로직스	신사업 투자	31.5	한국	12월
삼성SDI(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월
제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부가액	취득원가	순자산가액(*)	장부가액
삼성전기	359,237	1,025,417	1,018,761	359,237	989,924	991,579
삼성에스디에스	147,963	1,253,964	1,279,332	147,963	1,256,881	1,282,205
삼성바이오로직스	443,193	1,190,361	1,195,539	443,193	1,251,292	1,254,937
삼성SDI	1,242,605	2,296,730	2,150,188	1,242,605	2,266,451	2,126,244
제일기획	506,162	227,838	525,748	506,162	241,335	540,114
기타	602,069	231,498	405,770	593,080	215,025	376,349
계	3,301,229	6,225,808	6,575,338	3,292,240	6,220,908	6,571,428

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

(단위: 백만원)

기업명	당분기말			전기말		
	취득원가	순자산가액(*)	장부가액	취득원가	순자산가액(*)	장부가액
삼성코닝어드밴스드글라스	215,000	171,464	171,455	215,000	170,440	170,425
기타	259,994	66,910	63,852	259,994	65,106	60,498
계	474,994	238,374	235,307	474,994	235,546	230,923

(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당분기와 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기	991,579	17,728	23,467	(14,013)	1,018,761
삼성에스디에스	1,282,205	30,465	1,607	(34,945)	1,279,332
삼성바이오로직스	1,254,937	(17,056)	(1,508)	(40,834)	1,195,539
삼성SDI	2,126,244	15,751	21,655	(13,462)	2,150,188
제일기획	540,114	5,555	2,148	(22,069)	525,748
삼성코닝어드밴스드글라스	170,425	1,030	-	-	171,455
기타	436,847	10,891	8,255	13,629	469,622
계	6,802,351	64,364	55,624	(111,694)	6,810,645

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상, 계정 재분류 및 회계변경누적효과 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

기업명	기초평가액	지분법평가내역			분기말평가액
		지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	
삼성전기	997,022	11,534	(8,782)	(8,848)	990,926
삼성에스디에스	1,185,703	20,386	(15,932)	(13,104)	1,177,053
삼성바이오로직스	1,289,351	(10,460)	(1,804)	-	1,277,087
삼성SDI	1,232,986	(11,073)	(11,048)	(13,463)	1,197,402
제일기획	517,885	4,247	(5,812)	(8,711)	507,609
삼성코닝어드밴스드글라스	169,485	(1,449)	-	-	168,036
기타	445,452	6,153	(10,923)	(57,433)	383,249
계	5,837,884	19,338	(54,301)	(101,559)	5,701,362

(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정 재분류 등으로 구성되어 있습니다.

마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보

(1) 주요 관계기업의 요약 재무정보 및 관계기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	삼성전기	삼성에스디에스	삼성바이오로직스	삼성SDI	제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(당분기말) :					
유동자산	2,789,233	5,372,561	671,553	4,250,329	1,825,332
비유동자산	5,435,623	2,103,303	6,458,194	12,092,984	349,958
유동부채	2,755,837	1,526,955	2,342,790	3,003,785	1,256,218
비유동부채	977,326	239,201	1,007,102	1,693,333	115,738
비지배지분	108,326	156,280	-	238,502	8,683
요약 포괄손익계산서(당분기) :					
매출	2,018,774	2,356,889	131,035	1,908,874	811,938
계속영업손익(*)	111,203	134,670	(57,220)	125,317	19,360
기타포괄손익(*)	80,944	15,352	(172)	95,173	5,054
총포괄손익(*)	192,147	150,022	(57,392)	220,490	24,414
II. 배당(당분기)					
배당수령액	13,270	34,944	-	13,463	22,069

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

2) 전기

(단위: 백만원)

구 분	삼성전기	삼성에스디에스	삼성바이오로직스	삼성SDI	제일기획
I. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말) :					
유동자산	2,478,798	5,117,499	620,995	3,605,076	1,889,096
비유동자산	5,288,605	2,160,262	6,562,096	12,146,401	349,197
유동부채	2,454,110	1,324,862	2,287,442	2,670,360	1,281,293
비유동부채	981,802	233,469	919,198	1,629,117	101,012
비지배지분	99,848	161,151	-	194,698	9,927
요약 포괄손익계산서(전분기) :					
매출	1,570,465	2,149,521	107,648	1,304,779	674,559
계속영업손익(*)	2,189	89,727	(33,073)	80,848	16,850
기타포괄손익(*)	(37,542)	(70,558)	(5,634)	(89,196)	(23,112)
총포괄손익(*)	(35,353)	19,169	(38,707)	(8,348)	(6,263)
II. 배당(전분기)					
배당수령액	8,847	13,104	-	13,463	8,711

(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업의 요약 재무정보 및 공동기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	삼성코닝어드밴스드글라스	
	당분기	전기
I. 요약 재무정보		
요약 재무상태표 :		
유동자산	131,893	128,499
- 현금및현금성자산	13,140	11,035
비유동자산	249,442	253,840
유동부채	37,769	41,325
- 유동금융부채(*1)	16,540	18,900
비유동부채	638	134
요약 포괄손익계산서 : (*2)		
매출	53,232	63,396
감가상각비 및 무형자산상각비	324	360
이자수익	118	203
법인세비용(환입)	547	(734)
계속영업손익(*3)	2,049	(2,907)
기타포괄손익(*3)	-	-
총포괄손익(*3)	2,049	(2,907)
II. 배당		
배당수령액	-	-

(*1) 매입채무, 기타채무 및 충당부채가 제외된 금액입니다.

(*2) 분기 3개월 기준 금액입니다.

(*3) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기		전분기	
	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업
분기순손익	10,686	205	1,164	4,989
기타포괄손익	4,516	3,738	(7,071)	(3,852)
총포괄손익	15,202	3,943	(5,907)	1,137

바. 보고기간종료일 현재 시장성있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말		전기말
	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기	17,693,084	1,866,620	1,769,308
삼성에스디에스	17,472,110	4,464,124	3,494,422
삼성바이오로직스	20,836,832	10,147,537	7,730,465
삼성SDI	13,462,673	2,591,565	2,753,117
제일기획	29,038,075	522,685	615,607

8. 유형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부가액	111,665,648	91,473,041
일반취득 및 자본적지출	8,645,701	9,819,857
사업결합으로 인한 취득	-	858,796
감가상각	(5,915,263)	(4,769,499)
처분/폐기/손상	(137,211)	(48,699)
기타(*)	153,383	(2,011,078)
분기말순장부가액	114,412,258	95,322,418

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	5,364,243	4,252,772
판매비와관리비 등	551,020	516,727
계	5,915,263	4,769,499

9. 무형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	14,760,483	5,344,020
내부개발에 의한 취득	110,403	88,836
개별 취득	123,825	82,262
사업결합으로 인한 취득	-	10,013,241
상각	(351,073)	(371,959)
처분/폐기/손상	(15,743)	(2,113)
기타(*)	177,512	(378,357)
분기말장부가액	14,805,407	14,775,930

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	186,489	245,964
판매비와관리비 등	164,584	125,995
계	351,073	371,959

10. 차입금 :

보고기간종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
(1) 단기차입금				
담보부차입금(*1)	우리은행 외	0.1 ~ 11.2	8,350,098	14,270,202
무담보차입금	씨티은행 외	0.1 ~ 15.7	1,623,237	1,497,417
계			9,973,335	15,767,619
(2) 유동성장기차입금				
은행차입금	BTMU	-	-	262,493
금융리스부채(*2)	CSSD 외	1.1 ~ 15.7	10,447	10,925
계			10,447	273,418
(3) 장기차입금				
은행차입금	Mizuho 외	LIBOR+0.4 ~ 3.5	1,854,308	1,756,908
금융리스부채(*2)	CSSD 외	1.1 ~ 15.7	56,162	57,538
계			1,910,470	1,814,446

(*1) 담보부차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.

(*2) 리스부채와 관련하여 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 리스자산에 대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

11. 사채 :

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds(*1)	1997.10.2	2027.10.1	7.7	53,325 (US\$50,000천)	53,570 (US\$50,000천)
US\$ denominated Debenture Bonds(*2)	2015.5.6	2025.5.15	4.2	426,600 (US\$400,000천)	428,560 (US\$400,000천)
EURO€ denominated Debenture Bonds(*3)	2015.5.20	2022.5.27	2.0	459,184 (EUR€ 350,000천)	447,739 (EUR€350,000천)
1년 이내 만기도래분(유동성사채)				(5,333)	(5,357)
사채할인발행차금				(1,341)	(1,405)
사채할증발행차금				29,345	30,254
계				961,780	953,361

(*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*2) 종속기업 Harman International Industries에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며, 이자는 6개월마다 후급됩니다.

(*3) 종속기업 Harman Finance International SCA에서 발행하였고, 7년 만기 일시상환되며, 이자는 1년마다 후급됩니다.

12. 순확정급여부채(자산) :

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)와 관련하여 연결재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	7,470,384	7,302,621
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	271,745	234,315
소계	7,742,129	7,536,936
사외적립자산의 공정가치	(7,944,690)	(7,972,906)
순확정급여부채(자산) 계	(202,561)	(435,970)

나. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	208,965	226,348
순이자원가(수익)	(5,584)	(3,382)
기타	(1,782)	(2,724)
계	201,599	220,242

다. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	83,714	86,733
판매비와관리비 등	117,885	133,509
계	201,599	220,242

13. 총당부채 :

당분기 중 총당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여총당부채 (라)	기타총당부채 (마),(바)	계
기초	2,011,578	1,759,068	672,653	-	315,845	4,759,144
순전입액	458,035	81,001	69,436	1,169,886	33,973	1,812,331
사용액	(416,266)	(181,179)	(231,013)	(53,235)	(66,523)	(948,216)
기타(*)	16,338	4,925	(145)	90,181	33,587	144,886
당분기말	2,069,685	1,663,815	510,931	1,206,832	316,882	5,768,145

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여년도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 총당부채로 계상하고 있습니다.

마. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.

바. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 연결회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간 종료일 현재 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 만톤)

구 분	당분기말
무상할당 배출권	1,227
배출량 추정치	1,741

(2) 당분기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기
기초	25,059
취득	-
매각	-
당분기말	25,059

(3) 당분기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기
기초	13,116
순전입액	28,700
사용액	-
당분기말	41,816

14. 우발부채와 약정사항 :

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

내역	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증	40,732	49,937

나. 소송 등

(1) 보고기간 종료일 현재 Apple사와의 특허 관련 소송이 미국에서 진행중입니다. 해당 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 연결회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 평결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 연결회사 제품 판매금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 평결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 연결회사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 연결회사는 다시 항소하였으나, 2015년 10월 13일 항소가 기각되었고, 2015년 11월 19일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다.

연결회사는 2015년 12월 11일 일부 판결의 손해액을 Apple사에 지불하였고, 2015년 12월 14일 대법원에 디자인 관련 상고를 제기하였습니다. 이후 일부 판결 관련 부수적 손해 등에 대한 양사 서면이 1심 법원에 제출되었습니다. 2016년 3월 21일 대법원은 연결회사가 제기한 디자인 관련 상고를 허가하였고, 2016년 3월 22일 1심 법원은 2016년 3월 28일 시작 예정이었던 손해액 재재판을 포함하여 환송심의 모든 절차를 대법원 상고심 판결 시까지 정지하였습니다. 연결회사는 디자인 관련 상고심에서 2016년 6월 1일 본안 서면을 제출하였고, 2016년 6월 8일 여러 회사 및 단체 등이 연결회사 지지 서면을 제출하였습니다. Apple사는 2016년 7월 29일 반대 서면을 상고심에 제출하였고, 2016년 8월 5일 여러 회사 및 단체 등이 Apple사 지지 서면을 제출하였습니다. 연결회사는 2016년 8월 29일 반박 서면을 상고심에 제출하였습니다. 관련 상고심 구두변론은 2016년 10월 11일 대법원에서 진행되었습니다.

2016년 12월 6일 대법원은 회사 상고를 인용하는 판결을 내리고 사건을 항소심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 2월 7일 항소심 법원은 사건을 1심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 10월 12일 1심 법원은 디자인 관련 재재판 필요성에 대한 심리를 진행한 후 2017년 10월 22일 디자인 관련 재재판 진행 결정을 내렸습니다. 2018년 5월 14일부터 18일 1심 법원은 디자인 손해액을 재산정하는 재재판을 진행할 예정입니다.

또한, 2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두번째 소송과 관련해 연결회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 판결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 판결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 연결회사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 2016년 1월 5일 항소심 구두변론이 진행되었습니다. 별도로, 2014년 8월 27일 1심 법원은 Apple사의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소심법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고하였고, 2015년 12월 16일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 2016년 1월 18일 1심 법원은 판매금지결정을 내렸습니다. 2016년 2월 26일 항소심 재판부는 2014년 11월 25일 선고된 1심 판결을 번복하여 Apple사의 기술특허 관련하여 비침해 또는 무효를 판단하고 손해액을 파기하는 판결을 선고하였습니다. 2016년 3월 30일 Apple사는 항소심 재판부 판결에 대해 재심리 신청을 하였습니다. 2016년 10월 7일 항소심 전원합의체는 항소심 재판부 판결을 다시 번복하여, Apple사의 기술특허 관련하여 침해 및 유효를 판단하고 손해액 판결을 내렸습니다. 2017년 3월 10일 연결회사는 항소심 전원합의체 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다. 2017년 10월 4일 미국 법무부는 연결회사 상고에 반대하는 법정조언서를 대법원에 제출하였습니다. 2017년 11월 6일 대법원은 연결회사 상고를 기각하였습니다. 2018년 1월 11일 1심 법원은 추가 손해액 인정 여부에 대한 심리를 진행하였습니다. 2018년 2월 15일 1심 법원은 연결회사 회피설계를 받아들여 추가 손해액 중 일부만 인정하였습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간 종료일 현재 예측할 수 없습니다.

2014년 8월, 연결회사와 Apple사는 미국 외 지역에서의 소송을 취하한다는 합의에 이른 바 있으며, 보고기간 종료일 현재 미국 외 모든 국가에서 소송 취하가 완료되었습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 TFT-LCD 판매에 대한 가격담합과 관련된 일부 해외구매자들로 부터의 민사상 손해배상청구 등을 포함하여, 연결회사의 사업과 관련하여 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실 하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 기타 약정사항

삼성디스플레이는 2013년 10월 23일 Corning Incorporated 등과 포괄적 사업협력에 대한 기본계약을 체결하였습니다. 동 계약은 상호 간의 손실보전 조건을 포함하고 있어 향후 자원의 유입 또는 유출이 있을 수 있으며, 보고기간종료일 현재 지급이 예상되는 금액을 부채로 계상하였습니다.

15. 자본금 :

보고기간 종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)에서 25,000,000,000주(1주의 금액 : 100원)로 변경되었으며, 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각각 128,386,494주와 18,072,580주입니다 (주석 29 참조). 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 732,295백만원(보통주 641,932백만원 및 우선주 90,363백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다. 다만, 2018년 3월 23일 주식분할에 대한 주주총회 결의가 있었는 바, 구체적인 내용은 주석 29를 참고하시기 바랍니다.

16. 연결이익잉여금 :

가. 보고기간종료일 현재 연결회사의 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
임의적립금 등	150,745,342	139,629,195
연결미처분이익잉여금	71,740,056	76,182,005
계	222,485,398	215,811,200

나. 회사는 2018년 4월 26일 이사회결의에 의거 2018년 3월 31일을 배당기준일로 하여 분기배당을 지급하기로 하였으며, 당분기와 전분기의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기	전분기
배당받을 주식	보통주	119,395,651주	121,840,851주
	우선주	16,457,734주	17,069,534주
배당률(액면가 기준)		354%	140%
배당금액	보통주	2,113,303	852,886
	우선주	291,302	119,487
	계	2,404,605	972,373

17. 기타자본항목 :

가. 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(4,875,163)	(6,228,187)
매도가능금융자산평가이익	-	1,879,774
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	1,556,114	-
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	15,424	40,394
해외사업장환산외환차이	(8,154,756)	(9,192,002)
순확정급여부채 재측정요소	(441,082)	(405,206)
기타	(2,837)	6,036
계	(11,902,300)	(13,899,191)

나. 연결회사는 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 기명식보통주식 및 무의결권우선주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말		전기말	
	보통주	우선주	보통주	우선주
주식수(주)	8,990,843	1,614,846	9,410,125	1,720,171
취득가액(백만원)	4,435,755	439,408	5,560,506	667,681

18. 비용의 성격별 분류 :

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품 등의 변동	(1,306,234)	(1,012,033)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	19,238,798	17,067,611
급여	5,497,869	5,096,752
퇴직급여	234,381	236,784
감가상각비	5,915,263	4,769,499
무형자산상각비	351,073	371,959
복리후생비	1,024,489	932,518
지급수수료	1,606,075	1,843,706
광고선전비	914,523	818,878
판매촉진비	1,800,031	1,374,205
기타비용	9,645,276	9,149,286
계(*)	44,921,544	40,649,165

(*) 연결손익계산서상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비 :

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 판매비와관리비		
급여	1,582,945	1,588,303
퇴직급여	64,920	62,807
지급수수료	1,606,075	1,843,706
감가상각비	245,882	211,033
무형자산상각비	106,444	67,489
광고선전비	914,523	818,878
판매촉진비	1,800,031	1,374,205
운반비	579,251	785,644
서비스비	769,109	852,103
기타판매비와관리비	1,118,250	1,119,448
소계	8,787,430	8,723,616
(2) 경상연구개발비		
연구개발 총지출액	4,335,045	3,858,788
개발비 자산화	(110,403)	(88,836)
소계	4,224,642	3,769,952
계	13,012,072	12,493,568

20. 기타수익 및 기타비용 :

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 기타수익		
배당금수익	34,327	31,933
임대료수익	37,007	33,365
투자자산처분이익	1,558	74,448
유형자산처분이익	93,026	15,615
기타	205,058	161,062
계	370,976	316,423
(2) 기타비용		
유형자산처분손실	30,406	37,285
기부금	23,379	27,254
기타	191,478	212,695
계	245,263	277,234

21. 금융수익 및 금융비용 :

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 금융수익		
이자수익	451,305	400,606
- 대여금및수취채권	-	400,129
- 매도가능금융자산	-	477
- 상각후원가 측정 금융자산	451,237	-
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산	68	-
외환차이	1,471,871	1,485,057
파생상품관련이익	360,024	211,489
계	2,283,200	2,097,152
(2) 금융비용		
이자비용	136,223	148,390
- 상각후원가 측정 금융부채	71,742	90,298
- 기타금융부채	64,481	58,092
외환차이	1,603,939	1,492,524
파생상품관련손실	199,378	248,550
계	1,939,540	1,889,464

나. 연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용 :

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 27.7%입니다.

23. 주당이익 :

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기	전분기
지배회사지분 분기순이익	11,611,833	7,488,532
분기순이익 중 보통주 해당분	10,205,137	6,568,141
÷가중평균유통보통주식수	119,450	122,412
기본 보통주 주당이익(단위: 원)	85,435	53,656

(2) 우선주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기	전분기
지배회사지분 분기순이익	11,611,833	7,488,532
분기순이익 중 우선주 해당분	1,406,696	920,391
÷가중평균유통우선주식수	16,470	17,212
기본 우선주 주당이익(단위: 원)	85,408	53,473

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표 :

당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용	4,487,363	2,480,222
금융수익	(1,360,610)	(1,250,044)
금융비용	996,852	975,942
퇴직급여	234,381	236,784
감가상각비	5,915,263	4,769,499
무형자산상각비	351,073	371,959
대손상각비(환입)	(41,591)	17,573
배당금수익	(34,327)	(31,933)
지분법이익	(64,364)	(19,338)
유형자산처분이익	(93,026)	(15,615)
유형자산처분손실	30,406	37,285
재고자산평가손실 등	699,995	395,869
투자자산처분이익	(1,558)	(74,448)
기타	20,651	15,757
계	11,140,508	7,909,512

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 (증가)감소	(662,078)	2,125,284
미수금의 감소	939,281	168,469
선급금의 증가	(125,494)	(124,697)
장단기선급비용의 (증가)감소	(846,478)	142,215
재고자산의 증가	(2,193,860)	(3,893,502)
매입채무의 증가	142,328	3,083,919
장단기미지급금의 감소	(664,587)	(637,142)
선수금의 감소	(123,362)	(224,138)
예수금의 감소	(29,016)	(124,745)
미지급비용의 감소	(4,011,462)	(3,731,064)
총당부채의 증가	908,753	1,039,796
퇴직금의 지급	(110,481)	(199,537)
기타	(26,065)	(835,943)
계	(6,802,521)	(3,211,085)

25. 재무위험관리 :

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 연결회사는 해외 주요 권역별(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아) 지역 금융센터를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산, 당기손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

연결회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 또한 연결회사는 환율변동으로 인한 현금흐름의 불확실성과 손익변동을 최소화하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 연결회사의 환위험 관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

연결회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당분기 및 전기 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 29,964백만원 및 29,086백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

연결회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 변동위험의 발생을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재정팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성 위험

연결회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 연결회사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금 부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 줄이는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

연결회사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	89,213,233	87,260,662
자 본	223,259,880	214,491,428
부채비율	40.0%	40.7%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간 종료일 현재 연결회사 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	32,303,752	(*1)	30,545,130	(*1)
단기금융상품	46,027,700	(*1)	49,447,696	(*1)
단기매도가능금융자산	-	-	3,191,375	3,191,375
단기상각후원가금융자산	3,733,160	(*1)	-	-
매출채권	35,370,654	(*1)	27,695,995	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	-	-	7,752,180	6,561,155
만기보유금융자산	-	-	106,751	(*1)
상각후원가금융자산	260,660	(*1)	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,997,753	6,997,753	-	-
당기손익-공정가치금융자산	624,086	624,086	-	-
기타(*3)	5,862,025	144,194	6,325,825	113,098
소 계	131,179,790		125,064,952	
금융부채				
매입채무	9,301,132	(*1)	9,083,907	(*1)
단기차입금	9,973,335	(*1)	15,767,619	(*1)
미지급금(*3)	13,638,340	318,826	12,106,609	316,928
유동성장기부채	15,631	(*1)	278,619	(*1)
사채	961,780	980,596	953,361	978,643
장기차입금	1,910,470	(*1)	1,814,446	(*1)
장기미지급금(*3)	1,636,623	28,156	1,746,184	28,285
기타(*3)	10,307,130	155,229	10,954,513	222,012
소 계	47,744,441		52,705,258	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 전기말 현재 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액 1,191,025백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 취득원가로 평가한 금액 금융자산 5,717,831백만원(전기 : 6,212,727백만원) 및 금융부채 25,079,882백만원(전기 : 24,240,081백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 연결회사 금융상품의 공정가치 서열 체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,985,939	51,146	3,960,668	6,997,753
당기손익-공정가치금융자산	10,497	-	613,589	624,086
기타	-	144,194	-	144,194
(2) 부 채				
미지급금	-	-	318,826	318,826
사채	-	980,596	-	980,596
장기미지급금	-	-	28,156	28,156
기타	-	148,555	6,674	155,229

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,191,375	-	3,191,375
장기매도가능금융자산	2,908,581	-	3,652,574	6,561,155
기타	-	113,098	-	113,098
(2) 부 채				
미지급금	-	-	316,928	316,928
사채	-	978,643	-	978,643
장기미지급금	-	-	28,285	28,285
기타	-	215,307	6,705	222,012

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

연결회사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

1) 연결회사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2) Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산				
말타니	15,137	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.69%~9.69%(8.69%)
삼성벤처투자	7,784	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	19.56%~21.56%(20.56%)
Corning Incorporated 전환우선주	3,354,475	상향모형	위험 할인율	5.55%~7.55%(6.55%)
			가격 변동성	26.2%~32.2%(29.2%)
미지급금				
조건부금융부채	318,826	현금흐름할인모형	할인율	3.81%~4.65%(4.23%)
장기미지급금				
조건부금융부채	28,156	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	10.50%
			무위험할인율	0.97%
			자산변동성	34.54%
			신용스프레드	2.12%
기타				
조건부금융부채	4,959	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	17.57%
			무위험할인율	0.86%
			영업레버리지율	60.00%
			매출총이익할인율	6.68%
조건부금융부채	1,715	확률가중모형	가중평균자본비용	8.60%
			신용위험	2.12%

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	3,652,574	3,464,272
당기손익으로 인식된 손익	(4,565)	-
기타포괄손익으로 인식된 손익	(275,224)	(64,078)
기타	1,201,472	-
분기말	4,574,257	3,400,194

(단위: 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	351,918	342,702
당기손익으로 인식된 손익	3,367	(22,844)
사업결합으로 인한 취득	-	39,083
기타	(1,629)	(1,352)
분기말	353,656	357,589

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과 (기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	135,964	-	(131,988)
장기미지급금(*2)	112	112	(112)	(112)
계	112	136,076	(112)	(132,100)

(*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 변동성(26.2%~32.2%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 미지급금은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 10% 만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 부문별 보고 :

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간 종료일 현재 보고부문은 CE, IM, 반도체, DP, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 아니하였습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	CE	IM	DS			Harman	계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP				
매출액	21,396,841	60,312,806	56,023,663	39,514,424	15,180,352	2,545,062	140,607,363	(80,043,649)	60,563,714
내부매출액	(11,655,167)	(31,862,693)	(27,677,560)	(18,731,238)	(7,643,766)	(604,223)	(80,043,649)	80,043,649	-
순매출액(*2)	9,741,674	28,450,113	28,346,103	20,783,186	7,536,586	1,940,839	60,563,714	-	60,563,714
감가상각비	139,294	292,535	5,338,964	3,680,464	1,622,565	56,426	5,915,263	-	5,915,263
무형자산상각비	14,158	34,177	202,278	168,189	30,602	54,391	351,073	-	351,073
영업이익	275,153	3,769,623	11,763,656	11,550,359	408,263	(36,740)	15,642,170	-	15,642,170

(*1) 기타 부문은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

구 분	CE(*3)	IM	DS			계(*1)	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
			계(*1)	반도체	DP			
매출액	23,483,859	48,441,473	45,830,090	29,499,953	15,287,585	119,738,263	(69,190,737)	50,547,526
내부매출액	(13,267,718)	(24,943,118)	(22,981,482)	(13,839,526)	(7,995,300)	(69,190,737)	69,190,737	-
순매출액(*2)	10,216,141	23,498,355	22,848,608	15,660,427	7,292,285	50,547,526	-	50,547,526
감가상각비	142,303	327,982	4,189,016	3,103,079	1,030,389	4,769,499	-	4,769,499
무형자산상각비	9,507	39,390	251,855	216,915	30,448	371,959	-	371,959
영업이익	414,516	2,065,338	7,591,995	6,313,995	1,304,949	9,898,361	-	9,898,361

(*1) 기타 부문은 별도로 표시하지 아니하였습니다.

(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(*3) 의료기기 사업부가 CE에서 기타로 보고부문의 구성이 변경되어, 해당 부문정보를 재작성하였습니다.

나. 지역별 정보

당분기와 전분기의 지역별 영업현황(소재지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	8,520,783	19,799,354	11,023,997	11,612,285	9,607,295	-	60,563,714
비유동자산(*)	92,231,385	10,325,354	6,197,668	11,781,471	9,479,128	(797,341)	129,217,665

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	5,897,439	15,384,428	9,281,196	10,645,980	9,338,483	-	50,547,526
비유동자산(*)	72,852,400	17,315,395	738,074	9,989,933	9,968,970	(558,983)	110,305,789

(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

27. 특수관계자와의 거래 :

가. 매출·매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	40,759	-	545,409	65,109
	삼성전기	25,519	-	709,091	-
	삼성SDI	25,077	-	213,099	14,813
	제일기획	23,196	-	217,172	1,029
	기타	322,777	-	2,271,480	45,333
	관계기업 및 공동기업 계	437,328	-	3,956,251	126,284
그 밖의 특수관계자	삼성물산	39,553	-	96,256	761,324
	기타	40,978	-	227,270	178,605
	그 밖의 특수관계자 계	80,531	-	323,526	939,929
기타(*2)	삼성엔지니어링	1,264	-	1,451	284,177
	에스원	8,340	-	90,563	12,130
	기타	19,560	-	49,720	16,669
	기타 계	29,164	-	141,734	312,976

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	22,853	-	425,139	65,017
	삼성전기	16,435	-	527,080	-
	삼성SDI	25,767	-	241,148	3,647
	제일기획	9,632	-	122,581	667
	기타	118,776	-	1,989,777	46,730
	관계기업 및 공동기업 계	193,463	-	3,305,725	116,061
그 밖의 특수관계자	삼성물산	49,706	68	69,839	531,208
	기타	37,604	35	211,202	39,281
	그 밖의 특수관계자 계	87,310	103	281,041	570,489
기타(*2)	삼성엔지니어링	1,715	-	3,860	380,680
	에스원	8,491	-	81,826	11,395
	기타	17,113	-	22,214	-
	기타 계	27,319	-	107,900	392,075

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

나. 채권·채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	2,959	401,905
	삼성전기	4,529	341,535
	삼성SDI	88,690	109,598
	제일기획	489	320,592
	기타	227,663	878,659
	관계기업 및 공동기업 계	324,330	2,052,289
그 밖의 특수관계자	삼성물산	249,118	256,489
	기타(*2)	112,260	1,688,603
	그 밖의 특수관계자 계	361,378	1,945,092
기타(*3)	삼성엔지니어링	1,383	39,281
	에스원	7,832	42,050
	기타	2,798	48,987
	기타 계	12,013	130,318

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등 금액에는 삼성카드와의 구매카드 미결제금액 1,483,738백만원이 포함되어 있습니다. 삼성카드와의 구매카드 약정한도는 2,543,000백만원이며, 당기 중 사용 및 상환한 금액은 각각 1,483,794백만원 및 1,121,388백만원입니다.

(*3) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	14,182	406,760
	삼성전기	7,052	197,364
	삼성SDI	90,370	97,193
	제일기획	369	500,706
	기타	250,059	954,537
	관계기업 및 공동기업 계	362,032	2,156,560
그 밖의 특수관계자	삼성물산	242,506	731,995
	기타(*2)	29,457	1,313,314
	그 밖의 특수관계자 계	271,963	2,045,309
기타(*3)	삼성엔지니어링	2,518	652,519
	에스원	2,589	58,309
	기타	3,369	35,774
	기타 계	8,476	746,602

(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 채무 등 금액에는 삼성카드와의 구매카드 미결제금액 1,121,331백만원이 포함되어 있습니다. 삼성카드와의 구매카드 약정한도는 2,343,000백만원이며, 당기 중 사용 및 상환한 금액은 각각 5,091,576백만원 및 5,279,430백만원입니다.

(*3) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 17,137백만원 및 4,160백만원을 추가로 출자하였으며, 출자원금 148백만원 및 52,204백만원을 회수하였습니다.

라. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 516,419백만원 및 661,516백만원입니다. 당분기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 516,419백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 및 전분기 중 지급 결의한 배당금은 39,912백만원 및 51,050백만원입니다. 당분기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 39,912백만원입니다.

마. 주요 경영진에 대한 보상

당분기 및 전분기 중 연결회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	3,724	2,445
퇴직급여	436	198
기타 장기급여	2,724	2,154

28. 사업결합 :

전분기 중 발생한 주요한 사업결합 거래는 다음과 같습니다.

연결회사의 종속기업 Samsung Electronics America는 신성장 분야인 전장사업을 본격화 하고 오디오 사업을 강화하기 위해 2017년 3월 10일자로 Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업의 지분 100%를 인수하였습니다.

가. 피인수회사의 개요

구 분	내 용
피인수회사명	Harman International Industries, Inc. 외 109개 종속기업
본점소재지	Stamford, CT, USA
대표이사	Dinesh Paliwal
업종	오디오 및 비디오시스템 부품의 디자인, 개발, 제조 및 공급

나. 인수회계처리

(단위: 백만원)

구 분	금 액
I. 이전대가	9,272,702
II. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
현금및현금성자산	647,729
매출채권 및 기타채권	1,533,437
재고자산	1,068,865
유형자산	858,790
무형자산	5,564,309
기타자산	902,824
매입채무 및 기타채무	3,436,020
이연법인세부채	1,442,527
기타부채	873,637
총 식별가능한 순자산	4,823,770
III. 영업권 (I - II)	4,448,932

Harman과 그 종속기업이 2017년 1월 1일부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우, 연결 손익계산서에 포함될 전분기 매출 및 당기순이익은 2,015,773백만원 및 28,721백만원이며, 연결대상 편입 이후 Harman과 그 종속기업으로부터 발생한 전분기 매출 및 당기순이익은 537,749백만원 및 24,449백만원입니다.

29. 보고기간 후 사건 :

연결회사는 2018년 1월 31일 이사회 결의 및 2018년 3월 23일 주주총회 결의로 발행할 주식의 총수는 25,000,000,000주(1주의 금액 : 100원)로, 발행한 보통주식 및 우선주식의 수는 각각 6,419,324,700주 및 903,629,000주로 변경될 예정이며, 보고기간 종료일 이후 상법 제329조의2에 따라 구주권제출의 공고기간이 만료된 때인 2018년 5월 3일에 주식분할의 효력이 발생하고 2018년 5월 4일 주식분할로 인한 주권 변경상장 등 절차가 진행될 예정입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 50 기 1분기말 2018.03.31 현재

제 49 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 50 기 1분기말	제 49 기말
자산		
유동자산	72,370,085	70,155,189
현금및현금성자산	7,769,590	2,763,768
단기금융상품	20,136,857	25,510,064
매출채권	30,045,336	27,881,777
미수금	1,288,618	2,201,402
선급금	903,251	1,097,598
선급비용	2,380,965	2,281,179
재고자산	8,915,860	7,837,144
기타유동자산	929,608	582,257
비유동자산	132,836,079	128,086,171
장기매도가능금융자산		973,353
기타포괄손익-공정가치금융자산	981,073	
당기손익-공정가치금융자산	9,313	
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	55,730,367	55,671,759
유형자산	66,737,192	62,816,961
무형자산	2,823,356	2,827,035
장기선급비용	3,158,573	3,031,327
순확정급여자산	626,827	811,210
이연법인세자산	513,258	586,161
기타비유동자산	2,256,120	1,368,365
자산총계	205,206,164	198,241,360
부채		
유동부채	47,168,741	44,495,084
매입채무	9,817,029	6,398,629
단기차입금	7,657,877	12,229,701
미지급금	11,323,959	9,598,654
선수금	231,052	214,007
예수금	471,196	500,740
미지급비용	4,980,808	6,657,674

미지급법인세	9,553,005	6,565,781
유동성장기부채	5,183	5,201
총당부채	2,893,526	2,273,688
기타유동부채	235,106	51,009
비유동부채	1,842,051	2,176,501
사채	46,651	46,808
장기미지급금	1,365,702	1,750,379
장기총당부채	429,605	379,201
기타비유동부채	93	113
부채총계	49,010,792	46,671,585
자본		
자본금	897,514	897,514
우선주자본금	119,467	119,467
보통주자본금	778,047	778,047
주식발행초과금	4,403,893	4,403,893
이익잉여금(결손금)	154,284,538	150,928,724
기타자본항목	(3,390,573)	(4,660,356)
자본총계	156,195,372	151,569,775
자본과부채총계	205,206,164	198,241,360

손익계산서

제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 50 기 1분기		제 49 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	42,606,978	42,606,978	34,578,524	34,578,524
매출원가	25,196,260	25,196,260	22,941,536	22,941,536
매출총이익	17,410,718	17,410,718	11,636,988	11,636,988
판매비와관리비	6,209,821	6,209,821	5,961,417	5,961,417
영업이익(손실)	11,200,897	11,200,897	5,675,571	5,675,571
기타수익	270,127	270,127	766,581	766,581
기타비용	40,883	40,883	112,838	112,838
금융수익	799,826	799,826	859,048	859,048
금융비용	660,990	660,990	878,618	878,618
법인세비용차감전순이익(손실)	11,568,977	11,568,977	6,309,744	6,309,744
법인세비용	3,116,519	3,116,519	1,435,977	1,435,977
계속영업이익(손실)	8,452,458	8,452,458	4,873,767	4,873,767
당기순이익(손실)	8,452,458	8,452,458	4,873,767	4,873,767
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위:원) (단위 : 원)	62,189	62,189	34,920	34,920
희석주당이익(손실) (단위:원) (단위 : 원)	62,189	62,189	34,920	34,920

포괄손익계산서

제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 50 기 1분기		제 49 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익(손실)	8,452,458	8,452,458	4,873,767	4,873,767
기타포괄손익	(22,220)	(22,220)	53,899	53,899
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(22,220)	(22,220)	(34,513)	(34,513)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	13,198	13,198		
순확정급여자산 재측정요소	(35,418)	(35,418)	(34,513)	(34,513)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익			88,412	88,412
매도가능금융자산평가손익			88,412	88,412
총포괄손익	8,430,238	8,430,238	4,927,666	4,927,666

자본변동표

제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

		자본				
		자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	140,747,574	(8,502,219)	137,546,762
회계정책변경누적효과						
수정후 기초자본		897,514	4,403,893	140,747,574	(8,502,219)	137,546,762
자본의 변동	포괄손익					
	당기순이익(손실)			4,873,767		4,873,767
	매도가능금융자산평가				88,412	88,412
	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익					
	순확정급여자산 재측정요소				(34,513)	(34,513)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
	배당			(3,850,352)		(3,850,352)
	자기주식의 취득				(2,045,795)	(2,045,795)
	자기주식의 소각					
2017.03.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	141,770,989	(10,494,115)	136,578,281
2018.01.01 (기초자본)		897,514	4,403,893	150,928,724	(4,660,356)	151,569,775
회계정책변경누적효과				61,021	(61,021)	
수정후 기초자본		897,514	4,403,893	150,989,745	(4,721,377)	151,569,775
자본의 변동	포괄손익					
	당기순이익(손실)			8,452,458		8,452,458
	매도가능금융자산평가					
	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				13,198	13,198
	순확정급여자산 재측정요소				(35,418)	(35,418)
	자본에 직접 인식된 주주와의 거래					
	배당			(2,929,530)		(2,929,530)
	자기주식의 취득				(875,111)	(875,111)
	자기주식의 소각			(2,228,135)	2,228,135	
2018.03.31 (기말자본)		897,514	4,403,893	154,284,538	(3,390,573)	156,195,372

현금흐름표

제 50 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지

제 49 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 50 기 1분기	제 49 기 1분기
영업활동 현금흐름	13,056,587	7,087,039
영업에서 창출된 현금흐름	12,448,884	8,014,616
당기순이익	8,452,458	4,873,767
조정	6,447,338	3,696,372
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,450,912)	(555,523)
이자의 수취	94,118	130,077
이자의 지급	(53,935)	(51,058)
배당금 수입	615,485	504
법인세 납부액	(47,965)	(1,007,100)
투자활동 현금흐름	(2,629,346)	(1,651,453)
단기금융상품의 순감소(증가)	5,373,207	8,600,272
장기매도가능금융자산의 처분		3,059
장기매도가능금융자산의 취득		(529)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	532	
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(460)	
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	1,868	
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	148	49,055
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(58,755)	(6,005,553)
유형자산의 처분	141,569	95,309
유형자산의 취득	(7,870,910)	(4,244,626)
무형자산의 처분		95
무형자산의 취득	(218,113)	(155,862)
현금의 기타유출입	1,568	7,327
재무활동 현금흐름	(5,421,419)	(4,331,326)
단기차입금의 순증가(감소)	(4,546,306)	(2,285,529)
자기주식의 취득	(875,111)	(2,045,795)
배당금 지급	(2)	(2)
외화환산으로 인한 현금의 변동		(8,029)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	5,005,822	1,096,231
기초 현금 및 현금성자산	2,763,768	3,778,371
기말 현금 및 현금성자산	7,769,590	4,874,602

이익잉여금처분계산서

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 47 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과 목	제 49 기		제 48 기		제 47 기	
I. 미처분이익잉여금		14,031,533		38,248		12,089,583
1. 전기이월이익잉여금	31		30		30	
2. 분기배당액 제49기 - 주당배당금(률) : 21,000원 (420%) 제48기 - 주당배당금(률) : 1,000원(20%) 제47기 - 주당배당금(률) : 1,000원(20%)	(2,896,772)		(141,540)		(148,916)	
3. 자기주식 소각	(11,872,563)		(11,399,991)		-	
4. 당기순이익	28,800,837		11,579,749		12,238,469	
II. 임의적립금 등의 이입액		-		3,812,135		-
1. 기업합리화적립금	-		3,812,135		-	
III. 이익잉여금처분액		14,031,503		3,850,352		12,089,553
1. 기업합리화적립금	3,000,000		-		3,000,000	
2. 배당금 주당배당금(률) 제49기 - 보통주 : 21,500원(430%) 우선주 : 21,550원(431%) 제48기 - 보통주 : 27,500원(550%) 우선주 : 27,550원(551%) 제47기 - 보통주 : 20,000원(400%) 우선주 : 20,050원(401%)	2,929,530		3,850,352		2,919,821	
3. 연구및인력개발준비금	8,000,000		-		5,000,000	
4. 시설적립금	101,973		-		1,169,732	
III. 차기이월미처분이익잉여금		30		31		30

5. 재무제표 주석

제 50 기 분기 : 2018년 3월 31일 현재

제 49 기 : 2017년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사

1. 일반적 사항 :

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문으로 구성되어 있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, Foundry, System LSI 등의 반도체 사업으로 구성되어 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

이 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.

2. 중요한 회계처리방침

2.1. 재무제표 작성기준

회사의 2018년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간종료일인 2018년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 회사가 채택한 제·개정 기준서

회사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정

회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 제정

회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

- 기업회계기준해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정

제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 부채, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 기업회계기준해석서 제2122호의 채택으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서

2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 기업회계기준해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체할 예정입니다.

회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단하며, 최초 적용일에도 동 기준서에 따라 계약이 리스인지, 리스를 포함하고 있는지를 식별합니다. 다만, 회사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않을 수 있습니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리해야 합니다. 리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예: 기초자산 \$5,000 이하) 리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있습니다. 또한, 리스이용자는 실무적 간편법으로 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택하여 적용할 수 있습니다.

리스제공자 회계처리는 현행 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변동되지 않았습니다.

(1) 리스이용자로서의 회계처리

리스이용자는 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류'에 따라 표시되는 각 과거 보고기간에 소급 적용하는 방법(완전 소급법)과, 최초 적용일에 최초 적용 누적효과를 인식하도록 소급 적용하는 방법(누적효과 일괄조정 경과조치) 중 하나의 방법으로 적용할 수 있습니다. 회사는 아직 그 적용방법을 선택하지 않았습니다.

회사는 보고기간 종료일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 기업회계기준서 제1116호 적용시 2018년 재무제표에 미치는 잠재적인 영향을 예비 평가 중에 있으며, 향후 추가적인 정보에 기초하여 보다 구체적인 재무적 영향을 분석할 예정입니다.

(2) 리스제공자로서의 회계처리

회사는 리스제공자로서 현재의 리스 회계처리가 기업회계기준서 제1116호를 적용하더라도 유의적으로 달라지지 않아 재무제표에 미치는 영향도 유의적이지 않을 것으로 예상합니다.

2.2. 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

가. 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

나. 금융자산

(1) 분류

2018년 1월 1일부터 회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

- 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치측정 금융자산

상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

다. 금융부채

(1) 분류 및 측정

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 당기손익-공정가치 측정 금융부채. 파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채. 이러한 금융부채는 주석 2.2. 나)의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 금융보증계약. 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정. 최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 기업회계기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가. 이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

라. 수익인식

회사는 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

(1) 수행의무의 식별

회사는 Incoterms Group C 조건(무역조건 CIF 등) 따라 다양한 제품 및 상품을 수출하고 있습니다. 고객에게 통제가 이전된 이후 매도인이 운송서비스를 제공하므로 해당 운송서비스(보험 포함)를 별도의 수행의무로 인식합니다.

(2) 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무

회사는 조달청을 통해 수주되는 시스템에어컨 도급공사계약에 따라 고객에게 제품을 납품하고 설치를 수행하고 있습니다. 기업회계기준서 제1115호에 따르면 기업이 수행하여 만들어지거나 가치가 높아지는 대로 고객이 통제하는 자산을 기업이 만들거나 그 자산가치를 높이는 경우 진행기준을 적용하여 수익을 인식하여야 합니다. 이에 따라 시스템에어컨 설치용역의 경우 용역 수행 경과에 따른 결과물을 고객이 직접 통제하기 때문에 진행기준을 적용하여 수익을 인식합니다.

(3) 변동대가

회사는 받을 권리를 갖게 될 대가를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 기댓값 방법을 사용하여 변동 대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 기업이 받았거나 받을 대가 중에서 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는 금액은 환불부채로 인식하고, 고객이 반품 권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로 그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.

(4) 거래가격의 배분

회사는 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법' 등을 사용합니다.

2.3. 회계정책의 변경

가. 기준서 제1109호 '금융상품'의 적용

회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(1) 금융상품의 분류와 측정

1) 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융상품 계정별 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	측정 범주		장부금액	
	K-IFRS 제1039호	K-IFRS 제1109호	K-IFRS 제1039호	K-IFRS 제1109호
금융자산				
현금및현금성자산	대여금및수취채권	상각후원가	2,763,768	2,763,768
단기금융상품	대여금및수취채권	상각후원가	25,510,064	25,510,064
매출채권	대여금및수취채권	상각후원가	27,881,777	27,881,777
장기매도가능금융자산	매도가능금융자산	기타포괄손익-공정가치	973,353	963,534
		당기손익-공정가치		9,819
기타	대여금및수취채권	상각후원가	3,623,263	3,623,263
소 계			60,752,225	60,752,225

금융부채의 경우 상각후원가 측정 금융부채는 상각후원가로 분류하였습니다.

2) 당기초 현재 금융상품의 재분류로 인해 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	이익잉여금	기타자본항목	
		매도가능금융자산 평가손익	기타포괄손익- 공정가치 평가손익
기초 장부금액-기준서 제1039호	150,928,724	169,423	-
조정 :			
매도가능금융자산에서 기타포괄손익- 공정가치금융자산으로 재분류	61,021	(169,423)	108,402
기초 장부금액-기준서 제1109호	150,989,745	-	108,402

(2) 금융자산의 손상

회사는 기준서 제1109호의 새로운 기대신용손실 모형 적용대상이 되는 세가지 유형의 금융자산을 보유하고 있습니다.

- 재고자산의 매출에 따른 매출채권
- 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품
- 상각후원가로 측정되는 채무상품

회사는 기준서 제1109호의 도입으로 손상차손의 인식 관련 정책을 변경하였습니다.

매출채권의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용합니다. 기준서 제 1109호의 도입에 따라 기대신용위험모형의 적용으로 인한 조정금액은 경미합니다.

(3) 위험회피회계

당기초 현재 통화선도 위험회피는 기준서 제1109호의 현금흐름위험회피 적용조건을 충족합니다. 또한, 회사의 위험관리전략과 위험회피 문서화는 기준서 제1109호의 요구사항을 충족하며 이에 따라 위험회피관계는 지속되는 것으로 회계처리하였습니다.

나. 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 적용

회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1115호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(1) 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1115호의 도입으로 인해 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기준서 제1115호 채택 전 금액	조 정	기준서 제1115호 조정 후 금액
매출채권	27,881,777	402,367	28,284,144
선급비용	2,281,179	2,179	2,283,358
재고자산	7,837,144	(78,839)	7,758,305
기타유동자산	582,257	83,159	665,416
자산 총계	198,241,360	408,866	198,650,226
미지급비용	6,657,674	206,526	6,864,200
기타유동부채	51,009	202,340	253,349
부채 총계	46,671,585	408,866	47,080,451
자본 총계	151,569,775	-	151,569,775

(2) K-IFRS 제1115호를 최초 적용한 보고기간인 당분기말 현재 변경 전 기준에 따라 영향을 받는 재무제표의 각 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기준서 제1115호 채택 전 금액	조 정	기준서 제1115호 조정 후 금액
매출	42,605,806	1,172	42,606,978
매출원가	25,195,088	1,172	25,196,260
매출총이익	17,410,718	-	17,410,718
영업이익	11,200,897	-	11,200,897
법인세비용	3,116,519	-	3,116,519
분기순이익	8,452,458	-	8,452,458
분기총포괄이익	8,430,238	-	8,430,238

기준서 제1115호의 적용으로 인해 각각의 영업활동, 투자활동 및 재무활동 총 현금흐름은 동일합니다.

한편, 당분기말 및 당기초 현재 계약부채는 721,600백만원 및 454,003백만원이며, 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

2.4. 중요한 회계추정 및 가정

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 아래에서 설명하는 기준서 제 1109호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

가. 금융자산의 손상

기준서 제 1109호의 금융자산의 손실충당금은 채무불이행위험과 기대신용률에 대한 가정에 근거하였습니다. 회사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간말의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

3. 범주별 금융상품 :

보고기간종료일 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	계
현금및현금성자산	7,769,590	-	-	7,769,590
단기금융상품	20,136,857	-	-	20,136,857
매출채권	30,045,336	-	-	30,045,336
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	981,073	-	981,073
당기손익-공정가치금융자산	-	-	9,313	9,313
기타	3,443,406	-	64,310	3,507,716
계	61,395,189	981,073	73,623	62,449,885

(단위: 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	9,817,029	-	9,817,029
단기차입금	-	7,657,877	7,657,877
미지급금	11,104,441	-	11,104,441
유동성장기부채	5,183	-	5,183
사채	46,651	-	46,651
장기미지급금	1,152,312	-	1,152,312
기타	4,238,899	-	4,238,899
계	26,364,515	7,657,877	34,022,392

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보차입금 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	계
현금및현금성자산	2,763,768	-	2,763,768
단기금융상품	25,510,064	-	25,510,064
매출채권	27,881,777	-	27,881,777
장기매도가능금융자산	-	973,353	973,353
기타	3,623,263	-	3,623,263
계	59,778,872	973,353	60,752,225

(단위: 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	6,398,629	-	6,398,629
단기차입금	-	12,229,701	12,229,701
미지급금	9,465,685	-	9,465,685
유동성장기부채	5,201	-	5,201
사채	46,808	-	46,808
장기미지급금	1,537,329	-	1,537,329
기타	3,549,549	-	3,549,549
계	21,003,201	12,229,701	33,232,902

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보차입금 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산 :

가. 보고기간 종료일 현재 공정가치금융자산 구성내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분상품	981,073	-

(2) 당기손익-공정가치금융자산

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
채무상품	9,313	-

상기 금융상품들은 전기에 매도가능금융자산으로 분류되었습니다.

나. 당분기말 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기 업 명	당분기말			
	보유주식수(주)	지분율(%)(*)	취득원가	장부가액 (시장가치)
삼성중공업	65,930,982	16.9	473,727	508,988
호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	192,252
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	6,473
에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	17,273
원익홀딩스	1,759,171	2.3	15,410	12,930
원익아이피에스	1,850,936	4.5	16,214	61,636
케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	2,928
동진세미캠	2,467,894	4.8	48,277	36,278
솔브레인	835,110	4.8	55,618	49,188
용평리조트	400,000	0.8	1,869	3,008
계			655,088	890,954

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 장기매도가능금융자산 :

가. 보고기간종료일 현재 회사의 장기매도가능금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
지분증권 - 상장주식	-	872,749
지분증권 - 비상장주식	-	99,674
채무증권(*)	-	930
계	-	973,353

(*) 보고기간종료일 현재 매도가능금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대노출금액은 장부 금액입니다.

나. 전기말 현재 장기매도가능금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

기업명	전기말			
	보유주식수(주)	지분율(%)(*)	취득원가	장부가액 (시장가치)
삼성중공업	65,930,982	16.9	473,727	483,275
호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	170,200
아이마켓코리아	647,320	1.8	324	5,832
에이테크솔루션	1,592,000	15.9	26,348	19,423
원익홀딩스	1,759,171	2.3	15,410	13,880
원익아이피에스	1,850,936	4.5	16,214	61,821
케이티스카이라이프	240,000	0.5	3,344	3,228
동진씨미캠	2,467,894	4.8	48,277	54,540
솔브레인	835,110	4.8	55,618	56,370
용평리조트	400,000	0.8	1,869	4,180
계			655,088	872,749

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

취득원가는 회수가능액이 취득원가에 미달하여 인식한 매도가능금융자산 손상차손을 차감하지 아니한 금액입니다. 손상차손 금액을 제외한 취득원가와 시가의 차액은 자본항목에 직접 반영되는 법인세효과를 감안한 후 기타자본항목(매도가능금융자산평가손익)으로 계상하고 있습니다.

6. 재고자산 :

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			전기말		
	평가전금액	평가총당금(*)	장부가액	평가전금액	평가총당금(*)	장부가액
제품 및 상품	2,022,269	(333,029)	1,689,240	2,187,441	(484,364)	1,703,077
반제품 및 재공품	5,373,161	(107,669)	5,265,492	4,512,627	(124,510)	4,388,117
원재료 및 저장품	1,846,461	(322,137)	1,524,324	1,643,250	(263,886)	1,379,364
미착품	436,804	-	436,804	366,586	-	366,586
계	9,678,695	(762,835)	8,915,860	8,709,904	(872,760)	7,837,144

(*) 회사는 생산 및 판매 중단한 재고자산을 순실현가능가치로 평가하고 원가와와의 차이를 평가총당금으로 반영하였습니다.

7. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 :

가. 당분기 및 전분기 중 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	55,671,759	48,743,079
취득	58,755	6,005,553
처분	(147)	(48,884)
분기말장부가액	55,730,367	54,699,748

나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 투자 현황은 다음과 같습니다
(종속기업 현황은 주석 26 참조).

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장
삼성전기	수동소자, 회로부품, 모듈 등 전자부품의 생산 및 공급	23.7	한국
삼성에스디에스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합/관리업 등 IT서비스 및 물류서비스 제공	22.6	한국
삼성바이오로직스	신사업 투자	31.5	한국
삼성SDI(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국
제일기획	광고 대행업	25.2	한국

(*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

(*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

다. 보고기간종료일 현재 시장성있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	당분기말			전기말	
	주식수	시장가치	장부가액	시장가치	장부가액
삼성전기	17,693,084	1,866,620	445,244	1,769,308	445,244
삼성에스디에스	17,472,110	4,464,124	560,827	3,494,422	560,827
삼성바이오로직스	20,836,832	10,147,537	443,193	7,730,465	443,193
삼성SDI	13,462,673	2,591,565	1,242,605	2,753,117	1,242,605
제일기획	29,038,075	522,685	491,599	615,607	491,599

8. 유형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부가액	62,816,961	47,228,830
일반취득 및 자본적지출	7,075,127	4,495,605
감가상각	(3,067,033)	(2,497,564)
처분/폐기/손상	(49,726)	(28,954)
기타	(38,137)	(43,969)
분기말순장부가액	66,737,192	49,153,948

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	2,762,954	2,193,666
판매비와관리비 등	304,079	303,898
계	3,067,033	2,497,564

9. 무형자산 :

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	2,827,035	2,891,844
내부개발에 의한 취득	110,403	88,836
개별 취득	107,710	67,026
상각	(235,011)	(292,519)
처분/폐기/손상	(10,423)	(1,979)
기타	23,642	39,890
분기말장부가액	2,823,356	2,793,098

나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	167,170	224,881
판매비와관리비 등	67,841	67,638
계	235,011	292,519

10. 차입금 :

보고기간종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	금 액	
		당분기말	당분기말	전기말
담보부차입금	우리은행 외	0.1 ~ 11.2	7,657,877	12,229,701

상기 담보부차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.

11. 사채 :

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	발행일	만기상환일	연이자율(%)	금 액	
			당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated Straight Bonds	1997.10.2	2027.10.1	7.7	53,325 (US\$50,000천)	53,570 (US\$50,000천)
1년 이내 만기도래분(유동성사채)				(5,333)	(5,357)
사채할인발행차금				(1,341)	(1,405)
계				46,651	46,808

상기 사채는 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.

12. 순확정급여자산 :

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여자산과 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	5,762,037	5,609,870
기금이 적립되지 않는 확정급여채무의 현재가치	13,062	12,717
소 계	5,775,099	5,622,587
사외적립자산의 공정가치	(6,401,926)	(6,433,797)
순확정급여(자산) 계	(626,827)	(811,210)

나. 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	150,830	164,022
순이자원가(수익)	(8,240)	(5,911)
계	142,590	158,111

다. 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	55,458	59,176
판매비와관리비 등	87,132	98,935
계	142,590	158,111

13. 총당부채 :

당분기 중 총당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	판매보증 (가)	기술사용료 (나)	장기성과급 (다)	상여총당부채 (라)	기타총당부채 (마), (바)	계
기초	188,333	1,663,429	577,180	-	223,947	2,652,889
순전입액	60,552	80,444	50,404	903,332	32,328	1,127,060
사용액	(70,821)	(181,179)	(197,979)	-	(45,407)	(495,386)
기타(*)	-	4,959	-	-	33,609	38,568
당분기말	178,064	1,567,653	429,605	903,332	244,477	3,323,131

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다.

가. 회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 총당부채로 설정하고 있습니다.

나. 회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다. 상기 금액의 지급시기는 협상경과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 총당부채로 계상하고 있습니다.

라. 회사는 임직원들 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 총당부채로 계상하고 있습니다.

마. 회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.

바. 회사는 온실가스 배출과 관련하여 회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 보고기간종료일 현재 회사의 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 만톤)

구 분	당분기말
무상할당 배출권	637
배출량 추정치	1,151

(2) 당분기 중 회사의 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기
기초	25,059
취득	-
매각	-
당분기말	25,059

(3) 당분기 중 회사의 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기
기초	13,116
순전입액	28,551
사용액	-
당분기말	41,667

14. 우발부채와 약정사항 :

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 백만US\$)

내역	당분기말	전기말
임대주택 관련 채무보증	6,246	7,323
해외중속기업에 대한 채무보증 (한도 기준)	US\$ 8,315 (원화환산액: ₩8,867,476)	US\$ 8,294 (원화환산액: ₩8,885,708)
해외중속기업에 대한 채무보증 (실차입금 기준)	US\$ 342 (원화환산액: ₩363,433)	US\$ 441 (원화환산액: ₩473,014)

보고기간종료일 현재 회사가 해외중속기업의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(단위: 백만원)

해외중속기업	보증처	보증기간	금액	
			실차입금	지급보증금액
Samsung Electronics Turkey(SETK)	BTMU 외	2018-12-16	204,779	805,208
Samsung Electronics Peru(SEPR)	BBVA 외	2018-12-16	19,870	191,970
Samsung Electronics Chile Limitada(SECH)	Citibank 외	2018-12-16	17,660	189,837
Samsung Electronica Columbia(SAMCOL)	Citibank 외	2018-12-16	46,606	179,172
Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	HSBC	2018-06-13	74,518	133,313
기타			-	7,367,976
계			363,433	8,867,476

나. 소송 등

(1) 보고기간 종료일 현재 Apple사와의 특허 관련 소송이 미국에서 진행중입니다. 해당 소송과 관련해서는 2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 판결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 판결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 회사 제품 판매금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 판결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 회사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 회사는 다시 항소하였으나, 2015년 10월 13일 항소가 기각되었고, 2015년 11월 19일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다.

회사는 2015년 12월 11일 일부 판결의 손해액을 Apple사에 지불하였고, 2015년 12월 14일 대법원에 디자인 관련 상고를 제기하였습니다. 이후 일부 판결 관련 부수적 손해 등에 대한 양사 서면이 1심 법원에 제출되었습니다. 2016년 3월 21일 대법원은 회사가 제기한 디자인 관련 상고를 허가하였고, 2016년 3월 22일 1심 법원은 2016년 3월 28일 시작 예정이었던 손해액 재재판을 포함하여 환송심의 모든 절차를 대법원 상고심 판결 시까지 정지하였습니다. 회사는 디자인 관련 상고심에서 2016년 6월 1일 본안 서면을 제출하였고, 2016년 6월 8일 여러 회사 및 단체 등이 회사 지지 서면을 제출하였습니다. Apple사는 2016년 7월 29일 반대 서면을 상고심에 제출하였고, 2016년 8월 5일 여러 회사 및 단체 등이 Apple사 지지 서면을 제출하였습니다. 회사는 2016년 8월 29일 반박 서면을 상고심에 제출하였습니다. 관련 상고심 구두변론은 2016년 10월 11일 대법원에서 진행되었습니다.

2016년 12월 6일 대법원은 회사 상고를 인용하는 판결을 내리고 사건을 항소심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 2월 7일 항소심 법원은 사건을 1심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 10월 12일 1심 법원은 디자인 관련 재재판 필요성에 대한 심리를 진행한 후 2017년 10월 22일 디자인 관련 재재판 진행 결정을 내렸습니다. 2018년 5월 14일부터 18일 1심 법원은 디자인 손해액을 재산정하는 재재판을 진행할 예정입니다.

또한, 2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두번째 소송과 관련해 회사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 평결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 평결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 회사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 2016년 1월 5일 항소심 구두변론이 진행되었습니다. 별도로, 2014년 8월 27일 1심 법원은 Apple사의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소심 법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고하였고, 2015년 12월 16일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 2016년 1월 18일 1심 법원은 판매금지결정을 내렸습니다. 2016년 2월 26일 항소심 재판부는 2014년 11월 25일 선고된 1심 판결을 번복하여 Apple사의 기술특허 관련하여 비침해 또는 무효를 판단하고 손해액을 파기하는 판결을 선고하였습니다. 2016년 3월 30일 Apple사는 항소심 재판부 판결에 대해 재심리 신청을 하였습니다. 2016년 10월 7일 항소심 전원합의체는 항소심 재판부 판결을 다시 번복하여, Apple사의 기술특허 관련하여 침해 및 유효를 판단하고 손해액 판결을 내렸습니다. 2017년 3월 10일 회사는 항소심 전원합의체 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다. 2017년 10월 4일 미국 법무부는 회사 상고에 반대하는 법정조언서를 대법원에 제출하였습니다. 2017년 11월 6일 대법원은 회사 상고를 기각하였습니다. 2018년 1월 11일 1심 법원은 추가 손해액 인정 여부에 대한 심리를 진행하였습니다. 2018년 2월 15일 1심 법원은 회사 회피설계를 받아들여 추가 손해액 중 일부만 인정하였습니다. 동 소송을 포함한 Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간 종료일 현재 예측할 수 없습니다.

2014년 8월, 회사와 Apple사는 미국 외 지역에서의 소송을 취하한다는 합의에 이른 바 있으며, 보고기간 종료일 현재 미국 외 모든 국가에서 소송 취하가 완료되었습니다.

(2) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 분할과 관련된 연대책무

회사와 삼성디스플레이 주식회사 등은 분할된 삼성디스플레이 주식회사 등의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

15. 자본금 :

보고기간 종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)에서 25,000,000,000주(1주의 금액 : 100원)로 변경되었으며, 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각각 128,386,494주와 18,072,580주입니다(주석 27 참조). 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면 총액은 732,295백만원(보통주 641,932백만원 및 우선주 90,363백만원)으로 납입자본금(897,514백만원)과 상이합니다. 다만, 2018년 3월 23일 주식분할에 대한 주주총회 결의가있었는 바, 구체적인 내용은 주석 27을 참고하시기 바랍니다.

16. 이익잉여금 :

가. 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금	450,789	450,789
임의적립금 등	153,833,749	150,477,935
계	154,284,538	150,928,724

나. 회사는 2018년 4월 26일 이사회결의에 의거 2018년 3월 31일을 배당기준일로 하여 분기배당을 지급하기로 하였으며, 당분기 및 전분기의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분		당분기	전분기
배당받을 주식	보통주	119,395,651주	121,840,851주
	우선주	16,457,734주	17,069,534주
배당률(액면가 기준)		354%	140%
배당금액	보통주	2,113,303	852,886
	우선주	291,302	119,487
	계	2,404,605	972,373

17. 기타자본항목 :

가. 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
자기주식	(4,875,162)	(6,228,187)
매도가능금융자산평가손익	-	169,423
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	121,600	-
순확정급여자산 재측정요소	(397,418)	(362,000)
기타	1,760,407	1,760,408
계	(3,390,573)	(4,660,356)

나. 회사는 주가안정 및 주주가치 증대를 위하여 기명식보통주식 및 무의결권우선주식을 취득하여 기타자본항목으로 계상하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말		전기말	
	보통주	우선주	보통주	우선주
주식수(주)	8,990,843	1,614,846	9,410,125	1,720,171
취득가액(백만원)	4,435,754	439,408	5,560,506	667,681

18. 비용의 성격별 분류 :

당분기 및 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
제품 및 재공품 등의 변동	(863,538)	(234,062)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	18,693,113	16,819,840
급여	2,639,853	2,602,894
퇴직급여	143,127	158,334
감가상각비	3,067,033	2,497,564
무형자산상각비	235,011	292,519
복리후생비	440,754	375,985
지급수수료	744,398	849,315
광고선전비	205,005	243,294
판매촉진비	490,644	306,430
기타비용	5,610,681	4,990,840
계(*)	31,406,081	28,902,953

(*) 손익계산서 상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비 :

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 판매비와관리비		
급여	476,101	574,946
퇴직급여	27,408	33,907
지급수수료	744,398	849,315
감가상각비	86,433	82,598
무형자산상각비	31,444	31,792
광고선전비	205,005	243,288
판매촉진비	490,644	306,428
운반비	120,313	130,553
서비스비	136,298	191,608
기타판매비와관리비	448,165	387,441
소계	2,766,209	2,831,876
(2) 경상연구개발비		
연구개발 총지출액	3,554,015	3,218,377
개발비 자산화	(110,403)	(88,836)
소계	3,443,612	3,129,541
계	6,209,821	5,961,417

20. 기타수익 및 기타비용 :

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 기타수익		
배당금수익	88,488	631,654
임대료수익	40,816	36,533
투자자산처분이익	1,202	171
유형자산처분이익	98,426	63,130
기타	41,195	35,093
계	270,127	766,581
(2) 기타비용		
유형자산처분손실	6,611	1,501
기부금	9,320	16,538
기타	24,952	94,799
계	40,883	112,838

21. 금융수익 및 금융비용 :

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
(1) 금융수익		
이자수익	153,928	126,791
- 대여금및수취채권	-	126,791
- 상각후원가 측정 금융자산	153,928	-
외환차이	581,587	732,257
파생상품관련이익	64,311	-
계	799,826	859,048
(2) 금융비용		
이자비용	71,842	85,207
- 상각후원가 측정 금융부채	17,907	34,150
- 기타 금융부채	53,935	51,057
외환차이	589,148	793,411
계	660,990	878,618

나. 회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용 :

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 26.9%입니다.

23. 주당이익 :

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기	전분기
분기순이익	8,452,458	4,873,767
분기순이익 중 보통주 해당분	7,428,499	4,274,683
÷ 가중평균유통보통주식수	119,450	122,412
기본 보통주 주당이익(단위: 원)	62,189	34,920

(2) 우선주

(단위: 백만원, 천주)

구 분	당분기	전분기
분기순이익	8,452,458	4,873,767
분기순이익 중 우선주 해당분	1,023,959	599,084
÷ 가중평균유통우선주식수	16,470	17,212
기본 우선주 주당이익(단위: 원)	62,170	34,805

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표 :

당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정내역

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용	3,116,519	1,435,977
금융수익	(460,918)	(557,697)
금융비용	410,324	508,050
퇴직급여	143,127	158,334
감가상각비	3,067,033	2,497,564
무형자산상각비	235,011	292,519
대손상각비(환입)	(7,840)	37,921
배당금수익	(88,488)	(631,654)
유형자산처분이익	(98,426)	(63,130)
유형자산처분손실	6,611	1,501
재고자산평가손실 등	109,017	75,000
투자자산처분이익	(1,202)	(171)
기타	16,570	(57,842)
계	6,447,338	3,696,372

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
1. 매출채권의 (증가)감소	(1,951,691)	1,871,777
2. 미수금의 감소	389,436	967,316
3. 선급금의 증가	(94,140)	(86,768)
4. 장단기선급비용의 (증가)감소	(227,032)	259,578
5. 재고자산의 증가	(1,276,349)	(913,086)
6. 매입채무의 증가	3,473,536	646,406
7. 장단기미지급금의 감소	(782,341)	(1,713,897)
8. 선수금의 증가(감소)	17,044	(20,435)
9. 예수금의 감소	(29,636)	(24,063)
10. 미지급비용의 감소	(1,791,997)	(2,530,238)
11. 총당부채의 증가	631,674	1,086,788
12. 퇴직금의 지급	(52,256)	(172,004)
13. 기타	(757,160)	73,103
계	(2,450,912)	(555,523)

25. 재무위험관리 :

회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운영하고 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 중속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

또한, 회사는 해외 지역별 중심지(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)에 금융관리요원을 파견하여 지역 금융센터를 운영함으로써, 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산, 당기손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

회사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 회사의 환위험관리 규정에서는 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다.

회사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금액(법인세효과 반영 전)은 각각 8,910백만원 및 8,727백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 회사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

회사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 회사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달 기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

회사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 회사는 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 A1 평가등급을 받고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말
부 채	49,010,792	46,671,585
자 본	156,195,372	151,569,775
부채비율	31.4%	30.8%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 회사 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	7,769,590	(*1)	2,763,768	(*1)
단기금융상품	20,136,857	(*1)	25,510,064	(*1)
매출채권	30,045,336	(*1)	27,881,777	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	-	-	973,353	895,670
기타포괄손익-공정가치금융자산	981,073	981,073	-	-
당기손익-공정가치금융자산	9,313	9,313	-	-
기타	3,507,716	(*1)	3,623,263	(*1)
소계	62,449,885		60,752,225	
금융부채				
매입채무	9,817,029	(*1)	6,398,629	(*1)
단기차입금	7,657,877	(*1)	12,229,701	(*1)
미지급금	11,104,441	(*1)	9,465,685	(*1)
유동성장기부채	5,183	(*1)	5,201	(*1)
사채	46,651	62,140	46,808	61,943
장기미지급금	1,152,312	(*1)	1,537,329	(*1)
기타	4,238,899	(*1)	3,549,549	(*1)
소계	34,022,392		33,232,902	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 전기말 현재 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가하여 공정가치 공시에서 제외한 금액은 77,683백만원입니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	890,954	-	90,119	981,073
당기손익-공정가치금융자산	-	-	9,313	9,313
(2) 부 채				
사채	-	62,140	-	62,140

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
장기매도가능금융자산	872,749	-	22,921	895,670
(2) 부 채				
사채	-	61,943	-	61,943

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

회사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

1) 회사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2) Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
말타니	15,137	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.69%~9.69%(8.69%)
삼성벤처투자	7,784	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	19.56%~21.56%(20.56%)

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	22,921	23,785
기타	76,511	-
분기말	99,432	23,785

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과 (기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	4,798	-	(3,142)

(*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 특수관계자와의 거래 :

가. 지배, 종속관계

보고기간 종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)
국내	삼성디스플레이	디스플레이 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스	디스플레이 부품 생산	50.0
	스테코	반도체 부품생산	70.0
	세메스	반도체/FPD제조장비 생산	91.5
	삼성전자서비스	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자판매	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨	의료기기	68.5
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 23호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	미래로시스템	반도체 공정불량 및 품질관리 소프트웨어 개발 및 공급	99.9
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.0
레드벤드소프트웨어코리아	소프트웨어 개발 및 공급	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Electronics America(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NexusDX(Nexus)	의료기기	100.0
	NeuroLogica	의료기기	100.0
	Samsung Semiconductor(SSI)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada(SECA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Research America(SRA)	R&D	100.0
	Samsung Mexicana(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung International(SII)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico(SEM)	전자제품 판매	99.9
	SEMES America(SEMESA)	반도체 장비	100.0
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico(SEDAM)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	RT SV CO-INVEST(RT-SV)	벤처기업 투자	99.9
	Samsung HVAC	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings	스마트홈기기 판매	100.0
	Samsung Pay	모바일 결제 개발 및 서비스	100.0
	Prismview	LED 디스플레이 생산 및 판매	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund (Beijing Fund)	벤처기업 투자	61.4
	Stellus Technologies	반도체 시스템 생산 및 판매	100.0
Samsung Oak Holdings(SHI)	Holding Company	100.0	
AdGear Technologies	디지털광고 플랫폼	100.0	
Joyent	클라우드 서비스	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
미주	Samsung Next	Holding Company	100.0
	Samsung Next Fund	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Dacor Holdings	Holding Company	100.0
	Dacor	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada	가전제품 판매	100.0
	EverythingDacor.com	가전제품 판매	100.0
	Distinctive Appliances of California	가전제품 판매	100.0
	Viv Labs	인공지능관련 신기술 연구	100.0
	SigMast Communications	RCS (Rich Communication Service)	100.0
	AMX Holding Corporation	Holding Company	100.0
	AMX LLC	Holding Company	100.0
	Harman Becker Automotive Systems	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services Engineering	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Holding	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services South America	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	Holding Company	100.0
	Harman International Mexico S de RL de CV	오디오제품 판매	100.0
	Harman Investment Group, LLC	Financing Company	100.0
	Harman KG Holding, LLC	Holding Company	100.0
	Harman Professional	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software	소프트웨어 디자인	100.0
	S1NN USA	R&D	100.0
	Southern Vision Systems	영상 감지 장치 개발	100.0
	Triple Play Integration	Connected Service Provider	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America(SEHA)	가전제품 생산	100.0
China Materialia	벤처기업 투자	99.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Holding(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia(SESIA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia(SDSK)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Overseas(SEO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa(SEP)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Nordic(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe(SSEL)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	TV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing(SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Company(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Baltics(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus(SRR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Central Eurasia(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga(SERK)	TV 생산	100.0
	Samsung Electronics(London) Limited(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Denmark Research Center(SDRC)	R&D	100.0
Samsung France Research Center(SFRC)	R&D	100.0	
Samsung Cambridge Solution Centre(SCSC)	R&D	100.0	
Samsung Electronics Switzerland GmbH(SESG)	전자제품 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Samsung Electronics Caucasus(SECC)	마케팅	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
	Aditi Technologies Europe	오디오제품 판매 등	100.0
	AKG Acoustics	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX (Germany)	오디오제품 판매	100.0
	AMX UK	오디오제품 판매	100.0
	Duran Audio B.V.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Duran Audio Iberia Espana	오디오제품 판매	100.0
	Endeleo	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Automotive UK	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems (Germany)	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Finland OY	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services (Germany)	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Division Nordic A/S	오디오제품 판매	100.0
	Harman Consumer Finland OY	오디오제품 판매	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Deutschland	오디오제품 판매	100.0
	Harman Finance International GP S.a.r.l	Holding Company	100.0
	Harman Finance International SCA	Financing Company	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing	Financing Company	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Holding Company	100.0	
Harman International Estonia OU	R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
유럽/CIS	Harman International Industries (UK)	오디오제품 판매 등	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman International SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Management	Holding Company	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Inspiration Matters	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Knight Image	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Martin Manufacturing (UK)	오디오제품 생산	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Professional France SAS	오디오제품 판매	100.0
	Harman Professional Germany GmbH	오디오제품 판매	100.0
	R&D International	오디오제품 생산	100.0
	Red Bend Software (UK)	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Innoetics E.P.E.	소프트웨어 개발	100.0
	ARCAM	Holding Company	100.0
	A&R Cambridge	오디오제품 판매	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중동 및 아프리카	Samsung Electronics West Africa(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Israel R&D Center(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production(SSAP)	TV/모니터 생산	100.0
	Broadsense	서비스	100.0
	Global Symphony Technology Group	Holding Company	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius	Holding Company	100.0
	iOnRoad	R&D	100.0
	iOnRoad Technologies	R&D	100.0
	Red Bend	오디오제품 생산	100.0
TowerSec (Israel)	R&D	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국제외)	Samsung Japan(SJC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M)(SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics (M)(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics(SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Asia Private(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore(SRI-B)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services(SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Electronics Australia(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
	Thai Samsung Electronics(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Samsung Electronics Philippines(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Malaysia Electronics(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Bangladesh(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	통신제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Medison India(SMIN)	의료기기	100.0
	Samsung Electronics New Zealand(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam(SDV)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Laos Samsung Electronics Sole(LSE)	마케팅	100.0
	AMX Products and Solutions Private	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services India	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Technologies	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY	Holding Company	100.0
	Harman International Singapore	오디오제품 판매	100.0
	Harman Malaysia Sdn. Bhd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Professional Singapore Pte.	오디오제품 판매	100.0
	INSP India Software Development Pvt.	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
Martin Professional Pte.	오디오제품 판매	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
아시아 (중국제외)	Harman Connected Services Japan	Connected Service Provider	100.0
	Harman International Japan	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Japan	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Japan	Holding Company	100.0
중국	Samsung Display Dongguan(SDD)	디스플레이 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin(SDT)	디스플레이 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (China) Investment(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(STMC)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor(SESS)	반도체 임가공	100.0
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	전자제품 생산	99.9
	Tianjin Samsung Electronics(TSEC)	TV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(BST)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology(TSTC)	통신제품 생산	90.0
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Computer(DESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module(SSM)	디스플레이 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	디스플레이 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication (SSET)	통신제품 생산	95.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SCRC)	R&D	100.0
Samsung (China) Semiconductor(SCS)	반도체 생산	100.0	
Samsung Electronics (Beijing) Service(SBSC)	서비스	100.0	

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
중국	Tianjin Samsung LED(TSLED)	LED 생산	100.0
	SEMES (Xian)	반도체 장비	100.0
	Samsung Semiconductor Xian(SSCX)	반도체/디스플레이 판매	100.0
	Harman (China) Technologies	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai)	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Taiwan	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Automotive InfoTech (Dalian)	소프트웨어 개발 및 공급	100.0
	Harman Technology (Shenzhen)	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Beijing)	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu)	Connected Service Provider	100.0

(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

나. 매출·매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이	44,838	-	394,776	-
	Samsung Electronics America(SEA)	5,533,116	-	41,617	-
	Samsung (China) Investment(SCIC)	80,907	-	1,397	-
	Harman International Industries, Inc.	-	-	26,778	-
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	1,540,869	211	3,507,057	-
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	1,105,876	300	3,378,192	-
	Samsung Semiconductor(SSl)	7,280,961	-	94,614	-
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	-	-	-	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	137,370	63,795	1,160,468	7,131
	Samsung Display Vietnam(SDV)	203,416	-	-	-
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	580,159	-	2,616,340	195
	Samsung India Electronics(SIEL)	1,113,684	-	43,421	-
	Samsung Asia Private(SAPL)	396,188	-	14,125	-
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	323,395	-	2,018	-
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	4,743,735	-	-	-
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	232	-	857,659	-
	Thai Samsung Electronics(TSE)	473,940	-	441,430	-
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	637,204	-	4,499	-
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	901,890	-	6,814	-
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	40,343	-	17,939	-
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	73,716	-	527	12
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	7,087	-	-	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	143,581	500	590,176	-
	Samsung Electronics France(SEF)	590,383	-	1,251	-
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	24,152	-	179	-
	기타	10,862,030	3,200	4,923,844	5,141
	종속기업 계	36,839,072	68,006	18,125,121	12,479

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	40,414	-	499,156	59,337
	삼성전기	17,140	-	278,776	-
	삼성SDI	20,468	-	73,958	12,213
	제일기획	22,851	-	214,755	1,029
	기타	190,966	-	125,124	488
	관계기업 및 공동기업 계	291,839	-	1,191,769	73,067
그 밖의 특수관계자	삼성물산	37,678	-	61,025	688,225
	기타	33,162	-	106,763	36,751
	그 밖의 특수관계자 계	70,840	-	167,788	724,976
기타(*2)	삼성엔지니어링	1,213	-	1,119	187,010
	에스원	6,402	-	69,208	2,625
	기타	16,123	-	26,620	73
	기타 계	23,738	-	96,947	189,708

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전분기

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
종속기업	삼성디스플레이	81,002	79	329,904	-
	Samsung Electronics America(SEA)	4,356,861	-	45,223	-
	Harman International Industries	-	-	-	-
	Samsung (China) Investment(SCIC)	85,451	-	1,943	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	68,388	9,523	1,047,754	8,158
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	633,828	173	1,533,795	985
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	1,153,980	367	3,183,445	-
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	-	-	-	-
	Samsung Semiconductor(SSi)	4,421,136	-	99,948	-
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	428,268	19	1,951,748	-
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	301,009	203	476	-
	Samsung Asia Private(SAPL)	420,896	-	310	-
	Samsung India Electronics(SIEL)	1,032,126	-	45,517	-
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	-	63,205	813,146	-
	Samsung Display Vietnam(SDV)	208,693	-	-	-
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	4,165,435	-	-	-
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	11,003	-	-	-
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	653,354	-	2,787	-
	Thai Samsung Electronics(TSE)	524,590	842	457,873	-
	Samsung Electronics Slovakia(SESK)	126,465	42	750	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	148,514	42	512,974	-
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	749,660	-	1,192	-
	Samsung Electronics Taiwan(SET)	737,948	-	378	-
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	62,721	-	285	-
	Samsung Display Dongguan(SDD)	87,637	-	-	-
	기타	9,666,345	3,568	5,250,370	3,156
	종속기업 계	30,125,310	78,063	15,279,818	12,299

(단위: 백만원)

구분	기업명	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	22,108	-	379,688	58,057
	삼성전기	12,722	-	225,579	-
	삼성SDI	23,963	-	68,184	332
	제일기획	9,418	-	121,053	667
	기타	55,926	-	100,444	316
	관계기업 및 공동기업 계	124,137	-	894,948	59,372
그 밖의 특수관계자	삼성물산	33,917	68	39,978	204,747
	기타	32,014	35	97,193	6,228
	그 밖의 특수관계자 계	65,931	103	137,171	210,975
기타(*2)	삼성엔지니어링	1,661	-	2,709	85,854
	에스원	4,789	-	64,141	5,118
	기타	13,329	-	16,361	-
	기타 계	19,779	-	83,211	90,972

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

(*2) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 채권·채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	삼성디스플레이	7,456	142,197
	Samsung Electronics America(SEA)	4,767,138	198,504
	Samsung (China) Investment(SCIC)	25,937	770
	Harman International Industries, Inc.	-	16,004
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	900,969	2,451,369
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	744,882	2,529,885
	Samsung Semiconductor(SSI)	4,972,308	92,747
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	-	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	108,207	441,805
	Samsung Display Vietnam(SDV)	47,573	-
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	317,006	1,511,470
	Samsung India Electronics(SIEL)	2,415,586	13,695
	Samsung Asia Private(SAPL)	146,795	35,869
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	234,958	3,615
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	3,418,546	74
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	1,929	354,006
	Thai Samsung Electronics(TSE)	218,923	177,665
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	573,383	1,410
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	900,938	3,785
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	44,535	12,564
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	21,107	561
	Samsung Suzhou LCD(SSL)	5,200	-
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	67,896	221,112
	Samsung Electronics France(SEF)	588,876	3,507
	Samsung Electronics Benelux(SEBN)	24,525	77
	기타	7,053,340	2,025,558
	종속기업 계(*2)	27,608,013	10,238,249

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	2,741	374,583
	삼성전기	1,467	180,053
	삼성SDI	86,014	67,913
	제일기획	154	317,590
	기타	142,076	68,952
	관계기업 및 공동기업 계		232,452
그 밖의 특수관계자	삼성물산	225,153	179,656
	기타(*3)	15,831	1,281,406
	그 밖의 특수관계자 계	240,984	1,461,062
기타(*4)	삼성엔지니어링	1,328	38,797
	에스원	7,234	25,514
	기타	531	33,058
	기타 계	9,093	97,369

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 상기의 종속기업 채권금액에 대하여 대손충당금 276,080백만원을 계상하고 있으며, 당분기에 인식된 대손상각비는 4,472백만원입니다.

(*3) 채무 등 금액에는 삼성카드와의 구매카드 미결제금액 1,137,486백만원이 포함되어 있습니다. 삼성카드와의 연간 구매카드 약정금액은 2,000,000백만원이며, 당기중 사용 및 상환한 금액은 각각 1,137,542백만원 및 1,111,186백만원입니다.

(*4) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

(단위: 백만원)

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	삼성디스플레이	12,598	122,269
	Samsung Electronics America(SEA)	5,255,201	78,931
	Harman International Industries, Inc.	-	4,204
	Samsung (China) Investment(SCIC)	31,580	1,556
	Samsung Display Vietnam(SDV)	111,479	-
	Samsung Semiconductor(SSl)	4,993,262	127,706
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN(SEVT)	723,655	1,601,102
	Samsung Electronics Vietnam(SEV)	517,266	1,368,151
	Samsung Electronics Europe Holding(SEEH)	828	-
	Samsung (China) Semiconductor(SCS)	62,820	354,866
	Samsung Electronics Huizhou(SEHZ)	199,187	811,510
	Samsung India Electronics(SIEL)	1,821,881	14,594
	Samsung Asia Private(SAPL)	122,014	16,021
	Samsung Electronica da Amazonia(SEDA)	338,256	553
	Shanghai Samsung Semiconductor(SSS)	3,093,641	11
	Samsung Austin Semiconductor(SAS)	19,658	290,978
	Thai Samsung Electronics(TSE)	150,896	152,273
	Samsung Electronics Slovakia(ESK)	475,672	409

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(단위: 백만원)

구 분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
종속기업	Samsung Suzhou LCD(SSL)	4,724	-
	Samsung Electronics Europe Logistics(SELS)	892,789	6,885
	Samsung Electronics Hungarian(SEH)	24,965	164
	Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC)	58,983	238,522
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	831,102	2,484
	Samsung Electronics (UK)(SEUK)	71,493	16,517
	Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	185,909	55,394
	기타	7,160,968	2,122,030
	종속기업 계(*2)	27,160,827	7,387,130
관계기업 및 공동기업	삼성에스디에스	14,005	378,894
	삼성전기	3,521	132,156
	삼성SDI	87,830	58,261
	제일기획	58	498,262
	기타	55,035	101,234
	관계기업 및 공동기업 계	160,449	1,168,807
그 밖의 특수관계자	삼성물산	218,983	617,069
	기타(*3)	17,901	1,233,887
	그 밖의 특수관계자 계	236,884	1,850,956
기타(*4)	삼성엔지니어링	2,426	410,763
	에스원	649	42,590
	기타	2,621	28,772
	기타 계	5,696	482,125

(*1) 회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권·채무 금액입니다.

(*2) 상기의 종속기업 채권금액에 대하여 대손충당금 271,608백만원을 계상하고 있으며, 전기에 인식된 대손상각비는 48,246백만원입니다.

(*3) 채무 등 금액에는 삼성카드와의 구매카드 미결제금액 1,111,129백만원이 포함되어 있습니다. 삼성카드와의 연간 구매카드 약정금액은 1,800,000백만원이며, 전기중 사용 및 상환한 금액은 각각 4,267,894백만원 및 4,447,462백만원입니다.

(*4) 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

라. 회사는 당분기 및 전분기 중 종속기업에 58,755백만원 및 6,005,553백만원을 추가로 출자하였으며, 회수한 내역은 없습니다. 또한, 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 추가 출자한 내역은 없으며, 출자원금 147백만원 및 48,884백만원을 회수하였습니다.

마. 회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 516,419백만원 및 661,516백만원입니다. 당분기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 516,419백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 및 전분기 중 지급 결의한 배당금은 39,912백만원 및 51,050백만원입니다. 당분기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 39,912백만원입니다.

바. 주요 경영진에 대한 보상

당분기 및 전분기 중 회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	3,724	2,375
퇴직급여	436	198
기타 장기급여	2,724	2,154

사. 회사는 보고기간종료일 현재 특수관계자의 채무에 대하여 채무보증을 제공하고 있습니다(주석 14 참조).

27. 보고기간 후 사건

회사는 2018년 1월 31일 이사회 결의 및 2018년 3월 23일 주주총회 결의로 발행할 주식의 총수는 25,000,000,000주(1주의 금액 : 100원)로, 발행한 보통주식 및 우선주식의 수는 각각 6,419,324,700주 및 903,629,000주로 변경될 예정이며, 보고기간 종료일 이후 상법 제 329조의2에 따라 구주권제출의 공고기간이 만료된 때인 2018년 5월 3일에 주식분할의 효력이 발생하고 2018년 5월 4일 주식분할로 인한 주권 변경상장 등 절차가 진행될 예정입니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

- 해당사항 없음

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

- 최근 3사업연도내 본사 기준(별도 재무제표 기준) 주요한 합병 내역은 없으며, 종속기업의 주요한 사업결합 등의 내용은 연결재무제표의 사업결합 주석 등을 참조하시기 바랍니다.

[프린팅솔루션 사업부문]

- 분할 내역

- 회사명 : 에스프린팅솔루션 주식회사
- 소재지 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
- 대표이사 : 김기호
- 분할방법 : 물적분할(분할후 에스프린팅솔루션 주식회사 신설)
- 분할목적 : 프린팅솔루션 사업의 경쟁력 강화
- 분할승인 : 2016년 10월 27일(임시주주총회 결의)
- 분할기일 : 2016년 11월 1일

- 양도 내역

당사는 2016년 9월 12일 HP Inc.에게 에스프린팅솔루션 주식회사 지분을 포함한 프린팅솔루션 사업 부문을 US\$ 1,050,000천에 포괄적으로 양도하는 기본양수도 계약을 체결하였으며, 양도 거래가 2017년 11월 1일 종결되었습니다.

상기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (<http://dart.fss.or.kr/>) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

- 중요한 소송사건

1) Apple사

① 1차 소송

구분	내용
소제기일	2011년 4월 15일
소송 당사자	원고 : Apple사(Apple Inc.), 피고 : 당사(SEC, SEA, STA)
소송의 내용	Apple사 트레이드 드레스, 실용 특허, 디자인 특허 관련 침해금지 및 손해배상청구
진행현황	<p>2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 판결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 판결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 당사 제품 판매 금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 판결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 당사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 당사는 다시 항소하였으나, 2015년 10월 13일 항소가 기각되었고, 2015년 11월 19일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다.</p> <p>당사는 2015년 12월 11일 일부 판결의 손해액을 Apple사에 지불하였고, 2015년 12월 14일 대법원에 디자인 관련 상고를 제기하였습니다. 이후 일부 판결 관련 부수적 손해 등에 대한 양사 서면이 1심 법원에 제출되었습니다. 2016년 3월 21일 대법원은 당사가 제기한 디자인 관련 상고를 허가하였고, 2016년 3월 22일 1심 법원은 2016년 3월 28일 시작 예정이었던 손해액 재재판을 포함하여 환송심의 모든 절차를 대법원 상고심 판결 시까지 정지하였습니다. 당사는 디자인 관련 상고심에서 2016년 6월 1일 본안 서면을 제출하였고, 2016년 6월 8일 여러 회사 및 단체 등이 당사 지지 서면을 제출하였습니다. Apple사는 2016년 7월 29일 반대 서면을 상고심에 제출하였고, 2016년 8월 5일 여러 회사 및 단체 등이 Apple사 지지 서면을 제출하였습니다. 당사는 2016년 8월 29일 반박 서면을 상고심에 제출하였습니다. 관련 상고심 구두변론은 2016년 10월 11일 대법원에서 진행되었습니다.</p> <p>2016년 12월 6일 대법원은 당사 상고를 인용하는 판결을 내리고 사건을 항소심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 2월 7일 항소심 법원은 사건을 1심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 10월 12일 1심 법원은 디자인 관련 재재판 필요성에 대한 심리를 진행한 후 2017년 10월 22일 디자인 관련 재재판 진행 결정을 내렸습니다. 2018년 5월 14일부터 18일 1심 법원은 디자인 손해액을 재산정하는 재재판을 진행할 예정입니다.</p>
향후 소송일정	디자인 관련 재재판(2018년 5월)
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

② 2차 소송

구 분	내 용
소제기일	2012년 2월 8일
소송 당사자	원고 : Apple사(Apple Inc.), 피고 : 당사(SEC, SEA, STA)
소송의 내용	Apple사 특허 관련 침해금지 및 손해배상청구
진행현황	2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두 번째 소송과 관련해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 판결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 판결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 당사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 2016년 1월 5일 항소심 구두변론이 진행되었습니다. 별도로, 2014년 8월 27일 1심 법원은 Apple사의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고하였고, 2015년 12월 16일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 2016년 1월 18일 1심 법원은 판매금지결정을 내렸습니다. 2016년 2월 26일 항소심 재판부는 2014년 11월 25일 선고된 1심 판결을 반복하여 Apple사의 기술특허 관련하여 비침해 또는 무효를 판단하고 손해액을 파기하는 판결을 선고하였습니다. 2016년 3월 30일 Apple사는 항소심 재판부 판결에 대해 재심리 신청을 하였습니다. 2016년 10월 7일 항소심 전원합의체는 항소심 재판부 판결을 다시 반복하여, Apple사의 기술특허 관련하여 침해 및 유효를 판단하고 손해액 판결을 내렸습니다. 2017년 3월 10일 당사는 항소심 전원합의체 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다. 2017년 10월 4일 미국 법무부는 당사 상고에 반대하는 법정 조언서를 대법원에 제출하였습니다. 2017년 11월 6일 대법원은 당사 상고를 기각하였습니다. 2018년 1월 11일 1심 법원은 추가 손해액 인정 여부에 대한 심리를 진행하였습니다. 2018년 2월 15일 1심 법원은 당사 회피설계를 받아들여 추가 손해액 중 일부만 인정하였습니다.
향후 소송일정	당사는 Apple사에게 2018년 5월 중 손해액 지급 예정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당사가 Apple사에게 손해액 지급 후 절차 종료

2) TFT-LCD 판매 관련

① Iiyama社 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2014년 12월 19일
소송 당사자	원고 : Mouse Computer社, 유럽內 Iiyama 5개社 피고 : 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	피고 英대법원에 상고 신청
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

② 영국 정부기관 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2015년 11월 4일
소송 당사자	원고 : 영국 42개 정부기관 피고 : 삼성전자 및 해외 판매 자회사
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대한 영국 정부기관 클레임
진행상황	소장 송달 완료
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

③ 이스라엘LCD 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2013년 11월 26일
소송 당사자	원고 : Hatzlacha 피고 : 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	소장 송달 대기 중
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

- 채무보증 내역

1) 국내채무보증

2018년 1분기말 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대한 채무보증 약정한도는 40,732백만원이며, 잔액은 26,918백만원입니다.

2) 해외채무보증

(단위 : 천US\$)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거래내역(잔액)				채무보증한도	이자율 (%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	SMBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	1,423,000		2017-04-19
SEM (멕시코판매법인)	계열회사	Santander 외	2019-03-27	0	0	0	0	546,000		2017-06-14
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	66,939	0	23,239	43,700	168,000	6.33%	2017-06-14
SEDA (브라질생판법인)	계열회사	HSBC 외	2018-12-17	0	0	0	0	769,000		2017-06-14
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	14,639	1,920	0	16,559	178,000	2.52%	2017-06-14
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 외	2018-12-16	40,150	0	21,519	18,631	180,000	1.80%	2017-06-01
SSA (남아공판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	323,000		2017-06-14
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 외	2018-12-16	0	0	0	0	110,000		2017-11-09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BTMU 외	2018-12-16	242,345	0	50,335	192,010	755,000	13.75%	2017-06-14
SECE (카자흐판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	96,033		2017-07-20
SEEG (이집트생판법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	50,000		2017-06-14
SEIN (인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 외	2018-11-08	0	0	0	0	186,000		2017-06-14
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 외	2018-12-16	0	0	0	0	905,519		2017-04-28
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 외	2018-12-16	0	0	0	0	150,000		2017-06-14
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	371,000		2017-06-14
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	50,000		2017-12-17
SEEH (네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	647,000		2017-06-14
SERK (러시아생산법인)	계열회사	BNP 외	2018-12-16	0	0	0	0	245,000		2017-06-14
SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	10,000		2017-12-17
SAPL (싱가포르법인)	계열회사	BOA 외	2018-12-16	0	0	0	0	411,000		2017-06-14
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	15,000		2017-11-09
SAVINA (베트남판매법인)	계열회사	SCB 외	2018-11-08	0	0	0	0	71,000		2017-06-14

SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	30,000		2017-11-09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	350,000		2017-06-14
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	110,000		2017-11-09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	5,000		2017-12-17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	1,000		2017-12-17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	30,000		2017-11-09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	2,000		2017-06-14
SEPM (폴란드생산법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	77,419	0	7,547	69,872	125,000	2.15%	2017-06-14
Adgear (캐나다판매법인)	계열회사	BOA	2018-11-08	0	0	0	0	2,000		2017-11-09
Harman Finance International SCA	계열회사	JP Morgan 외	2022-05-27	417,900	12,652	0	430,552	430,552	2.00%	2015-05-27
합 계				859,392	14,572	102,640	771,324	8,745,105		

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며,
0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을 경영위원회에 위임하고 있습니다.

☞ 추가적인 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 채무에 관한 사항'의 '3. 연결채무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
- 해당사항 없음

나. 대손충당금 설정 현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제50기 1분기	매출채권	35,965,671	595,017	1.7%
	단기대여금	7,067	75	1.1%
	미수금	3,247,778	25,932	0.8%
	선급금	1,688,832	1,819	0.1%
	장기성매출채권	759,010	5,427	0.7%
	장기성미수금	137,460	315	0.2%
	장기성선급금	627,808	5,783	0.9%
	장기대여금	129,972	494	0.4%
	합 계	42,563,598	634,862	1.5%
제49기	매출채권	28,333,822	635,815	2.2%
	단기대여금	7,258	81	1.1%
	미수금	4,135,935	26,975	0.7%
	선급금	1,758,547	4,874	0.3%
	장기성매출채권	1,983,136	1,397	0.1%
	장기성미수금	139,472	330	0.2%
	장기성선급금	134,192	836	0.6%
	장기대여금	130,550	467	0.4%
	합 계	36,622,912	670,775	1.8%
제48기	매출채권	24,699,961	420,750	1.7%
	단기대여금	7,208	67	0.9%
	미수금	3,546,546	25,349	0.7%
	선급금	1,442,219	2,281	0.2%
	장기성매출채권	4,563	139	3.0%
	장기성미수금	35,683	153	0.4%
	장기성선급금	175,211	1,369	0.8%
	장기대여금	173,068	7,849	4.5%
	합 계	30,084,459	457,957	1.5%

※ 채권금액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.(연결기준)

(2) 대손충당금 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제50기 1분기	제49기	제48기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	670,775	457,957	383,194
2. 순대손처리액(① - ② ± ③)	△4,155	3,685	29,843
① 대손처리액(상각채권액) 등	4	38,584	31,334
② 상각채권회수액	250	559	1,491
③ 기타증감액	△3,909	△34,340	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	△40,068	216,503	104,606
4. 기말 대손충당금 잔액합계	634,862	670,775	457,957

※ 연결기준입니다.

[△는 부(-)의 값임]

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침

1) 대손충당금 설정방침

채무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정

2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거

- 대손경험률 : 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하여 설정
- 대손예상액 : 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정

[대손추산액 설정기준]

상황	설정률
분쟁	25 %
수금의뢰	50 %
소송	75 %
부도	100 %

- 3) 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리
- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우
 - 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우
 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우
 - 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우
 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	36,496,332	117,410	70,754	40,185	36,724,681
구성비율	99.4%	0.3%	0.2%	0.1%	100.0%

※ 매출채권잔액은 현재가치할인차금 차감 후 금액입니다.(연결기준)

다. 재고자산 현황

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

부문	사업부문	계정과목	제50기 1분기말	제49기말	제48기말	비고
CE		제품 및 상품	1,713,757	1,827,162	2,025,130	
		반제품 및 재공품	157,209	110,179	104,451	
		원재료 및 저장품	2,561,479	2,505,575	1,769,899	
		미착품	1,640,398	1,684,923	1,949,780	
		소 계	6,072,843	6,127,839	5,849,260	
IM		제품 및 상품	2,760,985	2,327,139	2,032,004	
		반제품 및 재공품	664,921	721,194	531,628	
		원재료 및 저장품	5,088,021	4,541,940	2,851,438	
		미착품	770,413	867,103	594,955	
		소 계	9,284,340	8,457,376	6,010,025	
DS	반도체	제품 및 상품	1,363,678	1,094,967	871,428	
		반제품 및 재공품	6,136,465	5,179,312	3,796,746	
		원재료 및 저장품	767,011	659,223	541,573	
		미착품	48,836	39,312	62,078	
		소 계	8,315,990	6,972,814	5,271,825	
	DP	제품 및 상품	409,997	746,856	299,208	
		반제품 및 재공품	692,091	638,268	444,831	
		원재료 및 저장품	654,970	849,786	375,611	
		미착품	28,603	133,038	69,782	
		소 계	1,785,661	2,367,948	1,189,432	
	DS 계	제품 및 상품	1,825,230	1,872,648	1,203,332	
		반제품 및 재공품	7,230,720	6,256,420	4,412,185	
		원재료 및 저장품	1,543,702	1,708,632	977,020	
		미착품	76,317	64,934	135,230	
		소 계	10,675,969	9,902,634	6,727,767	
Harman		제품 및 상품	485,358	432,184	-	
		반제품 및 재공품	84,473	77,696	-	
		원재료 및 저장품	348,821	322,649	-	
		미착품	117,184	140,939	-	
		소 계	1,035,836	973,468	-	
총 계		제품 및 상품	7,649,803	7,304,437	5,905,339	
		반제품 및 재공품	8,074,769	7,113,901	5,017,384	
		원재료 및 저장품	9,629,399	9,413,217	6,494,166	
		미착품	1,116,900	1,151,800	936,614	
		소 계	26,470,871	24,983,355	18,353,503	

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]	8.5%	8.3%	7.0%	
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고 + 기말재고)÷2}]	5.0회	6.0회	6.5회	

※ CE부문은 의료기기 사업부를 제외하여 작성하였습니다.

(2) 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자

- 5월말 및 11월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시
- 재고조사 시점인 11월말과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함.

2) 실사방법

- 사내보관재고 : 폐창식 전수조사 실시
 - ※ 반도체 및 DP 라인재고 및 자동화창고보관 SVC자재는 표본조사
- 사외보관재고
 - 제3자 보관재고, 운송 중인 재고에 대해선 전수로 물품보유확인서 또는 장치확인서 징구 및 표본조사 병행
- 외부감사인은 당사의 재고실사에 입회·확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인함.

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2018년 1분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가총당금	당분기말잔액	비 고
제품 및 상품	8,247,434	8,247,434	(597,631)	7,649,803	
반제품 및 재공품	8,518,543	8,518,543	(443,774)	8,074,769	
원재료 및 저장품	10,556,913	10,556,913	(927,514)	9,629,399	
미착품	1,116,900	1,116,900	-	1,116,900	
합 계	28,439,790	28,439,790	(1,968,919)	26,470,871	

※ 연결기준입니다.

라. 공정가치평가 방법 및 내역

(1) 평가방법

[금융자산]

- 분류

2018년 1월 1일부터 당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

- 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

- 측정

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가 측정 금융자산

계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

② 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익' 또는 '금융비용'으로 표시하고 손상차손은 '기타비용'으로 표시합니다.

③ 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다.

2) 지분상품

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때에 손익계산서에 '기타수익'으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익' 또는 '기타비용'으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

- 손상

당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

- 금융상품의 상계

금융자산과 금융부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계 권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있는 경우 상계되고 재무상태표에 순액으로 표시됩니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

- 금융상품의 제거

당사는 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 당사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하고 있습니다. 해당 금융부채는 재무상태표에 '차입금'으로 분류됩니다.

[금융부채]

- 분류 및 측정

모든 금융부채는 다음을 제외하고는 후속적으로 상각후원가로 측정되도록 분류합니다.

- 당기손익-공정가치 측정 금융부채. 파생상품부채를 포함한 이러한 부채는 후속적으로 공정가치로 측정합니다.
- 금융자산의 양도가 제거 조건을 충족하지 못하거나 지속적 관여 접근법이 적용되는 경우에 생기는 금융부채. 이러한 금융부채는 주석 2.2. 나)의 내용을 적용하여 측정합니다.
- 금융보증계약. 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 이후에 이러한 계약의 발행자는 해당 계약을 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 시장이자율보다 낮은 이자율로 대출하기로 한 약정. 최초 인식 후에 이러한 약정의 발행자는 후속적으로 해당 약정을 다음 중 큰 금액으로 측정합니다.
 - 기대신용손실에 따라 산정한 손실충당금
 - 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액
- 기업회계기준서 제1103호를 적용하는 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가. 이러한 조건부 대가는 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다.

- 제거

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다.

[파생상품]

당사는 파생상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 요건을 충족한 현금흐름위험회피와 해외사업장에 대한 순투자에 대한 위험회피금액은 자본항목으로 이연하고 있습니다.

당사는 재고자산의 가격 변동 위험 등을 회피하기 위한 현금흐름 위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식하고, 비효과적인 부분은 금융수익 또는 금융비용으로 인식하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

- 당분기말

(단위: 백만원)

금융자산	상각후원가 측정 금융자산	기타포괄손익-공정 가치 측정 금융자산	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타금융자산(*)	계
현금및현금성자산	32,303,752	-	-	-	32,303,752
단기금융상품	46,027,700	-	-	-	46,027,700
매출채권	35,370,654	-	-	-	35,370,654
상각후원가금융자산	3,993,820	-	-	-	3,993,820
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	6,997,753	-	-	6,997,753
당기손익-공정가치금융자산	-	-	624,086	-	624,086
기타	5,717,831	-	112,106	32,088	5,862,025
계	123,413,757	6,997,753	736,192	32,088	131,179,790

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위: 백만원)

금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채(*)	계
매입채무	-	9,301,132	-	9,301,132
단기차입금	-	1,623,237	8,350,098	9,973,335
미지급금	318,826	13,319,514	-	13,638,340
유동성장기부채	-	15,631	-	15,631
사채	-	961,780	-	961,780
장기차입금	-	1,910,470	-	1,910,470
장기미지급금	28,156	1,608,467	-	1,636,623
기타	87,140	10,151,901	68,089	10,307,130
계	434,122	38,892,132	8,418,187	47,744,441

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

- 전기말

(단위: 백만원)

금융자산	당기손익인식 금융자산	대여금 및 수취채권	매도가능 금융자산	만기보유 금융자산	기타금융자산 (*)	계
현금및현금성자산	-	30,545,130	-	-	-	30,545,130
단기금융상품	-	49,447,696	-	-	-	49,447,696
단기매도가능금융자산	-	-	3,191,375	-	-	3,191,375
매출채권	-	27,695,995	-	-	-	27,695,995
장기매도가능금융자산	-	-	7,752,180	-	-	7,752,180
만기보유금융자산	-	-	-	106,751	-	106,751
기타	67,702	6,212,727	-	-	45,396	6,325,825
계	67,702	113,901,548	10,943,555	106,751	45,396	125,064,952

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위: 백만원)

금융부채	당기손익인식 금융부채	상각후원가 측정 금융부채	기타금융부채 (*)	계
매입채무	-	9,083,907	-	9,083,907
단기차입금	-	1,497,417	14,270,202	15,767,619
미지급금	316,928	11,789,681	-	12,106,609
유동성장기부채	-	278,619	-	278,619
사채	-	953,361	-	953,361
장기차입금	-	1,814,446	-	1,814,446
장기미지급금	28,285	1,717,899	-	1,746,184
기타	180,366	10,732,501	41,646	10,954,513
계	525,579	37,867,831	14,311,848	52,705,258

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(3) 공정가치 측정

- 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산				
현금및현금성자산	32,303,752	(*1)	30,545,130	(*1)
단기금융상품	46,027,700	(*1)	49,447,696	(*1)
단기매도가능금융자산	-	-	3,191,375	3,191,375
단기상각후원가금융자산	3,733,160	(*1)	-	-
매출채권	35,370,654	(*1)	27,695,995	(*1)
장기매도가능금융자산(*2)	-	-	7,752,180	6,561,155
만기보유금융자산	-	-	106,751	(*1)
상각후원가금융자산	260,660	(*1)	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,997,753	6,997,753	-	-
당기손익-공정가치금융자산	624,086	624,086	-	-
기타(*3)	5,862,025	144,194	6,325,825	113,098
소 계	131,179,790		125,064,952	
금융부채				
매입채무	9,301,132	(*1)	9,083,907	(*1)
단기차입금	9,973,335	(*1)	15,767,619	(*1)
미지급금(*3)	13,638,340	318,826	12,106,609	316,928
유동성장기부채	15,631	(*1)	278,619	(*1)
사채	961,780	980,596	953,361	978,643
장기차입금	1,910,470	(*1)	1,814,446	(*1)
장기미지급금(*3)	1,636,623	28,156	1,746,184	28,285
기타(*3)	10,307,130	155,229	10,954,513	222,012
소 계	47,744,441		52,705,258	

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 전기말 현재 추정 현금흐름의 편차가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률 및 적용할 할인율을 신뢰성 있게 산정할 수 없어 취득원가로 평가한 금액 1,191,025백만원은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*3) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 취득원가로 평가한 금액 금융자산 5,717,831백만원(전기 : 6,212,727백만원) 및 금융부채 25,079,882백만원(전기 : 24,240,081백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

- 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,985,939	51,146	3,960,668	6,997,753
당기손익-공정가치금융자산	10,497	-	613,589	624,086
기타	-	144,194	-	144,194
(2) 부 채				
미지급금	-	-	318,826	318,826
사채	-	980,596	-	980,596
장기미지급금	-	-	28,156	28,156
기타	-	148,555	6,674	155,229

(단위: 백만원)

구 분	전기말			
	Level 1	Level 2	Level 3	계
(1) 자 산				
단기매도가능금융자산	-	3,191,375	-	3,191,375
장기매도가능금융자산	2,908,581	-	3,652,574	6,561,155
기타	-	113,098	-	113,098
(2) 부 채				
미지급금	-	-	316,928	316,928
사채	-	978,643	-	978,643
장기미지급금	-	-	28,285	28,285
기타	-	215,307	6,705	222,012

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- Level 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- Level 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
- Level 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

당사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

- 가치평가기법 및 투입변수

1) 당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

2) Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산				
말타니	15,137	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	7.69%~9.69%(8.69%)
삼성벤처투자	7,784	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)
			가중평균자본비용	19.56%~21.56%(20.56%)
Corning Incorporated 전환우선주	3,354,475	상향모형	위험 할인율	5.55%~7.55%(6.55%)
			가격 변동성	26.2%~32.2%(29.2%)
미지급금				
조건부금융부채	318,826	현금흐름할인모형	할인율	3.81%~4.65%(4.23%)
장기미지급금				
조건부금융부채	28,156	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	10.50%
			무위험할인율	0.97%
			자산변동성	34.54%
			신용스프레드	2.12%
기타				
조건부금융부채	4,959	몬테-카를로 시뮬레이션 현재가치법	할인율	17.57%
			무위험할인율	0.86%
			영업레버리지율	60.00%
			매출총이익할인율	6.68%
조건부금융부채	1,715	확률가중모형	가중평균자본비용	8.60%
			신용위험	2.12%

- Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	3,652,574	3,464,272
당기손익으로 인식된 손익	(4,565)	-
기타포괄손익으로 인식된 손익	(275,224)	(64,078)
기타	1,201,472	-
분기말	4,574,257	3,400,194

(단위: 백만원)

금융부채	당분기	전분기
기초	351,918	342,702
당기손익으로 인식된 손익	3,367	(22,844)
사업결합으로 인한 취득	-	39,083
기타	(1,629)	(1,352)
분기말	353,656	357,589

- Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 Level 3로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과 (기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동		불리한 변동	
	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*1)	-	135,964	-	(131,988)
장기미지급금(*2)	112	112	(112)	(112)
계	112	136,076	(112)	(132,100)

(*1) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 변동성(26.2%~32.2%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(*2) 미지급금은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 10% 만큼 증가 또는 감소 시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

(4) 유형자산 재평가내역

- 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.

마. 채무증권 발행실적 등

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
삼성전자	회사채	공모	1997.10.02	106,650	7.7	AA-(S&P), A1(Moody's)	2027.10.01	일부상환	골드만삭스 외
Harman International Industries, Inc	회사채	공모	2015.05.06	426,600	4.2	Baa2 (Moody's), BBB+ (S&P)	2025.05.15	미상환	J.P.모건 외
Harman Finance International, S.C.A	회사채	공모	2015.05.20	459,184	2.0	Baa2 (Moody's), BBB+ (S&P)	2022.05.27	미상환	HSBC 외
합 계	-	-	-	992,434	-	-	-	-	.

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2018년 3월 31일)

(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
US\$ 100,000,000 7.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	106,650	1997.10.02	The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2018년 3월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	해당 없음
	이행현황	해당 없음
담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만
	이행현황	계약내용 이행 중(해당자산에 대해 담보권 설정 없음)
자산처분 제한현황	계약내용	자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함
	이행현황	계약내용 이행 중('18년 1분기중 처분 자산은 전체의 0.0%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	해당 없음
	이행현황	해당 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당 없음

- ※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.
- ※ 기준일 환율을 적용하였습니다.
- ※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다.
- ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일입니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

- 해당사항 없음

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

- 해당사항 없음

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	5,333	5,333	5,333	5,333	464,517	453,260	-	939,109
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	5,333	5,333	5,333	5,333	464,517	453,260	-	939,109

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(삼성전자)

(기준일 : 2018년 3월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	26,660	-	53,325
	합계	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	26,660	-	53,325

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

- 회사채 미상환 잔액(Harman)

(기준일 : 2018년 3월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	459,184	426,600	-	885,784
	합계	-	-	-	-	459,184	426,600	-	885,784

※ 기준일 환율을 적용하였습니다.

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

- 해당사항 없음

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

- 해당사항 없음

(기준일 : -)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

삼일회계법인은 당사의 제48기, 제49기 감사 및 제50기 1분기 검토를 수행하였고, 감사 관련하여 제48기, 제49기 감사의견은 모두 적정이며 제 50기 1분기 검토 결과, 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다. 당사의 종속회사는 제50기 1분기말 현재 269개이며, 당분기 중에 Samsung Display Dongguan Co., Ltd.(SDD) 등 2개사는 PwC로 외부감사인을 변경하였습니다. 전기 중 신규 설립된 종속기업 Samsung Electronics Home Appliance(SEHA)는 당분기 중 PwC를 외부감사인으로 선임 하였습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제50기 1분기	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음
제49기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음
제48기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

<제50기 1분기 일정>

구 분		일정
1분기	사전검토	2018.03.05 ~ 2018.03.23
	본검토	2018.04.06 ~ 2018.05.14

※ 상기 일정은 별도·연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

[감사용역 체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내용	보수	총소요시간
제50기 1분기	삼일회계법인	별도 및 연결 분기 재무제표 검토	689	7,833
제49기(전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	4,030	46,576
제48기(전전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	3,690	43,999

당사의 감사인인 삼일회계법인은 회계감사 용역 외에 하기 내용의 비감사용역을 수행하였으며, 당사는 용역의 대가로 제50기 1분기에 310백만원을 지급하였습니다.

[비감사용역 계약체결 현황]

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고
제50기 1분기	2017년 11월	세무자문업무	2018.01~2018.3	194	
	2016년 12월	관세 등 관련 자문업무	2018.01~2018.3	116	
	소계			310	
제49기 (전기)	2017년 1월	세무자문업무	2017.01~2017.12	196	
	2016년 12월	관세 등 관련 자문업무	2017.01~2017.12	810	
	소계			1,006	
제48기 (전전기)	2016년 12월	세무자문업무	2016.12~2016.12	220	
	2016년 2월	관세 등 관련 자문업무	2016.01~2016.12	1,133	
	소계			1,353	

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일(2018년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(이상훈, 이재용, 김기남, 김현석, 고동진)과 사외이사 6인(이인호, 송광수, 김선욱, 박재완, 박병국, 김종훈), 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 거버넌스위원회 등 6개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.

※ 2018년 3월 23일 권오현 사내이사와 김한중, 이병기 사외이사가 임기만료되었으며, 윤부근, 신종균 사내이사가 사임하였습니다.

※ 2018년 3월 23일 주주총회를 통해 이상훈, 김기남, 김현석, 고동진 사내이사와 김종훈, 김선욱, 박병국 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사									
				이인호	김한중	송광수	이병기	김선욱	박재완	박병국	김종훈		
1차	'18.01.31	① 2017년(제49기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
		② 삼성메디슨㈜ 상표 사용료 수취의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
		③ 2018년 사회공헌기금 운영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
		④ 삼성꿈장학재단 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
		⑤ 발행주식 액면분할의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성			찬성			
		※ 보고사항											
		① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건											
		② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건											
2차	'18.02.23	① 제49기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
		② 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
		- 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고											
		- 제1호: 제49기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건											
		- 제2호: 이사 선임의 건											
- 제2-1호: 사외이사 선임의 건													
- 제2-2호: 사내이사 선임의 건													
- 제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건													
- 제3호: 이사 보수한도 승인의 건													
- 제4호: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건													
		③ 삼성디스플레이㈜와 경사설비 개발계약 체결 및 공급 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
		④ 학교법인 충남삼성학원 기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성			찬성			
3차	'18.03.23	① 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성		찬성			찬성	찬성	찬성	찬성	
		② 대표이사 선정의 건	가결	찬성		찬성			찬성	찬성	찬성	찬성	
		③ 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	해당 사항	찬성	해당 사항		찬성	찬성	찬성	찬성	
		④ 이사 보수 책정의 건	가결	찬성		찬성			찬성	찬성	찬성	찬성	
		⑤ 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	없음 (임기 만료)	찬성	없음 (임기 만료)		찬성	찬성	찬성	찬성	
		⑥ 2018년 경영계획 승인의 건	가결	찬성		찬성			찬성	찬성	찬성	찬성	
		⑦ 생산물 배상책임보험 가입의 건	가결	찬성		찬성			찬성	찬성	찬성	찬성	
		⑧ 창업 80주년 기념 전자제품 기부의 건	가결	찬성		찬성			찬성	찬성	찬성	찬성	

다. 이사회내의 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항
경영위원회	사내이사 3명	김기남, 김현석, 고동진	하단 기재내용 참조
내부거래위원회	사외이사 3명	이인호, 송광수, 김선욱	하단 기재내용 참조
보상위원회	사외이사 3명	송광수, 이인호, 김종훈	하단 기재내용 참조
거버넌스위원회	사외이사 6명	이인호, 송광수, 김선욱, 박재완, 박병국, 김종훈	하단 기재내용 참조

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2018년 1분기말 기준입니다.

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

- 설치목적 : 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행해야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항에 관하여 심의하고 결의한다.
경영위원회 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

- 권한사항

경영위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함

1. 경영일반에 관한 사항

- 1) 회사의 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략
- 2) 주요 경영전략
- 3) 사업계획 · 사업구조 조정 추진
- 4) 해외 지점 · 법인의 설치, 이전 및 철수
- 5) 해외업체와의 전략적 제휴 등 협력추진
- 6) 국내외 주요 자회사 매입 또는 매각(자기자본 0.1% 이상인 경우에 한함)
- 7) 기타 주요 경영현황
- 8) 지점, 사업장의 설치 및 이전, 폐지
- 9) 지배인의 선임 또는 해임
- 10) 최근사업연도 생산액의 5%이상 생산중단, 폐업
- 11) 자기자본 0.5%이상 기술도입계약 체결 및 기술이전, 제휴
- 12) 자기자본 0.5%이상 신물질, 신기술관련 특허권 취득, 양수, 양도계약
- 13) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 제품수거, 과기
- 14) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일계약 체결
- 15) 최근사업연도 매출액의 5%이상 상당 단일판매 대행 또는
공급계약 체결 또는 해지
- 16) 조직의 운영에 관한 기본원칙
- 17) 급여체계, 상여 및 후생제도의 기본원칙의 결정 및 변경
- 18) 명의개서 대리인의 선임, 해임 및 변경
- 19) 주주명부폐쇄 및 기준일 설정에 관한 사항
- 20) 업무추진 및 경영상 필요한 세칙의 제정

2. 재무 등에 관한 사항

- 1) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 타법인 출자, 처분
 - 2) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 해외 직접투자
 - 3) 자기자본 0.1%이상 2.5%미만 상당 신규 담보제공 또는 신규 채무보증(기간 연장은 제외함)
 - 담보 : 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함.
 - 채무보증 : 입찰, 계약, 하자, 차액보증 등의 이행보증과 납세보증은 제외.
 - 4) 자기자본 0.1%이상 5%미만 상당 신규 차입계약 체결 (기간 연장은 제외함)
 - 5) 내부거래의 승인

내부거래라 함은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 30억원 이상 50억원 미만 상당의 자금(가지급금, 대여금 등), 유가증권(주식, 회사채 등) 또는 자산(부동산, 무체재산권 등)을 제공하거나 거래하는 행위(기존 계약을 중대한 변경 없이 갱신하는 경우는 제외함)
 - 6) 사채발행
 - 7) 자기자본 0.1% 이상의 부동산 취득 및 처분. 단, 제3자와의 거래로 인한 경우에 한함
 - 8) 주요 시설투자 등 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
3. 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회 의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회

- 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항
 - 내부거래 보고 청취권
계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음
 - ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음
 - 내부거래 직권조사 명령권
 - 내부거래 시정조치 건의권

□ 보상위원회

- 설치목적 : 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함
- 권한사항
 - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
 - 등기이사에 대한 보상체계
 - 기타 이사회에서 위임한 사항

□ 거버넌스위원회

- 설치목적 : 기업의 사회적 책임을 다하고 주주가치를 제고하기 위함
- 권한사항
 - 회사의 사회적 책임과 관련된 사항
 - 주주가치 제고와 관련한 사항
 - 주주환원 정책 사전심의
 - 주주권의 개선을 위한 각종 활동 검토
 - 기타 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 검토
 - 위원회 산하 연구회, 협의회 등 조직의 설치, 구성, 운영과 관련된 사항
 - 기타 이사회에서 위임한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명/출석률 및 찬반여부
경영 위원회	'18.01.30	① 라이선스 계약 체결의 건	가결	해당사항 없음 (전원 사내이사로 구성)
	'18.02.07	① 메모리 투자의 건	가결	
		② 평택단지 투자의 건	가결	
		③ 화성캠퍼스 투자의 건	가결	
'18.03.12	① 분기배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 ② 전대차 계약 체결의 건	가결 가결		
'18.03.26	① 경영위원회 위원장 선임의 건 ② 해외법인 청산의 건 ③ 임대차 계약 체결의 건	가결 가결 가결		

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사의 성명			
				이인호 (출석률:100%)	김한중 (출석률:100%)	송광수 (출석률:100%)	김선욱 (출석률: -)
				찬 반 여 부			
내부거래 위원회	'18.01.30	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성메디슨 상표 사용료 수취의 건	-	-	-	-	해당사항 없음 (신규선임)
	'18.03.23	- 대규모 내부거래에 대한 사전 심의 1) 생산물 배상책임보험 가입의 건	-	-	-	-	

※ 2018년 3월 23일 김한중 사외이사가 임기만료되었습니다.

□ 보상위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사의 성명			
				송광수 (출석률:100%)	이인호 (출석률:100%)	이병기 (출석률:100%)	김종훈 (출석률: -)
				찬 반 여 부			
보상 위원회	'18.02.21	① 2018년 이사보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)

※ 2018년 3월 23일 이병기 사외이사가 임기만료되었습니다.

□ 거버넌스위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사의 성명							
				이병기 (출석률 :100%)	이인호 (출석률 :100%)	김한중 (출석률 :100%)	송광수 (출석률 :100%)	김선욱 (출석률:-)	박재완 (출석률 :100%)	박병국 (출석률:-)	김종훈 (출석률:-)
				찬 반 여 부							
거버넌스 위원회	'18.02.23	※ 보고사항 ① IR동향 보고의 건 ② CSR리스크관리협의회 안건 보고의 건	- -	- -	- -	- -	- -	해당사항 없음 (신규 선임)	- -	해당사항 없음 (신규 선임)	해당사항 없음 (신규 선임)

※ 2018년 3월 23일 이병기, 김한중 사외이사가 임기만료되었습니다.

라. 이사의 독립성

① 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
사내이사	이상훈	이사회	이사회 의장	해당없음	특수관계인
사내이사	이재용	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	김기남	이사회	DS부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	김현석	이사회	CE부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사내이사 (대표이사)	고동진	이사회	IM부문 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인
사외이사	이인호	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인
사외이사	송광수	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인
사외이사	김선욱	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인
사외이사	박재완	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인
사외이사	박병국	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인
사외이사	김종훈	사외이사후보 추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	특수관계인

※ 2018년 1분기말 기준입니다.

② 사외이사후보 추천위원회

주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3인(박재완, 박병국, 김종훈)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.
(상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

③ 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

- 지원조직 : 경영지원실 인사팀
- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원
- 담당 직원의 현황 : 5명

(2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실적

1) 신입 사외이사 오리엔테이션

- 시기 : '18년 3월, 4월
- 주체 : 인사팀 및 이사회 유관부서 경영진
- 내용 : 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2) 국내외 경영현장 점검

- 시기 : 매년 1~2회 실시
 - ※ '18년은 1월 실시
- 주체 : 인사팀 및 해당 경영현장 경영진
- 내용 : 경영활동 현황과약을 위한 현장 시찰

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 2018년 1분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	타회사 겸직 현황	비고
이인호 (위원장)	- 신한은행 고문 (2009~2011) - 신한금융지주회사 대표이사 사장 (2005~2009) - 신한은행 은행장 (1999~2003)	-	사외이사
송광수	- 김&장 법률사무소 고문 (2007~현재) - 제33대 대검찰청 검찰총장 (2003~2005) - 대구고등검찰청 검사장 (2002~2003)	(주)두산 사외이사 (2013~현재)	사외이사
김선욱	- 이화여자대학교 법학과(법학전문대학원) 교수 (1995~2018) - 이화여자대학교 총장 (2010~2014) - 법제처 처장 (2005~2007)	-	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계·재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등
- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항, 당사 감사위원회 규정 제2조
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)	
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이인호 1인)	상법 제542조의11 제 2항, 당사 감사위원회 규정 제3조
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족	
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명			
				이인호 (출석률:100%)	김한중 (출석률:100%)	송광수 (출석률:100%)	김선욱 (출석률: -)
				찬 반 여 부			
감사 위원회	'18.01.30	- 제49기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2017년 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - 2017년 4/4분기 대외 후원금 현황 보고 - 2017년 감사팀 감사실적 보고	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	해당사항 없음 (신규선임)
	'18.02.23	- 제49기 정기주주총회 목적사항 심의 - 2017년 내부감시장치 가동현황 보고	- -	- -	- -	- -	

※ 2018년 3월 23일 김한중 사외이사가 임기만료되었습니다.

라. 준법지원인에 관한 사항

구 분		내 용
1.준법지원인	성명	김영수
	나이	만49세
	최종학력	학사(서울대 법대)
	현직	삼성전자 법무실 Compliance팀장 (2018년 3월~현재)
	주요경력	'13.03 : 삼성전자 준법경영실 상무대우 '15.12 : 삼성전자 법무팀 상무대우 '18.03 : 삼성전자 개인정보보호사무국장(겸) 상무대우
2. 이사회 결의일		2018.03.23
3. 결격요건		해당사항 없음
4. 기타		해당사항 없음

※ 2018년 1분기말 기준입니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

다음은 기초 및 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기초		기말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
이건희	본인	보통주	4,985,464	3.86	4,985,464	3.88	-
이건희	본인	우선주	12,398	0.07	12,398	0.07	-
삼성물산	특수관계인	보통주	5,976,362	4.63	5,976,362	4.65	-
삼성복지재단	특수관계인	보통주	89,683	0.07	89,683	0.07	-
삼성문화재단	특수관계인	보통주	37,615	0.03	37,615	0.03	-
홍라희	특수관계인	보통주	1,083,072	0.84	1,083,072	0.84	-
이재용	특수관계인	보통주	840,403	0.65	840,403	0.65	-
삼성생명	특수관계인	보통주	10,622,814	8.23	10,622,814	8.27	-
삼성생명	특수관계인	우선주	879	0.00	879	0.00	-
삼성생명(특별계정)	특수관계인	보통주	466,715	0.36	453,675	0.35	장내매매 등
삼성생명(특별계정)	특수관계인	우선주	30,778	0.17	22,882	0.13	장내매매 등
삼성화재	특수관계인	보통주	1,856,370	1.44	1,856,370	1.45	-
이상훈	특수관계인	보통주	0	0	570	0.00	신규선임
김기남	특수관계인	보통주	0	0	3,500	0.00	신규선임
김현석	특수관계인	보통주	0	0	1,995	0.00	신규선임
고동진	특수관계인	보통주	0	0	1,000	0.00	신규선임
권오현	-	보통주	500	0.00	0	0	이사사임
계		보통주	25,958,998	20.11	25,952,523	20.21	-
		우선주	44,055	0.24	36,159	0.20	-

※ 장내매매 외 지분율 변동은 자사주 매입 및 소각에 따른 변동입니다.

[최대주주 관련 사항]

- 최대주주 : 이건희
- 경력(최근 5년간) : 삼성전자 회장 (2010.3 ~)
국제올림픽위원회 명예위원 (2017 ~)
국제올림픽위원회 위원 (1996 ~ 2017)

- 최대주주 변동현황

당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식의 분포현황

최근 주주명부폐쇄일인 2018년 3월 31일 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	국민연금공단	12,153,817	9.47	-
	삼성생명	11,076,489	8.63	-
우리사주조합		-	-	-

※ 삼성생명 소유주식수 및 지분율은 특별계정 포함 기준입니다.

3. 소액주주현황

최근 주주명부폐쇄일인 2018년 3월 31일 현재 보통주 기준 소액주주현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 3월 31일)

(단위 : 주, %)

구분	주 주		보유주식		비고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	241,414	99.96	75,058,701	58.46	-
전체	241,513	100.00	128,386,494	100.00	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다.

4. 주식사무

<p>정관상 신주인수권의 내용</p>	<p>1. 이 회사가 발행할 신주의 주주인수에 관하여는 제8조 6항에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정시 단수주가 발생 하였을 경우에는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 이를 처리한다.</p> <p>2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.</p> <p>① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우</p> <p>② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우</p> <p>③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우</p> <p>④ 제11조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우</p> <p>⑤ 제11조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.</p> <p>☞(주) 제8조 6항</p> <p>이 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.</p> <p>☞ (주) 제11조의 3 (일반공모증자)</p> <p>1. 이 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 제1항 제3호의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다.</p> <p>2. 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.</p> <p>☞ (주) 제11조의 4 (주식매수선택권)</p> <p>1. 이 회사는 임·직원(상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 상법이 허용하는 한도내에서</p>
--------------------------	--

	<p>상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 한도까지 임·직원(이 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.</p> <p>2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임·직원으로서 관련 법령에서 주식매수선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임·직원은 제외한다.</p> <p>3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.</p> <p>4. 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다.</p> <p>5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년 이내에 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 부여받은 자는 관련 법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.</p> <p>6. 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관련 법령 및 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, 관련 법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회 결의사항으로 규정하지 않은 사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다.</p> <p>7. 다음 각호에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 		
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내
	주주명부폐쇄기간		1월 1일부터 1개월 간
주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000(8종)		
명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23		
주주의 특전	없음	공고계재신문	중앙일보

5. 주가 및 주식거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종류			'17.10월	11월	12월	'18.1월	2월	3월
보통주	주가	최 고	2,754,000	2,861,000	2,605,000	2,606,000	2,491,000	2,589,000
		최 저	2,620,000	2,540,000	2,410,000	2,410,000	2,235,000	2,260,000
		평 균	2,698,063	2,769,091	2,537,053	2,499,136	2,362,444	2,484,190
	거래량	최고(일)	410,396	592,683	406,208	1,293,626	585,207	428,541
		최저(일)	116,121	90,724	147,005	167,673	177,399	155,542
		월 간	3,401	4,621	4,515	6,971	6,332	5,282
우선주	주가	최 고	2,240,000	2,335,000	2,096,000	2,113,000	2,059,000	2,169,000
		최 저	2,067,000	2,096,000	1,956,000	1,954,000	1,839,000	1,885,000
		평 균	2,155,188	2,233,818	2,041,526	2,039,682	1,970,556	2,052,143
	거래량	최고(일)	72,304	117,674	55,848	99,658	68,655	58,027
		최저(일)	18,315	19,388	18,431	21,940	21,754	9,048
		월 간	601	971	682	871	711	544

※ 월간 거래량은 천주 단위입니다.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 런던 증권거래소(보통주)]

(단위 : \$, 원, DR)

종류			'17.10월	11월	12월	'18.1월	2월	3월
보통주	주가	최 고	1,233.00	1,287.00	1,199.00	1,235.00	1,170.00	1,214.00
		(₩환산)	1,387,125	1,412,225	1,310,987	1,315,893	1,266,876	1,293,881
		최 저	1,153.00	1,175.00	1,147.00	1,132.00	1,036.00	1,055.00
		(₩환산)	1,322,145	1,271,820	1,246,445	1,208,184	1,126,961	1,140,772
		평 균	1,186.09	1,253.09	1,172.32	1,175.64	1,103.80	1,152.29
	거래량	최고(일)	82,433	58,894	50,503	84,914	47,339	51,346
		최저(일)	9,017	9,954	1,259	13,716	14,822	14,278
		월 간	656	583	425	606	608	554

※ 월간 거래량은 천DR 단위입니다.

※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준이며, 원주 1주당 2DR입니다.

[증권거래소명 : 룩셈부르크 증권거래소(우선주)]

(단위 : \$, 원, DR)

종 류		'17.10월	11월	12월	'18.1월	2월	3월	
우선주	주가	최 고	1,010.00	1,055.00	986.00	1,002.00	990.00	999.00
		(₩환산)	1,136,250	1,182,866	1,056,400	1,067,631	1,071,972	1,064,734
		최 저	918.00	966.00	917.00	922.00	859.00	879.00
		(₩환산)	1,052,671	1,045,598	993,019	987,646	934,420	950,463
		평 균	949.86	1,011.77	946.58	959.73	923.15	952.95
	거래량	최고(일)	17,333	7,836	10,494	9,862	7,235	4,750
		최저(일)	829	466	596	622	662	366
		월 간	78	66	68	60	59	37

※ 월간 거래량은 천DR 단위입니다.

※ 원화 환산 주가는 거래일 종가 원/달러 환율 기준이며, 원주 1주당 2DR입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
이상훈	남	1955.06	사내이사	등기임원	상근	이사회 의장	삼성전자 前 경영지원실장	570	-	57개월	2021.03.22
이재용	남	1968.06	사내이사	등기임원	상근	경영전반 총괄	삼성전자 부회장	840,403	-	18개월	2019.10.26
김기남	남	1958.04	대표이사	등기임원	상근	DS부문 경영전반 총괄	삼성전자 DS부문장	3,500	-	1개월	2021.03.22
김현석	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	CE부문 경영전반 총괄	삼성전자 CE부문장	1,995	-	1개월	2021.03.22
고동진	남	1961.03	대표이사	등기임원	상근	IM부문 경영전반 총괄	삼성전자 IM부문장	1,000	-	1개월	2021.03.22
이인호	남	1943.11	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	前 신한은행 은행장	-	-	97개월	2019.03.18
송광수	남	1950.01	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	김·장 법률사무소 고문	-	-	61개월	2019.03.14
김선옥	여	1952.12	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	이화여자대학교 명예교수	-	-	1개월	2021.03.22
박재완	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	성균관대학교 행정학과 교수	-	-	22개월	2019.03.11
박병국	남	1959.04	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교 전기·정보공학부 교수	-	-	1개월	2021.03.22
김종훈	남	1960.08	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	Kiswe Mobile 회장	-	-	1개월	2021.03.22

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자		겸 직 회 사	
성 명	직 위	회사명	직 위
송광수	사외이사	(주)두산	사외이사
박재완	사외이사	롯데쇼핑(주)	사외이사
김종훈	사외이사	Kiswe Mobile	회장

※ 2018년 3월 31일 기준입니다.

※ 권오현 사내이사는 2018년 3월 22일 삼성디스플레이(주) 사내이사, 대표이사직에서 사임하였습니다.

다. 미등기임원

성명	직위	출생 년월	성별	담당업무	약력	학력	재직기 간 (개월)	상근 여부
이건희	회장	1942.01	남	회장	대표이사 회장	서울대(博士)		비상근
권오현	회장	1952.10	남	종합기술원 회장	대표이사 부회장	Stanford Univ.(博士)		상근
신종균	부회장	1956.01	남	인재개발담당	대표이사 사장	광운대		상근
윤부근	부회장	1953.02	남	Corporate Relations담당	대표이사 사장	한양대		상근
김상균	사장	1958.07	남	법무실장	준법경영실장	서울대		상근
전동수	사장	1958.08	남	의료기기사업부장	SDS 대표이사	경북대(碩士)		상근
성인희	사장	1957.01	남	의료사업일류화추진단장	정밀화학 대표이사	경희대		상근
김영기	사장	1962.01	남	네트워크사업부장	네트워크 신규사업개발팀장	Univ. of Southern California(博士)		상근
정현호	사장	1960.03	남	사업지원T/F장	디지털이미징사업부장	Harvard Univ.(碩士)		상근
강인엽	사장	1963.07	남	System LSI사업부장	System LSI SOC개발실장	Univ. of California, LA(博士)		상근
노희찬	사장	1961.10	남	경영지원실장	삼성디스플레이 경영지원실장	연세대		상근
정은승	사장	1960.08	남	Foundry사업부장	반도체연구소장	Univ. of Texas, Arlington(博士)		상근
진교영	사장	1962.08	남	메모리사업부장	메모리 DRAM개발실장	서울대(博士)		상근
팀백스터	사장	1961.04	남	북미총괄	SEA법인장	Roger Williams Univ.		상근
한중희	사장	1962.03	남	영상디스플레이사업부장	영상디스플레이 개발팀장	인하대		상근
안승호	부사장대우	1959.07	남	법무실 IP센터장	종합기술원 IP전략팀장	Santa Clara Univ.(博士)		상근
조준형	부사장대우	1960.08	남	법무실 법무팀장	CEO 보좌역	동아대		상근
김상우	부사장대우	1961.10	남	법무실 해외법무팀장	구주총괄 대외협력팀장	Columbia Univ.(碩士)		상근
강경훈	부사장	1964.08	남	제도개선T/F	인사팀 담당임원	경찰대		상근
송현명	부사장대우	1960.10	남	무선 메카솔루션팀장	무선 금형기술팀장	서울대(碩士)		상근
엄영훈	부사장	1960.03	남	북미副总괄	구주총괄	한국과학기술원(碩士)		상근
이상철	부사장	1960.06	남	동남아총괄	무선 전략마케팅실장	인하대		상근
이영희	부사장	1964.11	여	무선 마케팅팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)		상근
박길재	부사장	1966.04	남	무선 제품기술팀장	무선 개발2실 담당임원	연세대(碩士)		상근
박병대	부사장	1959.02	남	한국총괄	생활가전 전략마케팅팀장	한국외국어대		상근
박중환	부사장	1961.12	남	전장사업팀장	생활가전 C&M사업팀장	연세대(碩士)		상근
배영창	부사장	1961.09	남	Foundry 전략마케팅팀장	System LSI 전략마케팅팀장	명지대		상근
안중현	부사장	1963.03	남	사업지원T/F 담당임원	기획팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
왕통	부사장	1962.06	남	중국전략협력실 담당임원	SCIC 담당임원	北京郵電大(북경우전대)		상근
최성호	부사장	1960.12	남	교육파견	지원팀장	성균관대		상근
최정혁	부사장	1962.03	남	Test&Package센터장	메모리 품질보증실장	인하대		상근
김문수	부사장	1963.01	남	구주총괄	영상전략마케팅팀장	고려대		상근
김용관	부사장	1963.12	남	의료기기 전략지원담당	지원팀 담당임원	Thunderbird(碩士)		상근
남궁범	부사장	1964.01	남	재경팀장	경영지원팀 담당임원	고려대		상근
데이빗스틸	부사장	1966.09	남	북미총괄 대외협력팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	MIT(博士)		상근
정태경	부사장	1963.10	남	LED사업팀장	Test&Package센터장	한국과학기술원(博士)		상근
주은기	부사장	1962.01	남	상생협력센터장	상생협력센터 대외협력팀장	한국과학기술원(碩士)		상근
최경식	부사장	1962.03	남	무선 전략마케팅실장	무선 전략마케팅실 담당임원	한양대(碩士)		상근
최윤호	부사장	1963.01	남	사업지원T/F 담당임원	무선 지원팀장	성균관대		상근
최주선	부사장	1963.05	남	DS부문 미주총괄	메모리 전략마케팅팀장	한국과학기술원(博士)		상근
계승교	부사장	1963.12	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	SDS SDSA법인장	The Johns Hopkins Univ.(碩士)	21	상근
권계현	부사장	1964.07	남	중국총괄	SCIC Mobile Div.장	Univ. of Edinburgh(碩士)		상근
김용희	부사장	1961.02	남	영상디스플레이 구매팀장	생활가전 구매팀장	광운대		상근
박용기	부사장	1963.04	남	인사팀장	무선 인사팀장	한국과학기술원(碩士)		상근

소병세	부사장	1962.09	남	SSIC 담당임원	SSIC 기술전략팀장	Univ. of Wisconsin, Madison (博士)		상근
신명훈	부사장대우	1965.01	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)		상근
삼원환	부사장	1960.02	남	베트남복합단지장	구미지원센터장	경북대(碩士)		상근
장시호	부사장	1961.07	남	글로벌기술센터장	무선 Global제조센터장	한양대		상근
최철	부사장	1962.05	남	DS부문 중국총괄	SSC 담당임원	청화대(碩士)		상근
김석기	부사장	1962.11	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	영상디스플레이 Global운영센터장	한양대		상근
김정환	부사장	1958.01	남	중남미총괄	영상디스플레이 Enterprise Business팀장	한국외국어대		상근
이정배	부사장	1967.02	남	메모리 품질보증실장	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)		상근
최시영	부사장	1964.01	남	Foundry제조기술센터장	System LSI제조센터장	The Ohio State Univ.(博士)		상근
한재수	부사장	1962.06	남	메모리 전략마케팅팀장	DS부문 미주총괄	성균관대		상근
홍현철	부사장	1961.01	남	서남아총괄	SELA법인장	한국외국어대		상근
강봉구	부사장	1962.02	남	생활가전 전략마케팅팀장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	홍익대		상근
강봉용	부사장	1964.01	남	DS부문 지원팀장	메모리 지원팀장	고려대		상근
강창진	부사장	1961.08	남	DS부문 기획팀장	DS부문 감사팀 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
김경준	부사장	1965.02	남	무선 Global CS팀장	무선 개발2실 담당임원	한양대(碩士)		상근
김원경	부사장	1967.08	남	Global Public Affairs팀장	북미총괄 대외협력팀장	The Johns Hopkins Univ.(碩士)		상근
김재윤	부사장	1963.03	남	기획팀장	삼성경제연구소 산업전략1실장	서울대(博士)	27	상근
김종성	부사장	1964.02	남	영상디스플레이 지원팀장	삼성디스플레이 경영지원팀장	서울대	47	상근
명성완	부사장	1962.03	남	중동총괄	SEG법인장	한국외국어대		상근
박경균	부사장	1962.10	남	무선 구매팀장	무선 구매팀 담당임원	동아대		상근
박찬훈	부사장	1962.04	남	기흥/화성/평택단지장	SAS법인장	電氣通信大學(博士)		상근
백수현	부사장	1963.01	남	커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대	54	상근
백홍주	부사장	1961.12	남	메모리제조기술센터장	SCS법인장	인하대		상근
안덕호	부사장대우	1968.07	남	DS부문 법무지원팀장	법무실 담당임원	서울대		상근
양걸	부사장	1962.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	서강대(碩士)		상근
윤철운	부사장	1962.11	남	영상디스플레이 Global운영팀장	영상디스플레이 Global CS팀장	한국과학기술원(碩士)		상근
이돈태	부사장	1968.09	남	디자인경영센터장	디자인경영센터 副센터장	연세대(博士)	39	상근
이명진	부사장	1958.08	남	IR그룹장	커뮤니케이션팀 담당임원	State Univ. of New York, Buffalo		상근
이봉주	부사장	1963.03	남	DS부문 인사팀장	System LSI 인사팀장	한국과학기술원(碩士)		상근
이왕익	부사장	1963.07	남	재경팀 담당임원	삼성생명 지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
전준영	부사장	1962.05	남	DS부문 구매팀장	System LSI 기획팀장	성균관대		상근
정수연	부사장	1961.06	남	무선 Global제조센터장	무선 Global제조센터 담당임원	금오공대		상근
최진원	부사장	1966.09	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	서울대		상근
삼순선	전무	1961.10	남	Global CS센터장	CS환경센터장	성균관대(碩士)		상근
이태협	전무	1960.05	남	성균관대(파견)	커뮤니케이션팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)		상근
윤한길	전무	1962.09	남	Samsung NEXT 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	Univ. of Florida(博士)		상근
이상주	전무대우	1970.09	남	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀장	Harvard Univ.(碩士)		상근
이중철	전무대우	1968.01	남	북미총괄 법무지원팀장	법무실 준법지원팀 담당임원	Univ. of Pennsylvania(碩士)	49	상근
최영규	전무	1961.03	남	무선 PC사업팀장	무선 개발실 담당임원	서울대(碩士)		상근
강윤제	전무대우	1968.08	남	무선 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀장	청주대		상근
김의탁	전무	1958.06	남	CIS총괄	영상전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대		상근
이인정	전무대우	1961.10	남	법무실 IP센터 라이선싱팀장	IP센터 IP법무팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)		상근
최구연	전무	1962.10	남	한국총괄 CE영업팀장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한양대		상근
김도형	전무	1958.09	남	SEHC법인장	SEPM법인장	아주대		상근
김연수	전무	1963.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	GMO 브랜드전략팀장	고려대		상근
박문호	전무	1965.01	남	인사팀 담당임원	경영진단팀 담당임원	성균관대		상근
박윤상	전무	1963.06	남	무선 PSI팀 담당임원	무선 개발1실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)		상근

배주천	전우대우	1958.11	남	기흥/화성/평택단지 전기기술팀장	기흥/화성단지총괄 Infra기술센터 담당임원	송실대(博士)		상근
서기용	전우	1960.11	남	네트워크 전략마케팅팀장	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	연세대(碩士)		상근
신재경	전우	1963.01	남	Test&Package센터 담당임원	SESS법인장	서울대(碩士)		상근
안정대	전우	1964.02	남	감사팀장	영상디스플레이 지원팀장	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)		상근
오수열	전우	1960.07	남	네트워크 Global운영팀장	네트워크 Global제조팀장	아주대		상근
장호식	전우대우	1963.10	남	법무실 IP센터 IP전략팀장	IP센터 IP전략팀 담당임원	Franklin Pierce Law Center(碩士)		상근
정경진	전우	1961.04	남	교육파견	감사팀장	충남대		상근
정광영	전우	1961.08	남	Global CS센터 Global서비스팀장	삼성전기 경영지원실장	한양대		상근
추종석	전우	1962.09	남	영상전략마케팅팀장	영상전략마케팅팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(碩士)		상근
김정호	전우	1964.04	남	재경팀 담당임원	경영지원팀 담당임원	Emory Univ.(碩士)		상근
송두현	전우	1964.01	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
이평우	전우	1963.11	남	삼성전자판매(파견)	SCIC 담당임원	성균관대		상근
이흥모	전우대우	1962.10	남	Samsung Research IP출원팀장	DMC연구소 IP출원팀장	Franklin Pierce Law Center(碩士)		상근
최주호	전우	1963.03	남	무선 인사팀장	인사팀 담당임원	아주대(碩士)		상근
하혜승	전우	1967.11	여	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	Wellesley Coll.		상근
황규철	전우	1964.09	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
고승환	전우	1962.09	남	생활가전 구매팀장	영상디스플레이 구매팀 담당임원	인하대		상근
김동욱	전우	1963.09	남	SEVT법인장	SEVT 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
김사필	전우	1965.04	남	상생협력센터 대외협력팀장	인사팀 담당임원	경찰대		상근
김성진	전우	1965.03	남	생활가전 지원팀장	지원팀 담당임원	고려대		상근
김진해	전우	1963.12	남	한국총괄 모바일영업팀장	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	광운대		상근
김학래	전우	1962.02	남	글로벌기술센터 자동화기술팀장	생산기술연구소 수석	한양대		상근
김홍경	전우	1965.11	남	사업지원T/F 담당임원	삼성SDI 경영지원실장	한국과학기술원(碩士)		상근
목장균	전우	1964.03	남	구미지원센터장	인사팀 담당임원	고려대		상근
성일경	전우	1964.01	남	SEG법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	연세대		상근
심상필	전우	1965.05	남	SAS법인장	System LSI Foundry사업팀 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
심의경	전우	1964.10	남	Foundry 인사팀장	메모리 인사팀장	한국과학기술원(碩士)		상근
윤성희	전우	1964.12	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	영남대		상근
이강협	전우	1962.12	남	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대		상근
이민혁	전우대우	1972.02	남	디자인경영센터 디자인혁신팀장	무선 디자인팀장	경희대		상근
이성수	전우	1964.11	남	DS부문 감사팀장	메모리 품질보증실 담당임원	경희대		상근
이승욱	전우	1967.02	남	사업지원T/F 담당임원	기획팀 담당임원	Akron(博士)	41	상근
전세원	전우	1964.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	SSI법인 담당부장	홍익대		상근
최방섭	전우	1963.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	지원팀 담당임원	서울대		상근
최승범	전우	1964.12	남	Samsung Research 기술전략팀장	소프트웨어센터 S/W전략팀장	한국과학기술원(碩士)		상근
최원진	전우	1964.01	남	한국총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대		상근
최정준	전우	1965.08	남	지원팀장	지원팀 담당임원	성균관대		상근
홍두희	전우	1964.02	남	무선 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	Wake Forest Univ.(碩士)		상근
강석림	전우	1964.10	남	기흥/화성/평택단지 스마트IT팀장	메모리 제조센터 담당임원	경북대		상근
김경진	전우	1963.11	남	SAMEX법인장	SESK법인장	송실대		상근
김원수	전우	1961.08	남	SEM-P법인장	SIEL-P(N)공장장	삼성전자기술대학(碩士)		상근
김우준	전우	1968.05	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	차세대사업팀 담당임원	서울대(博士)		상근
나기홍	전우	1966.03	남	인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	고려대		상근
박봉주	전우	1963.05	남	생활가전 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	서강대		상근
부성중	전우	1964.10	남	경영혁신센터 담당임원	지원팀 담당임원	성균관대		상근
스틴지아노	전우	1966.02	남	SEA 담당임원	SEA CB Div. SVP	Rutgers Univ.		상근
이병철	전우	1965.10	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	청화대(淸華大)(碩士)		상근
이현식	전우	1964.12	남	한국총괄 B2B영업팀장	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	연세대(碩士)		상근
임백균	전우	1963.02	남	SCS법인장	메모리제조센터 담당임원	삼성전자기술대학(碩士)		상근
채원철	전우	1966.05	남	무선 기술전략팀장	무선 기술관리팀장	광운대		상근

강민호	전우	1964.05	남	네트워크 지원팀장	무선 지원팀 담당임원	경북대		상근
구지흠	전우	1968.01	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	North Carolina State Univ.(博士)		상근
김기원	전우	1963.04	남	상생협력센터 담당임원	상생협력센터 담당임원	고려대(碩士)	53	상근
김남용	전우	1965.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	연세대		상근
김동욱	전우	1968.10	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대(碩士)		상근
김명욱	전우	1961.01	남	SSEC법인장	SIEL-P(N)공장장	인하대		상근
김상규	전우	1968.01	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당임원	서울대(碩士)		상근
김선식	전우	1964.06	남	DS부문 인사팀 담당임원	Test&Package센터 담당임원	성균관대(碩士)		상근
김성환	전우	1964.07	남	TSE-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	고려대(碩士)		상근
김영도	전우	1962.12	남	상생협력센터 구매전략팀장	상생협력센터 구매전략팀 담당부장	경북대		상근
김이태	전우	1966.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	기획팀 담당임원	Univ. of Missouri, Columbia(博士)	23	상근
김재훈	전우대우	1972.08	남	법무실 담당임원	법무실 Compliance팀 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)		상근
김진성	전우	1963.02	남	Foundry제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 담당임원	아주대		상근
김현도	전우	1966.04	남	영상디스플레이 인사팀장	무선 인사팀 담당임원	연세대(碩士)		상근
김현주	전우	1965.06	남	SEJ법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	광운대		상근
더롯데이인	전우	1962.09	남	DS부문 구조총괄	DS부문 구조총괄 담당임원	Limerick Regional Technical College		상근
류문형	전우	1965.07	남	북미총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	서울대		상근
문성우	전우	1971.12	남	경영혁신센터장	경영혁신센터 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
바우만	전우	1966.05	남	SEUK법인장	SEPOL법인장	Univ. of Bath(碩士)		상근
박봉출	전우	1964.01	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	인사팀 담당부장	송실대		상근
박영우	전우	1962.11	남	SESS법인장	메모리 Solution개발실 담당임원	인천대		상근
서동면	전우	1963.02	남	DS부문 커뮤니케이션팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	한양대		상근
송기찬	전우	1963.05	남	지원팀 담당임원	구조총괄 지원팀장	성균관대		상근
송봉섭	전우	1965.04	남	인사팀 담당임원	생활가전 인사팀장	경북대		상근
송원득	전우대우	1964.01	남	법무실 IP센터 기술분석팀장	법무실 IP센터 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
안정수	전우	1964.01	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대		상근
오세용	전우	1962.06	남	동남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	중앙대		상근
윤성혁	전우	1962.09	남	아프리카총괄	SSA법인장	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)		상근
윤태양	전우	1968.12	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대(碩士)		상근
이규열	전우	1966.05	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	항공대		상근
이병국	전우	1965.11	남	SVCC장	무선 Global제조센터 담당임원	부산대		상근
이상배	전우	1963.03	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI TD팀 담당임원	광운대(博士)		상근
임성택	전우	1966.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원	인사팀 담당임원	연세대		상근
장성대	전우	1964.08	남	기흥/화성/평택단지 건설팀장	기흥/화성단지총괄 Facility팀장	동국대		상근
장성재	전우	1965.06	남	지원팀 담당임원	감사팀 담당임원	서강대		상근
장재혁	전우	1967.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	중앙대		상근
조상호	전우	1965.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEUK법인장	경희대		상근
주창훈	전우	1970.10	남	사업지원T/F 담당임원	인사팀 담당임원	아주대(碩士)		상근
짐엘리엇	전우	1970.11	남	DS부문 미주총괄 담당임원	미주총괄 VP	California Polytechnic State Univ.	52	상근
최길현	전우	1966.10	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	한양대(碩士)		상근
최수영	전우	1965.11	남	생활가전 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당임원	고려대		상근
최종열	전우대우	1967.06	남	생활가전 디자인팀장	생활가전 디자인 담당임원	서울대(碩士)		상근
한승훈	전우	1965.07	남	DS부문 미주총괄 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Iowa State Univ.(博士)		상근
강승구	상우	1963.08	남	서남아총괄 SIEL-S 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	한양대		상근
이성덕	상우	1965.08	남	의료기기 DR사업팀장	의료기기 선행개발팀 담당임원	광운대(碩士)		상근
곽진환	상우	1968.01	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 기술분석팀 담당임원	Santa Clara Univ.(碩士)		상근
김병욱	상우	1963.08	남	기흥/화성/평택단지 지원팀 담당임원	재경팀 담당임원	고려대		상근
김영수	상우대우	1968.07	남	법무실 Compliance팀장	법무실 담당임원	서울대	60	상근
이재엽	상우	1966.08	남	지원팀 담당임원	SET법인장	한국외국어대		상근
허정호	상우	1962.06	남	중국총괄 지원팀장	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Long Island Univ.(碩士)		상근

김대현	상무	1964.08	남	SETK법인장	SEI법인장	한국과학기술원(碩士)		상근
김종신	상무	1963.10	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대(碩士)		상근
김창한	상무	1963.01	남	DS부문 상생협력센터장	DS부문 기획팀 담당임원	성균관대		상근
남정현	상무대우	1964.04	남	글로벌기술센터 제조혁신팀장	삼성중공업 생산부문 담당임원	천안공고		상근
박경철	상무	1964.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEDA-S 판매부부장	연세대		상근
서양석	상무	1966.10	남	경영혁신센터 담당임원	서남아총괄 지원팀장	Thunderbird(碩士)		상근
송하석	상무	1963.07	남	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당임원	성균관대		상근
신종민	상무	1962.10	남	SEV법인장	TSTC법인장	울산대		상근
양준호	상무대우	1971.02	남	무선 디자인팀 담당임원	디자인경영센터 차세대디자인팀 담당임원	세종대		상근
오창건	상무	1962.01	남	경영혁신센터 담당임원	SELS법인장	한국과학기술원(碩士)		상근
음두찬	상무	1965.12	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
이계성	상무대우	1967.11	남	구주총괄 대외협력팀장	법무실 담당임원	St. Louis Univ.(碩士)		상근
이상욱	상무	1964.06	남	무선 기술전략팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	서울대(博士)	39	상근
전승준	상무	1962.06	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	한양대(碩士)		상근
경윤	상무	1967.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SETK법인장	서울대(博士)		상근
조덕현	상무	1966.02	남	중동총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	경북대		상근
진연탁	상무	1963.05	남	SCIC 담당임원	SCIC 담당부장	성균관대(碩士)		상근
최승식	상무	1966.01	남	SERC 담당임원	SEKZ법인장	고려대		상근
최윤범	상무	1963.02	남	SEVT 담당임원	Media Solution센터 지원팀장	경원대		상근
한인국	상무	1964.11	남	기획팀 담당임원	기획팀 담당부장	한양대		상근
강동춘	상무대우	1970.12	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)		상근
권재훈	상무	1964.04	남	SEIN-S법인장	SEAU법인장	한국외국어대		상근
김도현	상무대우	1975.03	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	서울대		상근
김도현	상무	1966.11	남	무선 전략마케팅실 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	서울대(碩士)	46	상근
김동환	상무	1964.06	남	상생협력센터 담당임원	베트남복합단지 담당임원	항공대		상근
김민섭	상무	1966.02	남	Test&Package센터 담당임원	DS부문 지원팀 담당임원	성균관대		상근
김영수	상무	1966.08	남	한국총괄 IMC팀장	SESA법인장	서강대		상근
김영태	상무	1963.10	남	생활가전 C&M사업팀장	생활가전 C&M사업팀 담당임원	서울대		상근
김영호	상무	1964.12	남	감사팀 담당임원	재경팀 담당임원	Tulane Univ.(碩士)		상근
김유석	상무대우	1965.04	남	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 IP전략팀 담당임원	Washington Univ. in St. Louis (博士)		상근
김정렬	상무	1963.03	남	LED사업팀 담당임원	SSW 담당임원	경희대		상근
김중현	상무	1966.08	남	생활가전 인사팀장	인사팀 담당임원	육사		상근
김태관	상무	1965.01	남	구주총괄 지원팀장	생활가전 지원팀 담당임원	고려대		상근
박경호	상무	1965.06	남	종합기술원 기획지원팀장	종합기술원 CTO전략팀 담당임원	성균관대		상근
박성호	상무	1968.09	남	SEHZ법인장	SEV 담당임원	경북대(碩士)		상근
배학범	상무	1963.08	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SEDA-P(M) 담당임원	경희대		상근
손기태	상무	1967.12	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SEA 담당임원	서울대		상근
신동호	상무	1963.10	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Global운영팀장	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)		상근
안민용	상무	1963.06	남	Test&Package센터 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	경북대		상근
안용일	상무대우	1971.02	남	디자인경영센터 UX센터장	디자인경영센터 디자인전략팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
양경택	상무	1964.02	남	SEHC 담당임원	한국총괄 지원팀장	서강대		상근
양석환	상무	1962.05	남	생활가전 지원팀 담당임원	SEA 담당임원	Purdue Univ.(碩士)		상근
엄재훈	상무	1966.06	남	SCIC 담당임원	중국총괄 Retail Management팀장	서강대(碩士)		상근
이경태	상무	1966.12	남	무선 기획팀장	지원팀 담당임원	서울대(碩士)		상근
이동근	상무	1963.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	무선 인사팀 담당임원	고려대(博士)		상근
이상우	상무대우	1972.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	연세대	34	상근
이선영	상무	1965.04	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	한양대		상근

이승백	상무	1964.02	남	DS부문 커뮤니케이션팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당임원	중앙대		상근
이우섭	상무	1966.05	남	무선 구매팀 담당임원	무선 Global운영실 담당임원	성균관대		상근
이태관	상무대우	1971.12	남	법무실 담당임원	삼성물산 법무팀 담당임원	George Washington Univ.(碩士)		상근
임취용	상무	1965.02	남	네트워크 인사팀장	수원지원센터 인사팀장	서강대		상근
전경빈	상무	1966.12	남	생활가전 Global CS팀장	Global CS센터 품질혁신팀장	한국과학기술원(博士)		상근
정광열	상무	1965.09	남	커뮤니케이션팀 담당임원	DMC부문 커뮤니케이션팀 담당임원	연세대(碩士)		상근
정기수	상무	1965.02	남	의료기기 인사팀장	글로벌기술센터 담당임원	연세대		상근
정상섭	상무	1966.11	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
정상인	상무대우	1969.06	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	Case Western Reserve Univ.(碩士)		상근
정영락	상무	1962.10	남	SEI법인장(Co)	영상전략마케팅팀 담당임원	단국대		상근
정홍구	상무	1964.08	남	무선 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	고려대		상근
최완우	상무	1965.02	남	메모리 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	서강대		상근
최윤준	상무	1967.09	남	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 개발팀장	MIT(博士)		상근
허국	상무	1965.08	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	서강대		상근
허길영	상무	1965.08	남	DS부문 지원팀 담당임원	Test&Package센터 담당임원	아주대(碩士)		상근
홍승오	상무	1968.10	남	기획팀 담당임원	경영지원실 사업전략 담당부장	London Business Sch. (LBS) (碩士)		상근
가네코	상무	1958.12	남	DS부문 일본총괄	DS부문 일본총괄 VP	Musashi Univ.		상근
강윤석	상무	1964.05	남	LED사업팀 담당임원	Test&Package센터 인사팀장	성균관대(碩士)		상근
강인규	상무대우	1968.05	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	서울대	28	상근
강현석	상무	1963.08	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SIEL-S 담당임원	서강대		상근
권재욱	상무	1966.07	남	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 전략마케팅팀 담당임원	서울대(博士)		상근
권태훈	상무	1968.02	남	재경팀 담당임원	DS부문 일본총괄 담당임원	North Carolina, Chapel Hill(碩士)		상근
김개연	상무	1969.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(碩士)		상근
김경춘	상무대우	1974.01	남	영상디스플레이 디자인팀장	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	중앙대		상근
김도현	상무	1965.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SECH법인장	항공대		상근
김동관	상무	1969.10	남	인사팀 담당임원	SDS 보안선진화T/F장	한양대		상근
김요정	상무	1965.04	남	System LSI 품질팀장	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	포항공대(碩士)		상근
김윤수	상무	1967.12	남	SME법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	Thunderbird(碩士)		상근
김은중	상무	1965.06	남	메모리 Global운영팀장	메모리 Global운영팀 담당부장	성균관대		상근
김종근	상무	1967.06	남	SEDA-P(M)공장장	무선 Global제조센터 Global제조 지원팀장	경북대(碩士)		상근
김종두	상무	1964.09	남	SEV 담당임원	무선 구매팀 담당임원	부산대		상근
김종민	상무	1968.03	남	전장사업팀 담당임원	IRO	Univ. of Pennsylvania(碩士)		상근
김형남	상무	1965.06	남	영상디스플레이 Global CS팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
김호진	상무	1966.08	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당부장	성균관대		상근
까들로	상무	1971.01	남	SEI법인장(Co)	SEI 법인장	UNIVERSITA STATALE DI MILANO (碩士)		상근
나운천	상무	1967.02	남	SEA 담당임원	재경팀 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)		상근
남길준	상무	1963.08	남	SECA법인장	SEA 담당임원	서강대		상근
노형훈	상무	1964.11	남	TSE-P법인장	SSEC 담당부장	고려대		상근
마틴	상무	1970.02	남	SEG 법인장	SEG 담당임원	Staatl. Berufsakademie Mannheim		상근
맹경우	상무	1970.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(博士)		상근
박광채	상무	1964.04	남	의료기기 지원팀장	수원지원센터 지원팀장	서울대		상근
박동수	상무	1966.12	남	중남미총괄 CS팀장	Global CS센터 Global서비스팀장	광주대		상근
박범주	상무	1966.04	남	인재개발원 담당임원	인재개발센터 담당부장	성균관대(博士)		상근
박석민	상무	1970.12	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	Univ. of Texas, Austin(博士)		상근
박찬우	상무	1973.05	남	무선 상품혁신팀 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)		상근
방현우	상무	1967.07	남	베트남복합단지 대외협력팀장	서남아총괄 대외협력팀장	고려대(碩士)		상근
백일섭	상무	1968.08	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 개발2실 담당임원	광운대		상근
서응교	상무	1964.11	남	서남아총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	서울대		상근
신성우	상무	1965.12	남	Foundry 지원팀장	SAS법인 담당임원	연세대		상근
안준인	상무	1965.07	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 Global CS팀 담당부장	경운대		상근

안진	상무	1966.02	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SDC 감사팀 담당임원	인하대	39	상근
양동성	상무	1967.12	남	DS부문 구조총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	성균관대		상근
오시연	상무	1971.02	여	경영혁신센터 담당임원	중국총괄 지원팀 담당임원	고려대(碩士)	39	상근
오창민	상무	1965.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEJ 담당임원	서울대(碩士)		상근
오치오	상무	1967.01	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	종합기술원 인사팀 담당부장	건국대(碩士)		상근
윤여봉	상무	1964.10	남	Saudi Arabia지점장	SGE법인장	고려대		상근
이기호	상무	1964.06	남	SEPCO법인장	SEA 담당임원	성균관대		상근
이상재	상무	1965.06	남	서남미총괄 대외협력팀장	글로벌기술센터 담당임원	중앙대		상근
이성민	상무	1964.09	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	성균관대		상근
이승구	상무	1969.08	남	인사팀 담당임원	SEG 담당임원	성균관대		상근
이정주	상무	1964.06	남	SET법인장	SCIC 담당임원	고려대		상근
이철희	상무	1963.04	남	SEV 담당임원	무선 지원팀 담당임원	성균관대		상근
이현	상무	1969.02	남	SEAU법인장	SEPCO법인장	Syracuse Univ.(碩士)		상근
이홍빈	상무	1964.04	남	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당임원	명지대		상근
장문석	상무	1969.03	남	무선 Global운영팀장	무선 Global운영팀 담당임원	항공대		상근
전용병	상무	1966.08	남	SCIC 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	북경대(碩士)		상근
정광명	상무	1964.04	남	생활가전 광주지원팀장	무선 인사팀 담당부장	전남대		상근
정완영	상무	1965.05	남	DS부문 중국총괄 담당임원	중국상성전략협력실 담당임원	고려대		상근
정재신	상무	1964.08	남	중남미총괄 물류혁신팀장	경영혁신팀 담당임원	서강대	39	상근
조성수	상무	1966.12	남	SSEC 담당임원	프린팅솔루션 지원팀 담당임원	서울대		상근
조용취	상무	1968.06	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대		상근
조인하	상무	1974.02	여	영상전략마케팅팀 담당임원	SEASA 담당부장	서강대(碩士)		상근
지현기	상무	1968.01	남	메모리 기획팀장	DS부문 기획팀 담당임원	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)		상근
최경록	상무	1971.04	남	무선 제품기술팀 담당임원	SRC-Tianjin연구소장	경북대(碩士)		상근
케빈리	상무	1962.07	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 미주총괄 담당부장	Univ. of Texas, Austin		상근
폴브래넨	상무	1960.11	남	SECA 담당임원	SECA VP	Carleton Univ.		상근
홍유진	상무대우	1972.05	여	무선 UX혁신팀장	무선 UX혁신팀 담당임원	Univ. of California, LA(碩士)		상근
홍중서	상무	1966.11	남	반도체연구소 기술기획팀장	반도체연구소 수석	고려대		상근
가르시아	상무	1972.08	남	SESA 담당임원	SESA VP	ESADE(碩士)	52	상근
강상범	상무	1969.02	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(博士)	52	상근
고상범	상무대우	1965.10	남	무선 메카솔루션팀 담당임원	무선 금형기술팀 담당임원	부산대	52	상근
김광진	상무	1965.12	남	SCIC 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	고려대	52	상근
김기건	상무	1964.02	남	영상디스플레이 Global CS팀 담당임원	영상디스플레이 Global CS팀 담당부장	광운대	52	상근
김기훈	상무	1968.05	남	무선 지원팀 담당임원	SEI 담당임원	Univ. of Baltimore(碩士)	52	상근
김대원	상무	1965.11	남	SEF법인장	SEF 법인장	성균관대(碩士)	52	상근
김병도	상무	1967.03	남	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅실 디지털전략팀장	서강대(碩士)	52	상근
김상용	상무	1970.11	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당임원	연세대	52	상근
김세호	상무	1967.10	남	SENA법인장	SEAD법인장	동국대	52	상근
김수진	상무	1969.08	여	Global Public Affairs팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Pennsylvania(博士)	28	상근
김승민	상무	1967.03	남	SEA 담당임원	SEA 담당부장	성균관대	52	상근
김연성	상무	1966.05	남	중남미총괄 지원팀장	지원팀 담당임원	MIT(碩士)	52	상근
김재욱	상무	1965.05	남	상생활력센터 구매전략팀 담당임원	상생활력센터 상생활력팀 담당임원	국민대	52	상근
김재준	상무	1968.01	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)	52	상근
김정우	상무	1965.04	남	SEPOL법인장	SEROM법인장	고려대	52	상근
김종균	상무	1966.08	남	경영혁신센터 담당임원	정보전략팀 담당부장	경상대	52	상근
김진수	상무대우	1971.10	남	디자인경영센터 차세대디자인팀장	디자인경영센터 차세대디자인팀 담당임원	국민대	52	상근
김철기	상무	1968.03	남	SAVINA-S법인장	SME 담당부장	경북대	52	상근
김형준	상무	1966.11	남	SAMEX 담당임원	무선 지원팀 담당임원	Emory Univ.(碩士)	52	상근
김희선	상무	1969.10	여	글로벌마케팅센터 담당임원	무선 마케팅팀 담당임원	Duke Univ.(碩士)	52	상근
노상석	상무	1964.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	한국외국어대	52	상근

노원일	상무	1967.08	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발 1팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)	52	상근
데니맥글린	상무	1966.11	남	SEA 담당임원	SEA SVP	Villanova Univ.(碩士)	52	상근
매노	상무	1968.06	남	SEBN법인장	SEBN 담당임원	Haarlem Business School	52	상근
문국열	상무	1969.01	남	SVCC 담당임원	SEV 담당임원	구미1대	52	상근
박광준	상무	1964.11	남	기흥/화성/평택단지 지원팀장	기흥/화성단지총괄 지원팀장	송실대	52	상근
박순철	상무	1966.07	남	무선 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	연세대	52	상근
박정현	상무	1964.09	남	SCA법인장	SEEA법인장	서강대	52	상근
박효상	상무	1967.08	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	한양대	52	상근
백중수	상무	1971.01	남	전장사업팀 담당임원	기획팀 담당임원	서울대(碩士)	52	상근
서경록	상무	1966.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SAPL법인장	Michigan State Univ.(碩士)	52	상근
서기호	상무	1964.03	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	항공대	52	상근
서형석	상무	1968.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	연세대(碩士)	52	상근
석종욱	상무	1969.06	남	TSLED법인장	기흥/화성단지총괄 LED제조팀장	광운대	52	상근
손성원	상무	1969.02	남	사업지원T/F 담당임원	지원팀 담당임원	연세대(碩士)	52	상근
송명주	상무	1970.02	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	동남아총괄 마케팅팀 담당부장	서강대(碩士)	52	상근
송현주	상무대우	1969.03	여	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전 디자인 수석	한국과학기술원(碩士)	52	상근
신용인	상무	1969.11	남	SEVT 담당임원	SEV 담당임원	서강대	52	상근
심재덕	상무	1973.07	남	중국전략협력실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)	52	상근
안상호	상무	1965.03	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	한국과학기술원(碩士)	52	상근
안재우	상무	1969.12	남	한국총괄 인사팀장	중국총괄 인사팀장	고려대	52	상근
안해원	상무대우	1963.05	남	무선 메카솔루션팀 담당임원	무선 금형기술팀 담당임원	금오공대(博士)	52	상근
양예욱	상무	1965.03	남	생활가전 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당임원	항공대	52	상근
여명구	상무	1970.10	남	제도개선T/F	DS부문 인사팀 담당임원	충북대	52	상근
연경희	상무	1971.08	여	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당임원	경원대	52	상근
오병민	상무	1967.02	남	기흥/화성/평택단지 보건관리팀장	기흥/화성단지총괄 환경안전팀 담당임원	광운대	52	상근
오중훈	상무	1969.10	남	DS부문 미주총괄 담당임원	System LSI 지원팀장	Purdue Univ.(碩士)	52	상근
원종현	상무	1967.05	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	SAMEX 담당임원	성균관대	52	상근
윤종상	상무	1965.12	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 담당부장	연세대	52	상근
윤준오	상무	1967.06	남	사업지원T/F 담당임원	기획팀 담당임원	건국대	52	상근
윤창훈	상무	1965.06	남	SEDA-S판매부문장	SEDA-S 담당임원	경희대	52	상근
이경우	상무	1965.10	남	SRJ 경영지원실장	IRO	도시사대(博士)	52	상근
이규호	상무	1969.06	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	서강대	52	상근
이동우	상무	1967.06	남	메모리 지원팀장	감사팀 담당임원	경북대	52	상근
이성현	상무	1966.07	남	SELA법인장	SAMCOL법인장	홍익대	52	상근
이영순	상무	1966.10	여	인재개발원 부원장	인사팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	52	상근
이영호	상무	1967.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SCIC 담당임원	Univ. of Maryland, Coll. Park(碩士)	52	상근
이원준	상무	1970.02	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	연세대	52	상근
이재용	상무	1969.04	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	London Sch. of Economics(博士)	52	상근
이철구	상무	1968.07	남	글로벌기술센터 담당임원	SEVT 담당임원	강남대	52	상근
이청용	상무	1968.12	남	SGE법인장	글로벌마케팅센터 담당임원	MIT(碩士)	52	상근
이충순	상무	1967.09	남	SERC 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대	52	상근
이환구	상무	1964.03	남	DS부문 지원팀 담당임원	DS부문 구주총괄 담당임원	성균관대	52	상근
임성욱	상무	1964.02	남	SEDA-P(C)공장장	SEDA-P(M) 담당임원	영남대	52	상근
정호영	상무	1968.01	남	무선 구매팀	SEV 담당임원	경북대	52	상근
전필규	상무	1968.11	남	무선 인사팀 담당임원	북미총괄 인사팀장	HELSINKI SCH OF ECONOMICS (碩士)	52	상근
정훈	상무	1969.01	남	SESA법인장	SEBN법인장	홍익대	52	상근
조강용	상무	1964.02	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	삼성전자기술대학(碩士)	52	상근
조규일	상무	1968.09	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발2실 담당임원	포항공대(碩士)	52	상근
조기재	상무	1964.05	남	사업지원T/F 담당임원	지원팀 담당임원	Babson Coll.(碩士)	52	상근
조성혁	상무	1970.05	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당임원	Univ. of California, Berkeley(碩士)	52	상근
조시정	상무	1969.11	남	인사팀 담당임원	SEJ 담당부장	경희대	52	상근

조홍상	상무	1966.06	남	SEM-S법인장	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대	52	상근
쥬이시양	상무	1972.12	남	SAPL법인장	SME 담당임원	Naional Univ. of Singapore(碩士)	51	상근
진문구	상무	1965.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	지원팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	52	상근
채민영	상무	1966.04	남	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	중앙대	52	상근
최상진	상무	1967.03	남	메모리제조기술센터 담당임원	생산기술연구소 담당임원	포항공대(碩士)	52	상근
최승걸	상무	1968.12	남	기흥/화성/평택단지 Facility팀장	SCS법인 담당임원	서울시립대	52	상근
최익수	상무	1967.05	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEA 담당부장	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)	52	상근
피재걸	상무	1964.04	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)	52	상근
하영욱	상무	1964.01	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 기술전략팀 담당임원	HELSINKI SCH OF ECNOMICS (碩士)	52	상근
한장수	상무	1970.02	남	무선 지원팀 담당임원	무선 지원팀 책임번호사	State Univ. of New York, Buffalo (博士)	51	상근
허성희	상무	1969.01	남	SCS법인 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	52	상근
홍경현	상무	1963.01	남	글로벌기술센터 제조기술팀장	글로벌기술센터 자동화기술팀 담당임원	영남대	52	상근
홍범석	상무	1968.06	남	Iran지점장	SELV법인장	중앙대	52	상근
홍성희	상무	1966.02	남	DS부문 구매팀 담당임원	Test&Package센터 담당임원	서강대	52	상근
황하섭	상무	1964.03	남	SCS법인 담당임원	메모리제조센터 담당임원	인하대	52	상근
고대곤	상무	1965.03	남	SIEL-P(C)법인장	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	아주대	40	상근
곽연봉	상무대우	1967.03	남	기흥/화성/평택단지 전기기술팀 담당임원	기흥/화성단지총괄 담당부장	광운대	40	상근
김기상	상무	1965.11	남	SCS법인 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	아주대(碩士)	40	상근
김대주	상무	1969.10	남	아프리카총괄 지원팀장	프린팅솔루션 지원팀 담당임원	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)	40	상근
김병성	상무	1969.12	남	SEHZ 담당임원	무선 지원팀 담당임원	인하대	40	상근
김보경	상무	1966.08	남	한국총괄 CE영업팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	40	상근
김상효	상무	1967.10	남	IR그룹 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Duke Univ.(碩士)	40	상근
김성기	상무	1968.11	남	북미총괄 CS팀장	CIS총괄 CS팀장	연세대(碩士)	40	상근
김성욱	상무	1968.06	남	한국총괄 온라인영업팀장	인사팀 담당임원	고려대(碩士)	40	상근
김세녕	상무	1964.01	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	삼성전자기술대학(碩士)	40	상근
김연준	상무	1967.11	남	SESK 담당임원	SEH-P 담당임원	충남대(碩士)	40	상근
김우석	상무	1969.03	남	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅실 담당임원	New York Univ.(碩士)	40	상근
김의석	상무대우	1973.12	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인팀 수석	홍익대	40	상근
김재원	상무	1969.08	남	지원팀 담당임원	SEA 담당임원	Notre Dame(碩士)	40	상근
김정석	상무	1969.06	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	연세대(碩士)	40	상근
김정호	상무	1969.05	남	SEHK법인장	SCIC 담당임원	연세대	40	상근
김창엽	상무	1969.08	남	SEM-S 담당임원	SEDA-S 담당임원	한양대	40	상근
김한석	상무	1968.07	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	인하대	40	상근
김현수	상무	1970.09	남	Samsung Research 기술전략팀 담당임원	DMC연구소 기술전략팀 담당임원	성균관대(博士)	40	상근
데이브다스	상무	1975.06	남	SEA 담당임원	SEA VP	WHU-Kellogg(Germany-USA) (碩士)	40	상근
명호석	상무	1967.04	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	SEA 담당임원	중앙대	40	상근
박기원	상무	1966.06	남	글로벌마케팅센터 담당임원	Saudi Arabia지점장	서울대	40	상근
박성교	상무대우	1972.03	남	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	성균관대	40	상근
박성근	상무	1966.01	남	SEV 담당임원	중국전략협력실 담당임원	동국대	40	상근
박성민	상무	1965.04	남	Global CS센터 품질혁신팀장	생활가전 Global CS팀 담당임원	인하대	40	상근
박정선	상무	1972.12	여	SRA 담당임원	무선 지원팀 담당부장	Duke Univ.(碩士)	40	상근
박정호	상무대우	1971.09	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	법무실 담당임원	Michigan State Univ.(碩士)	40	상근
박진영	상무	1971.11	여	DS부문 구매팀 담당임원	DS부문 구매팀 담당부장	서울대	40	상근
박태호	상무	1969.03	남	영상디스플레이 AV사업팀 담당임원	SIEL-S 담당임원	Pittsburgh(碩士)	40	상근
박해진	상무	1965.10	남	DS부문 동남아총괄	메모리 전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대	40	상근

박현규	상무	1968.06	남	무선 Global CS팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	대구대	40	상근
백승엽	상무	1967.01	남	Samsung Research 지원팀장	SELS법인장	California State Univ., Hayward (碩士)	40	상근
부민혁	상무대우	1973.06	남	생활가전 디자인팀 담당임원	생활가전사업부 수석	제주대	40	상근
서한석	상무	1968.02	남	SEA 담당임원	STA 담당부장	George Washington Univ.(碩士)	40	상근
손영호	상무	1965.07	남	SEA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	연세대	40	상근
송승엽	상무	1968.08	남	SCS법인 담당임원	Test&Package센터 담당임원	성균관대	40	상근
신동수	상무	1968.06	남	네트워크 지원팀 담당임원	기획팀 담당부장	서울대(碩士)	40	상근
신승철	상무	1973.04	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	연세대	40	상근
신현진	상무	1971.01	남	동남아총괄 인사팀장	동남아총괄 인사팀장	경북대	40	상근
안장혁	상무	1967.12	남	전장사업팀 담당임원	SEF 담당임원	육사	40	상근
엄재원	상무	1968.04	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	연세대	40	상근
오창환	상무	1969.01	남	종합기술원 인사팀장	DS부문 인사팀 담당임원	George Washington Univ.(碩士)	27	상근
우영돈	상무대우	1974.01	남	법무실 담당임원	무선 지원팀 담당임원	한양대	40	상근
원성근	상무	1968.05	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	경북대	40	상근
위차이	상무	1966.04	남	TSE-S 담당임원	TSE-S VP	La Verne(碩士)	40	상근
유병길	상무	1970.09	남	감사팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Virginia(碩士)	40	상근
윤병관	상무	1970.11	남	SIEL-P(N)공장장	SIEL-P(N) 담당임원	구미1대	40	상근
윤인수	상무대우	1974.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)	40	상근
이광렬	상무	1969.02	남	Global CS센터 담당임원	구주총괄 CS팀장	한양대	40	상근
이민	상무	1971.07	남	영상디스플레이 상품전략팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	Univ. of Southern California(碩士)	40	상근
이상윤	상무	1968.09	남	CIS총괄 지원팀장	재경팀 담당임원	경희대	40	상근
이상재	상무	1965.12	남	Test&Package센터 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	홍익대	40	상근
이창섭	상무	1965.11	남	SELV법인장	영상전략마케팅팀 담당임원	한국외국어대	40	상근
이학민	상무	1972.04	남	지원팀 담당임원	글로벌지원팀 담당부장	서울대(碩士)	40	상근
이호영	상무	1965.02	남	DS부문 상생협력센터 담당임원	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	경희대	40	상근
이황균	상무	1965.05	남	SERK법인장	SEIN-P법인장	성균관대	40	상근
인석진	상무	1967.12	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SCIC 담당임원	성균관대	40	상근
장단단	상무	1964.06	여	중국전략협력실 담당임원	중국본사 담당임원	HOSEI UNIV.	40	상근
장세연	상무	1967.01	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	광운대	40	상근
전병준	상무	1966.02	남	영상전략마케팅팀 담당임원	SESG법인장	성균관대	40	상근
전우성	상무	1964.03	남	SEMA법인장	생활가전 Global제조센터 담당임원	조선대	40	상근
전은환	상무	1972.02	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Purdue Univ.(碩士)	40	상근
정순찬	상무	1965.02	남	기흥/화성/평택단지 평택인프라 기술팀장	메모리제조센터 담당임원	건국대	40	상근
정재동	상무	1969.02	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	국민대(碩士)	40	상근
조명호	상무	1969.05	남	감사팀 담당임원	감사팀 담당임원	연세대(碩士)	40	상근
조필주	상무	1971.07	남	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당부장	서울대(博士)	40	상근
주재완	상무	1968.02	남	중국총괄 CS팀장	CS환경센터 Global서비스팀 담당임원	연세대(碩士)	40	상근
지우정	상무	1967.11	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	한국총괄 인사팀장	고려대(碩士)	40	상근
트레비스	상무	1966.09	남	SEA 담당임원	SEA VP	Arizona State Univ.	40	상근
하영수	상무	1964.07	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	인하대	40	상근
한규한	상무	1966.02	남	DS부문 부품플랫폼사업팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(碩士)	40	상근
한상숙	상무	1966.07	여	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당부장	Northwestern Univ.(碩士)	40	상근
허석	상무	1973.10	남	DS부문 기획팀 담당임원	System LSI 기획팀 담당임원	Stanford Univ.(博士)	40	상근
현경호	상무	1966.05	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	한양대	40	상근
고재윤	상무	1973.01	남	지원팀 담당임원	경영혁신팀 담당임원	고려대(碩士)	28	상근
고재필	상무	1970.03	남	DS부문 인사팀 담당임원	영상디스플레이 인사팀 담당임원	Purdue Univ.(碩士)	28	상근

구본영	상무	1967.05	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	서울대(碩士)	28	상근
권오수	상무	1968.04	남	SEA 담당임원	TSTC 담당임원	성균관대	28	상근
김강수	상무	1966.09	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	성균관대	28	상근
김경조	상무	1965.12	남	Test&Package센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	성균관대	28	상근
김군한	상무	1968.06	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	성균관대	28	상근
김민정	상무	1971.07	여	DS부문 기획팀 담당임원	DS부문 기획팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	28	상근
김병우	상무	1968.03	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	경북대	28	상근
김성은	상무	1971.09	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	고려대(碩士)	28	상근
김수련	상무	1967.04	여	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	한국과학기술원(博士)	28	상근
김재훈	상무	1967.01	남	SEDA-S 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	서울대(碩士)	28	상근
김현숙	상무	1971.04	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	인하대(碩士)	28	상근
김홍식	상무	1969.09	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	인하대	28	상근
마이클레이 포드	상무	1962.02	남	SAS법인 담당임원	SAS VP	Texas, Dallas(碩士)	28	상근
문종승	상무	1971.08	남	SVCC 담당임원	글로벌기술센터 제조전략팀장	Georgia Inst. of Tech.(博士)	28	상근
문희동	상무	1971.07	남	사업지원T/F 담당임원	종합기술원 인사팀장	한양대	28	상근
박정미	상무	1968.07	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	한국과학기술원(碩士)	28	상근
박정진	상무	1968.07	남	SEG 담당임원	지원팀 담당부장	Minnesota, Twin Cities(碩士)	28	상근
박종범	상무	1969.02	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	연세대(碩士)	28	상근
박준호	상무	1972.05	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	한양대	28	상근
박철범	상무	1966.03	남	상생활력센터 구매전략팀 담당임원	상생활력센터 시너지구매팀 담당임원	고려대	28	상근
배상우	상무	1970.10	남	Foundry 품질팀장	System LSI 품질팀장	Purdue Univ.(博士)	28	상근
복정수	상무	1970.06	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	SESG법인장	고려대	28	상근
서보철	상무	1972.01	남	보안선진화T/F	감사팀 담당임원	동국대	28	상근
손종률	상무	1967.03	남	무선 전략마케팅실 담당임원	삼성화재 자동차보험본부 담당임원	건국대	4	상근
송철섭	상무	1967.12	남	DS부문 중국총괄 담당임원	System LSI 전략마케팅팀 담당부장	인하대	28	상근
신영주	상무	1969.09	남	메모리제조기술센터 담당임원	SCS법인 담당임원	Purdue Univ.(博士)	28	상근
안재용	상무	1968.08	남	DS부문 인사팀 담당임원	SDC 감사팀 담당임원	성균관대	21	상근
안종찬	상무	1968.10	남	무선 구매팀 담당임원	무선 구매팀 담당부장	경북대	28	상근
유승호	상무	1968.06	남	생활가전 지원팀 담당임원	지원팀 담당임원	연세대	28	상근
윤종덕	상무	1969.04	남	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	고려대(碩士)	28	상근
이계원	상무	1968.05	남	인재개발원 담당임원	인재개발원 담당부장	서울대(碩士)	28	상근
이광현	상무	1971.06	남	복미총괄 인사팀장	무선 인사팀 담당임원	연세대	28	상근
이규영	상무	1968.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	DS부문 중국총괄 담당임원	고려대(碩士)	28	상근
이무형	상무	1970.02	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	Purdue Univ.(博士)	28	상근
이상도	상무	1969.03	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	City Univ. of New York(CUNY) (碩士)	28	상근
이상원	상무	1971.07	남	SEF 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	Georgetown Univ.(碩士)	28	상근
이상직	상무	1970.06	남	SEASA법인장	Venezuela지점장	한국외국어대	28	상근
이승원	상무	1968.06	남	Foundry 기획팀장	SDI 사업운영그룹장	서강대(碩士)	4	상근
이재범	상무	1970.10	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당부장	홍익대	28	상근
이재환	상무	1967.08	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEPAK법인장	성균관대	28	상근
이정길	상무	1971.02	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	게이오대(Keio Univ.)(碩士)	28	상근
이정상	상무	1967.06	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	인하대	28	상근
이제현	상무	1970.04	남	사업지원T/F 담당임원	삼성디스플레이 경영지원실 담당임원	광운대	4	상근
이창수	상무	1971.07	남	DS부문 일본총괄 담당임원	DS부문 일본총괄 담당부장	경희대	28	상근
이창욱	상무	1965.05	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	광운대	28	상근
저스틴데니 슨	상무	1974.05	남	SEA 담당임원	SEA VP	Northwestern Univ.(碩士)	28	상근
정윤찬	상무	1968.09	남	상생활력센터 상생활력팀 담당임원	감사팀 담당부장	성균관대	28	상근
정지호	상무	1967.01	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 인사팀 담당임원	아주대	28	상근
정진성	상무	1967.08	남	Foundry제조기술센터 담당임원	System LSI제조센터 담당임원	부산대	28	상근

정호진	상무	1971.05	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SECA 담당부장	Rutgers Univ.(碩士)	28	상근
제이디라우	상무	1966.10	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	Houston(碩士)	28	상근
조영준	상무	1971.05	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당임원	성균관대	28	상근
지승하	상무	1973.01	여	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅실 담당부장	이화여대	28	상근
지용준	상무	1968.01	남	종합기술원 기획지원팀 담당임원	종합기술원 기획팀 담당부장	연세대(博士)	28	상근
최광보	상무	1971.03	남	사업지원T/F 담당임원	영상디스플레이 지원팀 담당임원	부산대	28	상근
케빈모어트	상무	1963.03	남	DS부문 미주총괄 담당임원	DS부문 미주총괄 VP	Loyola Marymount Univ.	28	상근
피터리	상무	1970.05	남	Global Public Affairs팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당임원	Chicago(碩士)	28	상근
한우섭	상무	1967.01	남	의료기기 IVD사업팀장	의료기기 Global CS팀장	한국과학기술원(博士)	28	상근
허태영	상무	1970.11	남	영상디스플레이 상품전략팀장	커뮤니케이션팀 담당임원	Univ. of California, LA	28	상근
홍성범	상무	1967.03	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	Institut Teknologi Bandung(碩士)	28	상근
황대환	상무	1969.06	남	TSTC법인장	무선 Global제조센터 담당임원	수도전기공고	28	상근
황보용	상무	1970.10	남	기획팀 담당임원	메모리 기획팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)	28	상근
황태환	상무	1968.04	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	SEAD법인장	경희대	28	상근
강재원	상무	1967.07	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신팀 담당부장	인하대	11	상근
김동준	상무	1973.05	남	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	광주과학기술원(博士)	11	상근
김성은	상무	1968.11	남	무선 구매팀 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	항공대	11	상근
김성환	상무	1970.05	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서울대(碩士)	11	상근
김세윤	상무	1973.06	남	지원팀 담당임원	글로벌마케팅센터 담당임원	고려대(碩士)	11	상근
김육환	상무	1967.12	남	SESG법인장	SEG 담당부장	한국과학기술원(碩士)	11	상근
김이수	상무	1973.03	남	SVCC 담당임원	SEVT 담당임원	아주대	11	상근
김호균	상무	1968.12	남	Samsung Research 인사팀장	DMC연구소 인사팀장	연세대(碩士)	11	상근
박건태	상무	1969.09	남	무선 구매팀 담당임원	감사팀 담당부장	Colorado, Boulder(碩士)	11	상근
박헌정	상무	1969.12	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대	11	상근
박훈중	상무	1967.08	남	한국총괄 모바일영업팀 담당임원	한국총괄 모바일영업팀 담당부장	인하대	11	상근
서영진	상무	1969.05	남	Global CS센터 제품환경팀장	Global CS센터 제품환경팀장	Insa De Lyon (博士)	11	상근
송두근	상무	1968.07	남	기흥/화성/평택단지 환경안전팀장	기흥/화성단지 환경안전팀장	성균관대	11	상근
염종국	상무	1968.03	남	SEDA-P(M) 담당임원	생활가전 지원팀 담당임원	인하대	11	상근
오정석	상무	1970.03	남	System LSI 지원팀장	DS부문 중국총괄 담당부장	청화대(淸華大)(碩士)	11	상근
윤주한	상무	1970.05	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	Univ. of California, Berkeley(碩士)	11	상근
이관수	상무	1969.11	남	네트워크 지원팀 담당임원	네트워크 지원팀 담당부장	영남대	11	상근
이동현	상무대우	1972.09	남	DS부문 법무지원팀 담당임원	DS부문 법무지원팀 담당임원	고려대	11	상근
이영직	상무	1967.08	남	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	아주대	11	상근
이재욱	상무	1968.07	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	성균관대(碩士)	11	상근
이재환	상무	1970.09	남	SEEG-S법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	중앙대(碩士)	11	상근
이종민	상무	1971.09	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Illinois Inst. of Tech.(碩士)	11	상근
이치훈	상무	1969.08	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	서울대(博士)	11	상근
이현	상무	1971.01	남	SEROM법인장	SECZ법인장	Duke Univ.(碩士)	11	상근
임성윤	상무	1971.01	남	SEPR법인장	SEPR법인장	고려대	11	상근
정상태	상무	1972.01	남	SEA 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	중앙대	11	상근
정의욱	상무	1968.07	남	Foundry Global운영팀장	Foundry Global운영팀장	인하대	11	상근
존헤링턴	상무	1962.02	남	SEA 담당임원	SEA 담당임원	Wisconsin, Madison	11	상근
최기화	상무	1969.03	남	네트워크 Global Technology Service팀	네트워크 개발1팀 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(博士)	11	상근
최병갑	상무	1969.08	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	서울대(博士)	11	상근
홍성민	상무	1969.06	남	System LSI 인사팀장	System LSI 인사팀 담당부장	Texas, Austin(碩士)	11	상근
홍영기	상무	1970.03	남	Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry제조기술센터 수석	Imperial College(博士)	11	상근
홍정호	상무	1969.02	남	SESA 담당임원	지원팀 담당부장	Washington, Seattle(碩士)	11	상근
강석채	상무	1971.06	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	Foundry 전략마케팅팀 담당부장	Georgia Inst. of Tech.(博士)	4	상근
강정대	상무	1970.09	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	상생협력센터 담당부장	한국방송통신대	4	상근
강태규	상무	1972.01	남	IR그룹 담당임원	기획팀 담당부장	Indiana Univ., Bloomington(碩士)	4	상근
강희성	상무	1970.08	남	Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry제조기술센터 수석	포항공대(博士)	4	상근

권형석	상무	1973.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	서강대(碩士)	4	상근
김기수	상무	1970.02	남	Foundry제조기술센터 담당임원	Foundry제조기술센터 담당부장	성균관대	4	상근
김보현	상무	1973.02	남	Test&Package센터 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	서강대(碩士)	4	상근
김상훈	상무	1968.02	남	SENA 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	건국대	4	상근
김수홍	상무	1972.11	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	Stanford Univ.(博士)	4	상근
김승리	상무	1972.09	여	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Stanford Univ.(碩士)	4	상근
김승일	상무	1970.07	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	단국대	4	상근
김장경	상무	1973.05	남	지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	홍익대	4	상근
김정주	상무	1969.01	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	광운대	4	상근
김정현	상무	1975.06	남	무선 상품혁신팀 담당임원	무선 상품혁신팀 담당부장	고려대	4	상근
김준엽	상무	1969.10	남	SEI 담당임원	SEDA-S 담당부장	경기대	4	상근
김중정	상무	1973.11	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	Tohoku Univ.(博士)	4	상근
김진주	상무	1969.05	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	고려대(碩士)	4	상근
김창영	상무	1973.03	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	중앙대	4	상근
김태균	상무	1969.01	남	SSIC IoT사업화팀 담당임원	SSIC 담당부장	성균관대	4	상근
김태중	상무대우	1971.05	남	무선 디자인팀 담당임원	무선 디자인팀 수석	한양대	4	상근
김대진	상무	1969.01	남	재경팀 담당임원	삼성경제연구소 사회인프라개발실 담당부장	George Washington Univ.(碩士)	4	상근
김평진	상무대우	1973.12	남	법무실 담당임원	법무실 수석변호사	연세대	4	상근
김현	상무	1968.07	남	구미지원센터 인사팀장	인사팀 담당부장	서강대(碩士)	4	상근
김형재	상무	1970.12	남	영상디스플레이 상품전략팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	4	상근
남정만	상무	1967.06	남	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조팀 담당부장	전남기계공고	4	상근
노태현	상무	1969.09	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	George Washington Univ.(碩士)	4	상근
류일근	상무	1968.07	남	무선 인사팀 담당임원	무선 인사팀 담당부장	경북대	4	상근
류재준	상무	1969.09	남	DS부문 감사팀 담당임원	DS부문 감사팀 담당부장	성균관대	4	상근
윤형준	상무	1968.07	남	System LSI 기획팀장	DS부문 지원팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	4	상근
박장득	상무	1967.02	남	재경팀 담당임원	재경팀 담당부장	계명대	4	상근
박재영	상무	1969.09	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	연세대(碩士)	4	상근
배광운	상무	1968.03	남	생활가전 구매팀 담당임원	생활가전 구매팀 담당부장	경희대	4	상근
배일환	상무	1970.07	남	SEVT 담당임원	인사팀 담당부장	고려대(碩士)	4	상근
설훈	상무	1970.03	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당부장	고려대	4	상근
손용우	상무	1968.09	남	TSTC 담당임원	무선 지원팀 담당부장	경희대	4	상근
손종근	상무	1970.09	남	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 수석	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)	4	상근
송우창	상무	1968.01	남	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	한국총괄 B2C영업팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	4	상근
송원준	상무	1969.04	남	SENZ법인장	TSE-S 담당부장	Illinois, Urbana-Champaign(碩士)	4	상근
세인혁비	상무	1972.05	남	SEA 담당임원	SEA VP	Fairleigh Dickinson Univ.(碩士)	4	상근
스테판코테	상무	1972.04	남	SEF 담당임원	SEF VP	INSEEC Paris(碩士)	4	상근
심재현	상무	1972.01	남	지원팀 담당임원	지원팀 담당부장	Georgetown Univ.(碩士)	4	상근
아심와르시	상무	1972.06	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S SVP	SIBM, Pune(碩士)	4	상근
안정희	상무	1970.09	남	SEMAG법인장	Lebanon지점장	경북대(碩士)	4	상근
양익준	상무	1969.11	남	경영혁신센터 담당임원	경영혁신센터 담당부장	성균관대	4	상근
여태정	상무	1970.06	남	전장사업팀 담당임원	전장사업팀 담당부장	서울대(博士)	4	상근
오재균	상무	1972.02	남	SAS법인 담당임원	DS부문 지원팀 담당부장	Iowa(碩士)	4	상근
오형석	상무	1970.09	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	고려대	4	상근
이기욱	상무	1970.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	동아대	4	상근
이민철	상무	1970.04	남	무선 PC사업팀 담당임원	무선 PC사업팀 담당부장	서강대(碩士)	4	상근
이상욱	상무	1972.08	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 개발2실 수석	금오공대	4	상근
이상욱	상무	1971.01	남	무선 제품기술팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당부장	경북대	4	상근
이상현	상무	1970.09	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 담당부장	인하대	4	상근
이승엽	상무	1968.08	남	SECH법인장	SAMCOL법인장	서울대	4	상근

이정자	상무	1969.04	여	기흥/화성/평택단지 Facility팀 담당임원	기흥/화성/평택단지 Facility팀 담당부장	인하대	4	상근
이한관	상무	1971.09	남	SCS법인 담당임원	SCS법인 담당부장	성균관대(碩士)	4	상근
이한형	상무	1968.09	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	경희대	4	상근
이희윤	상무	1968.08	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 수석	부산수산대	4	상근
장상익	상무	1968.07	남	영상디스플레이 구매팀 담당임원	영상디스플레이 구매팀 담당부장	경북대	4	상근
장형택	상무	1970.05	남	SEA 담당임원	SEA 담당부장	Washington Univ. in St. Louis (碩士)	4	상근
정지은	상무	1974.05	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern Univ.(碩士)	4	상근
조성훈	상무	1970.11	남	SELS법인장	감사팀 담당부장	건국대(博士)	4	상근
조철호	상무	1971.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당부장	Southern California(碩士)	4	상근
주명취	상무	1963.08	남	DS부문 중국총괄 담당임원	DS부문 중국총괄 VP	上海大(상해대)(碩士)	4	상근
지혜령	상무	1972.04	여	커뮤니케이션팀 담당임원	커뮤니케이션팀 담당부장	Michigan, Ann Arbor(碩士)	4	상근
차경환	상무	1972.04	남	무선 전략마케팅실 담당임원	SEA 담당부장	Univ. of California, Berkeley(碩士)	4	상근
최동준	상무	1972.05	남	글로벌마케팅센터 담당임원	글로벌마케팅센터 담당부장	Southern California(碩士)	4	상근
최순	상무	1970.10	남	SIEL-S 담당임원	SIEL-S 담당부장	Duke Univ.(碩士)	4	상근
최유중	상무	1971.12	남	인사팀 담당임원	인사팀 담당부장	연세대(碩士)	4	상근
최찬식	상무	1966.02	남	기흥/화성/평택단지 건설팀 담당임원	기흥/화성/평택단지 건설팀 담당부장	서울대(碩士)	4	상근
편정우	상무	1970.10	남	메모리 품질보증실 담당임원	메모리 품질보증실 수석	Texas, Austin(博士)	4	상근
한경환	상무	1971.02	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 담당부장	한국과학기술원(碩士)	4	상근
한준수	상무	1969.04	남	Test&Package센터 담당임원	Test&Package센터 담당부장	중앙대	4	상근
하지영	상무	1970.09	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리제조센터 담당부장	부산대	4	상근
홍승원	상무	1971.06	남	메모리제조기술센터 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서울대(碩士)	4	상근
황근하	상무	1970.05	남	SEH-P 담당임원	SEH-P 담당부장	아주대	4	상근
황호준	상무	1972.03	남	SEAD법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	인하대	4	상근
조승환	연구위원	1962.10	남	Samsung Research 펌센터장	소프트웨어센터 펌센터장	한양대(碩士)		상근
김희덕	연구위원	1963.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	광운대(碩士)		상근
노태문	연구위원	1968.09	남	무선 개발실장	무선 개발2실장	포항공대(博士)		상근
이효건	연구위원	1962.01	남	영상디스플레이 개발팀장	영상디스플레이 개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
김용재	연구위원	1962.04	남	무선 서비스사업실장	SRA연구소장	아주대(碩士)		상근
윤종식	연구위원	1961.09	남	Foundry 기술개발실장	System LSI Foundry사업팀장	Univ. of California, LA(博士)		상근
장덕현	연구위원	1964.02	남	System LSI SOC개발실장	System LSI LSI개발실장	Univ. of Florida(博士)		상근
전경훈	연구위원	1962.12	남	네트워크 개발팀장	네트워크 개발1팀장	Univ. of Michigan, Ann Arbor(博士)		상근
강호규	연구위원	1961.09	남	반도체연구소장	반도체연구소 공정개발실장	Stanford Univ.(博士)		상근
경계현	연구위원	1963.03	남	메모리 Flash개발실장	메모리 Flash개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
정재현	연구위원	1962.09	남	메모리 Solution개발실장	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of Southern Carolina(博士)		상근
천강욱	연구위원	1966.01	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 상용전략팀장	한국과학기술원(博士)		상근
이상훈	연구위원	1959.07	남	생활가전 메카솔루션팀장	생활가전 금형팀장	동아대		상근
이재승	연구위원	1960.07	남	생활가전 개발팀장	생활가전 개발팀 담당임원	고려대(碩士)		상근
장성진	연구위원	1965.07	남	메모리 DRAM개발실장	메모리 DRAM개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
황성우	연구위원	1962.08	남	종합기술원副원장	종합기술원 Device연구소 담당임원	Princeton Univ.(博士)		상근
황정욱	연구위원	1965.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	인하대		상근
남석우	연구위원	1966.03	남	반도체연구소 공정개발실장	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	연세대(博士)		상근
박용인	연구위원	1964.04	남	System LSI LSI개발실장	System LSI 차세대제품개발팀장	연세대(碩士)	48	상근
이규필	연구위원	1961.05	남	반도체연구소 메모리TD실장	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Univ. of Florida(博士)		상근
전재호	연구위원	1963.04	남	네트워크 Global Technology Service팀장	네트워크 Global Service팀장	한국과학기술원(博士)		상근
정순문	연구위원	1961.11	남	반도체연구소 담당임원	System LSI 영업사업팀 담당임원	Univ. of Florida(博士)		상근
조재문	연구위원	1961.08	남	의료기기 선행개발팀장	의료기기 개발2팀장	한국과학기술원(博士)		상근
성학경	연구위원	1960.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀장	생산기술연구소 금형기술센터장	Tokyo Institute of Tech(博士)		상근

이원식	연구위원	1962.08	남	전장사업팀 담당임원	무선 UX혁신팀장	Texas A&M-College(碩士)		상근
박재홍	연구위원	1965.01	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)		상근
이상윤	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구센터장	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Stanford Univ.(博士)		상근
김학상	연구위원	1966.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Massachusetts, Lowell (博士)		상근
박현호	연구위원	1962.05	남	네트워크 개발팀 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	계명대		상근
신민철	연구위원	1966.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	서울대(碩士)		상근
이덕형	연구위원	1961.12	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
강원석	연구위원	1964.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한양대		상근
도영수	연구위원	1965.09	남	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대		상근
신유균	연구위원	1965.02	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	반도체연구소 공정개발팀 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
이준현	연구위원	1965.05	남	SRA연구소장	DMC연구소 차세대모바일팀장	Cincinnati(博士)		상근
조병학	연구위원	1967.03	남	System LSI 기반설계팀장	System LSI Modem개발실 담당임원	Univ. of California, Berkeley(博士)		상근
강임수	연구위원	1963.07	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	성균관대(碩士)		상근
김민구	연구위원	1964.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	서울대(博士)		상근
김형섭	연구위원	1966.01	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	Texas, Austin(博士)		상근
송재혁	연구위원	1967.08	남	메모리 Flash개발실 담당임원	SCS법인 담당임원	서울대(博士)		상근
장의영	연구위원	1962.08	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 냉기개발팀 담당임원	경희대		상근
정기태	연구위원	1965.09	남	Foundry 기술개발실 담당임원	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	서울대(博士)		상근
최진혁	연구위원	1967.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(博士)		상근
한진만	연구위원	1966.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대		상근
곽동원	연구위원	1961.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Texas, Arlington(博士)		상근
권상덕	연구위원	1967.03	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)		상근
김주년	연구위원	1969.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한양사이버대		상근
디페쉬	연구위원	1969.06	남	SRI-Bangalore연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Indian Inst. of Management, Bangalore(碩士)		상근
박광일	연구위원	1971.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
박두식	연구위원	1965.08	남	종합기술원 Device & System연구센 터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임 원	포항공대(碩士)		상근
박성선	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	충남대		상근
박호진	연구위원	1962.09	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	한양대		상근
심은수	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	Columbia Univ.(博士)		상근
윤장현	연구위원	1968.12	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)		상근
이동기	연구위원	1969.05	남	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of California, San Diego (博士)		상근
이석준	연구위원	1965.07	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	한국과학기술원(博士)		상근
전영식	연구위원	1967.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한양대(碩士)		상근
정현준	연구위원	1964.06	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	SEH-P법인장	한양대		상근
주창남	연구위원	1965.04	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	성균관대		상근
한인택	연구위원	1966.10	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	서울대(博士)		상근
홍형선	연구위원	1963.08	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	인하대(碩士)		상근
김진기	연구위원	1961.05	남	기흥/화성/평택단지 스마트IT팀 담당임원	생산기술연구소 담당임원	New Jersey Inst. of Technologies (碩士)		상근
두석광	연구위원	1963.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Emerging센터 수석	서울대(博士)		상근

박정대	연구위원	1963.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	경북대	11	상근
오수열	연구위원	1967.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
정도형	연구위원	1967.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서울대(博士)		상근
김인수	연구위원	1963.06	남	SEV 담당임원	무선 개발1실 담당임원	부산대		상근
김대연	연구위원	1965.04	남	네트워크 Global Technology Service팀 담당임원	네트워크 제품기술팀 담당임원	서강대(碩士)		상근
노남석	연구위원	1967.08	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	삼성디스플레이 LCD사업부 담당임원	한국과학기술원(博士)	17	상근
서장석	연구위원	1967.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	연세대(碩士)		상근
서호수	연구위원	1966.07	남	SRC-Guangzhou연구소장	무선 개발실 담당임원	경북대(碩士)		상근
신재광	연구위원	1964.09	남	종합기술원 기반기술Lab장	종합기술원 Device연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
이준희	연구위원	1969.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	MIT(博士)		상근
전충삼	연구위원	1965.08	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	메모리제조센터 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
최명수	연구위원	1966.06	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	한양대(碩士)		상근
김정식	연구위원	1970.08	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	한양대(碩士)		상근
김대진	연구위원	1964.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대		상근
류제형	연구위원	1974.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
문승도	연구위원	1968.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(博士)		상근
박성용	연구위원	1969.02	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발1팀 담당임원	서울대(博士)		상근
박종애	연구위원	1965.08	여	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Future IT연구소 담당임원	이화여대(博士)		상근
선경일	연구위원	1968.01	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	한국과학기술원(碩士)		상근
신현석	연구위원	1969.05	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서강대(碩士)		상근
유미영	연구위원	1968.07	여	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	포항공대(碩士)		상근
유준영	연구위원	1967.09	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	성균관대		상근
유현상	연구위원	1964.02	남	생활가전 개발팀 담당임원	TSE-P 수석	인하대		상근
유호선	연구위원	1967.08	남	영상디스플레이 Global운영팀 담당 임원	생산기술연구소 담당임원	서울대(博士)		상근
이기수	연구위원	1964.07	남	생활가전 개발팀 담당임원	TSE-P법인장	한양대(碩士)		상근
이시화	연구위원	1965.12	남	Samsung Research Media Research팀장	DMC연구소 차세대미디어팀장	한국과학기술원(博士)		상근
이준화	연구위원	1972.03	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	한국과학기술원(碩士)		상근
임준서	연구위원	1968.08	남	DS부문 중국총괄 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
조창현	연구위원	1965.12	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)		상근
허정완	연구위원	1968.04	남	무선 개발실 담당임원	SEV 담당임원	광운대		상근
강대철	연구위원	1965.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	인하대	52	상근
강상기	연구위원	1968.04	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서울대(博士)	52	상근
김우섭	연구위원	1964.10	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	고려대(博士)	52	상근
문창록	연구위원	1971.01	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	서울대(博士)	52	상근
박기철	연구위원	1971.05	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)	52	상근
박기태	연구위원	1971.01	남	DS부문 미주총괄 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Tohoku Univ.(博士)	52	상근
박성준	연구위원	1971.01	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Device연구소 전문연구원	Stanford Univ.(博士)	52	상근
박정훈	연구위원	1969.10	남	Samsung Research Media Research팀 담당임원	DMC연구소 차세대미디어팀 담당임원	한양대(碩士)	52	상근
안수진	연구위원	1969.12	여	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	반도체연구소 수석	포항공대(博士)	52	상근
안원익	연구위원	1970.07	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	52	상근
안정착	연구위원	1970.12	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	포항공대(博士)	52	상근
이시영	연구위원	1972.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	경북대(碩士)	52	상근
이영민	연구위원	1964.03	남	SRPOL연구소장	SRR연구소장	한국과학기술원(博士)	52	상근
이은철	연구위원	1965.07	남	Foundry 제품기술팀장	System LSI 제품기술팀장	광운대	52	상근

이종열	연구위원	1970.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	DS부문 미주총괄 담당임원	서울대(博士)	52	상근
이주영	연구위원	1966.07	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Univ. of California, LA(博士)	52	상근
이진욱	연구위원	1970.02	남	SRR연구소장	소프트웨어센터 Applied Platform 팀장	Arizona State Univ.(博士)	52	상근
임채환	연구위원	1971.01	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	경북대(博士)	52	상근
장경훈	연구위원	1970.02	남	Samsung Research Frontier Research팀장	DMC연구소 융복합기술팀 담당임원	고려대(博士)	52	상근
장세영	연구위원	1974.09	여	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한국과학기술원(博士)	52	상근
전찬욱	연구위원	1966.05	남	반도체연구소 Mask개발팀장	반도체연구소 수석	연세대	52	상근
조상연	연구위원	1971.12	남	반도체연구소 S/W센터장	메모리 Solution개발실 담당임원	Univ. of Minnesota, Twin Cities (博士)	52	상근
조장호	연구위원	1969.04	남	System LSI 전략마케팅팀 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	52	상근
최경세	연구위원	1969.04	남	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	반도체연구소 수석	서울대(博士)	52	상근
최기환	연구위원	1970.01	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	52	상근
최승현	연구위원	1967.10	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	중앙대(碩士)	52	상근
최용원	연구위원	1968.05	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	고려대(碩士)	52	상근
최용훈	연구위원	1969.07	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	고려대	52	상근
최윤희	연구위원	1968.07	여	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	포항공대(碩士)	52	상근
키스호킨스	연구위원	1958.05	남	SARC연구소장	SAS 담당임원	Univ. of Texas, Dallas(碩士)	52	상근
허운행	연구위원	1969.08	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI Modem개발실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	52	상근
황기현	연구위원	1967.06	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(博士)	52	상근
김광연	연구위원	1965.07	남	생활가전 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	연세대(碩士)	40	상근
김두일	연구위원	1971.07	남	Samsung Research Platform팀장	소프트웨어센터 S/W Platform팀장	경북대	40	상근
김명철	연구위원	1968.09	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	한국과학기술원(博士)	40	상근
김영집	연구위원	1971.03	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	한국과학기술원(碩士)	40	상근
김우중	연구위원	1965.02	남	TSEC법인장	TSEC 담당임원	국민대	40	상근
류수정	연구위원	1971.10	여	System LSI SOC개발실 담당임원	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	GEORGIA INST. OF TECH.(博士)	40	상근
문용운	연구위원	1969.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서강대(碩士)	40	상근
문준	연구위원	1974.06	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	서울대(博士)	40	상근
민이규	연구위원	1966.10	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한양대(博士)	40	상근
민중술	연구위원	1968.03	남	영상디스플레이 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	고려대(碩士)	40	상근
박찬익	연구위원	1972.04	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 Solution개발실 담당임원	서울대(博士)	40	상근
백승협	연구위원	1966.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 제품기술팀 담당임원	경희사이버대학	40	상근
변준호	연구위원	1972.07	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Southern Illinois Univ.(博士)	40	상근
송호건	연구위원	1966.01	남	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	반도체연구소 수석	Univ. of California, Berkeley(博士)	40	상근
신경섭	연구위원	1968.09	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	Univ. of California, Berkeley(博士)	40	상근
알록나스데	연구위원	1962.11	남	SRI-Bangalore 담당임원	SRI-Bangalore SVP	Mcgill Univ.(博士)	40	상근
이근호	연구위원	1970.02	남	기흥/화성/평택단지 스마트IT팀 담당임원	반도체연구소 수석	한국과학기술원(博士)	40	상근
이용구	연구위원	1967.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서강대(博士)	40	상근
이제석	연구위원	1969.01	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	연세대(碩士)	40	상근
이종배	연구위원	1966.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대(碩士)	40	상근
임종형	연구위원	1969.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한양대	40	상근
장재훈	연구위원	1969.07	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	한국과학기술원(博士)	40	상근
조혜정	연구위원	1967.11	여	Samsung Research Frontier Research팀 담당임원	DMC연구소 융복합기술팀 담당임원	포항공대(博士)	40	상근
최창규	연구위원	1970.03	남	종합기술원 Device & System연구 센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구 센터 수석	한국과학기술원(博士)	40	상근
탁승식	연구위원	1965.04	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	성균관대	40	상근

프라나브	연구위원	1981.05	남	무선 상용화팀 담당임원	SRA 담당임원	Massachusetts Inst. of Tech.(MIT)(碩士)	40	상근
황상준	연구위원	1972.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	고려대(博士)	40	상근
고형중	연구위원	1970.11	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI 기반설계실 담당임원	Florida(博士)	28	상근
김강대	연구위원	1972.10	남	Samsung Research DX팀장	소프트웨어센터 SEM장	중앙대(博士)	28	상근
김경남	연구위원	1965.11	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	성균관대	28	상근
김기호	연구위원	1966.03	남	SRI-Delhi연구소장	SRC-Nanjing연구소장	George Washington Univ.(碩士)	28	상근
김도균	연구위원	1969.06	남	Samsung Research Media Research팀 담당임원	DMC연구소 차세대모바일팀 담당임원	연세대(碩士)	28	상근
김태훈	연구위원	1969.04	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(博士)	28	상근
김현우	연구위원	1970.02	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	한국과학기술원(博士)	28	상근
김후성	연구위원	1972.01	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	고려대(碩士)	28	상근
박형원	연구위원	1966.09	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	한양대(碩士)	28	상근
반효동	연구위원	1967.06	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(碩士)	28	상근
배광진	연구위원	1968.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	금오공대	28	상근
배용철	연구위원	1970.05	남	DS부문 중국총괄 담당임원	메모리 DRAM개발실 담당임원	서울대(碩士)	28	상근
서행룡	연구위원	1967.09	남	기흥/화성/평택단지 스마트IT팀 담당임원	기흥/화성단지총괄 시스템기술팀 수석	부산대	28	상근
손동현	연구위원	1969.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	고려대(碩士)	28	상근
손호성	연구위원	1968.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	경북대	28	상근
신동준	연구위원	1971.01	남	SSIC IoT사업화팀 담당임원	DS부문 소프트웨어연구소 수석	서울대(碩士)	28	상근
용석우	연구위원	1970.09	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(碩士)	28	상근
원순재	연구위원	1972.01	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	고려대(碩士)	28	상근
윤석호	연구위원	1972.07	남	LED사업팀 담당임원	LED사업팀 담당임원	서울대(博士)	28	상근
이영수	연구위원	1972.01	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	글로벌기술센터 요소기술팀 수석	서울대(博士)	28	상근
이중명	연구위원	1970.03	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	서울대(博士)	28	상근
이중호	연구위원	1968.01	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	연세대(碩士)	28	상근
이진엽	연구위원	1970.02	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash개발실 수석	서강대(碩士)	28	상근
이효순	연구위원	1970.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서울대(博士)	28	상근
정용준	연구위원	1969.10	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서강대(碩士)	28	상근
조기호	연구위원	1971.03	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발1팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	28	상근
박준수	연구위원	1967.08	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	연세대(碩士)	11	상근
박진환	연구위원	1970.07	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 전문연구원	한국과학기술원(博士)	11	상근
박철홍	연구위원	1968.05	남	반도체연구소 담당임원	반도체연구소 수석	California, San Diego(博士)	11	상근
방원철	연구위원	1969.04	남	의료기기 선행개발팀 담당임원	의료기기 선행개발팀 수석	한국과학기술원(博士)	11	상근
손영수	연구위원	1974.02	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	DS부문 미주총괄 수석	포항공대(博士)	11	상근
송기환	연구위원	1970.07	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash설계팀 수석	서울대(博士)	11	상근
오승훈	연구위원	1968.03	남	SRI-Noida연구소장	SRI-Bangalore 副연구소장	Aachen Univ. of Tech.(博士)	11	상근
오화석	연구위원	1972.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서강대(碩士)	11	상근
위훈	연구위원	1970.04	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	서울대(博士)	11	상근
이석원	연구위원	1970.07	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	서울대(博士)	11	상근
이애영	연구위원	1968.12	여	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	포항공대(碩士)	11	상근
이혜정	연구위원	1970.10	여	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서강대(碩士)	11	상근
임용식	연구위원	1971.01	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 Flash개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	11	상근
정상일	연구위원	1967.09	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	중앙대	11	상근
정진민	연구위원	1972.12	남	Samsung Research Platform팀 담당임원	소프트웨어센터 담당임원	한국과학기술원(博士)	11	상근
조성대	연구위원	1969.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	RPI(博士)	11	상근
조학주	연구위원	1969.03	남	반도체연구소 담당임원	System LSI 수석	Texas, Austin(博士)	11	상근

최성욱	연구위원	1969.02	남	글로벌기술센터 담당임원	글로벌기술센터 수석	삼성전자공과대	11	상근
최철민	연구위원	1973.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	서울대(博士)	11	상근
고경민	연구위원	1975.03	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	한국과학기술원(博士)	4	상근
권상욱	연구위원	1968.08	남	SRK연구소장	SRK연구소장	Southern California(博士)	4	상근
권순철	연구위원	1968.02	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	건국대	4	상근
김연정	연구위원	1975.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	연세대(碩士)	4	상근
김영대	연구위원	1968.10	남	Foundry 제품기술팀 담당임원	Foundry 제품기술팀 수석	동국대(碩士)	4	상근
김재영	연구위원	1971.11	남	SIEL-S 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 수석	포항공대(博士)	4	상근
김종한	연구위원	1971.05	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Virginia Tech(博士)	4	상근
김중훈	연구위원	1969.12	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	중앙대	4	상근
김준석	연구위원	1972.10	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	연세대(博士)	4	상근
김지영	연구위원	1970.04	남	반도체연구소 메모리TD실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Univ. of California, LA(博士)	4	상근
김창태	연구위원	1972.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 수석	금오공대	4	상근
목진호	연구위원	1968.09	남	글로벌기술센터 담당임원	글로벌기술센터 수석	연세대(博士)	4	상근
박기철	연구위원	1968.10	남	의료기기 선행개발팀 담당임원	의료기기 선행개발팀 수석	한국과학기술원(博士)	4	상근
박종규	연구위원	1969.07	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	경북대	4	상근
박종욱	연구위원	1968.11	남	영상디스플레이 AV사업팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	서울대(博士)	4	상근
성낙희	연구위원	1973.03	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Georgia Inst. of Tech.(博士)	4	상근
성덕용	연구위원	1973.09	남	생산기술연구소 담당임원	생산기술연구소 수석	Carnegie Mellon Univ.(博士)	4	상근
손태용	연구위원	1972.08	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 수석	연세대(碩士)	4	상근
송태중	연구위원	1971.04	남	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	Georgia Inst. of Tech.(博士)	4	상근
신종신	연구위원	1973.12	남	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 수석	서울대(博士)	4	상근
양해순	연구위원	1968.02	여	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 선행개발팀 수석	Michigan State Univ.(博士)	4	상근
오문록	연구위원	1974.02	남	메모리 Solution개발실 담당임원	메모리 Solution개발실 수석	서울대(碩士)	4	상근
오지성	연구위원	1971.07	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 수석	Stanford Univ.(博士)	4	상근
오태영	연구위원	1974.10	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	Stanford Univ.(博士)	4	상근
우경구	연구위원	1973.04	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 수석	한국과학기술원(博士)	4	상근
윤하룡	연구위원	1971.12	남	메모리 전략마케팅팀 담당임원	메모리 전략마케팅팀 수석	서울대(碩士)	4	상근
이경우	연구위원	1969.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 수석	한양대(博士)	4	상근
이금주	연구위원	1971.09	여	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	중앙대(碩士)	4	상근
이승재	연구위원	1974.08	남	메모리 Flash개발실 담당임원	메모리 Flash설계팀 수석	서울대(碩士)	4	상근
이정봉	연구위원	1970.03	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 수석	경북대(碩士)	4	상근
이종규	연구위원	1970.02	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	한양대(碩士)	4	상근
이진구	연구위원	1973.02	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 수석	성균관대(碩士)	4	상근
이효석	연구위원	1969.02	남	종합기술원 기반기술Lab 담당임원	종합기술원 기반기술Lab 수석	한국과학기술원(博士)	4	상근
정상규	연구위원	1970.03	남	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 수석	조선대	4	상근
정승필	연구위원	1968.06	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	George Washington Univ.(碩士)	4	상근
정혜순	연구위원	1975.12	여	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 수석	부산대	4	상근
조용호	연구위원	1970.03	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(博士)	4	상근
최영상	연구위원	1975.01	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 수석	Georgia Inst. of Tech.(博士)	4	상근
한상연	연구위원	1969.01	남	메모리 DRAM개발실 담당임원	메모리 DRAM개발실 수석	한국과학기술원(博士)	4	상근
한승훈	연구위원	1974.04	남	Samsung Research Frontier Research팀 담당임원	DMC연구소 융복합기술팀 수석	한국과학기술원(博士)	4	상근
홍기준	연구위원	1971.05	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Columbia Univ.(碩士)	4	상근
계종욱	연구위원	1966.10	남	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	서울대(碩士)	7	상근
권오상	연구위원	1967.04	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Univ. of Texas, Austin(博士)	39	상근
김기남	연구위원	1964.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	DMC연구소 ECO Solution팀 담당임원	Stevens Inst. of Tech.(博士)	36	상근
김대우	연구위원	1970.03	남	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	반도체연구소 Package개발팀 담당임원	연세대(博士)	5	상근

김대현	연구위원	1974.06	남	Samsung Research Media Research팀 담당임원	DMC연구소 차세대미디어팀 담당임원	Cornell Univ.(博士)	10	상근
김민경	연구위원	1973.07	여	생활가전 개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	University of Michigan(博士)	21	상근
김석원	연구위원	1970.11	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	MIT(博士)	13	상근
김성덕	연구위원	1966.09	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구센터 담당임원	Lehigh Univ.(博士)	10	상근
김성한	연구위원	1967.08	남	종합기술원 Material연구센터 담당임원	종합기술원 Material연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
김용재	연구위원	1972.03	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	서강대(碩士)	35	상근
김이환	연구위원	1968.12	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 수석	Univ. of California, Berkeley(博士)	42	상근
김준석	연구위원	1969.04	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 수석	Stanford Univ.(博士)	16	상근
김지희	연구위원	1965.08	여	Samsung Research AI센터 담당임원	소프트웨어센터 Artificial Intelligence팀 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	42	상근
김찬우	연구위원	1976.04	남	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(博士)	2	상근
김대식	연구위원	1958.10	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	한국과학기술원(碩士)		상근
김태용	연구위원	1973.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Southern California(博士)	22	상근
김형석	연구위원	1968.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	연세대(碩士)	54	상근
김홍석	연구위원	1976.05	남	Samsung Research AI센터 담당임원	소프트웨어센터 담당임원	Illinois, Urbana-Champaign(博士)	22	상근
니가노타카 시	연구위원	1968.09	남	System LSI LSI개발실 담당임원	System LSI LSI개발실 담당임원	동경농공대	4	상근
박성파	연구위원	1971.10	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서울대	23	상근
박창진	연구위원	1967.01	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발팀 담당임원	경북대	4	상근
방지훈	연구위원	1973.11	남	System LSI SOC개발실 담당임원	System LSI SOC개발실 담당임원	Carnegie Mellon Univ.(碩士)	2	상근
배홍상	연구위원	1972.01	남	종합기술원 Device & System연구센 터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센 터 담당임원	Stanford Univ.(博士)	1	상근
손재철	연구위원	1965.11	남	DS부문 인사팀 SSIT 부총장	System LSI SOC개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
송병우	연구위원	1973.08	남	Foundry 기술개발실 담당임원	Foundry 기술개발실 담당임원	Cornell Univ.(博士)	9	상근
송효정	연구위원	1969.10	여	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
신승혁	연구위원	1968.01	남	무선 개발실 담당임원	무선 기술전략팀 담당임원	Polytechnic Univ. of NY(博士)		상근
안길준	연구위원	1969.01	남	Samsung Research Security팀장	소프트웨어센터 Security팀장	George Mason Univ.(博士)	11	상근
양병덕	연구위원	1971.03	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	연세대(博士)	3	상근
양세영	연구위원	1975.08	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발실 담당임원	한국과학기술원(博士)	4	상근
양장규	연구위원	1963.09	남	생산기술연구소장	생산기술연구소 담당임원	한국과학기술원(博士)		상근
오경석	연구위원	1965.06	남	반도체연구소 Package개발팀장	반도체연구소 Package개발팀장	Illinois, Urbana-Champaign(博士)	19	상근
오부근	연구위원	1967.12	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	한양대(博士)	22	상근
윤종문	연구위원	1971.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Boston Univ.(碩士)	12	상근
윤종밀	연구위원	1963.05	남	Foundry 기술개발실 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대	39	상근
이경운	연구위원	1964.12	남	Samsung Research Cloud & IoT 팀장	소프트웨어센터 Convergence팀장	서울대		상근
이근배	연구위원	1961.03	남	Samsung Research AI센터장	소프트웨어센터 Artificial Intelligence팀장	Univ. of California, LA(博士)	30	상근
이기선	연구위원	1974.06	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Virginia Tech(博士)		상근
이용진	연구위원	1964.11	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	38	상근
이원석	연구위원	1967.10	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook(博士)	50	상근
이중현	연구위원	1966.12	남	무선 S/W담당 담당임원	무선 개발실 담당임원	Cambridge Univ.(博士)	34	상근
이현철	연구위원	1977.01	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Toronto(博士)	10	상근
임백준	연구위원	1968.07	남	Samsung Research AI센터 담당임원	Samsung Research AI센터 담당임원	Indiana Univ., Bloomington(碩士)	7	상근

임희태	연구위원	1966.11	남	생활가전 선행개발팀 담당임원	생활가전 개발팀 담당임원	부산대(博士)		상근
장동섭	연구위원	1962.11	남	글로벌기술센터 요소기술팀 담당임원	생산기술연구소 금형기술센터 수석 담당임원	The Ohio State Univ.(博士)		상근
장수백	연구위원	1975.09	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Southern Connecticut State Univ.(碩士)	21	상근
책안	연구위원	1966.02	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Stanford Univ.(碩士)	26	상근
전병환	연구위원	1965.05	남	System LSI LSI개발실 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	서강대		상근
전성모	연구위원	1971.09	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발팀 담당임원	Liverpool(碩士)	13	상근
정서형	연구위원	1967.05	남	네트워크 개발팀 담당임원	네트워크 개발2팀 담당임원	Univ. of Wisconsin, Madison (碩士)	28	상근
정의석	연구위원	1960.09	남	무선 S/W담당	무선 S/W담당	스웨덴 왕립과학대(碩士)	4	상근
정재연	연구위원	1974.09	여	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	MIT(博士)	18	상근
최성호	연구위원	1970.04	남	Samsung Research 글로벌표준팀장	DMC연구소 글로벌표준팀장	한국과학기술원(博士)		상근
최성춘	연구위원	1973.02	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	서울대(碩士)	19	상근
최원준	연구위원	1970.09	남	무선 개발실 담당임원	무선 개발2실 담당임원	Stanford Univ.(博士)	25	상근
최윤석	연구위원	1970.01	남	SRA 담당임원	DMC연구소 융복합기술팀 담당임원	Texas, Austin(博士)	9	상근
최형식	연구위원	1958.06	남	영상디스플레이 개발팀 담당임원	영상디스플레이 개발실 담당임원	인하대		상근
토모야스	연구위원	1961.01	남	반도체연구소 공정개발실 담당임원	반도체연구소 공정개발실 담당임원	Tokyo Univ.	48	상근
홍성춘	연구위원	1967.12	남	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	종합기술원 Device & System연구센터 담당임원	서울대(博士)	22	상근
강욱래	전문위원	1961.09	남	네트워크 전략마케팅팀 담당임원	네트워크 전략마케팅팀 담당부장	한국외국어대	39	상근
강윤경	전문위원	1968.12	여	창의개발센터 담당임원	창의개발센터 담당임원	Michigan, Ann Arbor(碩士)	4	상근
구성기	전문위원	1973.11	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 스마트가전T/F장	George Washington Univ.(博士)	18	상근
구수연	전문위원	1973.07	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Rutgers Univ.(碩士)	2	상근
구윤모	전문위원	1962.07	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Texas A&M Univ.(碩士)		상근
김광덕	전문위원	1962.08	남	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당임원	전남과학대	51	상근
김기선	전문위원	1968.04	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 상품전략팀 담당임원	성균관대(碩士)		상근
김대길	전문위원	1970.11	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	Southern California(碩士)	9	상근
김만영	전문위원	1969.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Boston Univ.	25	상근
김성윤	전문위원	1966.10	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 IP법무팀 담당임원	Harvard Univ.(碩士)		상근
김육기	전문위원	1961.10	남	SEPM법인장	SIEL-P(C) 담당임원	성균관대		상근
김인창	전문위원	1970.01	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 서비스사업실 담당임원	Georgia State Univ.(碩士)	4	상근
김재열	전문위원	1965.07	남	기흥/화성/평택단지 전기기술팀 담당임원	기흥/화성/평택단지 전기기술팀 담당임원	중앙대	3	상근
김정봉	전문위원	1965.07	남	경력컨설팅센터장	인사팀 담당임원	부산대	27	상근
김주환	전문위원	1968.09	남	무선 상품혁신팀 담당임원	무선 상품혁신팀 담당임원	MIT(碩士)	3	상근
김철구	전문위원	1966.09	남	SIEL-S 담당임원	네트워크 담당부장	한양대	27	상근
김행일	전문위원	1957.07	남	Global EHS센터장	환경안전센터장	광운대		상근
김호진	전문위원	1969.10	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	Hawthorne high school	16	상근
데이비드윤	전문위원	1971.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Northwestern University, Evanston (碩士)	11	상근
데이빗은	전문위원	1967.01	남	Samsung NEXT장	Global Innovation센터장	Harvard Univ.(碩士)		상근
도성대	전문위원	1966.12	남	서남아총괄 CS팀장	서남아총괄 CS팀장	부산대	11	상근
마츠오카	전문위원	1957.02	남	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	영상디스플레이 디자인팀 담당임원	多摩美術大		상근
민소영	전문위원	1967.07	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Cranfield Sch. of Management (碩士)	37	상근
민은주	전문위원	1968.08	여	SEA 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당부장	Univ. of Connecticut(博士)		상근
박상훈	전문위원	1969.09	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	SYRACUSE UNIV.(碩士)	11	상근
박성모	전문위원	1961.02	남	Global CS센터 품질혁신팀 담당임원	CS환경센터 품질혁신팀 담당임원	홍익대		상근
박수영	전문위원	1965.09	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Texas, Dallas(碩士)	26	상근

박은주	전문위원	1964.07	남	SEV 담당임원	기흥/화성단지총괄 환경안전팀장	서울과학기술대	46	상근
박정준	전문위원	1970.06	남	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	Cranfield Univ.(碩士)	22	상근
박제임스	전문위원	1973.06	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	California Polytechnic State Univ.	4	상근
박찬호	전문위원	1964.07	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	서울대(碩士)		상근
사이먼오초 버	전문위원	1967.07	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	London(碩士)	18	상근
서정아	전문위원	1971.05	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Columbia Univ.(碩士)	12	상근
서준호	전문위원	1967.11	남	SEHA법인장	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Duke Univ.(碩士)	15	상근
송병인	전문위원	1961.06	남	생활가전 Global제조팀 담당임원	생활가전 Global제조센터 담당임원	충주공전	51	상근
송인숙	전문위원	1974.01	여	의료기기 상품전략팀장	의료기기 상품기획팀장	The Johns Hopkins Univ.(博士)	35	상근
신민재	전문위원	1972.09	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 IP법무팀 담당임원	Harvard Univ.(碩士)	51	상근
안윤순	전문위원	1964.06	남	영상디스플레이 STB사업팀장	SEH-P법인장	인하대		상근
안진우	전문위원	1969.11	남	법무실 담당임원	법무실 담당임원	동아대	4	상근
엘리김	전문위원	1970.03	여	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	INSEAD(碩士)	25	상근
유경여	전문위원	1973.06	여	영상전략마케팅팀 담당임원	영상전략마케팅팀 담당임원	연세대	19	상근
유석영	전문위원	1963.04	남	DS부문 상생협력센터 담당임원	SCS법인 담당임원	Univ. of Michigan, Ann Arbor(碩士)		상근
윤구	전문위원	1970.10	남	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	Iowa Univ.(博士)	29	상근
윤준호	전문위원	1963.04	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당부장	송실대	27	상근
윤태식	전문위원	1969.04	남	한국총괄 IMC팀 담당임원	한국총괄 마케팅팀 담당임원	연세대(碩士)	59	상근
이경성	전문위원	1961.05	남	SEVT 담당임원	환경안전센터 Global환경안전팀장	Univ. of Sheffield(碩士)	37	상근
이귀로	전문위원	1966.08	남	DS부문 인사팀 담당임원	DS부문 인사팀 담당부장	동국대	40	상근
이기남	전문위원	1961.08	남	SESK 담당임원	영상디스플레이 Global운영팀 담당임원	항공대		상근
이상현	전문위원	1966.05	남	Foundry 전략마케팅팀 담당임원	System LSI Foundry사업팀 담당임원	서울대(博士)		상근
이원기	전문위원	1965.07	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	연세대(碩士)	39	상근
이원진	전문위원	1967.08	남	영상디스플레이 Service Business팀장	영상디스플레이 서비스전략팀장	Purdue Univ.(碩士)	47	상근
이은영	전문위원	1973.03	여	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	한국총괄 온라인영업팀 담당임원	State Univ. of New York, Stony Brook	17	상근
이재경	전문위원	1969.10	여	영상디스플레이 UX팀장	영상디스플레이 UX팀장	Univ. of Westminster(碩士)	4	상근
이재일	전문위원	1962.03	남	창의개발센터장	인재개발센터장	광운대		상근
이지선	전문위원	1971.08	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)	5	상근
이지수	전문위원	1976.02	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Georgia Inst. of Tech.(博士)	34	상근
이춘재	전문위원	1959.10	남	SEH-P법인장	영상디스플레이 Global운영팀장	경북대		상근
이현틀	전문위원	1974.02	여	무선 UX혁신팀 담당임원	무선 UX혁신팀 담당임원	MIT(博士)	41	상근
이희만	전문위원	1970.05	남	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	영상디스플레이 Service Business팀 담당임원	한국과학기술원(博士)	19	상근
임영수	전문위원	1969.06	남	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	한국총괄 B2B영업팀 담당임원	영남대	8	상근
장영인	전문위원	1961.10	남	상생협력센터 대외협력팀 담당임원	상생물산 기획실 담당임원	계명대		상근
장재수	전문위원	1962.07	남	종합기술원 미래기술육성센터장	DMC연구소 기술전략팀장	Syracuse Univ.(碩士)		상근
장호진	전문위원	1970.09	남	법무실 IP센터 담당임원	IP센터 라이선싱팀 책임변호사	Duke Univ.(碩士)	51	상근
전찬준	전문위원	1962.07	남	Global EHS센터 수원환경안전팀장	Global EHS센터 수원환경안전팀장	오산대	11	상근
조지현	전문위원	1961.06	남	상생협력센터 상생협력팀장	상생협력센터 상생협력팀 담당임원	아주대(博士)		상근
지세근	전문위원	1962.10	남	빙상연맹(파견)	경력건설팀장	서울디지털대		상근
채주락	전문위원	1964.08	남	영상디스플레이 AV사업팀장	영상디스플레이 개발실 담당임원	경북대		상근
최봉석	전문위원	1967.03	남	영상디스플레이 지원팀 담당임원	영상디스플레이 지원팀 책임변호사	Georgetown Univ.(碩士)	39	상근
최수호	전문위원	1963.02	남	LED사업팀 담당임원	메모리 품질보증실 담당임원	California State Univ., Sacramento (碩士)		상근
최승은	전문위원	1969.07	여	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서강대(碩士)	24	상근
최의경	전문위원	1971.05	여	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	생활가전 전략마케팅팀 담당임원	고려대(碩士)	37	상근

탁정욱	전문위원	1964.03	남	무선 Global Mobile B2B팀 담당임원	무선 전략마케팅실 담당임원	서울대	56	상근
토마스고	전문위원	1970.11	남	무선 서비스사업실 담당임원	무선 개발1실 담당임원	Univ. of Virginia	35	상근
파트릭쇼메	전문위원	1964.05	남	무선 상품혁신팀장	무선 상품전략팀장	Institut d administration des entreprises(碩士)	17	상근
피오승커	전문위원	1961.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	무선 마케팅팀 담당임원	California State Univ., Northridge (碩士)	36	상근
한상범	전문위원	1965.02	남	무선 Global CS팀 담당임원	SEA 담당임원	연세대	27	상근
한석제	전문위원	1960.04	남	무선 Global Mobile B2B팀장	무선 전략마케팅실 담당임원	Northwestern Univ.(碩士)	32	상근
한승희	전문위원	1969.11	여	영상전략마케팅실 담당임원	영상전략마케팅실 담당임원	서강대(碩士)	27	상근
홍종필	전문위원	1973.08	남	법무실 IP센터 담당임원	법무실 IP센터 담당임원	Boston Coll.(碩士)	4	상근
황득규	전문위원	1959.06	남	중국전략협력실장	기흥/화성단지장	Boston Univ.(碩士)		상근
황우찬	전문위원	1962.10	남	제도개선T/F	신문화T/F 담당임원	한양대(碩士)		상근

※ 상기 미등기임원 현황은 2018년 1분기말 재직 기준입니다.

※ 미등기 임원의 보유 주식수는 보통주(의결권 있는 주식) 5,004,267주 및 우선주(의결권 없는 주식) 12,765주입니다.

(이건희 회장 보통주 4,985,464주, 우선주 12,398주 등)

※ 미등기 임원 보유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 3월 31일 기준이며,

이후 변동 현황은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)의 '임원·주요주주 특정증권 등 소유상황보고서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 재직기간 기재를 생략하였습니다.

라. 미등기임원의 변동

보고기간종료일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	직위	성명	출생년월	성별	담당업무	사유
신규선임	상무대우	김상우	1971.01	남	법무실 담당임원	경력입사
	상무대우	김윤호	1974.11	남	법무실 담당임원	경력입사
	전문위원	이영춘	1967.10	남	무선 전략마케팅실 담당임원	경력입사
퇴임	상무	김도현	1966.11	남	무선 전략마케팅실 담당임원	의원면직
	연구위원	키스호킨스	1958.05	남	SARC연구소장	의원면직
	전문위원	강옥래	1961.09	남	네트워크 전략마케팅실 담당임원	의원면직
	전문위원	김호진	1969.10	남	영상디스플레이 Enterprise Business팀 담당임원	의원면직

마. 직원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

사업부문	성별	직원 수				합 계	평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	비고
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자						
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)					
CE	남	10,465	-	72	-	10,537	13.9	-	-	-
CE	여	2,196	74	20	-	2,216	9.1	-	-	-
IM	남	19,716	-	187	-	19,903	12.0	-	-	-
IM	여	7,703	79	38	-	7,741	9.7	-	-	-
DS	남	35,703	-	149	2	35,852	10.2	-	-	-
DS	여	14,930	194	12	-	14,942	10.0	-	-	-
기타	남	8,296	-	155	1	8,451	13.2	-	-	-
기타	여	2,271	96	38	-	2,309	9.1	-	-	-
성별합계	남	74,180	-	563	3	74,743	11.5	1,850,429	25	-
성별합계	여	27,100	443	108	-	27,208	9.8	414,142	17	-
합 계		101,280	443	671	3	101,951	11.1	2,264,571	23	-

- ※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.
- ※ 상기 직원의 수는 본사기준이며 사내이사(5명) 제외 기준입니다.
- ※ 1인 평균급여액은 분기 평균재직자 97,708명(남:73,012명, 여:24,696명) 기준으로 산출하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

<이사·감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	11	46,500	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 주주총회 승인금액은 상법 제388조에 따른 이사 보수 한도액으로, 당해 또는 과거연도에 퇴임한 이사의 직무수행의 대가를 포함하고 있습니다.

2. 보수지급금액

2-1. 이사·감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
11	11,813	1,143	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	11,684	2,191	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	45	23	-
감사위원회 위원	3	84	28	-
감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

<이사·감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

나. 주식선택권의 부여 및 행사현황

1. 이사·감사에게 부여한 주식매수선택권

구분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	5	-	-
사외이사	3	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	3	-	-
계	11	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2. 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

2018년 1분기말 현재 누적기준 미행사 주식매수선택권은 없습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

- 기업집단의 명칭 : 삼성

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 2018년 1분기말 현재 삼성그룹에는 전년말 대비 1개 회사가(에스프린팅솔루션(주)) 감소하여 62개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 46개사입니다.

(2018.3.31. 현재)

구 분	회사수	회 사 명	법인등록번호
상장사	16	삼성물산(주)	1101110015762
		삼성전자(주)	1301110006246
		삼성에스디아이(주)	1101110394174
		삼성전기(주)	1301110001626
		삼성화재해상보험(주)	1101110005078
		삼성중공업(주)	1101110168595
		삼성생명보험(주)	1101110005953
		(주)멀티캠퍼스	1101111960792
		삼성증권(주)	1101110335649
		삼성에스디에스(주)	1101110398556
		삼성카드(주)	1101110346901
		삼성엔지니어링(주)	1101110240509
		(주)에스원	1101110221939
		(주)제일기획	1101110139017
		(주)호텔신라	1101110145519
		삼성바이오로직스(주)	1201110566317
비상장사	46	(주)서울레이크사이드	1101110504070
		(주)삼우종합건축사사무소	1101115494151
		(주)씨브이네트	1101111931686
		삼성바이오에피스(주)	1201110601501
		삼성디스플레이(주)	1345110187812
		삼성코닝어드밴스드글라스(유)	1648140000991
		에스유머티리얼스(주)	1648110061337
		스테코(주)	1647110003490
		세메스(주)	1615110011795
		삼성전자서비스(주)	1301110049139
		삼성전자판매(주)	1801110210300
		삼성전자로지텍(주)	1301110046797

		수원삼성축구단(주)	1358110160126
		삼성메디슨(주)	1346110001036
		삼성화재애니카손해사(주)	1101111595680
		삼성화재서비스손해사(주)	1101111237703
		(주)삼성화재금융서비스보험대리점	1101116002424
		대정해상풍력발전(주)	2201110095315
		삼성선물(주)	1101110894520
		삼성자산운용(주)	1701110139833
		(주)생보부동산신탁	1101111617434
		삼성생명서비스손해사(주)	1101111855414
		삼성에스알에이자산운용(주)	1101115004322
		(주)삼성생명금융서비스보험대리점	1101115714533
		에스디플렉스(주)	1760110039005
		제일패션리테일(주)	1101114736934
		네추럴나인(주)	1101114940171
		삼성웰스토리(주)	1101115282077
		(주)시큐아이	1101111912503
		에스티엠(주)	2301110176840
		에스코어(주)	1101113681031
		오픈핸즈(주)	1311110266146
		(주)미라콤아이앤씨	1101111617533
		삼성카드고객서비스(주)	1101115291656
		(주)휴먼티에스에스	1101114272706
		에스원씨알엠(주)	1358110190199
		신라스테이(주)	1101115433927
		에이치디씨신라면세점(주)	1101115722916
		(주)삼성경제연구소	1101110766670
		(주)삼성라이온즈	1701110015786
		삼성벤처투자(주)	1101111785538
		삼성액티브자산운용(주)	1101116277382
		삼성헤지자산운용(주)	1101116277390
		(주)하만인터내셔널코리아	1101113145673
		레드밴드소프트웨어코리아(주)	1101113613315
		에스비티엠(주)	1101116536556
합	62		

2. 관계기업 및 자회사의 지분현황

피출자회사 출자회사	삼성 물산	삼성 전자	삼성 SDI	삼성 전기	삼성 중공업	호텔 신라	삼성 엔지니어링	제일 기획	에스원	삼성 SDS	삼성 라이온즈	삼성 경제 연구소	스테코
삼성물산		4.7			0.1		7.0			17.1		1.0	
삼성전자			19.6	23.7	16.9	5.1		25.2		22.6		29.8	70.0
삼성SDI	2.1				0.4	0.1	11.7		11.0			29.6	
삼성전기	2.6				2.3							23.8	
삼성중공업												1.0	
제일기획					0.1						67.5		
호텔신라													
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS													
삼성생명보험	0.1	8.6	0.1	0.3	3.3	7.8	0.1	0.1	5.4	0.1		14.8	
삼성화재해상보험	1.4	1.4					0.2		1.0				
삼성증권						3.1			1.3				
삼성카드						1.3		3.0	1.9				
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
삼성자산운용													
미라콤아이앤씨													
Harman International Industries, Inc.													
Red Bend Software Ltd.													
합계	6.3	14.7	19.7	24.0	23.2	17.4	19.0	28.4	20.6	39.8	67.5	100.0	70.0

※ 단위는 %, 기준일은 2018년 1분기말이며 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	세메스	삼성 전자 서비스	삼성 전자 판매	수원 삼성 축구단	삼성 전자 로지텍	삼성 디스플레이 이	삼성 메디슨	삼성 바이오 로직스	삼성 바이오 에피스	삼성코닝 어드밴스 드글라스	에스유머 티리얼스	씨브이 네트	서울 레이크 사이드
삼성물산								43.4				40.1	100.0
삼성전자	91.5	99.3	100.0		100.0	84.8	68.5	31.5					
삼성SDI						15.2							
삼성전기													
삼성중공업													
제일기획				100.0									
호텔신라													
에스원													
삼성경제연구소													
삼성SDS												9.4	
삼성생명보험								0.1					
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이										50.0	50.0		
삼성바이오로직스									94.6				
삼성자산운용													
미라콤아이앤씨													
Harman International Industries, Inc.													
Red Bend Software Ltd.													
합계	91.5	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	68.5	75.0	94.6	50.0	50.0	49.5	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2018년 1분기말이며 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	삼우 종합건축 사무소	에스디 플렉스	제일패션 리테일	네추럴 나인	삼성 웰스토리	대정해상 풍력발전	시큐 아이	휴먼티에스 에스	에스원씨 알앤	에스 티엠	멀티 캠퍼스	에스 코어	오픈 핸즈
삼성물산	100.0		100.0	51.0	100.0		8.7						
삼성전자													
삼성SDI		50.0								100.0			
삼성전기													
삼성중공업						50.1							
제일기획												5.2	
호텔신라													
에스원								100.0	100.0			0.6	
삼성경제연구소											15.2		
삼성SDS							56.5				47.2	81.8	100.0
삼성생명보험											0.0		
삼성화재해상보험													
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
삼성자산운용													
미라콤아이앤씨												0.5	
Harman International Industries, Inc.													
Red Bend Software Ltd.													
합계	100.0	50.0	100.0	51.0	100.0	50.1	65.2	100.0	100.0	100.0	62.4	88.1	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2018년 1분기말이며 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	미라콤 아이앤씨	신라 스테이	HDC 신라 면세점	에스비티 엠	삼성 생명 보험	생보 부동산 신탁	삼성생명 서비스 손해사정	삼성 에스알에이 자산운용	삼성생명 금융서비스 보험대리점	삼성화재 해상보험	삼성화재 애니카 손해사정	삼성화재 서비스 손해사정	삼성화재 금융서비스 보험대리점
삼성물산					19.3								
삼성전자													
삼성SDI													
삼성전기													
삼성중공업													
제일기획	5.4												
호텔신라		100.0	50.0	100.0									
에스원	0.6												
삼성경제연구소													
삼성SDS	83.6												
삼성생명보험						50.0	99.8	100.0	100.0	15.0			
삼성화재해상보험											100.0	100.0	100.0
삼성증권													
삼성카드													
삼성디스플레이													
삼성바이오로직스													
삼성자산운용													
미라콤아이앤씨													
Harman International Industries, Inc.													
Red Bend Software Ltd.													
計	89.6	100.0	50.0	100.0	19.3	50.0	99.8	100.0	100.0	15.0	100.0	100.0	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2018년 1분기말이며 보통주 기준입니다.

피출자회사 출자회사	삼성 증권	삼성 카드	삼성카드 고객서비스	삼성 자산운용	삼성 선물	삼성벤처 투자	삼성액티브 자산운용	삼성헤지 자산운용	하만 인터내셔널 코리아	레드벤드 소프트웨어 코리아
삼성물산						16.7				
삼성전자						16.3				
삼성SDI						16.3				
삼성전기						17.0				
삼성중공업						17.0				
제일기획										
호텔신라										
에스원										
삼성경제연구소										
삼성SDS										
삼성생명보험	29.5	71.9		100.0						
삼성화재해상보험										
삼성증권					100.0	16.7				
삼성카드			100.0							
삼성디스플레이										
삼성바이오로직스										
삼성자산운용							100.0	100.0		
미라콤아이앤씨										
Harman International Industries, Inc.									100.0	
Red Bend Software Ltd.										100.0
합계	29.5	71.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2018년 1분기말이며 보통주 기준입니다.

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율
(주)삼우종합건축사사무소	SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED	100.0
Samsung C&T America Inc.	Meadowland Distribution	100.0
Samsung C&T America Inc.	SAMSUNG OIL & GAS USA CORP	10.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Green repower, LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Construction Inc.	100.0
Samsung C&T America Inc.	QSSC, S.A. de C.V.	20.0
Samsung C&T America Inc.	Samsung Solar Energy LLC	100.0
Samsung C&T America Inc.	S-print Inc	24.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE WIND PA LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE GRS Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE K2 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE KS HOLDINGS LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Armow LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 LP H.LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Wind GP Holding Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Development LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Windsor Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Southgate Holdings GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Solar Construction Management LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE DEVELOPMENT GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE DEVELOPMENT LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC GP INC.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE BRW EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Belle River GP Holdings Inc	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC GP Inc	100.0

Samsung Renewable Energy Inc.	SRE NK1 EPC LP	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction GP Inc.	100.0
Samsung Renewable Energy Inc.	SRE Summerside Construction LP	100.0
Samsung Green repower, LLC	SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC	50.0
SP Armow Wind Ontario GP Inc	SP Armow Wind Ontario LP	0.0
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL Holdings LLC	83.6
Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	PLL E&P LLC	90.0
SRE GRW EPC GP Inc.	SRE GRW EPC LP	0.0
SRE SKW EPC GP Inc.	SRE SKW EPC LP	0.0
PLL Holdings LLC	Parallel Petroleum LLC	61.0
SRE GRW LP Holdings LP	Grand Renewable Wind LP Inc.	45.0
SRE SKW LP Holdings LP	South Kent Wind LP Inc.	50.0
SRE WIND PA GP INC.	SRE WIND PA LP	0.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	Grand Renewable Solar GP Inc.	50.0
SRE GRS Holdings GP Inc.	SRE GRS Holdings LP	0.0
SRE K2 EPC GP Inc.	SRE K2 EPC LP	0.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	KINGSTON SOLAR GP INC.	50.0
SRE KS HOLDINGS GP INC.	SRE KS HOLDINGS LP	0.0
SRE Belle River LP Holdings LP	SP Belle River Wind LP	42.5
SP Belle River Wind GP Inc	SP Belle River Wind LP	0.0
SRE Armow EPC GP Inc.	SRE Armow EPC LP	0.0
SRE Armow LP Holdings LP	SP Armow Wind Ontario LP	50.0
SRE North Kent 1 LP H.LP	North Kent Wind 1 LP	35.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SP Armow Wind Ontario GP Inc	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE GRW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE SKW LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	SRE Armow LP Holdings LP	0.0
SRE Wind GP Holding Inc.	South Kent Wind GP Inc.	50.0
SRE Wind GP Holding Inc.	Grand Renewable Wind GP Inc.	50.0
South Kent Wind GP Inc.	South Kent Wind LP Inc.	0.0
Grand Renewable Wind GP Inc.	Grand Renewable Wind LP Inc.	0.0
North Kent Wind 1 GP Inc	North Kent Wind 1 LP	0.0
SRE North Kent 2 LP Holdings LP	North Kent Wind 2 LP	50.0
North Kent Wind 2 GP Inc	North Kent Wind 2 LP	0.0
SRE Solar Development GP Inc.	SRE Solar Development LP	0.0
SRE Solar Construction Management GP Inc.	SRE Solar Construction Management LP	0.0
SRE DEVELOPMENT GP INC.	SRE DEVELOPMENT LP	0.0
SRE BRW EPC GP INC.	SRE BRW EPC LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	SRE North Kent 1 LP H.LP	0.0
SRE North Kent 1 GP Holdings Inc	North Kent Wind 1 GP Inc	50.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	SRE North Kent 2 LP Holdings LP	0.0
SRE North Kent 2 GP Holdings Inc	North Kent Wind 2 GP Inc	50.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SRE Belle River LP Holdings LP	0.0
SRE Belle River GP Holdings Inc	SP Belle River Wind GP Inc	50.0
SRE NK1 EPC GP Inc	SRE NK1 EPC LP	0.0
SRE Summerside Construction GP Inc.	SRE Summerside Construction LP	0.0

Samsung Solar Energy LLC	Samsung Solar Energy 1 LLC	100.0
Samsung Solar Energy 1 LLC	CS SOLAR LLC	50.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	SCNT Investment Atlantic SPRL	0.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	POSS-SLPC, s.r.o	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Romania 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	Solluce Slovenia 1 B.V.	20.0
Samsung C&T Deutschland GmbH	S.C. Otellinox S.A	94.3
Solluce Romania 1 B.V.	LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L.	78.0
Solluce Slovenia 1 B.V.	ZE Solar 1 D.O.O.	70.0
Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	PT. Cahaya Borneo Sukses Agrosindo	49.0
Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	PT. Cassava Borneo Sukses Plantation	49.0
Cheil Holding Inc.	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	75.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Samsung Chemtech Vina LLC	48.3
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S-print Inc	16.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	12.7
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	10.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	30.0
Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	S&G Biofuel PTE.LTD	12.6
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Gandaerah Hendana	95.0
S&G Biofuel PTE.LTD	PT. Inecda	95.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	13.2
Samsung C&T Hongkong Ltd.	천진국제무역공사	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD	100.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	45.0
Samsung C&T Hongkong Ltd.	Samsung Corporation (Guangzhou) Limited.	100.0
삼성전자주	Samsung Japan Corporation	100.0
삼성전자주	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics America, Inc.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Canada, Inc.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	63.6
삼성전자주	Samsung Electronics (UK) Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics(London) Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Holding GmbH	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Iberia, S.A.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics France S.A.S	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Italia S.P.A.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Benelux B.V.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Overseas B.V.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Portuguesa S.A.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Austria GmbH	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	55.7
삼성전자주	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	100.0

삼성전자주	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	75.0
삼성전자주	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자주	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Asia Private Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung India Electronics Private Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.	100.0
삼성전자주	PT Samsung Electronics Indonesia	100.0
삼성전자주	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	91.8
삼성전자주	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	69.1
삼성전자주	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	89.6
삼성전자주	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	48.2
삼성전자주	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.	90.0
삼성전자주	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	73.7
삼성전자주	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd.	95.0
삼성전자주	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung SemiConductor Xian	100.0
삼성전자주	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
삼성전자주	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	100.0
삼성전자주	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	87.0
삼성전자주	Samsung Electronics Argentina S.A.	98.0
삼성전자주	Samsung Electronics Chile Limitada	4.1
삼성전자주	Samsung Electronics Rus Company LLC	100.0
삼성전자주	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC	100.0
삼성전자주	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	100.0
삼성바이오에피스	Samsung Bioepis CH GmbH	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED	100.0
삼성바이오에피스	Samsung Bioepis TR Pharmaceutical Distributor LLC	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS IL LTD	100.0
삼성바이오에피스	SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA	100.0
삼성디스플레이주	Intellectual Keystone Technology LLC	41.9
삼성디스플레이주	Samsung Display Slovakia s.r.o.	100.0
삼성디스플레이주	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이주	Samsung Suzhou Module Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이주	Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.	60.0

삼성디스플레이㈜	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.	100.0
삼성디스플레이㈜	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.	95.0
삼성디스플레이㈜	Novald GmbH	9.9
세메스㈜	SEMES America, Inc.	100.0
세메스㈜	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	100.0
삼성메디슨㈜	Samsung Medison India Private Ltd.	100.0
Studer Japan Ltd.	Harman International Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NexusDX, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	NeuroLogica Corp.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Dacor Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung HVAC America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	SmartThings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Oak Holdings, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Joyent, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Pay, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Prismview, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Semiconductor, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Research America, Inc	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Samsung International, Inc.	100.0
Samsung Electronics America, Inc.	Harman International Industries, Inc.	100.0
Dacor Holdings, Inc.	Dacor	100.0
Dacor Holdings, Inc.	EverythingDacor.com, Inc.	100.0
Dacor Holdings, Inc.	Distinctive Appliances of California, Inc.	100.0
Dacor	Dacor Canada Co.	100.0
Samsung Oak Holdings, Inc.	Stellus Technologies, Inc.	100.0
Samsung Semiconductor, Inc.	Samsung Austin Semiconductor LLC.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	AdGear Technologies Inc.	100.0
Samsung Electronics Canada, Inc.	SigMast Communications Inc.	100.0
Samsung Research America, Inc	SAMSUNG NEXT LLC	100.0
Samsung Research America, Inc	Viv Labs, Inc.	100.0
SAMSUNG NEXT LLC	SAMSUNG NEXT FUND LLC	100.0
Samsung International, Inc.	Samsung Mexicana S.A. de C.V	100.0
Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV	100.0
Harman International Industries, Inc.	Studer Japan Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Industries Canada Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Professional, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Red Bend Software Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	S1NN USA, Inc.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Connected Services Holding Corp.	100.0
Harman International Industries, Inc.	AMX Holding Corporation	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Financial Group LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Belgium SA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Consumer Division Nordic A/S	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Consumer Finland OY	100.0

Harman International Industries, Inc.	Harman France SNC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International SNC	0.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Inc. & Co. KG	66.0
Harman International Industries, Inc.	Harman KG Holding, LLC	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Finance International, SCA	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Finance International GP S.a.r.l	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Malaysia Sdn. Bhd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Singapore Pte. Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	100.0
Harman International Industries, Inc.	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	99.9
AMX LLC	AMX UK Limited	100.0
AMX LLC	Harman Professional Singapore Pte. Ltd	100.0
Harman Becker Automotive Systems, Inc.	Harman International Estonia OU	100.0
Harman Investment Group, LLC	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	5.0
Harman Investment Group, LLC	Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	100.0
Harman Professional, Inc.	AMX LLC	35.5
Harman Professional, Inc.	Southern Vision Systems, Inc	100.0
Harman Professional, Inc.	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes Ltda.	0.0
Harman Professional, Inc.	Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	0.0
Red Bend Software Inc.	Red Bend Software SAS	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Engineering Corp.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Triple Play Integration LLC	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services South America S.R.L.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services UK Ltd.	100.0
Harman Connected Services, Inc.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	1.6
Harman Connected Services, Inc.	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	100.0
Harman Connected Services Holding Corp.	Harman Connected Services, Inc.	100.0
Harman Connected Services Holding Corp.	Harman Connected Services AB.	100.0
AMX Holding Corporation	AMX LLC	64.5
Harman Financial Group LLC	Harman International (India) Private Limited	0.0
Harman Financial Group LLC	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.1
Harman Financial Group LLC	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	0.0
Samsung Electronics (UK) Ltd.	Samsung Semiconductor Europe Limited	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Semiconductor Europe GmbH	100.0
Samsung Electronics Holding GmbH	Samsung Electronics GmbH	100.0
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	31.4
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.	Samsung Electronics Slovakia s.r.o	44.3
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.	36.4
Samsung Electronics Benelux B.V.	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics West Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics East Africa	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	99.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Israel Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	99.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.	100.0

Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Turkey	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Semiconductor Israel R&D Center,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Maghreb Arab	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Venezuela, C.A.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	13.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Chile Limitada	95.9
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Peru S.A.C.	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Ukraine Company LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung R&D Institute Rus LLC	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Central Eurasia LLP	100.0
Samsung Electronics Benelux B.V.	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	100.0
Samsung Electronics Nordic Aktiebolag	Samsung Nanoradio Design Center	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Harman Professional Denmark ApS	100.0
AKG Acoustics Gmbh	Studer Professional Audio Gmbh	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Japan Ltd.	40.0
Harman Professional Denmark ApS	R&D International BVBA	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Harman International s.r.o	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Harman Professional France SAS	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Harman Professional Germany GmbH	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Manufacturing (UK) Ltd	100.0
Harman Professional Denmark ApS	Martin Professional Pte. Ltd.	100.0
Harman France SNC	Harman International SNC	100.0
Harman International SNC	Harman France SNC	0.0
Harman Becker Automotive Systems Gmbh	Harman International Romania SRL	0.0
Harman Becker Automotive Systems Gmbh	iOnRoad Technologies Ltd	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Harman Becker Automotive Systems Gmbh	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Harman Deutschland Gmbh	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	95.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Duran Audio B.V.	100.0
Harman Holding Gmbh & Co. Kg	Harman RUS CIS LLC	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Holding Gmbh & Co. Kg	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Management Gmbh	100.0
Harman Inc. & Co. KG	Harman Hungary Financing Ltd.	100.0
Harman Connected Services Gmbh	Harman Connected Services OOO	100.0
Harman KG Holding, LLC	Harman Inc. & Co. KG	34.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Professional Kft	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman Consumer Nederland B.V.	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Harman International Romania SRL	100.0
Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Red Bend Ltd.	100.0

Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	Towersec Ltd.	100.0
Harman Hungary Financing Ltd.	Harman International Industries Limited	100.0
Harman Finance International GP S.a.r.l	Harman Finance International, SCA	0.0
Harman Consumer Nederland B.V.	AKG Acoustics Gmbh	100.0
Harman Consumer Nederland B.V.	Harman Holding Limited	100.0
Duran Audio B.V.	Harman Investment Group, LLC	100.0
Duran Audio B.V.	Duran Audio Iberia Espana S.L.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Japan Co., Ltd.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Finland OY	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services GmbH	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Limited	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Solutions (Beijing) Co., Ltd.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	100.0
Harman Connected Services AB.	Harman Connected Services Taiwan Inc.	100.0
AMX UK Limited	AMX Gmbh	100.0
AMX UK Limited	Knight Image Limited	100.0
AMX UK Limited	Inspiration Matters Limited	100.0
AMX UK Limited	Endeleo Limited	100.0
Harman Automotive UK Limited	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	100.0
Harman International Industries Limited	Harman Automotive UK Limited	100.0
Harman International Industries Limited	Arcam Limited	100.0
Harman International Industries Limited	Harman International Industries PTY Ltd.	100.0
Harman Connected Services UK Ltd.	Harman Connected Services Morocco	100.0
Arcam Limited	A&R Cambridge Limited	100.0
Samsung Electronics Austria GmbH	Samsung Electronics Switzerland GmbH	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.	68.6
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Romania LLC	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	49.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Greece S.A.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Innoetics E.P.E.	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Denmark Research Center ApS	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung France Research Center SARL	100.0

Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Samsung Cambridge Solution Centre Limited	100.0
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.	Novald GmbH	40.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics New Zealand Limited	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Philippines Corporation	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung R&D Institute BanglaDesh	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co. Ltd.,.	100.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	25.0
Samsung Asia Private Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.4
Samsung India Electronics Private Ltd.	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd	100.0
PT Samsung Electronics Indonesia	PT Samsung Telecommunications Indonesia	100.0
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.	LAOS Samsung Electronics Sole Co., Ltd	100.0
Harman Professional Singapore Pte. Ltd	AMX Products And Solutions Private Limited	100.0
Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	Aditi Technologies Europe GmbH	100.0
Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	INSP India Software Development Pvt. Ltd.	99.0
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Harman Connected Services Technologies Pvt. Ltd.	100.0
Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	INSP India Software Development Pvt. Ltd.	1.0
Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.	iMarket Asia Co., Ltd.	11.3
Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.	19.2
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Tianjin Mobile Development Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung R&D Institute China-Shenzhen	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.	10.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.	43.1
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Beijing Samsung Telecom R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.	26.3
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics China R&D Center	100.0
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.	Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman Automotive InfoTech (Dalian) Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	100.0
Harman Holding Limited	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	100.0
Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Egypt S.A.E	0.1
Samsung Electronics Maghreb Arab	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L	1.0
Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Harman International (India) Private Limited	100.0
Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	98.4

iOnRoad Technologies Ltd	iOnRoad Ltd	100.0
Red Bend Ltd.	Red Bend Software Japan Co., Ltd.	100.0
Red Bend Ltd.	Red Bend Software Ltd.	100.0
Red Bend Ltd.	Broadsense Ltd.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronica Colombia S.A.	100.0
Samsung Electronics Latinoamerica (Zona Libre)	Samsung Electronics Panama. S.A.	100.0
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.	Samsung Electronics Argentina S.A.	2.0
Harman do Brasil Industria Electronica e Participacoes Ltda.	Harman da Amazonia Industria Electronica e Participacoes Ltda.	100.0
Samsung Electronics Central Eurasia LLP	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd	0.0
삼성SDI(주)	Intellectual Keystone Technology LLC	41.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Japan Co., Ltd.	89.2
삼성SDI(주)	Samsung SDI America, Inc.	91.7
삼성SDI(주)	Samsung SDI Hungary Rt.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Europe GmbH	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Battery Systems GmbH	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	97.6
삼성SDI(주)	Samsung SDI China Co., Ltd.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd.	50.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Lt	65.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd.	50.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	50.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI Brasil Ltda.	45.0
삼성SDI(주)	Novald GmbH	50.1
삼성SDI(주)	SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.	100.0
삼성SDI(주)	Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd.	50.0
삼성SDI(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung SDI America, Inc.	Samsung SDI Brasil Ltda.	40.4
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.	80.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd.	30.0
Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	Samsung SDI Brasil Ltda.	14.6
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Japan Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	100.0
삼성전기(주)	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS GMBH	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd.	75.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp.	100.0
삼성전기(주)	Calamba Premier Realty Corporation	39.8
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS SOFTWARE INDIA BANGALORE	99.9
삼성전기(주)	Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0

삼성전기(주)	Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	81.8
삼성전기(주)	Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd.	95.0
삼성전기(주)	Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	100.0
삼성전기(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	8.7
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.	Samsung Electro-Mechanics do Brasil Intermediacoes de Negocios Ltda.	100.0
Calamba Premier Realty Corporation	Batino Realty Corporation	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE MANAGEMENT CORPORATION	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE	100.0
삼성화재해상보험(주)	P.T. Asuransi Samsung Tugu	70.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Vina Insurance Co., Ltd	75.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG REINSURANCE PTE. LTD	100.0
삼성화재해상보험(주)	삼성재산보험(중국)유한공사	100.0
삼성화재해상보험(주)	Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East	100.0
삼성화재해상보험(주)	SAMSUNG FIRE & MARINE CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA.	100.0
삼성중공업(주)	Camellia Consulting Corporation	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd.	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영파)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	삼성중공업(영성)유한공사	100.0
삼성중공업(주)	영성가야선업유한공사	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	100.0
삼성중공업(주)	Samsung Heavy Industries Mozambique LDA	100.0
삼성중공업(주)	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES BRASIL ASSESSORIA EM PROJETOS EMPRESARIAIS LTDA.	100.0
삼성중공업(주)	SHI BRAZIL CONSTRUCTION	100.0
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED	SHI - MCI FZE	70.0
삼성생명보험(주)	Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.	51.0
삼성생명보험(주)	30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMITED	100.0
삼성생명보험(주)	THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD.	48.9
삼성생명보험(주)	Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd	90.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (New York), Inc.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management(London) Ltd.	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd	100.0
삼성자산운용(주)	Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	100.0
30 GRESHAM STREET(JERSEY) LIMITED	30 GRESHAM STREET (SINGAPORE) LIMITED	100.0
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.	Samsung Asset Management (Beijing) Ltd.	100.0
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L	100.0
Samsung Fashion Trading Co., Ltd	Eight Seconds(Shanghai)Co., Ltd.	100.0
삼성물산(주)	MYODO METAL CO., LTD.	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Japan Corporation	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T America Inc.	100.0
삼성물산(주)	Samsung Finance Corporation.	80.0
삼성물산(주)	Samsung E&C America, INC.	100.0
삼성물산(주)	SAMSUNG OIL & GAS USA CORP	90.0

삼성물산주	Samsung Renewable Energy Inc.	100.0
삼성물산주	SCNT Power Norte S. De R.L. de C.V.	100.0
삼성물산주	QSSC, S.A. de C.V.	60.0
삼성물산주	Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp.	100.0
삼성물산주	Samsung C&T Canada Ltd.	100.0
삼성물산주	Samsung C&T Deutschland GmbH	100.0
삼성물산주	Samsung C&T U.K. Ltd.	100.0
삼성물산주	Samsung C&T ECUK Limited	100.0
삼성물산주	Whessoe engineering Limited	100.0
삼성물산주	SCNT Investment Atlantic SPRL	100.0
삼성물산주	POSS-SLPC, s.r.o	50.0
삼성물산주	Solluce Romania 1 B.V.	80.0
삼성물산주	SAM investment Manzanilo.B.V	53.3
삼성물산주	Solluce Slovenia 1 B.V.	80.0
삼성물산주	Ecosolar OOD	100.0
삼성물산주	Ecoenergy Solar OOD	100.0
삼성물산주	Agrilplam EOOD	100.0
삼성물산주	Fishtrade EOOD	100.0
삼성물산주	Manageproject EOOD	100.0
삼성물산주	Solar Park EOOD	100.0
삼성물산주	Veselinovo Energy OOD	100.0
삼성물산주	Samsung C&T Construction Hungary Kft.	100.0
삼성물산주	Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd.	100.0
삼성물산주	Samsung C&T Malaysia SDN. BHD	100.0
삼성물산주	Erdsam Co., Ltd.	100.0
삼성물산주	Samsung Chemtech Vina LLC	51.7
삼성물산주	S-print Inc	40.0
삼성물산주	Cassava Investment Korea Pte. Ltd.	29.7
삼성물산주	Samsung C&T Thailand Co., Ltd	43.9
삼성물산주	Cheil Holding Inc.	40.0
삼성물산주	Samsung Const. Co. Phils.,Inc.	25.0
삼성물산주	Samsung Design Philippines Inc	100.0
삼성물산주	PT. INSAM BATUBARA ENERGY	90.0
삼성물산주	Samsung C&T India Pte., Ltd.	100.0
삼성물산주	Samsung C&T Corporation India Private Limited	100.0
삼성물산주	Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd	70.0
삼성물산주	Samsung C&T Singapore Pte., Ltd.	100.0
삼성물산주	S&G Biofuel PTE.LTD	50.5
삼성물산주	SAMSUNG C&T Mongolia LLC.	70.0
삼성물산주	Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC.	100.0
삼성물산주	S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC.	40.0
삼성물산주	Samsung C&T Hongkong Ltd.	100.0
삼성물산주	Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.	100.0
삼성물산주	Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd.	55.0
삼성물산주	SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
삼성물산주	Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd.	100.0

삼성물산(주)	SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA	100.0
삼성물산(주)	SAM Gulf Investment Limited	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Chile Copper SpA	100.0
삼성물산(주)	SCNT Power Kelar Inversiones Limitada	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation Rus LLC	100.0
삼성물산(주)	JSC BALKHASH THERMAL POWER PLANT	50.0
삼성물산(주)	Samsung SDI America, Inc.	8.3
삼성물산(주)	Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.	2.4
삼성물산(주)	Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd	10.0
삼성물산(주)	Cheil Industries Corp., USA	100.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL	100.0
삼성물산(주)	Samsung Fashion Trading Co., Ltd	100.0
삼성물산(주)	CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM COMPANY LIMITED	100.0
삼성물산(주)	Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd	60.0
삼성물산(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	19.3
삼성웰스토리(주)	WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED	90.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD	85.0
삼성웰스토리(주)	Shanghai Welstory Food Company Limited	70.0
(주)멀티캠퍼스	LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC	82.4
Eight Seconds(Shanghai)Co., Ltd.	Eight Seconds (Shanghai) Trading Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai China Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai Taiwan Co., Ltd.	100.0
PengTai Greater China Co., Ltd.	PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	100.0
PengTai China Co., Ltd.	PengTai e-Commerce Co.,Ltd.	100.0
PengTai China Co., Ltd.	PengTai Marketing Service Co., Ltd.	100.0
PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	MEDIALYTICS Inc.	51.0
PengTai Interactive Advertising Co.,Ltd.	Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.	51.0
iMarket Asia Co., Ltd.	iMarket China Co., Ltd.	80.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (America), Inc.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Europe) Limited.	100.0
삼성증권(주)	Samsung Securities (Asia) Limited.	100.0
삼성에스디에스(주)	iMarket Asia Co., Ltd.	40.6
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	SAMSUNG SDS GSCL CANADA., LTD.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS America, Inc.	100.0
삼성에스디에스(주)	Neo EXpress Transportation (NEXT), Inc.	51.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Europe Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Hungary Kft.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL UK Ltd.	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung GSCL Sweden AB	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL France SAS	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Baltics, SIA	100.0
삼성에스디에스(주)	Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico	100.0

삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Germany GmbH	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung GSCL Portugal, Sociedade Unipessoal Lda	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Austria GmbH	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Czech s.r.o.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Switzerland GmbH	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS GSCL Romania SRL	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung Data Systems India Private Limited	100.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS VIETNAM CO., LTD.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS India Private Limited	100.0
삼성에스디에스㈜	VASCO SUPPLY CHAIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	51.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL ASIA PACIFIC PTE. LTD.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS GSCL Vietnam Co Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD.	100.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL AUSTRALIA PTY., LTD.	100.0
삼성에스디에스㈜	SDS-ACUTECH CO., LTD	50.0
삼성에스디에스㈜	ALS SDS Joint Stock Company	51.0
삼성에스디에스㈜	SDS-MP LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY	51.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS China, Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Hong Kong Ltd	100.0
삼성에스디에스㈜	SDS Kerry (Shanghai) Supply Chain Solutions Limited	50.0
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS Global SCL Egypt Co. Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd.	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Transport and Logistics Joint Stock Company	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC	100.0
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda	99.7
삼성에스디에스㈜	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD	99.7
삼성에스디에스㈜	Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	100.0
㈜미라콤아인씨	MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda	0.3
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V.	99.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Panama S. A.	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Chile Limitada	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C.	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S.	100.0
Samsung SDS Global SCL America, Inc.	SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD	0.3
Samsung SDS Europe Ltd.	Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	0.0

Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o.	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS GSCL Romania SRL	0.0
Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A	Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company	0.0
Samsung SDS China, Ltd.	Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd	100.0
Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd.	Samsung SDS Global Development Center Xi'an	100.0
MIRACOM INC ASIA PACIFIC LTD	MIRACOM INC CHINA LTD	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering America Inc.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Hungary Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	100.0
삼성엔지니어링(주)	PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.	81.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering India Private Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Lt	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Muharrag Wastewater Services Company W.L.L.	64.8
삼성엔지니어링(주)	Muharrag STP Company B.S.C.	4.6
삼성엔지니어링(주)	Muharrag Holding Company 1 Ltd.	45.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Mexico Construcccion Y Operacion S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V.	99.9
삼성엔지니어링(주)	Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Bolivia S.A	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V.	100.0
삼성엔지니어링(주)	Samsung Engineering Kazakhstan LLP	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Construction, LLC	100.0
Samsung Engineering America Inc.	SEA Louisiana Construction, L.L.C.	100.0
Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD.	Muharrag Wastewater Services Company W.L.L.	0.3
Samsung Engineering India Private Ltd.	Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	0.0
Samsung Saudi Arabia Co., Ltd.	Samsung EPC Co., Ltd	75.0
Muharrag Holding Company 1 Ltd.	Muharrag Holding Company 2 Ltd.	100.0
Muharrag Holding Company 2 Ltd.	Muharrag STP Company B.S.C.	89.9
(주)에스원	SOCM LLC	100.0
(주)에스원	S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD	100.0
(주)에스원	Samsung Beijing Security Systems	100.0
(주)제일기획	Cheil USA Inc.	100.0
(주)제일기획	Cheil Central America Inc.	100.0
(주)제일기획	IRIS Worldwide Holdings Limited	85.2

주제일기획	Cheil Europe Ltd.	100.0
주제일기획	Cheil Germany GmbH	100.0
주제일기획	Cheil France SAS	100.0
주제일기획	Cheil Nordic AB	100.0
주제일기획	Cheil India Pvt. Ltd.	100.0
주제일기획	Cheil (Thailand) Ltd.	100.0
주제일기획	Cheil Singapore Pte. Ltd.	100.0
주제일기획	Cheil Vietnam Co. Ltd.	99.0
주제일기획	Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	100.0
주제일기획	Cheil Malaysia SDN BHD	100.0
주제일기획	Cheil China	100.0
주제일기획	Cheil Hong Kong Ltd.	100.0
주제일기획	Bravo Asia Limited	100.0
주제일기획	Bravo Asia-Shanghai	100.0
주제일기획	Cheil MEA FZ-LLC	100.0
주제일기획	Cheil South Africa Pty., Ltd.	100.0
주제일기획	CHEIL KENYA LIMITED	99.0
주제일기획	Cheil Communications Nigeria Ltd.	99.0
주제일기획	Cheil Jordan LLC	100.0
주제일기획	Cheil Ghana Limited	100.0
주제일기획	Cheil Brazil Communications Ltda.	100.0
주제일기획	Cheil Mexico Inc. SA de CV	98.0
주제일기획	Cheil Chile SpA.	100.0
주제일기획	Cheil Peru SAC	100.0
주제일기획	Cheil Rus LLC	100.0
주제일기획	Cheil Ukraine LLC	100.0
주제일기획	Cheil Kazakhstan LLC	100.0
주호텔신라	Samsung Hospitality America Inc.	100.0
주호텔신라	Shilla Travel Retail Pte. Ltd.	100.0
주호텔신라	SHILLA LIMITED Macao	100.0
주호텔신라	Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	100.0
주호텔신라	SHILLA LIMITED Hong Kong	100.0
주호텔신라	Shilla Travel Retail Hong Kong Limited	100.0
주호텔신라	Shilla Travel Retail Taiwan Limited	64.0
에이치디씨신라면세점(주)	HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD.	100.0
에스비티엠 주식회사	Sasmsung Hospitality U.K. Inc.	100.0
에스비티엠 주식회사	SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL	100.0
에스비티엠 주식회사	Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.	99.0
에스비티엠 주식회사	Samsung Hospitality Philippines Inc.	100.0
에스비티엠 주식회사	Samsung Hospitality India Private Limited	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris USA, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Atlanta, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Experience, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Latin America, Inc.	100.0
Iris Americas, Inc.	Iris Worldwide San Diego, Inc.	100.0
Iris Latin America, Inc.	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	0.0

Iris Latin America, Inc.	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	0.0
Iris Canada Holdings Ltd	Pricing Solutions Ltd	100.0
Cheil USA Inc.	The Barbarian Group LLC	100.0
Cheil USA Inc.	McKinney Ventures LLC	100.0
Cheil USA Inc.	Cheil India Pvt. Ltd.	0.0
Cheil USA Inc.	Cheil Mexico Inc. SA de CV	2.0
Samsung Hospitality America Inc.	Samsung Hospitality Europe GmbH	100.0
IRIS Worldwide Holdings Limited	Iris Nation Worldwide Limited	100.0
IRIS Worldwide Holdings Limited	Josh & James Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Americas, Inc.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Canada Holdings Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris London Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Promotional Marketing Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures 1 Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Founded Partners Limited	76.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Products (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Korea Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris PR Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Concise Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Digital Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Amsterdam B.V.	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Datalytics Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Ventures (Worldwide) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Culture Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Concise Consultants Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Atom42 Limited	80.0
Iris Nation Worldwide Limited	Pricing Solutions (UK) Limited	75.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Services Limited Dooel Skopje	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Singapore Pte Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide Integrated Marketing Pvt Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Sydney PTY Ltd	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris Worldwide (Thailand) Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Iris (Beijing) Advertising Company Limited	100.0
Iris Nation Worldwide Limited	Irisnation Hong Kong Limited	100.0
Iris London Limited	Iris Partners LLP	100.0
Iris Promotional Marketing Ltd	Holdings BR185 Limited	100.0
Iris Ventures 1 Limited	Iris Germany GmbH	100.0
Founded Partners Limited	Founded Partners, Inc.	100.0
Iris Ventures (Worldwide) Limited	THE ELEPHANT ROOM LIMITED	49.0
Iris Germany GmbH	Pepper NA, Inc.	100.0
Iris Germany GmbH	Pepper Technologies Pte Limited	100.0
Cheil Europe Ltd.	BEATTIE MCGUINNESS BUNGAY LIMITED	100.0
Cheil Europe Ltd.	Cheil Italia S.r.l	100.0
Cheil Europe Ltd.	CHEIL SPAIN S.L	100.0

Cheil Europe Ltd.	CHEIL BENELUX B.V.	100.0
Cheil Germany GmbH	Cheil Austria GmbH	100.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PengTai Greater China Co., Ltd.	95.0
Cheil Singapore Pte. Ltd.	PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA	100.0
Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.	Cheil Philippines Inc.	30.0
Cheil Hong Kong Ltd.	PengTai Greater China Co., Ltd.	3.1
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.	Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One Agency FZ LLC	100.0
Cheil MEA FZ-LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	0.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	CHEIL KENYA LIMITED	1.0
Cheil South Africa Pty., Ltd.	Cheil Communications Nigeria Ltd.	1.0
One Agency FZ LLC	One RX India PVT. LTD	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Project Management Design and Production Limited Company	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Interior Design LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One RX Printing LLC	100.0
One Agency FZ LLC	One Agency South Africa Pty., Ltd.	100.0
One RX Interior Design LLC	One RX India PVT. LTD	0.0
Holdings BR185 Limited	Brazil 185 Participacoes Ltda	100.0
Brazil 185 Participacoes Ltda	Iris Router Marketing Ltda	100.0

※ 단위는 %, 기준일은 2018년 1분기말, 보통주 기준입니다.

3. 관련법령상의 규제내용 등

□ "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 상 상호출자제한기업집단 등

① 지정시기 : 2018년 5월 1일

② 규제내용 요약

- 상호출자의 금지
- 계열사 채무보증 금지
- 금융·보험사의 계열사 의결권 제한
- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
- 비상장사 중요사항 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(2018.3.31 현재)

성명	계열사 겸직현황		
	회사명	직위	상근여부
전동수	삼성메디슨	대표이사	상근
신재경	스टे코	대표이사	상근
이평우	삼성전자판매	대표이사	상근
최원진	삼성전자로지텍	감사	비상근
	삼성전자판매	감사	비상근
	삼성전자서비스	감사	비상근
윤태양	세메스	기타 비상무이사	비상근
장성재	삼성메디슨	감사	비상근
박광채	삼성메디슨	사내이사	상근
신성우	스टे코	감사	비상근
서기호	세메스	기타 비상무이사	비상근
이동우	세메스	감사	비상근
이원준	삼성경제연구소	감사	비상근
이환구	삼성디스플레이	감사	비상근
김재원	삼성벤처투자	감사	비상근
장세연	세메스	기타 비상무이사	비상근
이승원	스टे코	기타 비상무이사	비상근

5. 타법인출자 현황

2018년 1분기말 현재 당사의 타법인 출자금액은 장부가 기준 56조 7,198억원이며, 사업관련 등으로 출자하였습니다.

(2018.3.31 현재)

(단위 : 천주, 백만원, %)

계정과목	법인명 또는 종목명	최초 취득 일자	출자 목적	최초 취득 금액	기초잔액			증가(감소) 내역			기말잔액			최근 사업연도 재무현황		비고
					수량	지분율	장부가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기 순손익	
								수량	금액							
상장	삼성전기주	1977.01	사업관련	250	17,693	23.69	445,244				17,693	23.69	445,244	7,767,403	161,739	
비상장	스테코주	1995.06	경영참가 등	24,000	2,590	70	35,861				2,590	70	35,861	170,098	4,792	
비상장	세메스주	1992.12	경영참가 등	1,000	2,173	91.54	71,906				2,173	91.54	71,906	1,043,351	141,341	
비상장	㈜삼성경제연 구소	1991.05	사업관련	320	3,576	29.8	24,942				3,576	29.8	24,942	119,761	226	
상장	삼성에스디에스주	1992.07	사업관련	6,160	17,472	22.58	560,827				17,472	22.58	560,827	7,277,761	530,348	
비상장	삼성전자서비스주	1998.01	경영참가 등	30,000	6,000	99.33	48,121				6,000	99.33	48,121	347,411	-907	
비상장	삼성전자판매주	2000.12	경영참가 등	3,100	1,767	100	247,523				1,767	100	247,523	590,110	2,329	
비상장	삼성전자로지텍주	1999.04	경영참가 등	76	1,011	100	46,669				1,011	100	46,669	155,878	14,480	
비상장	삼성디스플레이주	2012.04	경영참가 등	16,009,547	221,969	84.78	18,509,307				221,969	84.78	18,509,307	50,723,199	3,352,802	
비상장	SVIC 21호 투자 조합	2011.11	경영참가 등	19,800	1	99	86,086	0	3,557		1	99	89,644	85,857	-2,564	출자
비상장	SVIC 22호 투자 조합	2011.11	경영참가 등	19,800	1	99	139,362				1	99	139,362	126,264	-2,146	
비상장	SVIC 26호 투자 조합	2014.11	경영참가 등	19,800	2	99	172,131				2	99	172,131	192,444	25,885	
비상장	SVIC 27호 투자 조합	2014.09	경영참가 등	5,940	0	99	19,008	0	2,158		0	99	21,166	16,871	-1,660	출자
비상장	SVIC 28호 투자 조합	2015.02	경영참가 등	7,425	2	99	163,653				2	99	163,653	186,164	-3,778	
비상장	SVIC 32호 투자 조합	2016.08	경영참가 등	19,800	1	99	69,567	0	29,547		1	99	99,114	64,077	-5,534	출자
비상장	SVIC 33호 투자 조합	2016.11	경영참가 등	4,950	1	99	68,567	0	16,493		1	99	85,061	64,873	-4,959	출자
비상장	삼성메디슨주	2011.02	경영참가 등	286,384	87,350	68.45	477,648				87,350	68.45	477,648	329,064	10,199	
상장	삼성바이오로 직스주	2011.04	사업관련	30,000	20,837	31.49	443,193				20,837	31.49	443,193	7,183,091	-96,972	
비상장	인텔렉추얼디 스커버리주	2011.05	사업관련	5,000	1,784	15.71	5,241				1,784	15.71	5,241	37,234	-1,416	
상장	삼성중공업주	1977.09	사업관련	125	65,931	16.91	483,274			25,713	65,931	16.91	508,987	13,818,113	-340,748	평가
상장	㈜호텔신라	1979.12	사업관련	252	2,005	5.11	170,200			22,052	2,005	5.11	192,252	2,249,913	25,286	평가
상장	㈜제일기획	1988.09	사업관련	185	29,038	25.24	491,599				29,038	25.24	491,599	2,238,293	127,153	
상장	에이테크솔루	2009.11	사업관련	26,348	1,592	15.92	19,422			-2,149	1,592	15.92	17,273	166,863	-468	평가

	선주																
상장	㈜아이마켓코리아	2000.12	사업관련	1,900	647	1.8	5,832			641	647	1.8	6,473	1,086,928	15,659	평가	
상장	㈜케이티스카이리 이프	2001.12	사업관련	3,344	240	0.5	3,228			-300	240	0.5	2,928	792,893	57,314	평가	
상장	삼성SDI㈜	1977.01	사업관련	304	13,463	19.58	1,242,605				13,463	19.58	1,242,605	15,751,477	657,236		
상장	㈜원익아이피 에스	2016.04	사업관련	16,214	1,851	4.48	61,821			-185	1,851	4.48	61,636	409,618	95,365	평가	
상장	㈜원익홀딩스 (舊원익IPS)	2013.12	사업관련	15,411	1,759	2.28	13,880			-950	1,759	2.28	12,930	1,061,203	80,652	평가	
상장	㈜동진세미켈	2017.11	사업관련	48,277	2,468	4.8	54,540			-18,262	2,468	4.8	36,278	667,169	44,997	평가	
상장	솔브레인㈜	2017.11	사업관련	55,618	835	4.8	56,370			-7,182	835	4.8	49,188	895,950	43,086	평가	
비상장	㈜기림기술금 융	1995.01	사업관련	5,000	1,000	17.24	5,000				1,000	17.24	5,000	98,120	1,107		
비상장	한국경제신문㈜	1987.05	사업관련	150	72	0.39	365				72	0.39	365	348,436	31,324		
비상장	삼성벤처투자㈜	1999.11	사업관련	4,900	980	16.33	7,784				980	16.33	7,784	100,809	7,583		
비상장	㈜씨이비뱅크	2000.12	사업관련	8,000	1,083	7.46	0				1,083	7.46	0	0	0		
비상장	화인컴스㈜	2001.12	사업관련	10	2	3.81	10				2	3.81	10	6,332	1,827		
비상장	㈜인켈	2006.11	사업관련	130	0	0	0				0	0	0	103,217	-6,643		
상장	㈜용평리조트	2007.05	사업관련	1,869	400	0.83	4,180			-1,172	400	0.83	3,008	868,156	16,953	평가	
비상장	㈜삼보컴퓨터	2012.09	채권회수	0	0	0.01	0				0	0.01	0	30,787	3,590		
비상장	아이큐브투자조합 1호	2009.12	사업관련	4,000	0	16.23	1,614				0	16.23	1,614	1,837	23		
비상장	㈜신성건설	2010.07	채권회수	1	0	0.01	0				0	0.01	0	186,429	9,096		
비상장	㈜우방 (舊씨앤우방)	2010.07	채권회수	0	1	0	0				1	0	0	451,452	48,233		
비상장	대우산업개발㈜	2012.12	채권회수	0	0	0.02	0				0	0.02	0	197,601	25,144		
비상장	대우중도개발㈜	2012.12	채권회수	0	9	0.02	0				9	0.02	0	19,367	-350		
비상장	자일자동차판매㈜	2012.12	채권회수	0	1	0	0				1	0	0	277,101	19,463		
비상장	성원건설㈜	2014.04	채권회수	0	1	0.03	0				1	0.03	0	27,744	-627		
비상장	㈜인희	2014.04	채권회수	0	2	0.17	0				2	0.17	0	9,566	-217		
비상장	삼성솔루션㈜	2014.04	채권회수	0	4	6.7	0				4	6.7	0	9,048	1,398		
비상장	풍림산업㈜	2014.05	채권회수	0	52	0.37	0				52	0.37	0	236,539	-37,906		
비상장	반도체성장펀드	2017.03	사업관련	500	34,500.00	66.67	34,500	7,000.00	7,000		41,500.00	66.67	41,500	51,906	-470	출자	
비상장	JNT(반도체펀드)	2011.02	사업관련	1,800	0	24	1,758				0	24	1,758	5,014	-113		
비상장	SV(반도체펀드)	2011.02	사업관련	1,850	0	14.85	0				0	14.85	0	16,643	17,678		
비상장	서울투자파트 너스㈜	2011.10	사업관련	1,550	0	19.38	2,468	0	-310		0	19.38	2,158	10,666	214	회수	
비상장	대신아주IB (반도체펀드)	2011.08	사업관련	258	0	3	726				0	3	726	19,468	-4,924		
비상장	TS(반도체펀드)	2011.11	사업관련	1,700	0	20.48	676	0	-148		0	20.48	528	11,277	559	회수	
비상장	L&S (반도체펀드)	2012.07	사업관련	848	0	7.46	1,756	0	-75		0	7.46	1,681	23,481	-78	회수	
비상장	㈜말타니(舊태 원 전기산업)	2012.04	사업관련	16,544	45	15	15,137				45	15	15,137	67,049	1,212		
비상장	㈜팬택자산관 리	2013.06	사업관련	53,000	53,000	10.03	0				53,000	10.03	0	59,660	485		
비상장	KTCNP-GC (반도체펀드)	2013.12	사업관련	960	0	3.56	3,832				0	3.56	3,832	124,960	17,748		
비상장	포스코기술투 자㈜	2013.12	사업관련	600	0	10	530				0	10	530	5,153	1,133		
비상장	㈜지능정보기	2016.07	사업관련	3,000	600	14.29	3,000				600	14.29	3,000	17,754	-2,351		

	출연구원															
비상장	SECA	1992.08	해외거점 확보	3,823	0	100	90,922				0	100	90,922	762,677	32,908	
비상장	SEA	1978.07	해외거점 확보	59,362	492	100	17,053,807				492	100	17,053,807	26,266,636	-70,198	
비상장	SELA	1989.04	해외거점 확보	319	40	100	86,962				40	100	86,962	373,528	30,281	
비상장	SEM	1995.07	해외거점 확보	3,032	3,837	63.58	165,638				3,837	63.58	165,638	1,049,929	42,174	
비상장	SEASA	1996.06	해외거점 확보	4,696	21,854	98	6,779				21,854	98	6,779	55,595	471	
비상장	SEDA	1994.01	해외거점 확보	13,224	77,205.7 09	87.04	647,620				77,205.7 09	87.04	647,620	5,838,533	1,449,426	
비상장	SECH	2002.12	해외거점 확보	597	0	4.1	597				0	4.1	597	445,411	14,837	
비상장	SESA	1989.01	해외거점 확보	3,276	8,021	100	142,091				8,021	100	142,091	734,838	37,303	
비상장	SENA	1992.03	해외거점 확보	392	1,000	100	69,372				1,000	100	69,372	701,024	32,492	
비상장	SEH	1991.05	해외거점 확보	1,954	753	100	650,157				753	100	650,157	1,823,278	459,848	
비상장	SEP	1982.09	해외거점 확보	204	1,751	100	37,616				1,751	100	37,616	159,301	7,254	
비상장	SEF	1991.08	해외거점 확보	230	2,700	100	234,115				2,700	100	234,115	1,262,849	79,144	
비상장	SEUK	1995.07	해외거점 확보	33,908	109,546	100	433,202				109,546	100	433,202	1,615,723	99,024	
비상장	SEHG	1982.02	해외거점 확보	28,042	0	100	354,846				0	100	354,846	711,919	130,726	
비상장	SEAG	2002.01	해외거점 확보	40	0	100	32,162				0	100	32,162	313,654	13,216	
비상장	SEI	1993.05	해외거점 확보	862	677	100	143,181				677	100	143,181	822,200	88,682	
비상장	SEBN	1995.07	해외거점 확보	236	539,138	100	914,751				539,138	100	914,751	1,484,026	64,009	
비상장	SELS	1991.05	해외거점 확보	18,314	1,306	100	24,288				1,306	100	24,288	1,927,321	6,718	
비상장	SEPOL	1996.04	해외거점 확보	5,462	106	100	78,267				106	100	78,267	528,044	43,468	
비상장	SSA	1998.12	해외거점 확보	263	2,000	100	32,622				2,000	100	32,622	496,007	11,388	
비상장	SESK	2002.06	해외거점 확보	8,976	0	55.68	263,767				0	55.68	263,767	2,019,572	100,617	
비상장	SEEH	2008.01	해외거점 확보	4,214	0	100	1,369,992				0	100	1,369,992	9,474,960	18,294	
비상장	SEO	1997.01	해외거점 확보	120	0	100	-10,043				0	100	-10,043	105,267	732	
비상장	SERC	2006.01	해외거점 확보	24,877	0	100	188,290				0	100	188,290	1,189,176	87,648	
비상장	SERK	2007.07	해외거점 확보	4,600	0	100	204,555				0	100	204,555	960,288	123,604	
비상장	SEAU	1987.11	해외거점	392	53,200	100	111,964				53,200	100	111,964	382,133	-45,978	

			확보												
비상장	SEMA	1989.09	해외거점 확보	4,378	16,247	100	103,402			16,247	100	103,402	155,377	15,028	
비상장	SGE	1995.05	해외거점 확보	827	0	100	32,836			0	100	32,836	743,222	71,314	
비상장	SEEG	2012.07	해외거점 확보	23	0	0.05	39			0	0.05	39	492,092	4,346	
비상장	SEIN	1991.08	해외거점 확보	7,463	46	99.99	118,909			46	99.99	118,909	1,562,037	77,149	
비상장	SDMA	1995.03	해외거점 확보	21,876	71,400	75	18,741			71,400	75	18,741	24,794	-458	
비상장	SIEL	1995.08	해외거점 확보	5,414	216,787	100	75,263			216,787	100	75,263	6,200,351	654,408	
비상장	SRI-B	2005.05	해외거점 확보	7,358	17	100	31,787			17	100	31,787	222,450	34,412	
비상장	SAVINA	1995.01	해외거점 확보	5,839	0	100	28,365			0	100	28,365	218,680	29,641	
비상장	TSE	1988.01	해외거점 확보	1,390	11,020	91.83	279,163			11,020	91.83	279,163	2,191,519	164,627	
비상장	STE	1996.01	해외거점 확보	4,206	2,499	49	0			2,499	49	0	6,426	0	
비상장	SME	2003.05	해외거점 확보	4,796	17,100	100	7,644			17,100	100	7,644	337,274	23,742	
비상장	SAPL	2006.07	해외거점 확보	793	877,133	100	981,483			877,133	100	981,483	6,138,652	1,293,924	
비상장	SEHK	1988.09	해외거점 확보	349	274,250	100	79,033			274,250	100	79,033	1,157,142	26,691	
비상장	SET	1994.11	해외거점 확보	456	27,270	100	112,949			27,270	100	112,949	1,447,907	35,193	
비상장	SESS	1994.12	해외거점 확보	18,875	0	100	504,313			0	100	504,313	950,691	77,856	
비상장	SCIC	1996.03	해외거점 확보	23,253	0	100	640,452			0	100	640,452	13,409,281	268,481	
비상장	SEHZ	1992.12	해외거점 확보	792	0	89.56	255,535			0	89.56	255,535	6,440,564	689,594	
비상장	SSEC	1995.04	해외거점 확보	32,128	0	69.06	130,551			0	69.06	130,551	558,610	-6,924	
비상장	TSEC	1993.04	해외거점 확보	15,064	0	48.2	138,101			0	48.2	138,101	672,687	99,195	
비상장	TSTC	2001.03	해외거점 확보	10,813	0	90	490,041			0	90	490,041	1,019,144	186,454	
비상장	SSET	2002.02	해외거점 확보	6,009	0	95	121,624			0	95	121,624	129,943	14,974	
비상장	SESC	2002.09	해외거점 확보	5,471	0	73.7	34,028			0	73.7	34,028	910,833	43,592	
비상장	SSS	2001.01	해외거점 확보	1,200	0	100	19,189			0	100	19,189	5,169,438	236,410	
비상장	SSCR	2006.09	해외거점 확보	3,405	0	100	9,332			0	100	9,332	27,417	2,689	
비상장	TSLED	2012.04	해외거점 확보	119,519	0	100	119,519			0	100	119,519	416,578	50,736	
비상장	SCS	2012.09	해외거점	111,770	0	100	4,239,680			0	100	4,239,680	8,076,107	1,359,007	

			확보												
비상장	SSCX	2016.04	해외거점 확보	1,141	0	100	1,141			0	100	1,141	796,942	40,268	
비상장	SJC	1975.12	해외거점 확보	273	1,560	100	253,108			1,560	100	253,108	934,227	2,415	
비상장	SRJ	1992.08	해외거점 확보	3,120	122	100	117,257			122	100	117,257	138,096	7,767	
비상장	TSST Japan	2004.03	사업관련	1,639	30	49.03	0			30	49.03	0	304	0	
비상장	Semiconductor Portal	2002.12	사업관련	38	0	1.21	10			0	1.21	10	1,474	52	
비상장	Nanosys	2010.08	사업관련	4,774	1,747	1.35	2,387			1,747	1.35	2,387	25,063	-2,772	
비상장	ONE BLUE LLC	2011.07	사업관련	1,766	0	16.67	1,766			0	16.67	1,766	30,714	540	
비상장	TidalScale	2013.08	사업관련	1,112	2,882	8.28	1,112			2,882	8.28	1,112	1,276	-6,584	
비상장	Sentiance	2012.12	사업관련	3,422	7	7.53	3,422			7	7.53	3,422	14,318	-6,277	
비상장	Mantis Vision	2014.01	사업관련	1,594	355	2.87	1,980			355	2.06	1,980	5,355	-5,607	
비상장	INEDA	2014.04	사업관련	3,181	6,100	2.88	5,397			6,100	2.88	5,397	12,631	-12,045	
비상장	Leman	2014.08	사업관련	1,019	17	3.38	1,019			17	3.38	1,019	2,550	-3,518	
비상장	Alces	2014.09	사업관련	4,832	421	18.5	0			421	18.5	0	928	-2,347	
비상장	Keyssa	2016.01	사업관련	3,332	1,235	2.12	3,332			1,235	2.12	3,332	18,899	-18,317	
비상장	Zyomed	2016.01	사업관련	2,044	1,464	2.88	2,044			1,464	2.88	2,044	14,891	-562	
비상장	Sensifree	2016.01	사업관련	2,111	490	17.88	2,111			490	17.88	2,111	2,000	-3,063	
비상장	Bot Home Automation	2016.03	사업관련	2,307	540	0.89	2,307			540	0.72	2,307	439,274	-154,043	
비상장	Unispectral	2016.02	사업관련	1,112	2,308	13.07	2,130			2,308	11.06	2,130	2,097	-4,084	
비상장	Quobyte	2016.04	사업관련	2,865	729	11.83	2,865			729	11.83	2,865	1,748	-2,520	
비상장	Afero	2016.05	사업관련	5,685	723	5.72	5,685			723	5.72	5,685	5,548	-13,835	
비상장	Graphcore	2016.06	사업관련	3,494	3,000	4.45	3,494			3,000	4.45	3,494	99,882	-14,592	
비상장	Soundhound	2016.12	사업관련	7,059	306	1.17	7,059			306	1.13	7,059	65,821	-22,412	
비상장	Almotive(舊 Adasworks)	2017.12	사업관련	3,302	2	3.18	3,302			2	3.18	3,302	11,124	-2,700	
합 계				17,464,104			56,643,395		58,222	18,206		56,719,823			

※ 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 지분율은 보통주 기준입니다.

※ 성원건설주와 Mantis Vision은 최근사업연도 자료의 확보가 현실적으로 곤란하여 2016년 12월 31일과 2017년 9월 30일의 재무현황을 기재하였습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등

가. 채무보증 내역

- 국내채무보증 : 해당사항 없음
- 해외채무보증

(단위 : 천US\$)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거래내역 (잔액)				채무보증한도	이자율 (%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	SMBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	1,423,000		2017-04-19
SEM (멕시코판매법인)	계열회사	Santander 외	2019-03-27	0	0	0	0	546,000		2017-06-14
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	66,939	0	23,239	43,700	168,000	6.33%	2017-06-14
SEDA (브라질생판법인)	계열회사	HSBC 외	2018-12-17	0	0	0	0	769,000		2017-06-14
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	14,639	1,920	0	16,559	178,000	2.52%	2017-06-14
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 외	2018-12-16	40,150	0	21,519	18,631	180,000	1.80%	2017-06-01
SSA (남아공판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	323,000		2017-06-14
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 외	2018-12-16	0	0	0	0	110,000		2017-11-09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BTMU 외	2018-12-16	242,345	0	50,335	192,010	755,000	13.75%	2017-06-14
SECE (카자흐판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	96,033		2017-07-20
SEEG (이집트생판법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	50,000		2017-06-14
SEIN (인도네시아생판법인)	계열회사	BNP 외	2018-11-08	0	0	0	0	186,000		2017-06-14
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 외	2018-12-16	0	0	0	0	905,519		2017-04-28
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 외	2018-12-16	0	0	0	0	150,000		2017-06-14
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	371,000		2017-06-14
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	50,000		2017-12-17
SEEH (네덜란드지주사)	계열회사	HSBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	647,000		2017-06-14

SERK (러시아생산법인)	계열회사	BNP 외	2018-12-16	0	0	0	0	245,000		2017-06-14
SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	10,000		2017-12-17
SAPL (싱가폴법인)	계열회사	BOA 외	2018-12-16	0	0	0	0	411,000		2017-06-14
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	15,000		2017-11-09
SAVINA (베트남판매법인)	계열회사	SCB 외	2018-11-08	0	0	0	0	71,000		2017-06-14
SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	30,000		2017-11-09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	350,000		2017-06-14
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	110,000		2017-11-09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	5,000		2017-12-17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	1,000		2017-12-17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	30,000		2017-11-09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	2,000		2017-06-14
SEPM (폴란드생산법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	77,419	0	7,547	69,872	125,000	2.15%	2017-06-14
Adgear (캐나다판매법인)	계열회사	BOA	2018-11-08	0	0	0	0	2,000		2017-11-09
Harman Finance International SCA	계열회사	JP Morgan 외	2022-05-27	417,900	12,652	0	430,552	430,552	2.00%	2015-05-27
합 계				859,392	14,572	102,640	771,324	8,745,105		

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며,
0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을 경영위원회에 위임하고 있습니다.

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관 계	변동금액					잔액	비고
		유가증권의 종류	매수	매도	합계	매매손익		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래목적	거래금액	처분손익
SCS	계열회사	자산매각/매입	2018.03.23	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	70,926	41,094
Innoetics E.P.E.	계열회사	자산매입	2018.03.23	매입일자	기타의무형자산	소프트웨어 개발 등	4,857	-
SESS	계열회사	자산매각/매입	2018.03.28	매각/매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	2,915	920
SEHC	계열회사	자산매각	2018.02.12	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	500	-
SEV	계열회사	자산매각	2018.02.26	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	300	45
SESK	계열회사	자산매각	2018.01.23	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	216	△163
SEVT	계열회사	자산매각	2018.03.27	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	211	22
SEHZ	계열회사	자산매입	2018.02.23	매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	195	-
TSLED	계열회사	자산매입	2018.01.03	매입일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	175	-
SEEG	계열회사	자산매각	2018.02.08	매각일자	기계장치 등	Capa증설/생산효율화 등	143	△117

※ 거래금액은 시장 및 가치평가 등을 거쳐 적절히 산정되었습니다.

[△는 부(-)의

값임]

※ 상기 자산양수도 거래는 이사회 결의 대상은 아닙니다.

※ 거래일자는 최근 거래일자 기준입니다.

당사는 2018년 1분기 중 법인 Capa 증설 등의 목적으로 자산을 SCS (Samsung China Semiconductor LLC.) 등 계열회사에 매각/매입하였으며, 국내생산 효율화를 위해 설비 등 자산을 계열회사로부터 매입하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

- 2018년 1분기 대주주와의 영업거래 중 공시대상 거래내역은 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 2018년 1분기말 현재 제품경쟁력 제고 및 상생경영을 위한 협력회사 지원 및 종업원 복리후생 목적의 주택대부, 학자금 등으로 1,297억의 대여금이 있습니다. 또한, 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대하여 2018년 1분기말 현재 62억을 한도로 채무보증을 제공하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

성 명 (법인명)	관 계	대여금 내역					비 고
		계정과목	거래내역				
			기초잔액	증가	감소	기말잔액	
세스트 외	협력업체	단기대여금	32,212	273	30	32,455	
범진아이앤디 외	협력업체 및 종업원	장기대여금	96,323	50,376	49,478	97,221	
합 계			128,535	50,649	49,508	129,676	

※ 상기 내역은 현재가치할인차금 차감후, 대손충당금 차감전 기준입니다.

2. 주주총회 의사록 요약

(2018.3.31 기준)

주총일자	안 건	결의내용
제49기 정기주주총회 (2018.3.23)	<ol style="list-style-type: none"> 제49기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건 <ol style="list-style-type: none"> 2-1호 : 사외이사 선임의 건 <ol style="list-style-type: none"> 2-1-1호 : 사외이사 김종훈 선임의 건 2-1-2호 : 사외이사 김선욱 선임의 건 2-1-3호 : 사외이사 박병국 선임의 건 2-2호 : 사내이사 선임의 건 <ol style="list-style-type: none"> 2-2-1호 : 사내이사 이상훈 선임의 건 2-2-2호 : 사내이사 김기남 선임의 건 2-2-3호 : 사내이사 김현석 선임의 건 2-2-4호 : 사내이사 고동진 선임의 건 2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이사 김선욱) 이사 보수한도 승인의 건 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건	<p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p>
제48기 정기주주총회 (2017.3.24)	<ol style="list-style-type: none"> 제48기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 이사 보수한도 승인의 건 	<p>가결</p> <p>가결</p>
제48기 임시주주총회 (2016.10.27)	<ol style="list-style-type: none"> 프린팅솔루션 사업부 분할계획서 승인의 건 사내이사 이재용 선임의 건 	<p>가결</p> <p>가결</p>
제47기 정기주주총회 (2016.3.11)	<ol style="list-style-type: none"> 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건 <ol style="list-style-type: none"> 2-1호 : 사외이사 선임의 건 <ol style="list-style-type: none"> 2-1-1호 : 사외이사 이인호 선임의 건 2-1-2호 : 사외이사 송광수 선임의 건 2-1-3호 : 사외이사 박재완 선임의 건 2-2호 : 사내이사 선임의 건 <ol style="list-style-type: none"> 2-2-1호 : 사내이사 윤부근 선임의 건 2-2-2호 : 사내이사 신종균 선임의 건 2-2-3호 : 사내이사 이상훈 선임의 건 2-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 <ol style="list-style-type: none"> 2-3-1호 : 감사위원회 위원 이인호 선임의 건 2-3-2호 : 감사위원회 위원 송광수 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 정관 일부 변경의 건 	<p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p> <p>가결</p>

3. 중요한 소송사건

(1) Apple사

① 1차 소송

구분	내용
소제기일	2011년 4월 15일
소송 당사자	원고 : Apple사(Apple Inc.), 피고 : 당사(SEC, SEA, STA)
소송의 내용	Apple사 트레이드 드레스, 실용 특허, 디자인 특허 관련 침해금지 및 손해배상청구
진행현황	<p>2012년 8월 24일 미국 캘리포니아 법원에서 디자인 및 기술특허에 대해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 판결이 있었습니다. 그 후 2013년 3월 1일 동 법원의 판사는 손해액 중 일부 금액이 잘못 산정되었기 때문에 동 일부 금액에 대해 새로운 재판을 하도록 결정하였습니다. 그에 따라 2013년 11월 21일 손해액 관련 배심원 판결이 있었으며, 2014년 3월 6일 Apple사의 당사 제품 판매 금지 주장을 기각하고 손해배상액은 배심원 판결 금액으로 하는 1심 판결이 선고되었습니다. 이 중 손해배상 관련 판결에 대해서 2014년 3월 7일 항소를 하여, 2014년 12월 4일 항소심 재판이 진행되었습니다. 2015년 5월 18일 항소심 법원은 2심 판결을 선고하면서 1심 판결 중 일부 판결은 파기 환송하고 일부 판결은 유지하였습니다. 당사는 유지된 일부 판결 중 디자인 침해와 관련하여 2015년 6월 17일 전원합의체 재심리 신청을 하였으나, 2015년 8월 13일 재심리 신청은 불허되었습니다. 이후 1심 법원에서 환송심 절차가 진행되었으며, 2015년 9월 18일 1심 법원은 항소심에서 유지된 일부 판결에 대한 최종판결을 선고하였습니다. 당사는 다시 항소하였으나, 2015년 10월 13일 항소가 기각되었고, 2015년 11월 19일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다.</p> <p>당사는 2015년 12월 11일 일부 판결의 손해액을 Apple사에 지불하였고, 2015년 12월 14일 대법원에 디자인 관련 상고를 제기하였습니다. 이후 일부 판결 관련 부수적 손해 등에 대한 양사 서면이 1심 법원에 제출되었습니다. 2016년 3월 21일 대법원은 당사가 제기한 디자인 관련 상고를 허가하였고, 2016년 3월 22일 1심 법원은 2016년 3월 28일 시작 예정이었던 손해액 재재판을 포함하여 환송심의 모든 절차를 대법원 상고심 판결 시까지 정지하였습니다. 당사는 디자인 관련 상고심에서 2016년 6월 1일 본안 서면을 제출하였고, 2016년 6월 8일 여러 회사 및 단체 등이 당사 지지 서면을 제출하였습니다. Apple사는 2016년 7월 29일 반대 서면을 상고심에 제출하였고, 2016년 8월 5일 여러 회사 및 단체 등이 Apple사 지지 서면을 제출하였습니다. 당사는 2016년 8월 29일 반박 서면을 상고심에 제출하였습니다. 관련 상고심 구두변론은 2016년 10월 11일 대법원에서 진행되었습니다.</p> <p>2016년 12월 6일 대법원은 당사 상고를 인용하는 판결을 내리고 사건을 항소심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 2월 7일 항소심 법원은 사건을 1심 법원으로 환송하였습니다. 2017년 10월 12일 1심 법원은 디자인 관련 재재판 필요성에 대한 심리를 진행한 후 2017년 10월 22일 디자인 관련 재재판 진행 결정을 내렸습니다. 2018년 5월 14일부터 18일 1심 법원은 디자인 손해액을 재산정하는 재재판을 진행할 예정입니다.</p>
향후 소송일정	디자인 관련 재재판(2018년 5월)
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	Apple사와의 특허 관련 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없습니다.

② 2차 소송

구 분	내 용
소제기일	2012년 2월 8일
소송 당사자	원고 : Apple사(Apple Inc.), 피고 : 당사(SEC, SEA, STA)
소송의 내용	Apple사 특허 관련 침해금지 및 손해배상청구
진행현황	2014년 5월 5일 미국 캘리포니아 법원에서 기술특허 관련한 두 번째 소송과 관련해 당사의 일부 침해를 인정하고 그에 따른 손해액을 지불해야 한다는 판결이 있었으며, 2014년 11월 25일 배심원 판결을 확인하는 1심 법원의 판결이 선고되었습니다. 당사는 2014년 11월 25일 1심 판결에 대해 항소하였으며, 2016년 1월 5일 항소심 구두변론이 진행되었습니다. 별도로, 2014년 8월 27일 1심 법원은 Apple사의 판매금지청구를 기각하였으나, 항소법원은 2015년 9월 17일 1심 판단을 파기 환송하는 판결을 선고하였고, 2015년 12월 16일 전원합의체 재심리 신청도 기각되었습니다. 2016년 1월 18일 1심 법원은 판매금지결정을 내렸습니다. 2016년 2월 26일 항소심 재판부는 2014년 11월 25일 선고된 1심 판결을 반복하여 Apple사의 기술특허 관련하여 비침해 또는 무효를 판단하고 손해액을 파기하는 판결을 선고하였습니다. 2016년 3월 30일 Apple사는 항소심 재판부 판결에 대해 재심리 신청을 하였습니다. 2016년 10월 7일 항소심 전원합의체는 항소심 재판부 판결을 다시 반복하여, Apple사의 기술특허 관련하여 침해 및 유효를 판단하고 손해액 판결을 내렸습니다. 2017년 3월 10일 당사는 항소심 전원합의체 판결에 불복하여 대법원에 상고하였습니다. 2017년 10월 4일 미국 법무부는 당사 상고에 반대하는 법정조언서를 대법원에 제출하였습니다. 2017년 11월 6일 대법원은 당사 상고를 기각하였습니다. 2018년 1월 11일 1심 법원은 추가 손해액 인정 여부에 대한 심리를 진행하였습니다. 2018년 2월 15일 1심 법원은 당사 회피설계를 받아들여 추가 손해액 중 일부만 인정하였습니다.
향후 소송일정	당사는 Apple사에게 2018년 5월 중 손해액 지급 예정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	당사가 Apple사에게 손해액 지급 후 절차 종료

(2) TFT-LCD 판매 관련

① Iiyama社 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2014년 12월 19일
소송 당사자	원고 : Mouse Computer社, 유럽內 Iiyama 5개社 피고 : 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	피고 英대법원에 상고 신청
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

② 영국 정부기관 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2015년 11월 4일
소송 당사자	원고 : 영국 42개 정부기관 피고 : 삼성전자 및 해외 판매 자회사
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대한 영국 정부기관 클레임
진행상황	소장 송달 완료
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

③ 이스라엘LCD 반독점 민사소송

구 분	내 용
소제기일	2013년 11월 26일
소송 당사자	원고 : Hatzlacha 피고 : 삼성전자 및 기타 LCD업체
소송의 내용	피고들의 LCD 담합에 대해 손해배상을 청구
진행상황	소장 송달 대기 중
향후 일정 및 전망	재판시기 미확정
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	소송에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하나, 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.

(3) 이외에도 다수의 회사와 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 채무보증내역

- 국내채무보증

2018년 1분기말 직원용 임대주택 제공과 관련한 직원들의 금융기관 대출금에 대한 채무보증 약정 한도는 40,732백만원이며, 잔액은 26,918백만원입니다.

- 해외채무보증

(단위 : 천US\$)

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거래내역(잔액)				채무보증한도	이자율(%)	보증시작일
				기초	증가	감소	기말			
SEA (미주총괄법인)	계열회사	SMBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	1,423,000		2017-04-19
SEM (멕시코판매법인)	계열회사	Santander 외	2019-03-27	0	0	0	0	546,000		2017-06-14
SAMCOL (콜롬비아판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	66,939	0	23,239	43,700	168,000	6.33%	2017-06-14
SEDA (브라질생산법인)	계열회사	HSBC 외	2018-12-17	0	0	0	0	769,000		2017-06-14
SECH (칠레판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	14,639	1,920	0	16,559	178,000	2.52%	2017-06-14
SEPR (페루판매법인)	계열회사	BBVA 외	2018-12-16	40,150	0	21,519	18,631	180,000	1.80%	2017-06-01
SSA (남아공판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	323,000		2017-06-14
SEMAG (모로코판매법인)	계열회사	SocGen 외	2018-12-16	0	0	0	0	110,000		2017-11-09
SETK (터키판매법인)	계열회사	BTMU 외	2018-12-16	242,345	0	50,335	192,010	755,000	13.75%	2017-06-14
SECE (카자흐판매법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	96,033		2017-07-20
SEEG (이집트생산법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	50,000		2017-06-14
SEIN (인도네시아생산법인)	계열회사	BNP 외	2018-11-08	0	0	0	0	186,000		2017-06-14
SJC (일본판매법인)	계열회사	Mizuho Bank 외	2018-12-16	0	0	0	0	905,519		2017-04-28
SEUC (우크라이나판매법인)	계열회사	Credit Agricole 외	2018-12-16	0	0	0	0	150,000		2017-06-14
SEDAM (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank 외	2018-12-16	0	0	0	0	371,000		2017-06-14
SELA (파나마판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	50,000		2017-12-17
SEEH (네덜란드지사)	계열회사	HSBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	647,000		2017-06-14
SERK (러시아생산법인)	계열회사	BNP 외	2018-12-16	0	0	0	0	245,000		2017-06-14

SELV (요르단판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	10,000		2017-12-17
SAPL (싱가폴법인)	계열회사	BOA 외	2018-12-16	0	0	0	0	411,000		2017-06-14
SEV (베트남생산법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	15,000		2017-11-09
SAVINA (베트남판매법인)	계열회사	SCB 외	2018-11-08	0	0	0	0	71,000		2017-06-14
SET (대만판매법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	30,000		2017-11-09
SCIC (중국법인)	계열회사	HSBC 외	2018-12-16	0	0	0	0	350,000		2017-06-14
SME (말레이시아판매법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	110,000		2017-11-09
SAMEX (멕시코생산법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	5,000		2017-12-17
SEASA (아르헨티나판매법인)	계열회사	Citibank	2018-12-16	0	0	0	0	1,000		2017-12-17
SSAP (남아공생산법인)	계열회사	SCB	2018-11-08	0	0	0	0	30,000		2017-11-09
SEHK (홍콩판매법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	0	0	0	0	2,000		2017-06-14
SEPM (폴란드생산법인)	계열회사	HSBC	2018-06-13	77,419	0	7,547	69,872	125,000	2.15%	2017-06-14
Adgear (캐나다판매법인)	계열회사	BOA	2018-11-08	0	0	0	0	2,000		2017-11-09
Harman Finance International SCA	계열회사	JP Morgan 외	2022-05-27	417,900	12,652	0	430,552	430,552	2.00%	2015-05-27
합 계				859,392	14,572	102,640	771,324	8,745,105		

※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 2.5% 이상일 경우 이사회 의결후 집행되며,
0.1% 이상 2.5% 미만인 경우 그 결정을 경영위원회에 위임하고 있습니다.

5. 제재현황 등 그 밖의 사항

당사는 2016년 12월 5일부터 12월 9일까지 진행된 고용노동부 PSM 이행상태점검 등과 관련하여 2016년 12월 14일 산업안전보건법 49조의2 7항(공정안전보고서 제출) 등 위반으로 352만원의 과태료를 부과받아 자진 납부완료하였습니다. 당사는 현장 공정안전 전문가를 육성하고 공정안전 자체평가를 실시하여 관련 법규 준수를 위해 노력하고 있습니다.

'박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사'는 2017년 2월 28일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 등의 혐의로 당사 임원 5명(이재용 부회장, 최지성 前부회장, 장충기 前사장, 박상진 前사장, 황성수 前전무)을 기소 하였습니다.

서울중앙지방법원은 2017년 8월 25일 위 혐의를 일부 인정하여 이재용 부회장 징역 5년, 최지성 前부회장 징역 4년, 장충기 前사장 징역 4년, 박상진 前사장 징역 3년 및 집행유예 5년, 황성수 前전무 징역 2년 6개월 및 집행유예 4년을 선고하였습니다.

서울고등법원은 2018년 2월 5일 제1심 판결을 파기하고, 이재용 부회장에 대하여는 집행유예 4년, 최지성 前부회장 및 장충기 前사장, 박상진 前사장, 황성수 前전무에 대하여는 집행유예 2년을 선고하였습니다.

이 사건은 현재 상고심 재판이 진행 중으로, 당사는 향후 진행 상황을 확인할 예정입니다.

당사는 에스케이브로드밴드(주)가 2009년 5월 및 2010년 11월 실시한 광케이블 구매입찰과 관련하여 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(부당한 공동행위의 금지) 위반으로 2018년 2월 6일 시정명령 및 과징금(520백만원) 부과 처분을 받아 납부하였습니다. 당사는 공정거래 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에게 불공정거래 예방교육을 시행하고 있습니다.

당사(삼성디스플레이 포함)는 삼성디스플레이 주식회사의 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

당사(삼성디스플레이 포함)는 2013년 10월 23일 Corning Incorporated 등과 포괄적 사업 협력에 대한 기본계약을 체결하였습니다. 동 계약은 상호 간의 손실보전 조건을 포함하고 있어 향후 자원의 유입 또는 유출이 있을 수 있으며, 보고기간종료일 현재 지급이 예상되는 금액을 부채로 계상하였습니다.

그 밖의 우발부채 및 약정사항에 대해서는 연결재무제표 및 재무제표의 우발부채와 약정사항 주석을 참조하시기 바랍니다.

6. 단기매매차익 미환수 현황

당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

7. 대외후원 현황

현황	금액	내용	비고
2017년사회공헌기금 운영 계획	125.9억원	- 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2017년 회사매칭기금으로 125.9억원 운영 계획 - 동 기금은 국내외 봉사활동 지원 및 지역 사회공헌 활동 등에 사용 예정	2017.3.24 이사회 의결
국제기능올림픽 후원	135만 유로 (약16.3억원)	- 제 44회 UAE 아부다비 국제기능올림픽대회 최상위 스폰서 후원 및 2017~2018년 국제기능올림픽위원회 (WorldSkills International) 후원	
호암재단 기부금 출연	40억원	- '호암상' 시상 등 재단사업 지원을 위한 출연	2017.4.27 이사회 의결
언론재단 기부금 출연	17억원	- '삼성언론상' 운영 등 언론 발전 사업을 지원하기 위한 출연	
삼성복지재단 기부금 출연	240억원	- 저소득층 중학생 학습지원	
삼성생명공익재단 기부금 출연	377억원	- 삼성의료원 운영 지원 등	
성균관대학 기부금 출연	150억원	- 삼성장학금 지원 등	
전국재해구호협회 출연	30억원	- 포항지역 지진피해 복구와 피해주민을 돕기 위한 출연	2017.11.24 이사회 의결
사회복지공동모금회 출연	201억원	- 연말 이웃돕기 성금모금 참여로 소외계층을 돕고 기업의 사회적 책임을 다하고자 출연	
2018년 사회공헌기금 운영 계획	122.1억원	- 당사 사회공헌기금은 임직원기부금과 회사매칭기금으로 구성되며, 2018년 회사매칭기금으로 122.1억원 운영 계획 - 동 기금은 국내외 봉사활동 지원 및 지역 사회공헌 활동 등에 사용 예정	2018.01.31 이사회 의결
삼성공장학재단 기부금 출연	11.2억원	- 저소득층 고등학생 학습지원	
학교법인 충남삼성학원 기부금 출연	27.42억원	- 지역 교육 환경 개선 도모	2018.02.23 이사회 의결
창업 80주년 기념 전자제품 기부	약 75억원	- 창업 80주년 기념 사회복지시설에 당사 전자제품 기부 - 기부처 : 1,500여개 사회복지시설	2018.03.23 이사회 의결

8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 2018년 1월 31일 이사회 결의 및 2018년 3월 23일 주주총회 결의로 발행할 주식의 총수는 25,000,000,000주(1주의 금액 : 100원)로, 발행한 보통주식 및 우선주식의 수는 각각 6,419,324,700주 및 903,629,000주로 변경되었으며, 작성기준일 이후 상법 제329조의 2에 따라 구주권제출의 공고기간이 만료된 때인 2018년 5월 3일에 주식분할의 효력이 발생하고 2018년 5월 4일 주식분할로 인한 주권 변경상장 등 절차가 진행되었습니다.

구분	구분		분할 전	분할 후
	1. 주식분할 내용	1주당 가액(원)		5,000
발행주식총수	보통주식(주)		128,386,494	6,419,324,700
	종류주식(주)		18,072,580	903,629,000
2. 주식분할 일정	주주총회일		2018.03.23	
	구주권제출기간	시작일	2018.03.26	
		종료일	2018.05.02	
	매매거래정지기간		2018.04.30, 05.02, 05.03 (3영업일, 05.01:증시 휴장일)	
	명의개서정지기간	시작일	2018.05.03	
		종료일	2018.05.10	
신주권상장일		2018.05.04		

9. 합병 등의 사후 정보

[프린팅솔루션 사업부문]

(1) 분할 내역

- 회사명 : 에스프린팅솔루션 주식회사
- 소재지 : 경기도 수원시 영통구 삼성로 129
- 대표이사 : 김기호
- 분할방법 : 물적분할(분할후 에스프린팅솔루션 주식회사 신설)
- 분할목적 : 프린팅솔루션 사업의 경쟁력 강화
- 분할승인 : 2016년 10월 27일(임시주주총회 결의)
- 분할기일 : 2016년 11월 1일

(2) 양도 내역

당사는 2016년 9월 12일 HP Inc.에게 에스프린팅솔루션 주식회사 지분을 포함한 프린팅솔루션 사업 부문을 US\$ 1,050,000천에 포괄적으로 양도하는 기본양수도 계약을 체결하였으며, 양도 거래가 2017년 11월 1일 종결되었습니다.

상기 분할 및 양도 거래에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 (<http://dart.fss.or.kr/>) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

그 밖의 주요한 사업결합 등의 내용은 연결재무제표 및 재무제표의 사업결합 주석 등을 참조하시기 바랍니다.

10. 녹색경영

당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '녹색기술 인증' 취득을 확대하고 있습니다.

(녹색기술 인증)

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제32조 제2항에 따라 '녹색기술 인증'을 취득하고 있습니다. 당사의 녹색기술 개발은 사람과 자연을 존중하는 기업활동을 목표로 하는 플래닛퍼스트(PlanetFirst) 전략으로 친환경 제품 개발과 보급 확대에 주력한 결과로서 인증 제도가 시작된 2010년 이래 2018년 1분기말 현재 총 18건의 유효 녹색기술 인증을 확보하고 있습니다. 또한 인증을 받은 녹색기술이 적용된 상용화제품에 대해 부여하는 '녹색기술제품 확인' 인증을 총 76건(634모델) 취득하였습니다.

2018년 1분기말 현재 인증취득 녹색기술은 아래 표와 같습니다.

부문	녹색기술 명칭	건수	비고
CE	Digital TV용 저전력 SoC설계 기술 등	15	
IM	칩셋 동작 모드 제어 기술을 이용한 PC 절전 기능 구현 소프트웨어 기술 등	3	
합 계		18	

※ 별도기준으로 작성되었습니다.

온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 'II. 사업의 내용'의 '11. 그 밖에 투자이사 결정에 필요한 사항(나. 환경관련 규제사항)'을 참조하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계